

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定



## 成都莱普科技股份有限公司

(成都高新区康强三路 179 号)

### 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 (申报稿)

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

#### 保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

## 发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 致投资者声明

### 一、发行人上市的目的

莱普科技以先进精密激光技术及半导体创新工艺开发为核心，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。公司主要产品包括激光热处理设备与专用激光加工设备两大序列，已广泛应用于 12 英寸集成电路产线、先进封装产线，是国内少数同时为半导体前、后道工序提供前沿激光工艺设备的厂商。莱普科技始终以用户需求为牵引，立足于自主创新，面向半导体产业有针对性地开展先进精密激光技术、创新工艺和设备的研发工作，并延伸布局至精密电子及 MLED 等产业。莱普科技现已适配国内半导体产业技术特征开发了多款原创性产品，并推出多款对标国际一流水平的半导体专用激光工艺设备，打破国际厂商在国内市场长期垄断局面。报告期内，公司相关设备已部署于客户 A、客户 B、客户 C、华润微、士兰微、三安半导体、中车时代、客户 D、华天科技、达迩科技等主流半导体厂商的先进制程和先进封装产线，并成功应用于先进制程 3D NAND Flash 存储芯片、先进制程 DRAM 存储芯片、28nm 及以下先进制程逻辑芯片、SiC 功率芯片、沟槽栅型 IGBT 功率芯片、先进电源管理芯片、BSI-CCD 芯片量产，以及国产 HBM 芯片工艺研发等前沿应用场景。

通过本次上市，公司可加大技术创新投入、完善产品矩阵，提升行业竞争优势，持续增强盈利能力，并加强团队能力建设、完善公司治理水平，为股东和行业持续创造价值。

### 二、发行人现代企业制度的建立健全情况

莱普科技建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法规、规章制度的要求，建立了完善的法人治理结构。公司股东会、董事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益、保持股利分配政策的持续性和稳定性、提高股东对公司经营和分配的监督、稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。

### 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金将投资于晶圆制造设备开发与制造中心项目，先进封装设

备开发与制造中心项目，研发中心及信息化建设项目，研发、技术支持与营销网络建设项目和补充流动资金。公司募集资金围绕公司的主营业务展开，聚焦国家战略和重大需求，进一步加大研发创新投入，进一步完善产业链和产品结构，增强公司产品和技术的竞争力。

#### 四、发行人持续经营能力及未来发展规划

公司长期致力于以科技创新助力国家半导体产业发展，已确立了“激光热处理设备和专用激光加工设备”双引擎可持续发展的战略。2022-2024年，公司营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元和 28,102.42 万元，净利润分别为 -938.22 万元、2,279.87 万元和 5,491.16 万元，公司业绩持续快速增长，盈利能力稳步增强。公司将以本次发行上市为契机，通过实施募集资金投资项目，不断巩固和增强公司的市场地位，进一步提升盈利能力。

未来，公司将继续以先进精密激光技术为核心，保持高强度研发投入，以提升公司技术水平，丰富产品序列，并积极开拓市场，扩大服务对象群体，提高市场占有率，丰富下游应用领域，以自主研发的先进精密激光技术保障国家半导体产业链安全与稳定。

董事长签字：



叶向明

成都莱普科技股份有限公司

2026年3月18日



## 本次发行概览

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行股票类型                | 人民币普通股（A 股）                                                                                |
| 发行股数、股东公开发售股数（如有）     | 本次发行股份全部为新股，原股东不公开发售股份。<br>本次拟公开发行股票数量不超过 1,606.00 万股，且不低于发行后公司总股本的 25%。                   |
| 每股面值                  | 人民币 1.00 元                                                                                 |
| 每股发行价格                | 人民币【】元                                                                                     |
| 预计发行日期                | 【】年【】月【】日                                                                                  |
| 拟上市的证券交易所和板块          | 上海证券交易所科创板                                                                                 |
| 发行后总股本                | 不超过 6,424.00 万股                                                                            |
| 保荐人（主承销商）             | 中信建投证券股份有限公司                                                                               |
| 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 | 若公司决定实施高管及员工战略配售，则将在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项具体方案，并依法进行披露。                               |
| 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况     | 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。 |
| 招股说明书签署日期             | 【】年【】月【】日                                                                                  |

## 目 录

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>第一节 释义 .....</b>                      | <b>9</b>  |
| 一、常用词语 .....                             | 9         |
| 二、专业术语 .....                             | 13        |
| <b>第二节 概览 .....</b>                      | <b>17</b> |
| 一、重大事项提示 .....                           | 17        |
| 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .....                | 21        |
| 三、本次发行概况 .....                           | 22        |
| 四、发行人主营业务情况 .....                        | 23        |
| 五、发行人符合科创板定位的说明 .....                    | 25        |
| 六、主要财务数据和财务指标 .....                      | 25        |
| 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 .....           | 26        |
| 八、发行人选择的具体上市标准 .....                     | 31        |
| 九、公司治理特殊安排等重要事项 .....                    | 31        |
| 十、募集资金运用与未来发展规划 .....                    | 31        |
| 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .....                  | 34        |
| <b>第三节 风险因素 .....</b>                    | <b>35</b> |
| 一、与发行人相关的风险 .....                        | 35        |
| 二、与行业相关的风险 .....                         | 41        |
| 三、其他风险 .....                             | 42        |
| <b>第四节 发行人基本情况 .....</b>                 | <b>48</b> |
| 一、发行人基本情况 .....                          | 48        |
| 二、发行人设立情况 .....                          | 48        |
| 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 .....                | 52        |
| 四、发行人成立以来重要事件 .....                      | 59        |
| 五、发行人在其他证券市场的挂牌情况 .....                  | 59        |
| 六、发行人股权结构 .....                          | 59        |
| 七、发行人子公司及参股公司的情况 .....                   | 59        |
| 八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..... |           |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| .....                                    | 60         |
| 九、发行人特别表决权股份情况.....                      | 68         |
| 十、发行人协议控制架构情况.....                       | 68         |
| 十一、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.....      | 68         |
| 十二、发行人股本情况.....                          | 68         |
| 十三、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况..... | 79         |
| 十四、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.....          | 95         |
| 十五、发行人员工情况.....                          | 101        |
| <b>第五节 业务与技术 .....</b>                   | <b>101</b> |
| 一、发行人的主营业务、主要产品或服务基本情况.....              | 104        |
| 二、发行人所属行业基本情况.....                       | 120        |
| 三、发行人所属行业竞争格局.....                       | 153        |
| 四、发行人的销售情况和主要客户.....                     | 168        |
| 五、发行人的采购情况和主要供应商.....                    | 171        |
| 六、发行人的主要资产情况.....                        | 171        |
| 七、发行人核心技术及研发情况.....                      | 177        |
| 八、发行人生产经营涉及的环境污染及处理情况.....               | 191        |
| 九、发行人的境外经营情况.....                        | 193        |
| <b>第六节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>            | <b>194</b> |
| 一、财务会计信息.....                            | 194        |
| 二、重要会计政策及会计估计.....                       | 202        |
| 三、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.....                | 221        |
| 四、主要税项.....                              | 222        |
| 五、主要财务指标.....                            | 224        |
| 六、经营成果分析.....                            | 226        |
| 七、资产质量分析.....                            | 255        |
| 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....                 | 277        |
| 九、重大投资、资本性支出及重大资产业务重组或股权收购合并事项.....      | 291        |
| 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....             | 291        |



|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 十一、审计截止日后的主要经营情况.....                                        | 292        |
| 十二、盈利预测.....                                                 | 296        |
| <b>第七节 募集资金运用与未来发展规划 .....</b>                               | <b>297</b> |
| 一、募集资金运用概况.....                                              | 297        |
| 二、募投项目可行性及与发行人主要业务、核心技术的关系.....                              | 300        |
| 三、未来发展与规划.....                                               | 303        |
| <b>第八节 公司治理与独立性 .....</b>                                    | <b>306</b> |
| 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.....                                 | 306        |
| 二、内部控制情况.....                                                | 306        |
| 三、发行人报告期内违法违规行及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.....               | 310        |
| 四、报告期内资金被实际控制人及其控制企业占用或者为实际控制人及其控制企业担保的情况.....               | 310        |
| 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力情况.....                                  | 310        |
| 六、发行人同业竞争情况.....                                             | 312        |
| 七、关联方与关联交易情况.....                                            | 315        |
| <b>第九节 投资者保护 .....</b>                                       | <b>328</b> |
| 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序.....                             | 331        |
| 二、本次股利分配政策.....                                              | 331        |
| 三、发行人上市后三年内分红回报规划.....                                       | 332        |
| 四、长期回报规划的内容及制定考虑因素.....                                      | 335        |
| 五、本次发行前后股利分配政策的差异情况.....                                     | 335        |
| 六、发行人存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的保护投资者合法权益措施..... | 336        |
| <b>第十节 其他重要事项 .....</b>                                      | <b>337</b> |
| 一、重大合同情况.....                                                | 337        |
| 二、对外担保情况.....                                                | 339        |
| 三、重大诉讼或仲裁事项.....                                             | 339        |
| <b>第十一节 声明 .....</b>                                         | <b>340</b> |
| 一、发行人全体董事、审计委员会、高级管理人员声明.....                                | 340        |



|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 二、发行人控股股东、实际控制人声明.....                    | 343        |
| 三、保荐人（主承销商）声明.....                        | 345        |
| 四、发行人律师声明.....                            | 347        |
| 五、审计机构声明.....                             | 348        |
| 六、资产评估机构声明.....                           | 349        |
| 七、验资复核机构声明.....                           | 352        |
| <b>第十二节 附件 .....</b>                      | <b>353</b> |
| 一、备查文件.....                               | 353        |
| 二、查阅时间和地点.....                            | 353        |
| 附件一、发行人已获授权专利情况.....                      | 355        |
| 附件二、发行人软件著作权情况.....                       | 360        |
| 附件三、与投资者保护相关的承诺.....                      | 363        |
| 附件四、股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明..... | 379        |
| 附件五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....             | 381        |
| 附件六、募集资金具体运用情况.....                       | 382        |

## 第一节 释义

在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：

### 一、常用词语

|                    |   |                                       |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| 发行人/公司/本公司/莱普科技    | 指 | 成都莱普科技股份有限公司                          |
| 莱普有限               | 指 | 成都莱普科技有限公司，发行人前身                      |
| 本次发行               | 指 | 发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市             |
| 保荐人/保荐机构/主承销商/中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司                          |
| 致同会计师/发行人会计师       | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）                      |
| 发行人律师              | 指 | 北京市康达律师事务所                            |
| 东骏激光有限             | 指 | 成都东骏激光有限责任公司，成都东骏激光股份有限公司的前身          |
| 东骏激光               | 指 | 成都东骏激光股份有限公司，发行人原控股股东，发行人实际控制人控制的其他企业 |
| 东骏投资               | 指 | 东莞市东骏投资有限公司，发行人控股股东                   |
| 东莞莱普               | 指 | 东莞市莱普管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台         |
| 东莞聚慧               | 指 | 东莞市聚慧股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东             |
| 东莞骏峰               | 指 | 东莞骏峰管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台          |
| 东莞天戈               | 指 | 东莞市天戈管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东             |
| 东莞普英               | 指 | 东莞市普英管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东             |
| 厦门石普               | 指 | 厦门石普投资合伙企业（有限合伙），发行人股东                |
| 广州山立               | 指 | 广州山立企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东              |
| 青岛琮碧               | 指 | 青岛琮碧佳石创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东          |
| 全德学镭科芯             | 指 | 全德学镭科芯创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙），发行人股东      |
| 华西金智               | 指 | 成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东        |
| 鼎创一号               | 指 | 株洲时代鼎创一号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东          |
| 泰达恒鼎               | 指 | 天津泰达恒鼎创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东            |
| 青岛勤芯               | 指 | 青岛勤芯股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东              |
| 全德学四专芯             | 指 | 全德学四专芯创业投资（平潭）合伙企业（有限合伙），发行人股东        |
| 西藏芯前沿              | 指 | 西藏芯前沿企业管理有限公司，发行人股东                   |
| 鼎创二号               | 指 | 株洲时代鼎创二号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东          |

|            |   |                                                                                   |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 金智莱鑫       | 指 | 共青城金智莱鑫投资合伙企业（有限合伙），发行人股东                                                         |
| 成都高投       | 指 | 成都高投电子信息产业集团有限公司，发行人股东                                                            |
| 浦东海望       | 指 | 上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙），发行人股东                                                  |
| 上海浦宸       | 指 | 上海浦宸私募投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东                                                        |
| 无锡国联       | 指 | 无锡国联洋泽创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东                                                        |
| 淄博君恒       | 指 | 淄博君恒华川三号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东                                                      |
| 蓉创投资       | 指 | 蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东                                                        |
| 国家集成电路基金二期 | 指 | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，发行人股东                                                        |
| 长存产投       | 指 | 长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙），发行人股东                                                      |
| 余姚石溪       | 指 | 余姚石溪舜创创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东                                                        |
| 江苏莱普       | 指 | 江苏莱普激光技术有限公司，发行人控股子公司                                                             |
| 深圳分公司      | 指 | 成都莱普科技股份有限公司深圳分公司                                                                 |
| 佰维存储       | 指 | 深圳佰维存储科技股份有限公司，A 股科创板上市公司，证券代码 688525.SH                                          |
| 东骏集团       | 指 | 东莞市东骏集团有限公司                                                                       |
| 骏铭佳创       | 指 | 成都骏铭佳创科技有限责任公司，成都东骏激光股份有限公司子公司                                                    |
| 华润微        | 指 | 华润微电子有限公司，A 股科创板上市公司，证券代码 688396.SH                                               |
| 士兰微        | 指 | 杭州士兰微电子股份有限公司，A 股主板上市公司，证券代码 600460.SH                                            |
| 三安半导体      | 指 | 三安光电股份有限公司，A 股主板上市公司，证券代码 600703.SH                                               |
| 中车时代       | 指 | 株洲中车时代电气股份有限公司，A 股科创板上市公司，证券代码 688187.SH                                          |
| 华天科技       | 指 | 天水华天科技股份有限公司，A 股主板上市公司，证券代码 002185.SZ                                             |
| 长电科技       | 指 | 江苏长电科技股份有限公司，A 股主板上市公司，证券代码 600584.SH                                             |
| 达迩科技       | 指 | Diodes Incorporated，纳斯达克上市公司，证券代码 DIOD.O                                          |
| 比亚迪半导体     | 指 | 比亚迪半导体股份有限公司                                                                      |
| 捷捷微电       | 指 | 江苏捷捷微电子股份有限公司，A 股创业板上市公司，证券代码 300623.SZ                                           |
| 晶合集成       | 指 | 合肥晶合集成电路股份有限公司                                                                    |
| 华虹公司       | 指 | 上海华虹（集团）有限公司                                                                      |
| 安世半导体      | 指 | 安世半导体（中国）有限公司                                                                     |
| 盛合晶微       | 指 | 盛合晶微半导体（江阴）有限公司                                                                   |
| 江波龙        | 指 | 深圳市江波龙电子股份有限公司                                                                    |
| 应用材料       | 指 | 总部位于美国硅谷，股票代码为 AMAT.O。该公司主要提供半导体晶圆薄膜沉积设备、半导体薄片装配、蚀刻及离子注入设备和单芯片处理等半导体设备（含激光热处理设备）。 |

|       |   |                                                                                                     |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 维易科   | 指 | 总部位于美国纽约州，股票代码为 VECO.O。该公司主要提供离子束、激光退火、MOCVD、CVD、先进封装光刻、单晶圆湿法加工、MBE 和 ALD 技术及其解决方案。                 |
| 住友重工  | 指 | 总部位于日本东京，股票代码为 6302.T。该公司的精密机械部门提供塑料加工机械、激光加工机械、低温冰箱、精密定位、放射线设备、超精密机床 NC 化及改装等通用机械设备。               |
| 迪恩士   | 指 | 总部位于日本京都，股票代码为 7735.T。该公司主要从事半导体设备的制造和销售，业务部门包括半导体设备部门（含激光热处理设备）、图形和精密解决方案部门、精细技术解决方案部门和其他部门。       |
| DIT   | 指 | 总部位于韩国京畿道，股票代码为 110990.KS。该公司主要提供 AOI 解决方案、激光解决方案及其他。                                               |
| 上海微电子 | 指 | 上海微电子装备（集团）股份有限公司，总部位于中国上海。该公司致力于半导体装备、泛半导体装备以及高端智能装备等半导体设备（含激光热处理设备）的开发、设计、制造及技术服务。                |
| 华卓精科  | 指 | 北京华卓精科科技股份有限公司，总部位于中国北京，提供超精密运动平台、激光退火设备、晶圆键合设备、晶圆传输系统、主被动隔振器、静电卡盘、精密测量系统等整机设备，并进行半导体关键零部件的研发与制造。   |
| 迪思科   | 指 | 总部位于日本东京，股票代码为 6146.T。该公司主要提供切割锯，激光锯、磨床、抛光机、干蚀刻机、表面刨床、切割刀片、砂轮和干抛光轮等半导体制造设备，同时提供精密加工工具的相关服务。         |
| 伊欧激光  | 指 | 总部位于韩国京畿道，股票代码为 039030.KS。该公司主要从事半导体激光打标机和激光应用设备的制造和分销。                                             |
| ASMPT | 指 | 总部位于新加坡，股票代码为 0522.HK。该公司是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商，业务涵盖高精度之激光二极管焊机。                              |
| 联动科技  | 指 | 总部位于中国广东，股票代码为 301369.SZ。该公司主要提供半导体行业后道封装测试领域专用设备，包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。                    |
| 德龙激光  | 指 | 总部位于中国江苏，股票代码为 688170.SH。该公司主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。                                  |
| 大族激光  | 指 | 总部位于中国广东，股票代码为 002008.SZ。该公司是世界主要的激光加工设备生产厂商之一。                                                     |
| 中微公司  | 指 | 总部位于中国上海，股票代码为 688012.SH。该公司产品包括用于 IC 集成电路领域的等离子体刻蚀设备（CCP、ICP）、深硅刻蚀设备（TSV），以及用于 LED 芯片领域的 MOCVD 设备。 |
| 芯源微   | 指 | 总部位于中国辽宁，股票代码为 688037.SH。该公司产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机）。                      |
| 拓荆科技  | 指 | 总部位于中国辽宁，股票代码为 688072.SH。该公司主要提供高性能薄膜沉积设备。                                                          |
| 华海清科  | 指 | 总部位于中国天津，股票代码为 688120.SH。该公司主要产品为化学机械抛光（CMP）设备。                                                     |
| 屹唐股份  | 指 | 总部位于中国北京，股票代码为 688729.SH。该公司主要产品包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备等。                                           |
| 东京电子  | 指 | 总部位于日本东京，股票代码为 8035.T。该公司主要产品包括涂布显影设备、蚀刻设备、薄膜沉积设备等。                                                 |

|                       |   |                                                                                                |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVG                   | 指 | 总部位于奥地利提罗尔州。该公司主要产品包括半导体、MEMS、化合物半导体的晶圆键合、光刻/纳米压印及薄晶圆处理设备。                                     |
| IC Insights           | 指 | 一家专业的半导体市场研究公司，总部位于美国亚利桑那州的斯科茨代尔。                                                              |
| SemiWiki              | 指 | 全球半导体行业技术社区平台，总部位于美国纽约。                                                                        |
| Knomet Research       | 指 | 一家半导体产业链的权威分析机构，总部位于美国加利福尼亚州。                                                                  |
| IBS                   | 指 | 一家全球半导体行业权威咨询机构                                                                                |
| SEMI                  | 指 | 半导体设备和材料国际协会（Semiconductor Equipment and Materials International），是一个全球性的产业协会，致力于服务半导体和平板显示产业。 |
| QYResearch            | 指 | 一家全球细分行业调研机构，全球总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶，中国总部位于北京市。                                                      |
| TrendForce            | 指 | 一家高科技产业深度分析机构，全球总部位于中国台湾。                                                                      |
| Morgan Stanley        | 指 | 一家提供国际金融服务公司，总部位于美国纽约。                                                                         |
| 《Photonics Views》     | 指 | 一本德国光子学领域专业期刊，聚焦光学技术、激光应用及光电子产业动态。                                                             |
| 中国科学院武汉文献情报中心         | 指 | 一家专注于科技情报研究、知识服务、战略咨询，覆盖能源、生物医药、先进制造等领域的机构，总部位于中国湖北省。                                          |
| 头豹研究院                 | 指 | 一家中国市场研究机构，总部位于中国广东省。                                                                          |
| SIA                   | 指 | Semiconductor Industry Association，一家全球半导体行业倡导组织，推动政策制定、市场数据发布及技术标准合作，总部位于美国华盛顿州。              |
| Omdia                 | 指 | 一家科技市场研究机构，总部位于英国伦敦。                                                                           |
| 智研咨询                  | 指 | 一家市场研究公司，总部位于中国北京市。                                                                            |
| Yole                  | 指 | 一家半导体、MEMS、光电领域的技术与市场分析机构，总部位于法国里昂。                                                            |
| AMD                   | 指 | 一家半导体设计公司，总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。                                                                    |
| 赛迪顾问                  | 指 | 中国电子信息产业发展研究院下属咨询机构，总部位于中国北京市。                                                                 |
| Statista              | 指 | 一家全球统计数据平台，总部位于德国汉堡。                                                                           |
| 境内                    | 指 | 中国境内。                                                                                          |
| 证监会、中国证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                    |
| 上交所、交易所               | 指 | 上海证券交易所                                                                                        |
| 国务院                   | 指 | 中华人民共和国国务院                                                                                     |
| 财政部                   | 指 | 中华人民共和国财政部                                                                                     |
| 国家发改委                 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会                                                                              |
| 公司法                   | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                   |
| 证券法                   | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                   |
| 报告期、报告期内、报告期各期、报告期各年度 | 指 | 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年第三季度                                                                |

|         |   |                                                                            |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 报告期初    | 指 | 2022 年 1 月 1 日                                                             |
| 报告期末    | 指 | <b>2025 年 9 月 30 日</b>                                                     |
| 报告期各期末  | 指 | 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、 <b>2025 年 9 月 30 日</b> |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                           |

二、专业术语

|         |   |                                                                                                                         |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 激光      | 指 | Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation（LASER），由粒子受激辐射产生的光束，具有良好的单色性、相干性、方向性和高能量密度的特点，广泛应用于各种工业制造及科研领域。 |
| 激光器     | 指 | 产生、输出激光的器件，是激光加工系统的核心器件。                                                                                                |
| 光、机、电、算 | 指 | 光：采用先进光学设计，光束整形及光学监控系统，实现激光光束整形匀化，高精度调控，确保激光光学系统长期稳定可靠。                                                                 |
|         | 指 | 机：基于精密机械结构设计，确保设备具备高稳定性和高定位精度，支持灵活的模块化配置。                                                                               |
|         | 指 | 电：融合了高效率的电气控制系统，提供完善的电控解决方案和快速的信号处理能力。全方位的安全防护措施，进一步确保了设备和操作者的安全，提升了系统的可靠性和稳定性。                                         |
|         | 指 | 算：利用智能化计算平台，支持实时数据采集分析及监控维护，优化生产和维护流程。                                                                                  |
| 脉宽      | 指 | 激光功率维持在一定值时所持续的时间。                                                                                                      |
| 波长      | 指 | 激光光束在真空中传播的相邻波峰间距，不同波长表现为不同颜色。                                                                                          |
| 热处理     | 指 | 一类半导体制程步骤，涉及将半导体器件或材料在控制温度下暴露于热环境中，以改变其性能、结构或其他特性。主要涉及晶体生长与结晶改善、应力控制、掺杂和扩散、氧化与退火、金属连接的形成等工艺。                            |
| 激光热处理   | 指 | 一种利用激光束对材料进行局部加热和处理的技术，通常涉及使用高能激光束照射材料表面，以实现诸如热处理、改性、熔化、硬化等目的。                                                          |
| 退火      | 指 | 一种半导体制程步骤，是通过将半导体材料加热到特定温度，然后在控制的环境下冷却，以改善晶体结构、消除缺陷或改变材料的性质。                                                            |
| 激光退火    | 指 | 一种利用激光束对材料进行热处理的过程。通过控制激光束的功率和照射时间，可以实现对材料局部区域的加热和冷却，从而改变材料的结构和性质。                                                      |
| 材料改性    | 指 | 通过物理、化学或生物手段对材料成分、微观结构及表面特性进行定向调控。                                                                                      |
| 诱导结晶    | 指 | 定向引导分子有序排列形成晶体的工艺技术。                                                                                                    |
| 外延生长    | 指 | 单晶衬底表面沿特定晶向生长原子级匹配的单晶薄层的工艺技术。                                                                                           |
| 温度梯度    | 指 | 指在空间中某一方向上单位距离内的温度变化率。它通常表示为温度关于空间坐标的偏导数。                                                                               |
| 热预算     | 指 | 半导体制造中材料/器件可承受的温度-时间累积阈值。                                                                                               |
| 激光加工    | 指 | 一种利用激光束进行材料加工的技术，它涵盖了多种不同的应用，包括切割、焊接、雕刻、打标和增材制造等。                                                                       |



|                                          |   |                                                                                                       |
|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 激光切割                                     | 指 | 由计算机控制激光器放电，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光功率等参数，对加工材料形成切割的工艺效果。                                                |
| 激光标刻                                     | 指 | 由计算机控制激光的聚焦及运动，使焦点在物体表面快速移动轨迹，从而在物体表面刻蚀出图形、文字等信息标记，以达到印刷目的。                                           |
| 激光去溢胶                                    | 指 | 利用激光的高选择性烧蚀特性，精确去除微电子封装过程中溢出的环氧树脂或聚酰亚胺胶体。                                                             |
| 激光钻孔、激光蚀刻                                | 指 | 由激光加工设备输出受控高频脉冲激光束聚焦在加工材料表面，形成细微高能量密度光斑，以高温熔化或气化被加工材料，对加工材料形成钻孔或蚀刻的工艺效果。                              |
| 键合/解键合                                   | 指 | 通过熔融、胶粘或阳极键合等技术将晶圆/芯片与载板永久或临时接合的技术；<br>在完成特定工艺步骤后，通过热滑移、激光照射或化学溶解等方式分离键合组件的技术。                        |
| 离子注入                                     | 指 | 一种半导体制造工艺，用于在半导体材料中引入掺杂物质，从而改变其电学性质。这个过程涉及使用离子注入机向半导体材料表面或体内引入离子（又称“杂质”），这些离子可以是正离子或负离子，具体取决于需要的掺杂类型。 |
| 毫秒（ms）、微秒（ $\mu$ s）、纳秒（ns）、皮秒（ps）、飞秒（fs） | 指 | 均为时间单位，其中 1 毫秒= $10^{-3}$ 秒、1 微秒= $10^{-6}$ 秒、1 纳秒= $10^{-9}$ 秒、1 皮秒= $10^{-12}$ 秒、1 飞秒= $10^{-15}$ 秒 |
| 毫米（mm）、微米（ $\mu$ m）、纳米（nm）               | 指 | 均为长度单位，其中 1 毫米= $10^{-3}$ 米、1 微米= $10^{-6}$ 米、1 纳米= $10^{-9}$ 米                                       |
| 平顶光斑                                     | 指 | 光强分布均匀、边缘陡峭的激光光束截面形态。                                                                                 |
| 瑞利极限                                     | 指 | 光学系统分辨率理论极限                                                                                           |
| 半导体                                      | 指 | 常温下导电性能介于导体（Conductor）与绝缘体（Insulator）之间的材料。                                                           |
| 晶圆                                       | 指 | 半导体制成的晶片，用于制造半导体器件。                                                                                   |
| 集成电路                                     | 指 | 又称 IC，一种将多个电子元件（如晶体管、电阻、电容等）集成在单一半导体片上的器件。                                                            |
| 逻辑芯片                                     | 指 | 专门用于执行逻辑操作的集成电路，其上包含各种逻辑门和逻辑元件，可以实现数学和逻辑运算，控制数字信息的流动，以及实现计算和决策。                                       |
| 存储芯片/存储器                                 | 指 | 专门用于存储数据的集成电路，用于存储和检索数字信息，包括闪存（Flash）、动态随机存取存储器（DRAM）等。                                               |
| Flash                                    | 指 | 一种非易失性存储器，断电后存储的数据不会丢失，一般作为计算机系统硬盘，长期存放数据。<br>目前，主流 Flash 存储芯片主要为 NAND Flash。                         |
| NAND                                     | 指 | 一种利用与非逻辑门电路存储数据的闪存技术，可以实现较高的存储密度，适用于需要大容量存储的设备。                                                       |
| 3D NAND                                  | 指 | 一种 NAND Flash 存储技术的演进形式，引入了垂直层叠的结构，相较于传统的平面 NAND，通过在垂直方向上堆叠存储单元，提高了存储密度和性能。                           |
| DRAM                                     | 指 | 动态随机存取存储器，一种易失性存储器，断电后存储的数据会丢失，一般作为计算机系统内存，存放正在运行的软件与使用的数据。                                           |



|             |   |                                                                                                           |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HBM         | 指 | 将多层 DRAM 垂直集成并与逻辑芯片紧耦合封装的高性能存储解决方案，主要应用于 AI 领域。                                                           |
| 功率芯片        | 指 | 用于管理电能转换和电源管理的集成电路芯片。                                                                                     |
| IGBT        | 指 | 绝缘栅双极晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor），是一种广泛用于功率电子设备中的半导体器件，具有高效能、低导通压降和高频特性。                        |
| 沟槽栅型 IGBT   | 指 | 通过刻蚀形成垂直沟槽栅极结构取代传统平面栅的 IGBT，其沟道密度提升 2-3 倍，可显著增强 IGBT 器件性能。                                                |
| 硅           | 指 | 化学式 Si，集成电路及光伏器件的核心衬底材料。                                                                                  |
| 第三代化合物半导体材料 | 指 | 相对于传统的硅基材料而言的新一代半导体材料，具有更好的导电性、散热性和功率密度，由其制成的半导体器件在高功率、高频率、高温等极端环境下适应性更强。两种主要的第三代半导体材料是碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）。 |
| 碳化硅         | 指 | 化学式 SiC，是一种应用于半导体行业的第三代半导体材料，具备高热导率、高电子迁移率、高击穿电场强度等特性。                                                    |
| 氮化镓         | 指 | 化学式 GaN，是一种应用于半导体行业的第三代半导体材料，具备高电子迁移率、高饱和电子漂移速度、较大的击穿电场强度等特性。                                             |
| Low-K       | 指 | 介电常数（K 值，衡量绝缘能力特性）显著低于传统二氧化硅的绝缘材料。                                                                        |
| 图像芯片        | 指 | 用于执行图像采集、处理、增强及分析等核心功能，可高效转换光学信号为数字信号，包括 CCD 和 CMOS 图像芯片等。                                                |
| BSI-CCD     | 指 | 背面照射型电荷耦合器件（Back-Side Illuminated Charge-Coupled Device），一种用于图像芯片，用于在低光条件下获得更好的图像质量。                      |
| 精密电子        | 指 | 通过微米级精密加工工艺制造，具有高尺寸精度、高可靠性及微型化特征电子元器件。                                                                    |
| MLED        | 指 | Mini LED（次毫米发光二极管）与 Micro LED（微米级发光二极管）的统称，系以微缩化芯片结构、高密度集成及无机材料发光为核心特征的下一代显示技术。                           |
| 晶圆制造        | 指 | 通过各种半导体工艺在晶圆表面形成特定电路结构及电子元器件的生产过程。                                                                        |
| 制程          | 指 | 晶圆制造的加工工艺水平，通常以纳米（nm）为单位的工艺节点表征（如 28 纳米、7 纳米等），反映晶体管栅极宽度等关键尺寸。                                            |
| 先进制程        | 指 | 一般指代 28nm 以下制程。                                                                                           |
| 三维堆叠        | 指 | 指通过硅通孔、混合键合等工艺将多个芯片或晶圆在垂直方向进行物理集成与电气互连的半导体制造技术。                                                           |
| 同质集成        | 指 | 在同一制程及材料体系下，将多个相同功能或结构的半导体组件通过高密度互连技术进行模块化整合。                                                             |
| 异构集成        | 指 | 将不同制程、不同材料或不同功能模块集成至同一封装体内的技术，实现性能、功耗、成本的全局优化。                                                            |
| Chiplets    | 指 | 将传统单颗系统级芯片拆解为多个具备独立功能的裸芯片，分别制造并通过先进互联架构实现模块化组合的设计和制造技术。                                                   |
| 三维器件        | 指 | 基于立体结构设计的半导体器件，通过垂直方向构建导电沟道、栅极及源漏区，或多层器件堆叠等方式，突破平面器件物理极限，显著提升晶体管密度、开关速度及能效比。                              |
| 封装          | 指 | 将晶圆制造完成的裸芯片进行切割、测试后，通过引线键合、倒装焊等技术将其固定在基板或外壳内，并完成电气连接、物理保护及散热设计的工艺过程。                                      |

|             |   |                                                                                                                           |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 先进封装        | 指 | 通过扇出型封装、系统级封装等技术，实现多芯片/组件的高密度互连与功能整合。                                                                                     |
| TAIKO 环     | 指 | 晶圆薄化工艺中，通过背面研磨保留边缘环形支撑结构（通常宽度为 2-3mm）以增强机械强度的技术方案。                                                                        |
| 非晶硅、多晶硅、单晶硅 | 指 | 硅的一种无序、部分有序的非晶体结构形式以及晶体形态，电学性能依次增强。                                                                                       |
| SNC、BLC     | 指 | DRAM 存储芯片中用于存储电荷的电容结构，和用于电压补偿、噪声抑制等功能的数据字线。                                                                               |
| PN 结/结      | 指 | P 型和 N 型两种不同半导体结合形成的界面结构。<br>P 型：半导体材料中掺入硼等三价元素。<br>N 型：半导体材料中掺入磷等五价元素。                                                   |
| 载流子         | 指 | 半导体中承载电荷并参与导电的微观粒子。                                                                                                       |
| 表面迁移率       | 指 | 载流子在半导体表面沟道内迁移能力的物理量。                                                                                                     |
| 晶格          | 指 | 半导体材料内部原子按特定对称性周期性排列形成的空间点阵。                                                                                              |
| 欧姆接触        | 指 | 指两个物体之间通过直接的电流传导而形成的电接触，具备接触电阻低的特性，形成良好的欧姆接触有利于电流的输入和输出。                                                                  |
| AI/AIGC     | 指 | Artificial Intelligence，通过算法与计算系统模拟人类智能行为的技术；<br>Artificial Intelligence Generated Content，通过训练数据生成文本、图像、音视频等原创内容的 AI 技术。 |
| TSV         | 指 | Through Silicon Via，硅通孔，一种穿透硅晶圆或芯片的垂直互连方式。                                                                                |
| CoWoS       | 指 | Chip on Wafer on Substrate，一种 2.5D 先进封装技术，通过中介层实现多芯片异构集成，为 AI 等高端芯片提供高速低延迟互联。                                             |

本招股说明书除特别说明外，所有数值保留 2 位或 4 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、重大事项提示

#### （一）业绩下滑情形相关承诺

本公司提示投资者认真阅读实际控制人、控股股东及一致行动人作出的业绩下滑而延长股份锁定期的相关承诺，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件三、与投资者保护相关的承诺”。

#### （二）利润分配政策及长期回报规划

本公司提示投资者认真阅读本公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，详细内容请参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、本次股利分配政策”、“三、发行人上市后三年内分红回报规划”和“四、长期回报规划的内容及制定考虑因素”。

#### （三）重大风险提示

本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”。

##### 1、客户集中度较高及单一客户重大依赖的风险

报告期各期，公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 66.86%、65.89%、83.45%和 **81.50%**，其中向客户 A 及其同一控制下的其他主体销售金额占当期营业收入的比例分别为 18.86%、42.87%、67.86%和 **59.30%**，向客户 A 及其同一控制下的其他主体销售毛利占当期毛利的比例分别为 **28.42%**、**63.62%**、**81.52%**和 **73.49%**。公司对客户 A 及其同一控制下的其他主体收入及毛利占比较高，**对其存在重大依赖**。

公司下游的晶圆制造产业兼具资本密集与技术密集特征，行业集中度较高，而公司激光热处理设备产品主要面向集成电路先进制程、三维异构集成等前沿高端应用领域，相关产能进一步集中于少数晶圆厂。且相较于国际设备厂商，公司

业务规模相对较小，受制于融资渠道有限、资金实力不足、产能有限等因素，公司现阶段重点拓展并满足具有明确扩产预期的客户，导致公司业务呈现集中于**客户 A 等**国内主流、头部半导体制造商的阶段特征。若**客户 A 等**公司主要客户因自身技术更新、产业政策变化、市场竞争加剧等原因，导致其资本性支出下降，或公司因未能持续满足**客户 A 等**客户需求、未能在市场竞争中保持优势，导致公司与客户合作的稳定性与可持续性受影响，均可能导致客户需求订单量下降，则公司业绩稳定性也会受到较大影响。此外，如果公司后续不能持续开拓新客户并转化为收入，将不利于公司未来持续稳定发展。

## 2、发行人实际控制人存在大额对外担保的风险

截至**2026 年 2 月 25 日**，发行人实际控制人叶向明、毛冬对东莞东骏电器有限公司（以下简称“东骏电器”）、东莞市汉邦能源有限公司（以下简称“汉邦能源”）等其控制企业以外的第三方提供的担保债务本金余额为**7.36 亿元**，其中东骏电器担保债务本金余额**5.52 亿元**、汉邦能源担保债务本金余额**1.84 亿元**。

就上述叶向明、毛冬为东骏电器提供担保的债务，东骏电器贷款资金专项用于建设东骏广场项目。东骏广场项目为位于广东省东莞市南城街道的商业、办公楼，其 1 号楼已取得《现售备案证书》（莞商房现证第 202400211 号）、2 号楼已取得《预售许可证》（东莞商房预证字第 202300102 号）。

**2020 年 4 月**，东骏电器担保债务主债权人之一的中国农业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“农业银行”）与东骏电器签署《商业、办公楼买卖意向书》，根据该意向书，农业银行有意购买东骏广场 2 号楼作为营业大楼，双方同意以先签署意向书再签署正式合同的方式进行房产转让，并约定在东骏广场的设计、建设过程中，双方共同参与并友好协商。

农业银行于**2025 年 9 月 17 日**发布《中国农业银行股份有限公司东莞分行业务经营用房购置项目报名公告》，根据上述公告，农业银行拟采购业务经营用房，要求房产位于东莞市主城区，用途为办公、商业，建筑面积约**2.40-2.60 万**平方米，报名截止日期为**2025 年 9 月 21 日**。根据东骏电器说明，东骏广场项目房产各项指标均符合农业银行的采购要求并已完成报名；如果东骏电器成为农业银行上述业务经营用房购置项目选定的供应商，相关交易完成后，东骏电器将使用房

产销售款偿还相关债务，发行人实际控制人担保责任将相应消减。

由于农业银行前述业务经营用房采购程序推进较为缓慢，东骏电器已于2025年10月向东莞市第一人民法院提起诉讼，诉请农业银行履行《商业、办公楼买卖意向书》合同义务并赔偿东骏电器的损失。根据东骏电器说明，由于农业银行广东省分行已将东骏广场2号楼采购方案报送总行审批，东骏电器于2025年12月31日以“双方有长期合作关系”、“争议事实较为清楚”、“节约司法资源”为由向受理法院申请诉中调解，请求给予2个月调解期限。2026年3月9日，东莞市第一人民法院出具“（2025）粤1971民初72112号”《通知书》，该《通知书》载明：“原告东莞东骏电器有限公司与被告中国农业银行股份有限公司东莞分行商品房预售合同纠纷一案，被告中国农业银行股份有限公司东莞分行向本院提交延长调解期限申请书，提出其‘一直积极向上级推进案涉办公楼购置项目审批流程，目前该项目的审批流程已由省行提交至总行，双方同意继续等待总行审批结果’，原告亦向本院申请延长调解期限，因此，对原告、被告双方申请延长调解期限，本院予以准许”。截至本招股说明书签署日，东骏电器与农业银行上述诉讼案件仍处于调解阶段。

除公司股权外，发行人实际控制人叶向明、毛冬的其他资产主要包括两人通过东骏投资持有的东骏激光63.44%股权以及其他一级市场投资、房产、个人理财等。就叶向明、毛冬提供担保事项，两人承诺：“截至2026年3月18日，本人及本人的关联方未收到主债权人提出的任何要求承担担保责任的主张，无论该等主张是书面或其他形式。如因主债务人迟延履行主债务或其他违约事项导致主债权人主张本人对担保债务承担连带保证责任，本人将立即针对相关事项采取包括但不限于转让除东骏投资、莱普科技股权之外的其他资产（含东骏投资持有的东骏激光股权）等积极措施，并使用其他资产或其他自筹资金偿还担保债务，以避免相关违约事项对莱普科技造成不利影响，确保莱普科技的控制权稳定性”。

虽然发行人实际控制人叶向明、毛冬已作出上述承诺，但鉴于相关担保的主债务本金余额较大，如果担保债务逾期未偿还，主债权人主张叶向明、毛冬承担连带保证责任，而两人未能及时清偿担保债务，则存在两人持有的发行人控股股东东骏投资的股权被主债权人申请冻结、甚至被司法强制执行的风险。



### 3、经营业绩波动的风险

报告期各期，公司营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元、28,102.42 万元和 **19,046.49 万元**；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 -920.00 万元、2,177.26 万元、4,834.56 万元和 **718.83 万元**。

半导体设备行业受下游市场需求波动的影响较大，如果未来市场竞争加剧、宏观经济景气度回落或者国家产业政策发生变化，下游客户对相关设备的需求量可能下降。此外，公司将保持对新产品和新技术的高研发投入，相关研发投入短期内将对公司经营业绩造成一定的影响。在以上因素影响下，不排除未来公司经营业绩出现波动甚至亏损的风险。

### 4、技术迭代的风险

公司下游的晶圆制造产业具备制程持续演进、工艺不断迭代升级的特点。为满足下游客户高速迭代的工艺需求，公司在与境内领先晶圆厂客户和专业科研机构保持密切技术信息交流的基础上，结合半导体制造技术演化态势确立创新性激光半导体工艺方向并执行开发工作，同时持续升级更新设备研制相关的光学、机械、电气、软件算法相关的全流程核心技术体系。

公司需要在现有的全流程核心技术体系下，进一步实现创新性半导体工艺、核心光路结构、核心零部件等相关核心技术的积累，通过长期的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。若公司产品及技术研发升级节奏无法满足下游客户需求，产品未能及时实现技术迭代，可能导致公司市场竞争力下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。

### 5、市场竞争风险

公司立足于先进精密激光技术，致力于以激光工艺半导体设备满足集成电路先进制程、三维堆叠、异构集成等前沿领域的应用需求。受益于近年来半导体设备的稳定供应需求，公司已助力多家知名半导体厂商实现最新一代半导体产品量产，已在我国激光工艺半导体设备市场竞争中占据了一定的市场份额，建立起了一定的竞争优势。但不排除未来其他新晋竞争对手进入激光工艺半导体设备领域，或是快速热处理等领域的供应商开拓激光工艺半导体设备产品品类并与公司在先进制程、三维堆叠、异构集成等相关工艺环节展开直接竞争。如果竞争



对手开发出更具有市场竞争力的产品，或者提供更好的价格及服务，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等会受到不利影响。

## 6、2025 年度业绩下滑的风险

根据 2025 年度审阅报告，公司 2025 年度的经营业绩情况及其与上年同期的对比情况如下：

单位：万元

| 项目                     | 2025 年度   | 2024 年度   | 变动比例    |
|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入                   | 35,045.78 | 28,102.42 | 24.71%  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 7,230.39  | 5,564.28  | 29.94%  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 4,085.47  | 4,834.56  | -15.49% |

2025 年度，由于“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房转固，折旧摊销费大幅上升等原因，公司 2025 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2024 年度下降 15.49%。公司 2025 年度经营业绩的具体情况与分析详见本招股说明书“第二节 概览”之“七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”之“（二）2025 年经营业绩情况”。

## 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

| （一）发行人基本情况                               |                  |                     |                               |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| 发行人名称                                    | 成都莱普科技股份有限公司     | 成立日期                | 2003 年 12 月 22 日              |
| 注册资本                                     | 4,818.00 万元      | 法定代表人               | 叶向明                           |
| 注册地址                                     | 成都高新区康强三路 179 号  | 主要生产<br>经营地址        | 成都高新区康强三路<br>179 号            |
| 控股股东                                     | 东莞市东骏投资有限公司      | 实际控制人               | 叶向明、毛冬                        |
| 行业分类                                     | 专用设备制造业（C35）     | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无                             |
| （二）本次发行的有关中介机构                           |                  |                     |                               |
| 保荐人                                      | 中信建投证券股份有限公司     | 主承销商                | 中信建投证券股份有限公司                  |
| 发行人律师                                    | 北京市康达律师事务所       | 其他承销机构              | 不适用                           |
| 审计机构                                     | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 评估机构                | 中水致远资产评估有限公司、中威正信（北京）资产评估有限公司 |
| 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经 |                  | 无                   |                               |

|                           |                     |      |              |
|---------------------------|---------------------|------|--------------|
| 办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 |                     |      |              |
| (三) 本次发行其他有关机构            |                     |      |              |
| 股票登记机构                    | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 收款银行 | 中信银行北京京城大厦支行 |
| 其他与本次发行有关的机构              |                     |      | 无            |

### 三、本次发行概况

|               |                                                                                  |           |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| (一) 本次发行的基本情况 |                                                                                  |           |         |
| 股票种类          | 人民币普通股（A 股）                                                                      |           |         |
| 每股面值          | 人民币 1.00 元                                                                       |           |         |
| 发行股数          | 不超过 1,606.00 万股                                                                  | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |
| 其中：发行新股数量     | 不超过 1,606.00 万股                                                                  | 占发行后总股本比例 | 不低于 25% |
| 股东公开发售股份数量    | 无                                                                                | 占发行后总股本比例 | 无       |
| 发行后总股本        | 不超过 6,424.00 万股                                                                  |           |         |
| 每股发行价格        | 【】元                                                                              |           |         |
| 发行市盈率         | 【】倍（按发行价格除以发行后每股收益计算）                                                            |           |         |
| 发行前每股净资产      | 【】元                                                                              | 发行前每股收益   | 【】元     |
| 发行后每股净资产      | 【】元                                                                              | 发行后每股收益   | 【】元     |
| 发行市净率         | 【】倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）                                                           |           |         |
| 预测净利润（如有）     | 无                                                                                |           |         |
| 发行方式          | 本次发行将采用网下向询价对象配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或者中国证监会认可的其他方式                                 |           |         |
| 发行对象          | 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开通科创板交易权限的境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外）                    |           |         |
| 承销方式          | 余额包销                                                                             |           |         |
| 募集资金总额        | 【】万元                                                                             |           |         |
| 募集资金净额        | 【】万元                                                                             |           |         |
| 募集资金投资项目      | 晶圆制造设备开发与制造中心项目                                                                  |           |         |
|               | 先进封装设备开发与制造中心项目                                                                  |           |         |
|               | 研发中心及信息化建设项目                                                                     |           |         |
|               | 研发、技术支持与营销网络建设项目                                                                 |           |         |
|               | 补充流动资金                                                                           |           |         |
| 发行费用概算        | 本次发行费用总额为【】万元，其中主要包括保荐及承销费【】万元；审计及验资费【】万元；律师费【】万元；用于本次发行的信息披露费用【】万元；发行手续费及其他【】万元 |           |         |
| 高级管理人员、员工拟参   | 若发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售认购本次公开发行                                                     |           |         |

|                                          |                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 与战略配售情况                                  | 的新股，公司将依据相关法律法规的要求，适时履行相应审议程序及其他相关所需程序，并依法详细披露                                                  |
| 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况                        | 保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件 |
| 拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有） | 不适用                                                                                             |
| （二）本次发行上市的重要日期                           |                                                                                                 |
| 刊登发行公告日期                                 | 【】年【】月【】日                                                                                       |
| 开始询价推介时间                                 | 【】年【】月【】日                                                                                       |
| 刊登定价公告日期                                 | 【】年【】月【】日                                                                                       |
| 申购日期和缴款日期                                | 【】年【】月【】日                                                                                       |
| 股票上市日期                                   | 【】年【】月【】日                                                                                       |

四、发行人主营业务情况

（一）发行人主要业务、主要产品或服务及其用途

莱普科技以先进精密激光技术及半导体创新工艺开发为核心，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。莱普科技始终以用户需求为牵引，立足于自主创新，面向半导体产业有针对性地开展先进精密激光技术、创新工艺和设备的研发工作，并延伸布局至精密电子制造及 MLED 等产业，由此构建起涵盖激光热处理设备与专用激光加工设备两大产品线的完整供应体系。

报告期内，莱普科技相关设备已成功应用于先进制程 3D NAND Flash 存储芯片、先进制程 DRAM 存储芯片、28nm 及以下先进制程逻辑芯片、SiC 功率芯片、沟槽栅型 IGBT 功率芯片、先进电源管理芯片、BSI-CCD 芯片量产，以及国产 HBM 芯片工艺研发等前沿应用场景。

报告期内，公司主营业务收入按产品或服务类别构成情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2025 年 1-9 月 |        | 2024 年度   |        | 2023 年度   |        | 2022 年度  |        |
|---------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
|         | 金额           | 占比     | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     | 金额       | 占比     |
| 激光热处理设备 | 16,000.03    | 85.46% | 24,429.21 | 87.90% | 13,816.34 | 74.10% | 3,467.26 | 48.05% |

| 项目          | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|-------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|             | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 专用激光加工设备    | 2,589.78     | 13.83%  | 3,085.07  | 11.10%  | 4,059.67  | 21.77%  | 3,602.52 | 49.92%  |
| 升级改造及其他技术服务 | 132.39       | 0.71%   | 278.83    | 1.00%   | 768.41    | 4.12%   | 146.53   | 2.03%   |
| 合计          | 18,722.20    | 100.00% | 27,793.12 | 100.00% | 18,644.42 | 100.00% | 7,216.31 | 100.00% |

受益于下游行业景气度提升、客户资本性支出上升以及公司持续研发推出新产品、市场开拓情况良好等因素，公司报告期内主营业务收入实现快速上升。其中，公司应用于存储芯片、逻辑芯片、功率器件等半导体制造领域的激光热处理设备产品线不断丰富、升级，销售数量持续增长。

## （二）主要原材料及重要供应商

公司生产经营所需的原材料主要包括激光器等光学类材料、机械手等电气类材料，公司整体采用“以产定采”的采购模式，结合生产计划和现有库存情况实施采购。公司主要供应商包括富通尼激光科技（东莞）有限公司、北京卓镭激光技术股份有限公司等。

## （三）主要生产模式

公司主要基于自主生产体系制造设备产品。公司主要采用“以销定产”的生产模式，基于市场需求及交付时限制定生产计划，并弹性安排生产，实行接单生产、按需生产。

## （四）销售方式和渠道及重要客户

公司主要产品具备复杂度高、专业性强、差异化明显等特征，因此公司采取以直销为主的销售模式。报告期内，公司相关设备已部署于客户 A、客户 B、客户 C、华润微、士兰微、三安半导体、中车时代、客户 D、华天科技、达迩科技等主流半导体厂商的先进制程和先进封装产线。

## （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

公司现已适配国内半导体产业技术特征开发了多款原创性产品，并推出多款对标国际一流水平的半导体专用激光工艺设备，打破国际厂商在国内市场长期垄断局面。在激光热处理行业，公司是国内少数专注于半导体激光热处理设备的厂

商，产品布局相对完整，2024 年公司国内市占率约 16%；在激光加工行业，公司已在前沿应用领域具备了较高的技术实力与创新能力。

五、发行人符合科创板定位的说明

（一）公司符合科创板行业领域的规定

|              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司所属<br>行业领域 | <input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术 | 根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》，公司所处的行业为“专用设备制造业（C35）”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司从事的半导体器件专用设备制造为战略性新兴产业，被纳入战略性新兴产业“1 新一代信息技术产业-1.2 电子核心产业-1.2.1 新型电子元器件及设备制造-半导体器件专用设备制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（上证发 2024 年 4 月修订），公司属于“第五条（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”列示的科技创新企业。 |
|              | <input type="checkbox"/> 高端装备               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <input type="checkbox"/> 新材料                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <input type="checkbox"/> 新能源                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <input type="checkbox"/> 节能环保               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <input type="checkbox"/> 生物医药               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | <input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

综上所述，公司所属行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》第五条（一）中所规定的“新一代信息技术领域——半导体和集成电路”行业领域的要求。

（二）公司符合科创属性规定的规定

| 科创属性相关指标                                        | 是否符合                                                             | 指标情况                                                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或者最近三年研发投入金额累计在 8,000 万元以上 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 2022 年至 2024 年，公司研发投入合计 9,797.04 万元，占营业收入比例为 17.95%，满足标准。                            |
| 研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%                           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至 2024 年 12 月 31 日，发行人研发人员 62 名，研发人员占当年员工总数的比例为 22.38%，超过 10%。                      |
| 应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上                      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 截至 2025 年 12 月 31 日，公司已取得发明专利 16 项，应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利超过 7 项。                       |
| 最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或者最近一年营业收入金额达到 3 亿元         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 2022 至 2024 年，公司营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元和 28,102.42 万元，年复合增长率 94.68%，超过 25%。 |

六、主要财务数据和财务指标

报告期内，公司主要财务数据和财务指标如下：

| 项目 | 2025.9.30/<br>2025 年 1-9 月 | 2024.12.31/<br>2024 年度 | 2023.12.31/<br>2023 年度 | 2022.12.31/<br>2022 年度 |
|----|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|----|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

| 项目                         | 2025. 9. 30/<br>2025 年 1-9 月 | 2024.12.31/<br>2024 年度 | 2023.12.31/<br>2023 年度 | 2022.12.31/<br>2022 年度 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额（万元）                   | 114,254.14                   | 102,640.75             | 66,609.12              | 24,608.15              |
| 归属于母公司所有者权益（万元）            | 54,564.86                    | 53,269.51              | 47,357.08              | 6,182.38               |
| 资产负债率（母公司）                 | 51.50%                       | 47.51%                 | 28.51%                 | 74.04%                 |
| 营业收入（万元）                   | 19,046.49                    | 28,102.42              | 19,075.73              | 7,414.56               |
| 净利润（万元）                    | 988.73                       | 5,491.16               | 2,279.87               | -938.22                |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元）          | 1,034.24                     | 5,564.28               | 2,303.67               | -879.62                |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） | 718.83                       | 4,834.56               | 2,177.26               | -920.00                |
| 基本每股收益（元）                  | 0.21                         | 1.15                   | 0.63                   | -0.33                  |
| 稀释每股收益（元）                  | 0.21                         | 1.15                   | 0.63                   | -0.33                  |
| 加权平均净资产收益率                 | 1.82%                        | 11.06%                 | 9.98%                  | -43.35%                |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）          | 4,626.66                     | 3,202.59               | -3,272.37              | -2,827.26              |
| 现金分红（万元）                   | -                            | -                      | -                      | -                      |
| 研发投入占营业收入的比例               | 19.87%                       | 20.90%                 | 12.56%                 | 20.61%                 |

注：上述财务指标的计算方法请参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“五、主要财务指标”。

七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

（一）财务报告审计截止日后主要经营状况

公司财务报告审计截止日为 2025 年 9 月 30 日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，公司所面临的产业政策、税收政策等未发生重大变化，公司业务经营模式、主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

（二）2025 年经营业绩情况

致同会计师对公司 2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2025 年度的合并



利润表、合并现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（致同审字（2026）第 510A002706 号）。

根据经审阅的财务数据，公司主要财务情况如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目          | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 变动比例   |
|-------------|------------------|------------------|--------|
| 资产总额        | 111,875.30       | 102,640.75       | 9.00%  |
| 负债总额        | 51,149.58        | 49,444.26        | 3.45%  |
| 所有者权益       | 60,725.72        | 53,196.49        | 14.15% |
| 归属于母公司所有者权益 | 60,848.04        | 53,269.51        | 14.23% |

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额较上年末增长 9.00%，主要系公司整体业务规模扩大；公司负债总额较上年末增长 3.45%，变动幅度不大；公司归属于母公司所有者权益较上年末增长 14.23%，与归属于母公司所有者净利润的变动趋势一致。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目                     | 2025 年度        | 2024 年度        | 变动比例    |
|------------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                   | 35,045.78      | 28,102.42      | 24.71%  |
| 净利润                    | 7,171.13       | 5,491.16       | 30.59%  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 7,230.39       | 5,564.28       | 29.94%  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 4,085.47       | 4,834.56       | -15.49% |
| 项目                     | 2025 年 10-12 月 | 2024 年 10-12 月 | 变动比例    |
| 营业收入                   | 15,999.29      | 18,932.51      | -15.49% |
| 净利润                    | 6,182.41       | 6,659.87       | -7.17%  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 6,196.14       | 6,676.35       | -7.19%  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 3,366.64       | 6,217.90       | -45.86% |

2025 年度公司实现营业收入 35,045.78 万元，同比增长 24.71%，收入增长主要受益于下游行业景气度提升、客户资本性支出上升以及公司持续研发推出新产品、市场开拓情况良好等因素；2025 年 10-12 月公司实现营业收入

15,999.29 万元，同比下降-15.49%，主要系公司首台 USJLA、LIEG 设备经过较长时间的验证周期后在 2024 年第四季度得到了下游客户最终验证通过，2024 年 10-12 月的营业收入较高。

2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 7,230.39 万元，同比增长 29.94%，一方面系公司经营规模扩大、营业收入增长；另一方面，公司国家某部委应用专项与“面向芯片先进制程的激光退火技术与制造装备研制项目”于 2025 年第四季度验收通过，相关政府补助款按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》由递延收益转入其他收益，公司的非经常性损益金额上升。

2025 年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,085.47 万元，同比下降 15.49%，2025 年 10-12 月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,366.64 万元，同比下降-45.86%，主要系当年“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房转固，折旧摊销费大幅上升。

3、合并现金流量表主要数据

（1）2025 年度现金流情况

单位：万元

| 项目            | 2025 年度        | 2024 年度        | 变动比例     |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,603.46       | 3,202.59       | 74.97%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,352.20     | -24,255.52     | 53.20%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,538.78       | 13,226.93      | -65.69%  |
| 项目            | 2025 年 10-12 月 | 2024 年 10-12 月 | 变动比例     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 976.80         | -144.88        | 774.22%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,952.04      | -3,495.15      | 44.15%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -435.95        | 2,829.40       | -115.41% |

2025 年度公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 74.97%，主要系当年销售回款金额较高；2025 年 10-12 月公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 774.22%，主要系当期收到的政府补助款增加。

2025 年度公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 53.20%，主要系公司“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”已于当年竣工，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年减少；2025 年 10-12 月公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 44.15%，主要系当期存在大额银行理财赎回。

2025 年度公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降-65.69%，主要系公司当年取得借款收到的现金减少；2025 年 10-12 月公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 115.41%，主要系当期存在大额银行借款归还。

4、非经常性损益明细表

(1) 2025 年度非经常性损益明细表

| 单位：万元                                                                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 项目                                                                   | 2025 年度        | 2024 年度        |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -38.92         | 0.45           |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 3,484.23       | 591.58         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 333.94         | 307.41         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 2.60           | -              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -73.72         | -37.51         |
| 非经常性损益总额                                                             | 3,708.12       | 861.93         |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                                      | 556.22         | 132.14         |
| 非经常性损益净额                                                             | 3,151.91       | 729.79         |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数                                                 | 6.99           | 0.08           |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益                                                    | 3,144.92       | 729.72         |
| 项目                                                                   | 2025 年 10-12 月 | 2024 年 10-12 月 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -76.30         | 0.17           |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 3,350.63       | 490.00         |

|                                                                      |          |        |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 69.19    | 82.25  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | -        | -      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -14.31   | -33.04 |
| 非经常性损益总额                                                             | 3,329.21 | 539.38 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                                      | 499.38   | 80.91  |
| 非经常性损益净额                                                             | 2,829.82 | 458.48 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数                                                 | 0.32     | 0.03   |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益                                                    | 2,829.50 | 458.45 |

2025 年 10-12 月，公司的非经常性损益金额较高，主要系公司国家某部委应用专项与“面向芯片先进制程的激光退火技术与制造装备研制项目”于 2025 年第四季度验收通过，相关政府补助款按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》由递延收益转入其他收益。

综上，公司 2025 年度的财务状况稳定，与公司实际经营活动相匹配。

### （三）2026 年 1-3 月业绩预计

基于目前的经营状况和市场环境，公司预计 2026 年 1-3 月主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目                     | 2026 年 1-3 月        | 2025 年 1-3 月 | 变动比例              |
|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 营业收入                   | 5,000.00 至 5,500.00 | 3,662.77     | 36.51%至 50.16%    |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 220.00 至 650.00     | 79.96        | 175.15%至 712.96%  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | -500.00 至 -70.00    | -53.32       | -837.70%至 -31.28% |

2026 年 1-3 月，发行人预计实现营业收入较上年同期增加 36.51%至 50.16%，主要受益于下游行业景气度提升、客户资本性支出上升、市场开拓情况良好等因素；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 175.15%至 712.96%，与营业收入的变动趋势一致；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少-837.70%至-31.28%，主要系“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房转固后，折旧摊销费大幅上升。

八、发行人选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）款：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

根据致同会计师出具的《审计报告》（致同审字（2026）第 510A001232 号），发行人 2023 年及 2024 年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 2,177.26 万元、4,834.56 万元，2024 年度营业收入为 28,102.42 万元；同时，根据发行人 2023 年 12 月外部融资的估值情况以及同行业可比上市公司的估值，预计发行人的市值不低于人民币 10 亿元。综上，发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）款。

九、公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用

本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

| 项目名称             | 投资总额      | 利用募集资金投资额 |
|------------------|-----------|-----------|
| 晶圆制造设备开发与制造中心项目  | 30,588.35 | 30,588.35 |
| 先进封装设备开发与制造中心项目  | 13,970.46 | 13,970.46 |
| 研发中心及信息化建设项目     | 15,240.43 | 15,240.43 |
| 研发、技术支持与营销网络建设项目 | 16,209.32 | 16,209.32 |
| 补充流动资金           | 8,991.44  | 8,991.44  |
| 合计               | 85,000.00 | 85,000.00 |

若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自有资金、银行借款等途径解决；若本次发行实际募集资金高于募集资金项目投资额，公司将按照相关法律法规、公司发展情况妥善安排超募资金的使用。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的部分或全部项目在本次发行募

集资金到位前必须进行先期投入，公司拟自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，再以募集资金置换先期已投入的自筹资金。

## （二）未来发展规划

### 1、整体发展战略规划

公司长期致力于以科技创新助力国家半导体产业发展，已确立了“激光热处理设备和专用激光加工设备”双引擎可持续发展的战略。未来，公司将继续以先进精密激光技术为核心，通过高强度研发投入持续夯实公司技术实力，推进产品矩阵多元化发展和深度优化；同时积极扩大服务对象群体，丰富下游应用领域并提高市场占有率，以自主研发的先进精密激光技术助力维护国家半导体等关键产业链的安全与稳定。

### 2、报告期内已采取的措施及实施效果

#### （1）建立健全高层次研发人才体系，扩大研发投入支出

报告期内，公司持续引进光、机、电、算及半导体工艺等各领域具有国际化视野和背景的高专业水准研发人才，并通过加强内部人才培育制度自主培养技术骨干，建立健全高层次人才体系。截至报告期末，公司研发人员 **79** 人，占员工总数的 **23.10%**。

公司同时保持较高强度研发水平。报告期内，公司研发投入分别为 1,528.13 万元、2,395.18 万元、5,873.72 万元和 **3,784.97 万元**，占营业收入的比例分别为 20.61%、12.56%、20.90%和 **19.87%**。公司参与了国家某部委应用专项，并积极与合作单位 A、合作单位 B 等产业链上下游企业，以及中国科学院等境内领先的科研机构开展合作研发，促进先进精密激光技术与半导体产业融合发展。

#### （2）扩充产品序列，推进多领域市场布局

报告期内，基于行业前沿技术发展及市场需求升级，公司研发并生产了多款半导体领域激光热处理设备与专用激光加工设备，不断扩充产品序列以满足各应用领域高端制程工艺需求。

目前，公司设备产品已应用于客户 A、客户 B、客户 C、华润微、士兰微、三安半导体、中车时代、客户 D、华天科技、达迩科技等主流半导体厂商，应用



于包括先进制程 3D NAND 存储芯片、先进制程 DRAM 存储芯片、28nm 及以下先进制程逻辑芯片、SiC 功率芯片、沟槽栅型 IGBT 功率芯片、先进电源管理芯片、BSI-CCD 芯片量产，以及国产 HBM 芯片工艺研发等前沿工艺场景。

### **（3）优化治理结构，完善基础设施建设**

报告期内，公司持续优化内部治理结构、提高管理水平以适应公司高速发展需求。公司参照上市公司要求不断完善法人治理结构，规范股东会、董事会及其下设专门委员会的运作，建立独立董事、董事会秘书、内部审计等相关制度，形成了科学有效的公司运营决策机制，为公司持续发展提供治理结构基础。

为满足持续快速增长的半导体设备科研、生产、试验任务需求，以及人员办公需求，公司正持续完善基础设施。报告期内，公司开工建设“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”，包含激光工程研发中心、半导体材料先进激光技术联合实验室等。

## **3、未来规划采取的措施**

### **（1）推进创新常态化，布局前沿技术**

公司将以市场需求为导向大力推进创新常态化。公司计划持续引入高层次研发人才，保持高强度研发投入，巩固创新的底层支撑；同时深度接触市场，确保技术创新方向与产业界实际需求保持一致。

基于常态化创新机制，公司将紧密跟随行业前沿动态，布局前沿产业技术，针对激光和半导体制造领域的前沿理论持续开展技术研究及产品开发，加快推动产业转型升级。

### **（2）强化品牌效应，扩大市场覆盖**

基于成熟的自主创新能力和领先的产品力，公司已在半导体领域激光热处理及激光加工市场建立良好口碑并初步形成品牌效应，实现多数客户重复采购。未来，公司将巩固现有客户关系，并借助已有的设备产品的成功应用案例进一步强化品牌效应，推广自身品牌并加快市场开发，开拓更多不同应用领域的领先客户。

此外，公司积极践行“走出去”战略，公司将通过积极兴建海外技术支持与营销网点的方式开拓海外市场。扩大海外市场覆盖，不仅有助于公司提高全球影

响力，挖掘新的业绩增长点，也有助于公司强化研发实力，通过直接服务国际领先晶圆厂并与国际领先设备厂商直接展开竞争，进一步深化公司对先进半导体制造工艺的理解。

### **（3）充分发挥资本平台优势，加大资源整合力度**

公司将充分利用本次 IPO 融资机会，合理、高效利用资本市场资金支持。公司已结合业务发展目标与市场需求等因素对募集资金运用做了充分论证，上市后公司将审慎推进募集资金使用。

未来，公司还将充分利用上市后的融资平台，为公司发展提供长期资金和产业资源支持，增强自身竞争力，提高国产半导体供应链稳定性水平，并同步实现股东利益最大化。

## **十一、其他对发行人有重大影响的事项**

截至本招股说明书签署日，不存在重大诉讼等其他对发行人有重大影响的事项。

## 第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险主要根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

### 一、与发行人相关的风险

#### （一）经营风险

##### 1、客户集中度较高及单一客户重大依赖的风险

报告期各期，公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为66.86%、65.89%、83.45%和**81.50%**，其中向客户A及其同一控制下的其他主体销售金额占当期营业收入的比例分别为18.86%、42.87%、67.86%和**59.30%**，向**客户A及其同一控制下的其他主体销售毛利占当期毛利的比例分别为28.42%、63.62%、81.52%和73.49%**。公司对客户A及其同一控制下的其他主体收入及毛利占比较高，**对其存在重大依赖**。

公司下游的晶圆制造产业兼具资本密集与技术密集特征，行业集中度较高，而公司激光热处理设备产品主要面向集成电路先进制程、三维异构集成等前沿高端应用领域，相关产能进一步集中于少数晶圆厂。且相较于国际设备厂商，公司业务规模相对较小，受制于融资渠道有限、资金实力不足、产能有限等因素，公司现阶段重点拓展并满足具有明确扩产预期的客户，导致公司业务呈现集中于**客户A等国内主流、头部半导体制造商的阶段特征**。若**客户A等公司主要客户**因自身技术更新、产业政策变化、市场竞争加剧等原因，导致其资本性支出下降，或公司因未能持续满足**客户A等客户需求、未能在市场竞争中保持优势**，导致**公司与客户合作的稳定性与可持续性受影响**，均可能导致客户需求订单量下降，则公司业绩稳定性也会受到较大影响。此外，如果公司后续不能持续开拓新客户并转化为收入，将不利于公司未来持续稳定发展。

##### 2、产品验收周期较长的风险

晶圆制造属于高精密制造领域，对产线各环节的良率要求极高，相关设备验收前需经过长时间的工艺验证和产线联调联试。

公司产品需在客户现场经过较长时间的安装调试后方可验收。验收周期受晶圆生产工艺的成熟程度、客户对工艺的要求、客户产线整体验收情况、现场突发状况及其他偶然因素影响，存在波动。若公司产品验收周期延长，可能会导致公司调试相关成本增加、收款时点拖后、存货规模增大，进而对公司的生产经营造成不利影响。

### 3、产品验证及市场开拓不及预期的风险

公司一般需要经历审厂、设备开发、装机、硬件验收、单步工艺验证、整线工艺适配验证以及量产验证等多项流程，方可导入客户供应链体系。相关产品具有认证标准高、认证周期长的特点。未来，若公司相关新产品的客户验证进度不及预期、或相关新产品通过工艺验证后市场开拓不利，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

### 4、内控风险

报告期内，公司资产规模、销售收入规模和人员规模快速增长。伴随公司规模增长，公司研发、采购、生产、销售、财务等环节的资源配置和内控管理的复杂度也同步上升，这对公司的战略规划、内部治理、经营管理能力提出了更高的要求。如果公司未能有效提升自身的管理水平，可能导致生产经营、内部控制出现混乱，将影响公司的经营业绩和长远发展。

### 5、房屋租赁风险

发行人及分子公司存在租赁房产未办理房屋租赁备案手续、租赁房屋未取得产权证书等瑕疵问题。相关租赁房产非发行人主要经营生产场所，并且所在地租赁市场成熟，若发生无法继续承租相关租赁房产的情形，可较为便捷地寻找到可替代的租赁房产，不会对发行人的持续经营构成重大不利影响。

虽然发行人控股股东东骏投资已承诺：“若因本次发行上市前租赁的房产存在权属瑕疵等情形导致莱普科技及其控股子公司、分公司无法继续按租赁协议约定租赁使用该等房产，或被相关主管部门处以行政处罚，东骏投资将自愿承担莱普科技因此遭受的损失”，但相关瑕疵仍存在影响发行人及分子公司继续承租和使用租赁房产的风险。

## （二）技术风险

### 1、技术迭代的风险

公司下游的晶圆制造产业具备制程持续演进、工艺不断迭代升级的特点。为满足下游客户高速迭代的工艺需求，公司在与境内领先晶圆厂客户和专业科研机构保持密切技术信息交流的基础上，结合半导体制造技术演化态势确立创新性激光半导体工艺方向并执行开发工作，同时持续升级更新设备研制相关的光学、机械、电气、软件算法相关的全流程核心技术体系。

公司需要在现有的全流程核心技术体系下，进一步实现创新性半导体工艺、核心光路结构、核心零部件等相关核心技术的积累，通过长期的研发投入和技术创新，保持技术先进性和产品竞争力。若公司产品及技术研发升级节奏无法满足下游客户需求，产品未能及时实现技术迭代，可能导致公司市场竞争力下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。

### 2、核心人员流失的风险

公司半导体激光设备产品具备技术密集性的特征，技术迭代及产品研发高度依赖于高层次的研发人员。公司目前拥有一批在半导体激光设备领域具备丰富经验的研发人员。公司已与上述人员签署保密协议、竞业禁止协议，并向关键人员授予股份。但伴随市场发展，若公司不能持续加强高层次研发人员的引进、培养、激励和保护力度，可能面临技术人才流失、储备不足的局面，使得公司技术迭代及产品研发能力不足，进而导致公司市场竞争力下降。

### 3、核心技术泄露的风险

公司在长期研发生产过程中，已于半导体激光设备领域积累了大量光、机、电、算以及半导体工艺等方面的核心技术及工艺，形成了较高的技术壁垒。公司已通过执行严格的保密措施、与核心技术人员签订保密协议及竞业禁止协议、申请专利保护等方式防止核心技术泄露。但若未来公司出现核心技术信息保管不善、核心研发人员流失等情况，可能导致公司核心技术泄露，进而削弱公司的技术优势。

### （三）财务风险

#### 1、经营业绩波动的风险

报告期各期，公司营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元、28,102.42 万元和 **19,046.49 万元**；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 -920.00 万元、2,177.26 万元、4,834.56 万元和 **718.83 万元**。

半导体设备行业受下游市场需求波动的影响较大。如果未来市场竞争加剧、宏观经济景气度回落或者国家产业政策发生变化，下游客户对相关设备的需求量可能下降。此外，公司将保持对新产品和新技术的高研发投入，相关研发投入短期内将对公司经营业绩造成一定的影响。在以上因素影响下，不排除未来公司经营业绩出现波动甚至亏损的风险。

#### 2、毛利率发生波动的风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 42.50%、44.55%、54.82%和 **51.74%**。公司基于半导体晶圆制造、芯片封装等领域用户对先进激光技术的需求，形成了激光热处理设备和专用激光加工设备两类主要产品。公司的毛利率水平主要取决于收入结构及市场竞争格局的变化。

如果未来公司不能把握下游市场需求并持续提升产品性能，或因下游客户需求下降、行业竞争加剧等因素导致主要产品价格下降，抑或公司成本控制能力下降，均可能导致公司毛利率下降。

#### 3、应收账款金额较高及发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 3,776.53 万元、4,726.18 万元、11,173.87 万元和 **7,815.95 万元**，占各期末流动资产的比例分别为 17.42%、8.60%、17.34%和 **10.77%**。伴随公司经营规模的扩大，公司应收账款金额可能进一步增加。如果公司无法及时收回货款，将对公司生产经营造成不利影响。

#### 4、收入季节性波动的风险

受下游半导体制造行业客户年度预算、资本性支出波动及客户验收周期等因素的影响，公司第四季度主营业务收入金额及占比较高。2022-2024 年，公司第四季度主营业务收入分别为 2,589.17 万元、7,840.32 万元和 18,889.07 万元，占



全年主营业务收入的比例分别为 35.88%、42.05%和 67.96%。预计未来一定期间内，影响公司收入季节性波动的因素将持续存在。

## 5、存货跌价的风险

伴随公司经营规模的扩大，公司存货规模有所增长。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 9,043.63 万元、13,334.44 万元、18,472.20 万元和 **27,895.87 万元**，占各期末流动资产的比例分别为 41.72%、24.27%、28.67%和 **38.45%**，存货跌价准备计提比例分别为 1.81%、2.83%、3.18%和 **5.53%**。

如果未来公司产品销售价格下降，或发出商品未被客户验收而退回，可能导致部分存货出现跌价风险，进而影响公司的盈利水平。

## 6、经营活动产生的现金流量净额波动的风险

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,827.26 万元、-3,272.37 万元、3,202.59 万元和 **4,626.66 万元**。

由于半导体设备前期生产需投入大量资金且公司持续保持较高的研发投入，公司对营运资金的需求较高。伴随公司经营规模的扩大，公司对营运资金的需求进一步增加。如果客户出现未按时付款的情况，可能影响公司的资金周转及使用效率，进而导致公司出现营运资金不足的风险。

## 7、政府补助及税收优惠政策变动的风险

报告期各期，公司计入损益的政府补助金额分别为 42.99 万元、90.29 万元、591.58 万元和 **133.60 万元**，占各期利润总额的比例分别为-3.62%、3.61%、10.78%和 **22.42%**；公司享受的税收优惠金额分别为 187.43 万元、816.54 万元、1,622.75 万元和 **665.59 万元**，占各期利润总额的比例分别为-15.78%、32.65%、29.57%和 **111.68%**。如果公司未来不能持续获得政府补助、或未能持续获得高新技术企业资质认定、或国家相关税收优惠政策发生变化，公司可能面临因政府补助或税收优惠金额减少而降低盈利水平的风险。

## 8、2025 年度业绩下滑的风险

根据 2025 年度审阅报告，公司 2025 年度的经营业绩情况及其与上年同期的对比情况如下：

单位：万元

| 项目                     | 2025 年度   | 2024 年度   | 变动比例    |
|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入                   | 35,045.78 | 28,102.42 | 24.71%  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 7,230.39  | 5,564.28  | 29.94%  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 4,085.47  | 4,834.56  | -15.49% |

2025 年度，由于“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房转固，折旧摊销费大幅上升等原因，公司 2025 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2024 年度下降 15.49%。公司 2025 年度经营业绩的具体情况与分析详见本招股说明书“第二节 概览”之“七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”之“（二）2025 年经营业绩情况”。

（四）法律风险

1、诉讼及知识产权争议的风险

半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，公司激光系列半导体设备的研发和制造是一项融合机械、化学、电子、信息、材料和能源等多学科尖端技术的复杂过程，技术壁垒较高，涉及的知识产权领域广泛、数量众多，因此对技术壁垒及知识产权的维护尤为重要。公司尊重知识产权，重视对自主知识产权的保护，建立了科学、独立、完整的研发体系和完善的知识产权保护体系，并对核心技术均申请了专利保护。但仍不能排除未来公司与竞争对手产生知识产权纠纷的可能，亦不能排除公司知识产权被侵犯的可能，进而可能对公司的生产经营造成不利影响。此外，半导体产业链上下游供应商与客户合作过程也可能会受知识产权争议、诉讼等因素影响，进而间接影响公司正常的生产经营。

2、产品质量纠纷的风险

公司激光热处理设备与专用激光加工设备两大产品序列，已广泛应用于 12 英寸集成电路产线、先进封装产线，属于半导体产业链中至关重要的环节，下游客户对公司产品的质量及可靠性要求较高。如果公司未能有效执行产品质量控制制度，可能造成公司产品质量缺陷，导致客户损失，进而引发客户退货、索赔、诉讼等不利后果，并对公司的市场竞争力和声誉造成不利影响。

## （五）募集资金投资项目风险

### 1、市场风险

公司本次募集资金拟用于晶圆制造设备开发与制造中心项目、先进封装设备开发与制造中心项目、研发中心及信息化建设项目、研发、技术支持与营销网络建设项目、补充流动资金。虽然公司本次募集资金投资项目已经过充分、审慎的可行性研究论证，但该可行性研究系基于当前的产业政策、市场环境和发展趋势等因素作出。未来在公司实施募集资金投资项目过程中，可能面临产业政策调整、行业技术发展趋势变化、市场环境变动等诸多不确定性，进而导致公司本次募集资金投资项目的实际效益与可行性研究报告存在一定差异。

### 2、实施风险

本次募集资金投资项目为公司基于实际经营状况确定，公司已对各项目的经济效益进行了合理测算。公司认为本次募集资金投资项目的实施将有助于在现有产品序列的基础上进一步扩大经营规模，并提升公司新品开发质量和效率，优化对客户响应需求的时效性，从而强化公司对下游制造业的支撑作用。但如果宏观经济、产业政策、市场竞争格局发生重大变化，或募投项目实施后市场开拓不力、研发进展不及预期，均可能对募投项目的实施效果或实施进度造成不利影响。

## 二、与行业相关的风险

### （一）市场竞争风险

公司立足于先进精密激光技术，致力于以激光工艺半导体设备满足集成电路先进制程、三维堆叠、异构集成等前沿领域的应用需求。受益于近年来半导体设备的稳定供应需求，公司已助力多家知名半导体厂商实现最新一代半导体产品量产，已在我国激光工艺半导体设备市场竞争中占据了一定的市场份额，建立起了一定的竞争优势。但不排除未来其他新晋竞争对手进入激光工艺半导体设备领域，或是快速热处理等领域的供应商开拓激光工艺半导体设备产品品类并与公司在先进制程、三维堆叠、异构集成等相关工艺环节展开直接竞争。如果竞争对手开发出更具有市场竞争力的产品，或者提供更好的价格及服务，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等会受到不利影响。

## （二）宏观经济及行业景气度波动的风险

公司主要从事半导体领域激光设备的开发，处于半导体产业链上游环节。公司产品需求受到产业链下游**存储芯片、逻辑芯片、功率芯片等领域晶圆制造厂商的资本性支出及 AIGC、数据中心、消费电子、新能源、轨道交通等终端领域需求变动**的影响。若宏观经济在未来出现波动，或由于经济景气度下降导致终端投资需求减弱，相关影响将会传导至公司所处的产业链环节，并对公司的经营业绩造成不利影响。

## （三）产业政策变化的风险

公司所处的集成电路产业，作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。近年来，我国出台了一系列鼓励政策，以推动我国集成电路及其装备制造业的发展，增强了集成电路产业的创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，公司在生产经营、对外融资等方面可能会面临更多困难，将对公司发展造成一定的不利影响。

## （四）国际贸易摩擦加剧影响公司供应链安全的风险

半导体先进激光工艺设备属于高精密的自动化装备，对产品机械结构的精度和材质要求较高，研发和生产均需使用多种精密元器件。

由于我国半导体产业起步较晚，部分精密元器件的产业配套仍然不够成熟。公司部分核心零部件仍然从国外采购。受当前国际局势变动影响，国际贸易摩擦多发。若国际贸易摩擦进一步加剧，公司部分供应商受国际形势及相关政策的影响，可能减少或者停止对公司零部件的供应。这将在一定程度上约束公司的生产能力、生产进度和交货时间，进而对公司生产经营造成不利影响。

# 三、其他风险

## （一）发行人实际控制人存在大额对外担保的风险

截至 2026 年 2 月 25 日，发行人实际控制人叶向明、毛冬对东骏电器、汉邦能源等其控制企业以外的第三方提供的担保债务本金余额为 7.36 亿元，相关债务情况如下：

| 序号 | 债务人/<br>被担保人 | 债权人                                         | 担保债务<br>最高限额/<br>总额<br>(亿元) | 担保债务<br>本金余额<br>(亿元) | 主债务<br>期限           | 叶向明、<br>毛冬担<br>保性质 | 主债务增信措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 东骏电器         | 中国农业银行<br>股份有限公司<br>东莞分行、东<br>莞银行股份有<br>限公司 | 6.00                        | 5.52                 | 2020.6.17-2030.6.16 | 连带责<br>任保证         | <p>(1) 由东莞市东骏集团有限公司、曾滔勇、何剑雄、叶向明、毛冬提供连带责任保证；</p> <p>(2) 东骏电器本项债务贷款资金专用于建设“东骏广场项目”，该项目为位于广东省东莞市的商业、办公楼，本项债务由东骏电器以“东骏广场项目”所在地的土地使用权提供抵押担保；</p> <p><b>(3) 由东莞市立志贸易有限公司、德雄发展有限公司以其分别持有的东骏电器 76.79%、23.21%股权提供质押担保，合同载明的质押财产暂作价分别为 53,320.00 万元、16,112.00 万元；</b></p> <p>(4) 由东骏电器以“东骏广场项目”合计 4.21 万平方米的房产提供抵押担保，合同载明的抵押房产暂作价合计约 8.02 亿元。</p> |
| 2  | 汉邦能源         | 东莞农村商业<br>银行股份有限公司中心支行/<br>东联支行             | 3.96                        | 1.84                 | 2018.9.20-2026.9.19 | 连带责<br>任保证         | <p>(1) 由东莞市东骏集团有限公司、广东南峰集团有限公司、东莞市兴业投资有限公司、曾滔勇、叶向明、毛冬、王君扬、谭金荣、谭炜樑、深圳市思贝克集团有限公司、洪小佳、深圳美佳华实业有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保；</p> <p>(2) 由东莞市嘉济实业投资有限公司、汉邦投资集团有限公司以其分别持有的汉邦能源 60.00%、40.00%股权提供质押担保，合同载明的质押财产暂作价分别为 5,209.00 万元、3,472.00 万元；</p> <p>(3) 由汉邦能源以其名下位于东莞市沙田镇的油罐、管道提供抵押担保，合同载明的抵押物暂作价 2,165.78 万元；</p>                                     |

| 序号 | 债务人/<br>被担保人 | 债权人 | 担保债务<br>最高限额/<br>总额<br>(亿元) | 担保债务<br>本金余额<br>(亿元) | 主债务<br>期限 | 叶向明、<br>毛冬担<br>保性质 | 主债务增信措施                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------|-----|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |     |                             |                      |           |                    | (4) 由汉邦能源以其名下位于东莞市沙田镇的土地使用权提供抵押担保，合同载明的抵押物暂作价 5.74 亿元；<br>(5) 由汉邦能源提供质押担保，质押标的为位于东莞市沙田镇阁西村百亩村民小组项目在租赁有效期限内的租金收益权，合同载明的上述出质权利的评估价值为 6.85 亿元；<br>(6) 汉邦能源与债权人签订《物业权证托管及物业处置协议》，约定将相关财产权证交由债权人保管并提供相关债务担保，该等担保财产对应的担保债权最高限额为 2.85 亿元。 |
| 合计 |              |     | 9.96                        | 7.36                 |           |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |

注：（1）就第一项东骏电器相关担保，主债务合同约定的贷款提款期为 2020 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 16 日；发行人实际控制人提供的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年；主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日起三年。（2）就第二项汉邦能源相关担保，主债务合同约定贷款期间和最高贷款限额内债务人可循环使用贷款额度；发行人实际控制人提供的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。（3）就第二项汉邦能源相关担保，2018 年 9 月汉邦能源与东莞农村商业银行股份有限公司中心支行签订了主债务合同，并于 2024 年 5 月与东莞农村商业银行股份有限公司东联支行就上述主债务合同签订了调整还款方式的《补充协议》，约定还款方式调整为 2024 年 4 月至 6 月按季付息、2024 年 6 月归还本金不少于 5 万元、2024 年 7 月至 11 月按月付息、2024 年 12 月起按月分期还本付息；根据中国人民银行征信中心 2025 年 12 月 3 日开具的汉邦能源《企业信用报告》（NO. 2025120315351052383133），截至 2025 年 12 月 3 日，汉邦能源相关债务最近一次还款日期为 2024 年 8 月 9 日，未按上述《补充协议》约定的方式还款。汉邦能源根据与债权人的友好协商，于 2026 年 1 月 5 日偿还贷款本息 4.01 万元，其中本金 4.00 万元。



就上述叶向明、毛冬为东骏电器提供担保的债务，东骏电器贷款资金专项用于建设东骏广场项目。东骏广场项目为位于广东省东莞市南城街道的商业、办公楼，其1号楼已取得《现售备案证书》（莞商房现证第202400211号）、2号楼已取得《预售许可证》（东莞商房预证字第202300102号）。

2020年4月，东骏电器担保债务主债权人之一的农业银行与东骏电器签署《商业、办公楼买卖意向书》，根据该意向书，农业银行有意购买东骏广场2号楼作为营业大楼，双方同意以先签署意向书再签署正式合同的方式进行房产转让，并约定在东骏广场的设计、建设过程中，双方共同参与并友好协商。

农业银行于2025年9月17日发布《中国农业银行股份有限公司东莞分行业务经营用房购置项目报名公告》，根据上述公告，农业银行拟采购业务经营用房，要求房产位于东莞市主城区，用途为办公、商业，建筑面积约2.40-2.60万平方米，报名截止日期为2025年9月21日。根据东骏电器说明，东骏广场项目房产各项指标均符合农业银行的采购要求并已完成报名；如果东骏电器成为农业银行上述业务经营用房购置项目选定的供应商，相关交易完成后，东骏电器将使用房产销售款偿还相关债务，发行人实际控制人担保责任将相应消减。

由于农业银行前述业务经营用房采购程序推进较为缓慢，东骏电器已于2025年10月向东莞市第一人民法院提起诉讼，诉请农业银行履行《商业、办公楼买卖意向书》合同义务并赔偿东骏电器的损失。根据东骏电器说明，由于农业银行广东省分行已将东骏广场2号楼采购方案报送总行审批，东骏电器于2025年12月31日以“双方有长期合作关系”、“争议事实较为清楚”、“节约司法资源”为由向受理法院申请诉中调解，请求给予2个月调解期限。2026年3月9日，东莞市第一人民法院出具“（2025）粤1971民初72112号”《通知书》，该《通知书》载明：“原告东莞东骏电器有限公司与被告中国农业银行股份有限公司东莞分行商品房预售合同纠纷一案，被告中国农业银行股份有限公司东莞分行向本院提交延长调解期限申请书，提出其‘一直积极向上级推进案涉办公楼购置项目审批流程，目前该项目的审批流程已由省行提交至总行，双方同意继续等待总行审批结果’，原告亦向本院申请延长调解期限，因此，对原告、被告双方申请延长调解期限，本院予以准许”。截至本招股说明书签署日，东骏电器与农业银行上述诉讼案件仍处于调解阶段。

除公司股权外，发行人实际控制人叶向明、毛冬的其他资产主要包括两人通过东骏投资持有的东骏激光 63.44%股权以及其他一级市场投资、房产、个人理财等。就叶向明、毛冬提供担保事项，两人承诺：“截至 2026 年 3 月 18 日，本人及本人的关联方未收到主债权人提出的任何要求承担担保责任的主张，无论该等主张是书面或其他形式。如因主债务人迟延履行主债务或其他违约事项导致主债权人主张本人对担保债务承担连带保证责任，本人将立即针对相关事项采取包括但不限于转让除东骏投资、莱普科技股权之外的其他资产（含东骏投资持有的东骏激光股权）等积极措施，并使用其他资产或其他自筹资金偿还担保债务，以避免相关违约事项对莱普科技造成不利影响，确保莱普科技的控制权稳定性”。

虽然发行人实际控制人叶向明、毛冬已作出上述承诺，但鉴于相关担保的主债务本金余额较大，如果担保债务逾期未偿还，主债权人主张叶向明、毛冬承担连带保证责任，而两人未能及时清偿担保债务，则存在两人持有的发行人控股股东东骏投资的股权被主债权人申请冻结、甚至被司法强制执行的风险。

## （二）股东特殊权利恢复的风险

公司历史上融资引入外部投资人股东时，约定了股份回购权等特殊权利条款。2025 年 6 月 10 日，公司与相关股东签订了《<关于成都莱普科技股份有限公司之全体股东协议书>之补充协议》，约定自公司提交的首次公开发行上市申请材料被正式受理（以交易所出具受理函之日为准）之日起，2023 年 12 月 18 日《全体股东协议书》中约定的股份回购权等特殊权利条款立即终止，但附有恢复生效条款。

公司若未能成功上市，部分股东可能会要求回购义务人回购其持有的公司股份，届时公司将面临股权结构可能发生变化的风险。

## （三）预测性陈述存在不确定性的风险

本招股说明书刊载有若干预测性陈述，涉及公司所处行业的未来市场需求及公司未来发展规划、业务发展目标、财务状况、盈利能力、现金流量等方面的预期或讨论，上述预测性陈述能否实现仍存在不确定性。鉴于该等不确定因素的存在，本招股说明书所刊载的任何预测性陈述不应视为公司的承诺或声明。

## （四）发行风险

### 1、发行失败的风险

公司本次公开发行股票拟在上海证券交易所科创板上市，发行结果将受到公开发行人时证券市场整体情况、公司经营业绩、半导体设备行业景气度、公司发展前景及投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。

根据相关法规的要求，若本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量不足，或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的，本次发行应当中止。若发行人中止发行上市审核程序超过交易所规定的时限，或者中止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复，抑或存在其他影响发行的不利情形，可能导致本次发行失败。

### 2、本次发行摊薄即期回报的风险

本次发行后，公司资本实力将得到增强，净资产大幅增加。但由于募集资金投资项目从建设到达产、实现效益需要一定周期，无法立即释放预期效益。因此，发行当年公司的每股收益及净资产收益率受股本摊薄影响可能出现下降，进而导致公司即期回报被摊薄。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 中文名称             | 成都莱普科技股份有限公司                 |
| 英文名称             | Chengdu LasTop Tech Co.,Ltd. |
| 注册资本             | 4,818.00 万元                  |
| 法定代表人            | 叶向明                          |
| 有限公司成立日期         | 2003 年 12 月 22 日             |
| 股份公司成立日期         | 2021 年 9 月 1 日               |
| 公司住所             | 成都高新区康强三路 179 号              |
| 邮政编码             | 611730                       |
| 联系电话             | 028-88556028                 |
| 传真号码             | 028-85222347                 |
| 互联网网址            | http://www.la-ap.com         |
| 电子邮箱             | dshbgs@la-ap.com             |
| 负责信息披露和投资者关系的部门  | 董事会办公室                       |
| 信息披露和投资者关系负责人、电话 | 唐昊、028-88556028              |

### 二、发行人设立情况

发行人是由莱普有限整体变更设立的股份有限公司。

#### （一）有限公司设立情况

##### 1、莱普有限设立情况

2003 年 12 月 2 日，东骏激光有限、曾滔勇签署公司章程，设立莱普有限，公司注册资本 500.00 万元，东骏激光有限、曾滔勇分别出资 450.00 万元、50.00 万元。

2003 年 12 月 12 日，四川正则会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（川正验字（2003）字 078 号），审验确认，截至 2003 年 12 月 11 日，莱普有限合计收到 500.00 万元出资款项，均为货币出资。

2003 年 12 月 22 日，莱普有限取得成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：5101091001475）。

莱普有限成立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称   | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------|---------|---------|
| 1  | 东骏激光有限 | 450.00  | 90.00   |
| 2  | 曾滔勇    | 50.00   | 10.00   |
| 合计 |        | 500.00  | 100.00  |

## 2、莱普有限设立时存在的股权代持及后续解决情况

莱普有限设立时适用的《公司法》（1999 年修正）第二十条规定：“有限责任公司由二个以上五十个以下股东共同出资设立”。为完成工商登记注册程序，在设立莱普有限时由曾滔勇代东骏激光有限持有莱普有限 50.00 万元出资额所对应的股权，曾滔勇的出资实际来自东骏激光有限，东骏激光有限为莱普有限设立时事实上唯一的股东。

2008 年 4 月 28 日，莱普有限召开股东会作出决议，同意曾滔勇将其持有的莱普有限 50.00 万元出资额转让给东骏激光有限；2008 年 4 月 30 日，曾滔勇与东骏激光有限签订《股权转让协议》，并于 2008 年 6 月 3 日完成工商变更登记。本次转让完成后，上述股权代持关系解除。

对于上述股权代持及解除事项，东骏激光和曾滔勇均已确认：双方股权代持事项已经解除，双方对上述股权代持及解除事项不存在纠纷、争议或潜在纠纷、争议。

## （二）股份公司设立情况

### 1、莱普科技设立情况

2021 年 8 月 10 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中汇会审[2021]6547 号），确认截至 2021 年 6 月 30 日，莱普有限经审计的净资产为 11,193,232.12 元。2021 年 8 月 11 日，中水致远资产评估有限公司出具《成都莱普科技有限公司拟进行股改涉及成都莱普科技有限公司审计后净资产市场价值评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第 030058 号），确认截至 2021 年 6 月 30 日，莱普有限净资产评估价值为 1,140.24 万元。

2021 年 8 月 11 日，莱普有限召开股东会作出决议，同意莱普有限整体变更为股份有限公司。莱普有限以截至 2021 年 6 月 30 日经审计的净资产 11,193,232.12

元为基础，折合为 10,000,000.00 股股份，每股面值 1.00 元，净资产超过股本部分计入资本公积。同日，莱普有限全体股东东骏投资、东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰和东莞天戈签订了发起人协议。

2021 年 8 月 20 日，莱普科技召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于成都莱普科技股份有限公司筹建工作报告的报告》《关于成都莱普科技股份有限公司整体变更设立成都莱普科技股份有限公司的议案》等议案，同意上述整体变更设立股份有限公司相关事项。

2021 年 9 月 1 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《成都莱普科技股份有限公司（筹）验资报告》（中汇会验[2021]第 6976 号），对发行人整体变更设立股份有限公司的出资情况进行了审验。

2021 年 9 月 1 日，莱普科技取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101007559792882）。

莱普科技设立时，各发起人持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 东骏投资 | 990.00   | 99.00   |
| 2  | 东莞聚慧 | 3.00     | 0.30    |
| 3  | 东莞天戈 | 3.00     | 0.30    |
| 4  | 东莞莱普 | 3.00     | 0.30    |
| 5  | 东莞骏峰 | 1.00     | 0.10    |
| 合计 |      | 1,000.00 | 100.00  |

## 2、整体变更过程中的瑕疵及整改情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会审[2021]6547 号），截至 2021 年 6 月 30 日莱普有限净资产为 11,193,232.12 元。莱普有限整体变更为股份公司时，全体发起人以莱普有限 11,193,232.12 元净资产为基础，按照 1.1193：1 的比例折合股份 10,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，共计股本 10,000,000.00 元投入整体变更后的股份公司。

2023 年 12 月 28 日，为弥补公司在改制之时的账面净资产与实际金额可能存在的差异，公司发起人东骏投资、东莞聚慧、东莞天戈、东莞莱普、东莞骏峰以自有货币资金按莱普有限整体变更时各自持股比例向公司补足支付差额共计



1,000.00 万元，上述各方均同意按审计机构最终确定的金额执行实际补差。

2025 年 4 月 10 日，致同会计师出具《成都莱普科技股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日净资产专项审计报告》（致同审字（2025）第 510C010075 号）。根据该报告，截至 2021 年 6 月 30 日，莱普有限净资产值为 4,307,135.46 元。

发行人分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第六次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发起人股东以现金补足股改净资产的议案》，该议案内容主要如下：为解决因会计追溯调整引起的股份公司整体变更时净资产额低于实收股本问题、确保公司资本充实，公司发起人股东已于 2023 年 12 月 28 日以自有货币资金按股改时各自持股比例向公司支付了人民币 1,000.00 万元。根据致同会计师出具的《成都莱普科技股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日净资产专项审计报告》（致同审字（2025）第 510C010075 号），公司截至 2021 年 6 月 30 日的净资产值为 4,307,135.46 元，公司发起人股东于 2023 年 12 月 28 日向公司支付的 1,000.00 万元全部用于弥补公司整体变更时注册资本与致同会计师确认的公司截至 2021 年 6 月 30 日净资产 4,307,135.46 元之间的差额，超出部分计入公司资本公积。

2025 年 8 月 8 日，致同会计师出具《成都莱普科技股份有限公司验资复核报告》（致同专字（2025）第 510A018567 号），对本次股改出资进行了验资复核。

莱普科技系通过莱普有限整体变更的方式设立的股份公司，莱普有限的债权债务由改制后成立的莱普科技承继，不存在通过调整自身资产或者资产转移等行为侵害债权人合法利益的情形。

根据发行人于 2025 年 4 月 2 日取得的《市场主体专用信用报告（无违法违规证明版）》（CX20250402000044）及 2026 年 2 月 5 日取得的《经营主体专项信用报告（有无违法违规记录证明版）》（CX20260205000018）：莱普科技自整体变更为股份公司至报告期末，未受到过市场监管部门的行政处罚、未被纳入经营异常名录、未被列入市场监管严重违法失信名单。

根据莱普有限变更为股份有限公司之时适用的《公司法》的相关规定：“有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产

额”。莱普有限在整体变更为股份公司之后，基于公司自查并经注册会计师审定、验证，公司改制时的实收股本总额高于当时的净资产。上述事项系会计追溯调整的原因所致，不属股东抽逃资金行为；发行人前身的资产、业务、债权、债务全部由股份公司承继，至今未发生受到债权人追偿债务或质疑偿债能力的情形、未受工商行政管理机关行政处罚；公司全体发起人已按照股改时持股比例向发行人补足了差额并获得公司股东大会认可。

综上所述，截至本招股说明书签署日，发行人已通过发起人以货币资金补足差额的方式解决了因会计追溯调整引起的整体变更时净资产额不足问题，相关事项已经过发行人董事会、股东大会审议通过，发行人会计师已对发行人股东出资情况进行验资复核。莱普科技股改时的出资瑕疵已经整改完毕，对发行人本次发行不构成实质障碍。

### 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况

报告期内，发行人共进行了 3 次增资和 3 次股权转让，简要情况如下：

| 序号 | 时间          | 事项                                                                                                                                  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2022 年 8 月  | 报告期内第一次增资，注册资本由 3,000.00 万元增加至 3,400.00 万元，新增注册资本由东莞普英认缴。                                                                           |
| 2  | 2023 年 3 月  | 报告期内第二次增资，注册资本由 3,400.00 万元增加至 4,200.00 万元，新增注册资本由厦门石普、广州山立、青岛琮碧、全德学镂科芯、华西金智、鼎创一号、泰达恒鼎、青岛勤芯、全德学四专芯、西藏芯前沿、鼎创二号、金智莱鑫认缴。               |
| 3  | 2023 年 8 月  | 报告期内第一次股权转让，注册资本未发生变化，发行人股东东莞莱普、东莞普英、东莞天戈向成都高投、浦东海望合计转让 75.00 万股股份。                                                                 |
| 4  | 2023 年 9 月  | 报告期内第二次股权转让，注册资本未发生变化，发行人股东东莞普英向东莞莱普转让 68.00 万股股份。                                                                                  |
| 5  | 2023 年 12 月 | 报告期内第三次增资、第三次股权转让，注册资本由 4,200.00 万元增加至 4,818.00 万元，新增注册资本由国家集成电路基金二期、长存产投、余姚石溪认缴；发行人股东东莞普英向上海浦宸、无锡国联、徐林仙、淄博君恒和蓉创投资合计转让 100.00 万股股份。 |

#### （一）发行人报告期初股权结构

截至 2022 年 1 月 1 日，发行人股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 东骏投资 | 1,290.00 | 43.00   |
| 2  | 东莞莱普 | 540.00   | 18.00   |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 3  | 东莞聚慧 | 480.00   | 16.00   |
| 4  | 东莞骏峰 | 360.00   | 12.00   |
| 5  | 东莞天戈 | 330.00   | 11.00   |
| 合计 |      | 3,000.00 | 100.00  |

## （二）2022 年 8 月，发行人报告期内第一次增资

2022 年 7 月 5 日，莱普科技召开 2022 年第一次临时股东大会，同意公司股本总额增加 400.00 万股至 3,400.00 万股，全部由东莞普英认购。东莞普英为发行人当时的全体股东按照其各自持有的发行人股份比例认缴出资设立的有限合伙企业。本次增资时，东莞普英的出资结构如下：

| 序号 | 出资人姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 合伙人类别 |
|----|-------|---------|---------|-------|
| 1  | 东骏投资  | 258.00  | 43.00   | 普通合伙人 |
| 2  | 东莞莱普  | 108.00  | 18.00   | 有限合伙人 |
| 3  | 东莞聚慧  | 96.00   | 16.00   | 有限合伙人 |
| 4  | 东莞骏峰  | 72.00   | 12.00   | 有限合伙人 |
| 5  | 东莞天戈  | 66.00   | 11.00   | 有限合伙人 |
| 合计 |       | 600.00  | 100.00  | -     |

本次增资价格为 1.50 元/股，增资金额 600.00 万元，全部由东莞普英以货币形式出资。

2022 年 8 月 4 日，莱普科技取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101007559792882）。

本次变更完成后，莱普科技的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 东骏投资 | 1,290.00 | 37.94   |
| 2  | 东莞莱普 | 540.00   | 15.88   |
| 3  | 东莞聚慧 | 480.00   | 14.12   |
| 4  | 东莞普英 | 400.00   | 11.76   |
| 5  | 东莞骏峰 | 360.00   | 10.59   |
| 6  | 东莞天戈 | 330.00   | 9.71    |
| 合计 |      | 3,400.00 | 100.00  |

### （三）2023 年 3 月，发行人报告期内第二次增资

2022 年 12 月 1 日，莱普科技召开 2022 年第二次临时股东大会，同意公司股本总额增加 800.00 万股至 4,200.00 万股，由厦门石普、广州山立、青岛琮碧、全德学镂科芯、华西金智、鼎创一号、泰达恒鼎、青岛勤芯、全德学四专芯、西藏芯前沿、鼎创二号、金智莱鑫分别认购 148.00 万股、148.00 万股、111.00 万股、110.00 万股、65.50 万股、54.00 万股、45.00 万股、39.00 万股、38.00 万股、19.00 万股、17.00 万股、5.50 万股。

2022 年 12 月 12 日，增资各方与莱普科技签订了《股份认购协议》，由厦门石普、广州山立、青岛琮碧、全德学镂科芯、华西金智、鼎创一号、泰达恒鼎、青岛勤芯、全德学四专芯、西藏芯前沿、鼎创二号、金智莱鑫以货币形式合计出资 21,600.00 万元，增资价格为 27.00 元/股。

2023 年 3 月 24 日，莱普科技取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101007559792882）。

本次变更完成后，莱普科技的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称   | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|--------|----------|---------|
| 1  | 东骏投资   | 1,290.00 | 30.71   |
| 2  | 东莞莱普   | 540.00   | 12.86   |
| 3  | 东莞聚慧   | 480.00   | 11.43   |
| 4  | 东莞普英   | 400.00   | 9.52    |
| 5  | 东莞骏峰   | 360.00   | 8.57    |
| 6  | 东莞天戈   | 330.00   | 7.86    |
| 7  | 厦门石普   | 148.00   | 3.52    |
| 8  | 广州山立   | 148.00   | 3.52    |
| 9  | 青岛琮碧   | 111.00   | 2.64    |
| 10 | 全德学镂科芯 | 110.00   | 2.62    |
| 11 | 华西金智   | 65.50    | 1.56    |
| 12 | 鼎创一号   | 54.00    | 1.29    |
| 13 | 泰达恒鼎   | 45.00    | 1.07    |
| 14 | 青岛勤芯   | 39.00    | 0.93    |
| 15 | 全德学四专芯 | 38.00    | 0.90    |

| 序号 | 股东名称  | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|-------|----------|---------|
| 16 | 西藏芯前沿 | 19.00    | 0.45    |
| 17 | 鼎创二号  | 17.00    | 0.40    |
| 18 | 金智莱鑫  | 5.50     | 0.13    |
| 合计 |       | 4,200.00 | 100.00  |

#### （四）2023 年 8 月，发行人报告期内第一次股权转让

2023 年 7 月 17 日，莱普科技召开 2023 年第二次临时股东大会，同意股东东莞莱普、东莞普英、东莞天戈向成都高投、浦东海望转让总股份数不超过 75.00 万股的莱普科技股份有限公司，转让总金额不超过 2,025.00 万元。

2023 年 8 月 18 日，成都高投和浦东海望分别与东莞莱普、东莞普英、东莞天戈、莱普科技签订了《股权转让协议》，由成都高投出资 1,512.00 万元受让东莞莱普、东莞普英和东莞天戈合计持有的 56.00 万股莱普科技股份有限公司，其中，受让东莞莱普 21.6534 万股、东莞普英 19.4133 万股、东莞天戈 14.9333 万股；由浦东海望出资 513.00 万元受让东莞莱普、东莞普英和东莞天戈合计持有的 19.00 万股莱普科技股份有限公司，其中，受让东莞莱普 7.3466 万股、东莞普英 6.5867 万股、东莞天戈 5.0667 万股；上述股权转让价格为 27.00 元/股。

2023 年 8 月 31 日，莱普科技变更了本次转让后的股东名册。

本次变更完成后，莱普科技股权结构如下：

| 序号 | 股东名称   | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|--------|----------|---------|
| 1  | 东骏投资   | 1,290.00 | 30.71   |
| 2  | 东莞莱普   | 511.00   | 12.17   |
| 3  | 东莞聚慧   | 480.00   | 11.43   |
| 4  | 东莞普英   | 374.00   | 8.90    |
| 5  | 东莞骏峰   | 360.00   | 8.57    |
| 6  | 东莞天戈   | 310.00   | 7.38    |
| 7  | 厦门石普   | 148.00   | 3.52    |
| 8  | 广州山立   | 148.00   | 3.52    |
| 9  | 青岛琮碧   | 111.00   | 2.64    |
| 10 | 全德学镂科芯 | 110.00   | 2.62    |
| 11 | 华西金智   | 65.50    | 1.56    |

| 序号 | 股东名称   | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|--------|----------|---------|
| 12 | 成都高投   | 56.00    | 1.33    |
| 13 | 鼎创一号   | 54.00    | 1.29    |
| 14 | 泰达恒鼎   | 45.00    | 1.07    |
| 15 | 青岛勤芯   | 39.00    | 0.93    |
| 16 | 全德学四专芯 | 38.00    | 0.90    |
| 17 | 西藏芯前沿  | 19.00    | 0.45    |
| 18 | 浦东海望   | 19.00    | 0.45    |
| 19 | 鼎创二号   | 17.00    | 0.40    |
| 20 | 金智莱鑫   | 5.50     | 0.13    |
| 合计 |        | 4,200.00 | 100.00  |

注：成都高投属于国有股东，标识为“SS”，具体详见本节之“十二、发行人股本情况”之“（四）发行人股本中国有股份及外资股份情况”。

### （五）2023年9月，发行人报告期内第二次股权转让

2023年6月28日，莱普科技召开2022年年度股东大会，审议通过了《成都莱普科技股份有限公司第二期股权激励计划》。本次股权激励计划拟授予员工68.00万股股份，股份来源为员工持股平台东莞莱普受让东莞普英持有的公司股份。

2023年7月10日，东莞普英与东莞莱普签订了《股份转让合同》，东莞普英向东莞莱普转让其所持有的莱普科技68.00万股股份，转让价格为1.50元/股，转让价款为102.00万元。

2023年9月25日，莱普科技变更了本次转让后的股东名册。

本次变更完成后，莱普科技股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 东骏投资 | 1,290.00 | 30.71   |
| 2  | 东莞莱普 | 579.00   | 13.79   |
| 3  | 东莞聚慧 | 480.00   | 11.43   |
| 4  | 东莞骏峰 | 360.00   | 8.57    |
| 5  | 东莞天戈 | 310.00   | 7.38    |
| 6  | 东莞普英 | 306.00   | 7.29    |
| 7  | 厦门石普 | 148.00   | 3.52    |



| 序号 | 股东名称   | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|--------|----------|---------|
| 8  | 广州山立   | 148.00   | 3.52    |
| 9  | 青岛琮碧   | 111.00   | 2.64    |
| 10 | 全德学镂科芯 | 110.00   | 2.62    |
| 11 | 华西金智   | 65.50    | 1.56    |
| 12 | 成都高投   | 56.00    | 1.33    |
| 13 | 鼎创一号   | 54.00    | 1.29    |
| 14 | 泰达恒鼎   | 45.00    | 1.07    |
| 15 | 青岛勤芯   | 39.00    | 0.93    |
| 16 | 全德学四专芯 | 38.00    | 0.90    |
| 17 | 西藏芯前沿  | 19.00    | 0.45    |
| 18 | 浦东海望   | 19.00    | 0.45    |
| 19 | 鼎创二号   | 17.00    | 0.40    |
| 20 | 金智莱鑫   | 5.50     | 0.13    |
| 合计 |        | 4,200.00 | 100.00  |

#### （六）2023 年 12 月，发行人报告期内第三次增资、第三次股权转让

2023 年 11 月 29 日，莱普科技召开 2023 年第三次临时股东大会，同意公司股本总额增加 618.00 万股至 4,818.00 万股，由国家集成电路基金二期、长存产投、余姚石溪分别认购 369.00 万股、200.00 万股和 49.00 万股；同意股东东莞普英向不超过 5 名受让方转让合计不低于 100.00 万股的莱普科技股份。

2023 年 12 月 18 日，增资各方与莱普科技及其控股股东、实际控制人共同签订了《股份认购协议》，由国家集成电路基金二期、长存产投、余姚石溪以货币形式合计出资 18,540.00 万元，增资价格为 30.00 元/股。

2023 年 12 月 7 日，东莞普英与上海浦宸、无锡国联、徐林仙、淄博君恒和蓉创投资共同签订了《股份转让协议》，由上海浦宸、无锡国联、徐林仙、淄博君恒和蓉创投资分别出资 999.9990 万元、600.00 万元、600.00 万元、590.0010 万元和 210.00 万元受让东莞普英持有的 33.3333 万股、20.00 万股、20.00 万股、19.6667 万股和 7.00 万股莱普科技股份，转让价格为 30.00 元/股。

2023 年 12 月 21 日，莱普科技取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：915101007559792882）。

2023 年 12 月 28 日，莱普科技变更了本次增资、转让后的股东名册。

本次变更完成后，莱普科技股权结构如下：

| 序号 | 股东名称       | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------------|----------|---------|
| 1  | 东骏投资       | 1,290.00 | 26.77   |
| 2  | 东莞莱普       | 579.00   | 12.02   |
| 3  | 东莞聚慧       | 480.00   | 9.96    |
| 4  | 国家集成电路基金二期 | 369.00   | 7.66    |
| 5  | 东莞骏峰       | 360.00   | 7.47    |
| 6  | 东莞天戈       | 310.00   | 6.43    |
| 7  | 东莞普英       | 206.00   | 4.28    |
| 8  | 长存产投       | 200.00   | 4.15    |
| 9  | 厦门石普       | 148.00   | 3.07    |
| 10 | 广州山立       | 148.00   | 3.07    |
| 11 | 青岛琮碧       | 111.00   | 2.30    |
| 12 | 全德学镂科芯     | 110.00   | 2.28    |
| 13 | 华西金智       | 65.50    | 1.36    |
| 14 | 成都高投       | 56.00    | 1.16    |
| 15 | 鼎创一号       | 54.00    | 1.12    |
| 16 | 余姚石溪       | 49.00    | 1.02    |
| 17 | 泰达恒鼎       | 45.00    | 0.93    |
| 18 | 青岛勤芯       | 39.00    | 0.81    |
| 19 | 全德学四专芯     | 38.00    | 0.79    |
| 20 | 上海浦宸       | 33.33    | 0.69    |
| 21 | 无锡国联       | 20.00    | 0.42    |
| 22 | 徐林仙        | 20.00    | 0.42    |
| 23 | 淄博君恒       | 19.67    | 0.41    |
| 24 | 西藏芯前沿      | 19.00    | 0.39    |
| 25 | 浦东海望       | 19.00    | 0.39    |
| 26 | 鼎创二号       | 17.00    | 0.35    |
| 27 | 蓉创投资       | 7.00     | 0.15    |
| 28 | 金智莱鑫       | 5.50     | 0.11    |
| 合计 |            | 4,818.00 | 100.00  |

注：国家集成电路基金二期属于国有股东，标识为“SS”，具体详见本节之“十二、发行人股本情况”之“（四）发行人股本中国有股份及外资股份情况”。

## 四、发行人成立以来重要事件

自成立以来，发行人不存在重大资产重组情形，亦不存在其他未披露的成立以来重要事件。

## 五、发行人在其他证券市场的挂牌情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在于其他证券市场上市或挂牌情况。

## 六、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：



注：1、叶向明、毛冬为一致行动人；2、东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英为东骏投资的一致行动人。

## 七、发行人子公司及参股公司的情况

截至本招股说明书签署日，莱普科技共有 1 家控股子公司和 1 家分公司，无参股公司。具体情况如下：

### （一）发行人控股子公司情况

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 公司名称    | 江苏莱普激光技术有限公司                             |
| 成立时间    | 2022 年 7 月 18 日                          |
| 注册资本    | 1,000.00 万元                              |
| 实收资本    | 792.45 万元                                |
| 注册地     | 苏州工业园区葑亭大道 502 号泓创科技园 1 号楼 1 楼 101 室     |
| 主要生产经营地 | 苏州工业园区葑亭大道 502 号泓创科技园 1 号楼 1 楼 101 室     |
| 股权结构    | 发行人持股 70.00%，苏州莱普企业管理合伙企业（有限合伙）持股 30.00% |

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 主营业务情况及在发行人业务板块中定位 | 主营业务定位于发行人产品板块中的专用激光加工设备，积极拓展精密电子制造和封装测试领域市场 |
|--------------------|----------------------------------------------|

最近一年及一期，江苏莱普的主要财务数据如下：

单位：万元

| 期间                               | 总资产      | 净资产    | 营业收入   | 净利润     |
|----------------------------------|----------|--------|--------|---------|
| 2025 年 1-9 月/<br>2025 年 9 月 30 日 | 2,037.55 | 135.34 | 665.91 | -151.73 |
| 2024 年度/<br>2024 年 12 月 31 日     | 1,693.64 | 277.11 | 691.41 | -243.74 |

注：发行人合并报表数据已经致同会计师事务所审计，江苏莱普为发行人合并范围内的子公司。

（二）发行人分公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人设立了深圳分公司，具体情况如下：

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 公司名称               | 成都莱普科技股份有限公司深圳分公司                          |
| 成立时间               | 2023 年 3 月 7 日                             |
| 注册地                | 深圳市光明区公明街道下村社区第三工业区 5 号三楼                  |
| 主要生产经营地            | 深圳市光明区公明街道下村社区第三工业区 5 号三楼                  |
| 主营业务情况及在发行人业务板块中定位 | 主营业务定位于发行人产品板块中的专用激光加工设备，积极拓展先进封装领域和华南地区市场 |

八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）发行人控股股东基本情况

截至本招股说明书签署日，东骏投资直接持有公司 1,290.00 万股股份，占本次发行前总股本的 26.77%，为公司控股股东。东骏投资的基本情况如下：

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| 中文名称              | 东莞市东骏投资有限公司                   |
| 成立日期              | 2008 年 9 月 1 日                |
| 注册资本              | 1,380.00 万元人民币                |
| 实收资本              | 1,380.00 万元人民币                |
| 注册地址              | 广东省东莞市南城街道隆溪路 3 号 3 栋 206 室之六 |
| 主要生产经营地           | 广东省东莞市南城街道隆溪路 3 号 3 栋 206 室之六 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 主要从事股权投资，与发行人主营业务无关           |

东骏投资的股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 叶向明  | 690.00   | 50.00   |
| 2  | 毛冬   | 690.00   | 50.00   |
| 合计 |      | 1,380.00 | 100.00  |

东骏投资最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

| 期间                               | 总资产       | 净资产      | 营业收入  | 净利润      |
|----------------------------------|-----------|----------|-------|----------|
| 2025 年 1-9 月<br>/2025 年 9 月 30 日 | 17,899.97 | 3,217.67 | 41.50 | 1,246.00 |
| 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度     | 17,340.58 | 1,971.66 | 45.93 | 1,383.18 |

注：以上财务数据为单体报表口径；2024 年财务数据已经东莞市正盛会计师事务所（普通合伙）审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

（二）发行人实际控制人基本情况

东骏投资直接持有公司 1,290.00 万股股份，占本次发行前总股本的 26.77%，为公司控股股东。东骏投资与东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英签订了一致行动人协议，各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会、董事会作出决议时均应采取一致行动，出现意见不一致时，以东骏投资的意见为准。

截至本招股说明书签署日，叶向明、毛冬分别持有东骏投资 50.00%股权，对东骏投资形成共同控制。叶向明、毛冬合计控制的公司有表决权股份为 3,225.00 万股，占公司有表决权股份总数的 66.94%。2021 年 2 月 20 日，叶向明、毛冬签订了《一致行动人协议》，约定两人在莱普科技股东大会、董事会中保持一致行动，以共同控制公司；在两人无法达成一致意见时，以叶向明意见为准。

综上所述，公司实际控制人为叶向明、毛冬。

1、叶向明的基本情况

叶向明先生，出生于 1960 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，身份证号码为：4403011960\*\*\*\*\*。1993 年 9 月至 2004 年 2 月，担任东骏集团副经理；1995 年 9 月至 2011 年 2 月，担任东骏电器总经理；2008 年 3 月至 2020 年 5 月，担任成都东骏房地产开发有限公司董事；2013 年 12 月至 2019 年 5 月，担任东骏集团执行董事；2014 年 5 月至今，担任东骏激光董事；2020

年4月至今，担任东骏投资总经理；2021年8月至今担任公司董事长。

## 2、毛冬的基本情况

毛冬先生，出生于1958年11月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，身份证号码为：4425271958\*\*\*\*\*。1993年9月至1997年12月，历任东骏集团经理、执行董事；1995年9月至2011年2月，担任东骏电器董事长；2002年11月至今，历任东骏激光董事长、董事；2008年3月至2020年5月，担任成都东骏房地产开发有限公司董事；2020年4月至今，担任东骏投资执行董事；2021年8月至今，担任公司董事。

此外，公司间接股东王晓峰（通过东莞骏峰间接持有发行人股份）、潘岭峰（通过东莞骏峰间接持有发行人股份）、唐昊（通过东莞莱普间接持有发行人股份）与发行人控股股东东骏投资构成《上市公司收购管理办法（2025 修正）》第八十三条第二款第（五）项所述的一致行动。公司间接股东叶玉冰（通过东莞聚慧间接持有发行人股份）、刘钧伟（通过东莞聚慧间接持有发行人股份）、刘嘉桦（通过东莞聚慧间接持有发行人股份）与发行人实际控制人叶向明、毛冬构成《上市公司收购管理办法（2025 修正）》第八十三条第二款第（五）项所述的一致行动，但不构成共同实际控制人。

### （三）控股股东、实际控制人直接或间接持有的发行人股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东东骏投资以及实际控制人叶向明、毛冬直接或间接持有的发行人股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

### （四）其他持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，除控股股东东骏投资外，其他持有发行人5%以上股份或表决权的股东及其一致行动人如下表所示：

| 序号 | 股东名称       | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------------|----------|---------|
| 1  | 东莞莱普       | 579.00   | 12.02   |
| 2  | 东莞聚慧       | 480.00   | 9.96    |
| 3  | 国家集成电路基金二期 | 369.00   | 7.66    |
| 4  | 东莞骏峰       | 360.00   | 7.47    |



| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------|----------|---------|
| 5  | 东莞天戈 | 310.00   | 6.43    |
| 6  | 东莞普英 | 206.00   | 4.28    |
| 合计 |      | 2,304.00 | 47.82   |

注：东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英为发行人控股股东东骏投资的一致行动人。

## 1、东莞莱普

截至本招股说明书签署日，东莞莱普的基本情况如下：

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 企业名称              | 东莞市莱普管理咨询合伙企业（有限合伙）     |
| 成立时间              | 2021年6月2日               |
| 执行事务合伙人           | 黄永忠                     |
| 出资额               | 868.95万元                |
| 注册地               | 广东省东莞市南城街道隆溪路5号3栋520室03 |
| 主要生产经营地           | 广东省东莞市南城街道隆溪路5号3栋520室03 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 发行人员工持股平台，与发行人主营业务无关    |

截至本招股说明书签署日，东莞莱普的合伙人情况如下表所示：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 合伙人类别 | 在发行人处任职情况     |
|----|-------|---------|---------|-------|---------------|
| 1  | 黄永忠   | 253.50  | 29.17   | 普通合伙人 | 董事、总经理、核心技术人员 |
| 2  | 何刘    | 146.25  | 16.83   | 有限合伙人 | 副总经理、核心技术人员   |
| 3  | 郭红    | 60.05   | 6.91    | 有限合伙人 | 财务总监          |
| 4  | 刘辉涛   | 52.55   | 6.05    | 有限合伙人 | 全职员工          |
| 5  | 杨博    | 45.05   | 5.18    | 有限合伙人 | 副总经理          |
| 6  | 刘弘    | 41.25   | 4.75    | 有限合伙人 | 全职员工          |
| 7  | 唐昊    | 37.50   | 4.32    | 有限合伙人 | 副总经理、董事会秘书    |
| 8  | 陈永智   | 30.05   | 3.46    | 有限合伙人 | 全职员工          |
| 9  | 付志良   | 30.00   | 3.45    | 有限合伙人 | 全职员工          |
| 10 | 王德友   | 22.50   | 2.59    | 有限合伙人 | 全职员工          |
| 11 | 潘冬    | 22.50   | 2.59    | 有限合伙人 | 全职员工          |
| 12 | 彭杨    | 16.55   | 1.90    | 有限合伙人 | 全职员工          |
| 13 | 杨春兰   | 16.55   | 1.90    | 有限合伙人 | 全职员工          |
| 14 | 刘文建   | 15.05   | 1.73    | 有限合伙人 | 全职员工          |

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 合伙人类别 | 在发行人处任职情况 |
|----|-------|-------------|-------------|-------|-----------|
| 15 | 刘海志   | 12.00       | 1.38        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 16 | 张满强   | 12.00       | 1.38        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 17 | 刘强    | 10.50       | 1.21        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 18 | 周建芳   | 10.50       | 1.21        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 19 | 刘勇    | 7.55        | 0.87        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 20 | 王国坤   | 7.55        | 0.87        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 21 | 索朝君   | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 22 | 郭朝勇   | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 23 | 龙捷    | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 24 | 钟县英   | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 25 | 徐云    | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 26 | 徐万宇   | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 27 | 薛易    | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 28 | 江柯苇   | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 29 | 赵磊    | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 30 | 杨林森   | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 31 | 董林    | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 32 | 杜培    | 1.50        | 0.17        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 33 | 舒祖刚   | 0.75        | 0.09        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 34 | 陈冬冬   | 0.75        | 0.09        | 有限合伙人 | 全职员工      |
| 合计 |       | 868.95      | 100.00      | -     | -         |

## 2、东莞聚慧

截至本招股说明书签署日，东莞聚慧的基本情况如下：

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 企业名称              | 东莞市聚慧股权投资合伙企业（有限合伙）            |
| 成立时间              | 2021 年 5 月 11 日                |
| 执行事务合伙人           | 叶向忠                            |
| 出资额               | 720.62 万元                      |
| 注册地               | 广东省东莞市南城街道隆溪路 5 号 3 栋 520 室 01 |
| 主要生产经营地           | 广东省东莞市南城街道隆溪路 5 号 3 栋 520 室 01 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 股权投资，与发行人主营业务无关                |

截至本招股说明书签署日，东莞聚慧的合伙人情况如下表所示：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 合伙人类别 | 在发行人处任职情况           |
|----|-------|-------------|-------------|-------|---------------------|
| 1  | 叶向忠   | 225.56      | 31.30       | 普通合伙人 | 无                   |
| 2  | 叶玉冰   | 180.02      | 24.98       | 有限合伙人 | 无                   |
| 3  | 刘钧伟   | 157.52      | 21.86       | 有限合伙人 | 取消监事会前曾任监事会主席，目前无任职 |
| 4  | 刘嘉桦   | 157.52      | 21.86       | 有限合伙人 | 无                   |
| 合计 |       | 720.62      | 100.00      | -     | -                   |

### 3、国家集成电路基金二期

截至本招股说明书签署日，国家集成电路基金二期的基本情况如下：

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 企业名称              | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司         |
| 成立时间              | 2019年10月22日                  |
| 法定代表人             | 张新                           |
| 注册资本              | 20,415,000.00 万元             |
| 实收资本              | 17,935,732.60 万元             |
| 注册地               | 北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6 |
| 主要生产经营地           | 北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 主要从事集成电路产业股权投资，与发行人主营业务无关    |

截至本招股说明书签署日，国家集成电路基金二期的股东情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称                      | 出资额（万元）      | 持股比例（%） |
|----|---------------------------|--------------|---------|
| 1  | 中华人民共和国财政部                | 2,250,000.00 | 11.02   |
| 2  | 国开金融有限责任公司                | 2,200,000.00 | 10.78   |
| 3  | 浙江富浙集成电路产业发展有限公司          | 1,500,000.00 | 7.35    |
| 4  | 武汉光谷金融控股集团有限公司            | 1,500,000.00 | 7.35    |
| 5  | 成都天府国集投资有限公司              | 1,500,000.00 | 7.35    |
| 6  | 中国烟草总公司                   | 1,500,000.00 | 7.35    |
| 7  | 上海国盛（集团）有限公司              | 1,500,000.00 | 7.35    |
| 8  | 重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,400,000.00 | 6.86    |
| 9  | 江苏惠泉集成电路产业投资有限公司          | 1,000,000.00 | 4.90    |
| 10 | 北京国谊医院有限公司                | 1,000,000.00 | 4.90    |
| 11 | 北京亦庄国际投资发展有限公司            | 1,000,000.00 | 4.90    |
| 12 | 中移资本控股有限责任公司              | 1,000,000.00 | 4.90    |

| 序号 | 股东名称                      | 出资额（万元）       | 持股比例（%） |
|----|---------------------------|---------------|---------|
| 13 | 安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）   | 750,000.00    | 3.67    |
| 14 | 安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）    | 750,000.00    | 3.67    |
| 15 | 福建省国资集成电路投资有限公司           | 300,000.00    | 1.47    |
| 16 | 深圳市深超科技集成电路产业投资合伙企业（有限合伙） | 300,000.00    | 1.47    |
| 17 | 广州产业投资基金管理有限公司            | 300,000.00    | 1.47    |
| 18 | 黄埔投资控股（广州）有限公司            | 200,000.00    | 0.98    |
| 19 | 中国电信集团有限公司                | 150,000.00    | 0.73    |
| 20 | 联通资本投资控股有限公司              | 100,000.00    | 0.49    |
| 21 | 广西投资引导基金有限责任公司            | 100,000.00    | 0.49    |
| 22 | 中电金投控股有限公司                | 50,000.00     | 0.24    |
| 23 | 华芯投资管理有限责任公司              | 15,000.00     | 0.07    |
| 24 | 福建三安集团有限公司                | 10,000.00     | 0.05    |
| 25 | 协鑫资本管理有限公司                | 10,000.00     | 0.05    |
| 26 | 北京紫光通信科技集团有限公司            | 10,000.00     | 0.05    |
| 27 | 北京建广私募基金管理有限公司            | 10,000.00     | 0.05    |
| 28 | 上海矽启企业管理合伙企业（有限合伙）        | 10,000.00     | 0.05    |
| 合计 |                           | 20,415,000.00 | 100.00  |

#### 4、东莞骏峰

截至本招股说明书签署日，东莞骏峰的基本情况如下：

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 企业名称              | 东莞骏峰管理咨询合伙企业（有限合伙）      |
| 成立时间              | 2021年6月16日              |
| 执行事务合伙人           | 王晓峰                     |
| 出资额               | 540.50万元                |
| 注册地               | 广东省东莞市南城街道隆溪路3号3栋206室之八 |
| 主要生产经营地           | 广东省东莞市南城街道隆溪路3号3栋206室之八 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 发行人员工持股平台，与发行人主营业务无关    |

截至本招股说明书签署日，东莞骏峰的合伙人情况如下表所示：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 合伙人类别 | 在发行人处任职情况      |
|----|-------|---------|---------|-------|----------------|
| 1  | 王晓峰   | 270.45  | 50.04   | 普通合伙人 | 董事、副总经理、核心技术人员 |

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 合伙人类别 | 在发行人处任职情况   |
|----|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 2  | 潘岭峰   | 270.05      | 49.96       | 有限合伙人 | 副总经理、核心技术人员 |
| 合计 |       | 540.50      | 100.00      | -     | -           |

## 5、东莞天戈

截至本招股说明书签署日，东莞天戈的基本情况如下：

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 企业名称              | 东莞市天戈管理咨询合伙企业（有限合伙）            |
| 成立时间              | 2021 年 6 月 1 日                 |
| 执行事务合伙人           | 傅建伟                            |
| 出资额               | 465.10 万元                      |
| 注册地               | 广东省东莞市南城街道隆溪路 5 号 3 栋 520 室 02 |
| 主要生产经营地           | 广东省东莞市南城街道隆溪路 5 号 3 栋 520 室 02 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 股权投资，与发行人主营业务无关                |

截至本招股说明书签署日，东莞天戈的合伙人情况如下表所示：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 合伙人类别 | 在发行人处任职情况 |
|----|-------|-------------|-------------|-------|-----------|
| 1  | 傅建伟   | 349.50      | 75.15       | 普通合伙人 | 董事        |
| 2  | 周世斌   | 30.00       | 6.45        | 有限合伙人 | 无         |
| 3  | 刘成懿   | 27.00       | 5.81        | 有限合伙人 | 无         |
| 4  | 龚鸣晓   | 16.55       | 3.56        | 有限合伙人 | 无         |
| 5  | 王贵波   | 13.50       | 2.90        | 有限合伙人 | 无         |
| 6  | 黄小林   | 7.50        | 1.61        | 有限合伙人 | 无         |
| 7  | 赖维明   | 6.00        | 1.29        | 有限合伙人 | 无         |
| 8  | 喻彬    | 6.00        | 1.29        | 有限合伙人 | 无         |
| 9  | 陈丽英   | 4.55        | 0.98        | 有限合伙人 | 无         |
| 10 | 罗华斌   | 4.50        | 0.97        | 有限合伙人 | 无         |
| 合计 |       | 465.10      | 100.00      | -     | -         |

## 6、东莞普英

截至本招股说明书签署日，东莞普英的基本情况如下：

|      |                     |
|------|---------------------|
| 企业名称 | 东莞市普英管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2022 年 6 月 27 日     |

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 执行事务合伙人           | 东骏投资                              |
| 出资额               | 309.00 万元                         |
| 注册地               | 广东省东莞市东城街道鸿福东路 1 号国贸中心 1 栋 2411 室 |
| 主要生产经营地           | 广东省东莞市东城街道鸿福东路 1 号国贸中心 1 栋 2411 室 |
| 主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 股权投资，与发行人主营业务无关                   |

截至本招股说明书签署日，东莞普英的合伙人情况如下表所示：

| 序号 | 合伙人名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 合伙人类别 |
|----|-------|---------|---------|-------|
| 1  | 东骏投资  | 104.97  | 33.97   | 普通合伙人 |
| 2  | 东莞莱普  | 69.08   | 22.35   | 有限合伙人 |
| 3  | 东莞聚慧  | 53.46   | 17.30   | 有限合伙人 |
| 4  | 东莞骏峰  | 45.08   | 14.59   | 有限合伙人 |
| 5  | 东莞天戈  | 36.42   | 11.79   | 有限合伙人 |
| 合计 |       | 309.00  | 100.00  | -     |

## 九、发行人特别表决权股份情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排。

## 十、发行人协议控制架构情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构。

## 十一、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为

报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

## 十二、发行人股本情况

### （一）本次发行前的总股本、本次发行的股份，以及本次发行的股份占发行后总股本的比例

本次发行前，公司总股本为 4,818.00 万股，本次拟公开发行新股不超过 1,606.00 万股，不涉及股东公开发售股份，本次发行的股份占发行后公司总股本



的比例不低于 25.00%。发行前后的股本结构如下：

| 序号 | 股东名称       | 本次发行前股本结构    |          | 本次发行后股本结构    |          |
|----|------------|--------------|----------|--------------|----------|
|    |            | 持股数量<br>(万股) | 持股比例 (%) | 持股数量<br>(万股) | 持股比例 (%) |
| 1  | 东骏投资       | 1,290.0000   | 26.7746  | 1,290.0000   | 20.0809  |
| 2  | 东莞莱普       | 579.0000     | 12.0174  | 579.0000     | 9.0131   |
| 3  | 东莞聚慧       | 480.0000     | 9.9626   | 480.0000     | 7.4720   |
| 4  | 国家集成电路基金二期 | 369.0000     | 7.6588   | 369.0000     | 5.7441   |
| 5  | 东莞骏峰       | 360.0000     | 7.4720   | 360.0000     | 5.6040   |
| 6  | 东莞天戈       | 310.0000     | 6.4342   | 310.0000     | 4.8257   |
| 7  | 东莞普英       | 206.0000     | 4.2756   | 206.0000     | 3.2067   |
| 8  | 长存产投       | 200.0000     | 4.1511   | 200.0000     | 3.1133   |
| 9  | 厦门石普       | 148.0000     | 3.0718   | 148.0000     | 2.3039   |
| 10 | 广州山立       | 148.0000     | 3.0718   | 148.0000     | 2.3039   |
| 11 | 青岛琮碧       | 111.0000     | 2.3039   | 111.0000     | 1.7279   |
| 12 | 全德学镭科芯     | 110.0000     | 2.2831   | 110.0000     | 1.7123   |
| 13 | 华西金智       | 65.5000      | 1.3595   | 65.5000      | 1.0196   |
| 14 | 成都高投       | 56.0000      | 1.1623   | 56.0000      | 0.8717   |
| 15 | 鼎创一号       | 54.0000      | 1.1208   | 54.0000      | 0.8406   |
| 16 | 余姚石溪       | 49.0000      | 1.0170   | 49.0000      | 0.7628   |
| 17 | 泰达恒鼎       | 45.0000      | 0.9340   | 45.0000      | 0.7005   |
| 18 | 青岛勤芯       | 39.0000      | 0.8095   | 39.0000      | 0.6071   |
| 19 | 全德学四专芯     | 38.0000      | 0.7887   | 38.0000      | 0.5915   |
| 20 | 上海浦宸       | 33.3333      | 0.6918   | 33.3333      | 0.5189   |
| 21 | 无锡国联       | 20.0000      | 0.4151   | 20.0000      | 0.3113   |
| 22 | 徐林仙        | 20.0000      | 0.4151   | 20.0000      | 0.3113   |
| 23 | 淄博君恒       | 19.6667      | 0.4082   | 19.6667      | 0.3061   |
| 24 | 西藏芯前沿      | 19.0000      | 0.3944   | 19.0000      | 0.2958   |
| 25 | 浦东海望       | 19.0000      | 0.3944   | 19.0000      | 0.2958   |
| 26 | 鼎创二号       | 17.0000      | 0.3528   | 17.0000      | 0.2646   |
| 27 | 蓉创投资       | 7.0000       | 0.1453   | 7.0000       | 0.1090   |
| 28 | 金智莱鑫       | 5.5000       | 0.1142   | 5.5000       | 0.0856   |

| 序号 | 股东名称     | 本次发行前股本结构    |          | 本次发行后股本结构    |          |
|----|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|    |          | 持股数量<br>（万股） | 持股比例（%）  | 持股数量<br>（万股） | 持股比例（%）  |
| 29 | 本次拟发行的股份 | -            | -        | 1,606.0000   | 25.0000  |
| 合计 |          | 4,818.0000   | 100.0000 | 6,424.0000   | 100.0000 |

（二）本次发行前的前十名股东

| 序号 | 股东名称       | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|----|------------|----------|---------|
| 1  | 东骏投资       | 1,290.00 | 26.77   |
| 2  | 东莞莱普       | 579.00   | 12.02   |
| 3  | 东莞聚慧       | 480.00   | 9.96    |
| 4  | 国家集成电路基金二期 | 369.00   | 7.66    |
| 5  | 东莞骏峰       | 360.00   | 7.47    |
| 6  | 东莞天戈       | 310.00   | 6.43    |
| 7  | 东莞普英       | 206.00   | 4.28    |
| 8  | 长存产投       | 200.00   | 4.15    |
| 9  | 厦门石普       | 148.00   | 3.07    |
| 10 | 广州山立       | 148.00   | 3.07    |
| 合计 |            | 4,090.00 | 84.89   |

（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署日，发行人股东中含 1 名自然人股东徐林仙。徐林仙持有发行人 20.00 万股股份，占本次发行前总股本的 0.42%。徐林仙未在亦曾在发行人处担任职务。

（四）发行人股本中国有股份及外资股份情况

1、国有股份

财政部向国家集成电路基金二期出具的《财政部关于确认国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司莱普科技项目国有股权管理方案的函》（财建函[2024]44 号）确认，发行人股东中国家集成电路基金二期和成都高投为国有股东，股份性质为国有法人股，对其应标注国有股东标识，具体情况如下：

| 序号 | 股东名称       | 本次发行前<br>持股数量（万股） | 本次发行前<br>持股比例（%） | 国有股东<br>标识 |
|----|------------|-------------------|------------------|------------|
| 1  | 国家集成电路基金二期 | 369.00            | 7.66             | SS         |

| 序号 | 股东名称 | 本次发行前<br>持股数量（万股） | 本次发行前<br>持股比例（%） | 国有股东<br>标识 |
|----|------|-------------------|------------------|------------|
| 2  | 成都高投 | 56.00             | 1.16             | SS         |
| 合计 |      | 425.00            | 8.82             | -          |

## 2、外资股份

截至本招股说明书签署日，发行人股本中无外资股份。

### （五）发行人申报前十二个月新增股东情况

发行人无申报前十二个月新增股东情况。

### （六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股说明书签署日，本次发行前公司各股东间的关联关系、一致行动关系以及关联股东的各自持股情况比例如下：

| 序号 | 股东名称   | 本次发行前持股比例（%） | 关联关系、一致行动关系                                                                                                                                                                                        |
|----|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 东骏投资   | 26.77        | （1）东骏投资、东莞聚慧、东莞天戈、东莞莱普、东莞骏峰为东莞普英的合伙人；其中，东骏投资为东莞普英执行事务合伙人，对其形成控制；<br>（2）东骏投资实际控制人之一叶向明的弟弟叶向忠担任东莞聚慧的执行事务合伙人；<br>（3）东骏投资与东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英签订了一致行动人协议；<br>（4）东莞天戈的执行事务合伙人傅建伟，为东骏投资控股子公司东骏激光的总经理 |
| 2  | 东莞莱普   | 12.02        |                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | 东莞聚慧   | 9.96         |                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | 东莞骏峰   | 7.47         |                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | 东莞天戈   | 6.43         |                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | 东莞普英   | 4.28         |                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | 厦门石普   | 3.07         | 同受北京石溪清流私募基金管理有限公司控制                                                                                                                                                                               |
| 9  | 余姚石溪   | 1.02         |                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | 全德学镭科芯 | 2.28         | 同受全德学尔私募基金管理（上海）有限公司控制                                                                                                                                                                             |
| 11 | 全德学四专芯 | 0.79         |                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | 华西金智   | 1.36         | （1）金智莱鑫为华西金智的员工跟投平台；<br>（2）华西金智由成都高新投资集团有限公司出资 40.00%；成都高投由成都高新投资集团有限公司出资 100.00%；华西金智与成都高投存在主要出资人重合情形                                                                                             |
| 13 | 金智莱鑫   | 0.11         |                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | 成都高投   | 1.16         |                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | 鼎创一号   | 1.12         | 同受株洲时代高新创业投资有限公司（曾用名<br>为株洲中车时代高新投资有限公司）控制                                                                                                                                                         |
| 16 | 鼎创二号   | 0.35         |                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | 徐林仙    | 0.42         | 西藏芯前沿由佰维存储 100.00%持股，徐林仙                                                                                                                                                                           |

| 序号 | 股东名称  | 本次发行前持股比例（%） | 关联关系、一致行动关系      |
|----|-------|--------------|------------------|
| 18 | 西藏芯前沿 | 0.39         | 为佰维存储实际控制人孙成思的母亲 |

### （七）本次公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次发行不涉及老股东公开发售其持有公司股份的情况。

### （八）发行人股东中的私募投资基金及其备案情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 28 名股东，包括 27 名机构股东和 1 名自然人股东，其中 17 名机构股东履行了私募投资基金备案手续，具体情况如下：

| 序号 | 股东名称       | 股东性质 | 私募基金编号 | 私募基金备案时间   | 私募基金管理人            | 私募基金管理人登记编号  |
|----|------------|------|--------|------------|--------------------|--------------|
| 1  | 国家集成电路基金二期 | 私募基金 | SJU890 | 2020/3/12  | 华芯投资管理有限责任公司       | P1009674     |
| 2  | 长存产投       | 私募基金 | SABY22 | 2023/11/15 | 长存（武汉）私募基金管理有限公司   | P1075012     |
| 3  | 厦门石普       | 私募基金 | SZB096 | 2023/2/9   | 北京石溪清流私募基金管理有限公司   | P1068420     |
| 4  | 青岛琮碧       | 私募基金 | SZA050 | 2023/3/2   | 深圳琮碧秋实投资管理有限公司     | P1019549     |
| 5  | 全德学镭科芯     | 私募基金 | SQN910 | 2021/6/9   | 全德学尔私募基金管理（上海）有限公司 | P1071902     |
| 6  | 华西金智       | 私募基金 | SLU695 | 2020/9/10  | 华西金智投资有限责任公司       | GC2600030923 |
| 7  | 鼎创一号       | 私募基金 | SSQ488 | 2022/5/30  | 株洲时代高新创业投资有限公司     | P1061064     |
| 8  | 余姚石溪       | 私募基金 | SZM584 | 2023/3/8   | 北京石溪清流私募基金管理有限公司   | P1068420     |
| 9  | 青岛勤芯       | 私募基金 | SACD37 | 2023/10/19 | 北京勤科投资管理有限公司       | P1071011     |
| 10 | 泰达恒鼎       | 私募基金 | SJV527 | 2020/7/3   | 天津泰达科技投资股份有限公司     | P1001349     |
| 11 | 全德学四专芯     | 私募基金 | SZK348 | 2023/3/8   | 全德学尔私募基金管理（上海）有限公司 | P1071902     |

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 私募基金<br>编号 | 私募基金<br>备案时间 | 私募基金管理<br>人              | 私募基金管理<br>人登记编号 |
|----|------|------|------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 12 | 上海浦宸 | 私募基金 | SABA07     | 2023/9/18    | 上海国盛资本<br>管理有限公司         | P1068692        |
| 13 | 无锡国联 | 私募基金 | SNC431     | 2020/11/16   | 国联通宝资本<br>投资有限责任<br>公司   | GC1900031594    |
| 14 | 淄博君恒 | 私募基金 | SAEE48     | 2023/12/19   | 北京君恒私募<br>基金管理有限<br>公司   | P1074002        |
| 15 | 浦东海望 | 私募基金 | SQX812     | 2021/7/6     | 上海浦东海望<br>私募基金管理<br>有限公司 | P1072004        |
| 16 | 鼎创二号 | 私募基金 | SXY093     | 2023/1/17    | 株洲时代高新<br>创业投资有限<br>公司   | P1061064        |
| 17 | 蓉创投资 | 私募基金 | SVN300     | 2022/5/26    | 成都创新风险<br>投资有限公司         | P1022366        |

注：1、根据长存产投提供的合伙协议及其出具的股东调查表等资料，长存产投的基金管理人已变更为长存（武汉）私募基金管理有限公司。截至本招股说明书签署日，长存产投基金管理人在中国证券投资基金业协会的变更登记尚在进行中，中国证券投资基金业协会官方网站（<https://www.amac.org.cn>）显示的长存产投基金管理人仍为湖北国芯产业投资管理有限责任公司（基金管理人登记编号 P1062935）。2、株洲时代高新创业投资有限公司曾用名株洲中车时代高新投资有限公司。

发行人其他 10 名机构股东包括东骏投资、东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英、广州山立、成都高投、西藏芯前沿、金智莱鑫，该等机构股东不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需履行相关登记或备案程序。

## （九）发行人股东特殊权利安排及解除情况

### 1、特殊权利安排条款签订情况

发行人历史上曾签订的特殊权利安排条款情况如下：

| 序号 | 享有特殊权利的股东                                                                               | 协议签订情况                                                                                                                                                                     | 主要股东特殊权利安排条款                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 特殊权利安排存续状态                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | <b>2023年3月增资入股的股东:</b> 厦门石普、广州山立、青岛琮碧、全德学镓科芯、华西金智、鼎创一号、泰达恒鼎、青岛勤芯、全德学四专芯、西藏芯前沿、鼎创二号、金智莱鑫 | 2022年12月12日, 厦门石普、广州山立、青岛琮碧、全德学镓科芯、华西金智、鼎创一号、泰达恒鼎、青岛勤芯、全德学四专芯、西藏芯前沿、鼎创二号、金智莱鑫12名股东(协议简称“甲方”)与公司(协议简称“目标公司”)、控股股东(协议简称“丙方”)、东莞莱普、东莞骏峰、东莞普英以及实际控制人(协议简称“戊方”)签订了《股份认购协议之补充协议》 | <b>回购权:</b> 触发下列任一回购条件时, 任一甲方有权要求丙方和戊方回购其全部或者部分目标公司股权:<br>(1) 目标公司未能在2026年12月31日前提提交IPO申请并获受理或经双方同意的其他年限内实现合格IPO;<br>……<br>在享有回购权的主体向丙方和戊方提出书面主张行使本项权利后, 丙方、戊方应尽快以中国法律允许的方式履行回购义务, 包括但不限于促成目标公司定向减资、定向分配、丙方和戊方或其指定的第三方回购等。<br><b>其他特殊权利:</b> 股权转让限制、优先购买及随售权、优先认购权及反稀释、优先清算权、最优惠待遇等            | 特殊权利安排未曾触发; 上述特殊权利条款已于2023年12月18日终止, 且自始无效 |
| 2  | <b>2023年8月受让股份入股的股东:</b> 成都高投、浦东海望                                                      | 2023年8月18日, 成都高投、浦东海望2名股东(协议简称“甲方”)与东莞莱普、东莞普英、东莞天戈3名股东(协议简称“乙方”)以及公司(协议简称“目标公司”)、控股股东、实际控制人、其他股东签订了《股东协议书》                                                                 | <b>回购权:</b> 触发下列任一回购条件时, 任一甲方有权要求各乙方非连带地回购该甲方从该乙方受让的全部或者部分目标公司股份:<br>(1) 目标公司未能在2026年12月31日前提提交IPO申请并获受理或经该甲方与目标公司同意的其他年限内实现合格IPO;<br>……<br>拟行使回购权的甲方向任一乙方提出书面主张行使本项权利后, 该乙方应尽快以中国法律允许的方式履行回购义务, 包括但不限于促成目标公司定向减资、定向分配、该乙方或其指定的第三方回购。<br><b>其他特殊权利:</b> 股权转让限制、优先购买及随售权、优先认购权及反稀释、优先清算权、最优惠待遇等 | 特殊权利安排未曾触发; 上述特殊权利条款已于2023年12月18日终止, 且自始无效 |
| 3  | <b>2023年3月增资入股的股东:</b> 厦门石普、广州山立、青岛琮碧、全德学镓科芯、华西金智、鼎创一号、                                 | 2023年12月18日, 公司(协议简称“目标公司”)、控股股东(协议简称“丙方”)、实际控制人(协议简称“丁方”)和其                                                                                                               | <b>回购权:</b> 触发下列任一回购条件时, 2023年3月、2023年12月增资入股的股东有权要求丙方及/或丁方回购其届时持有的目标公司股份; 2023年12月受让股份入股的股东有权要求东莞普英回购其出售给股份受让方且届时股份受让方仍持有的目标公                                                                                                                                                                 | 特殊权利安排未曾触发; 各方约定, 上述特殊权利条款于发行人             |



| 序号 | 享有特殊权利的股东                                                                                                                                                                      | 协议签订情况          | 主要股东特殊权利安排条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特殊权利安排存续状态                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | 泰达恒鼎、青岛勤芯、全德学四专芯、西藏芯前沿、鼎创二号、金智莱鑫；<br><b>2023年8月受让股份入股的股东：</b> 成都高投、浦东海望；<br><b>2023年12月增资入股的股东：</b> 国家集成电路基金二期、长存产投、余姚石溪；<br><b>2023年12月受让股份入股的股东：</b> 上海浦宸、无锡国联、徐林仙、淄博君恒、蓉创投资 | 他股东签订了《全体股东协议书》 | 司股份；2023年8月受让股份入股的股东有权要求东莞莱普、东莞普英、东莞天戈非连带地分别回购其出售给受让方且届时受让方仍持有的目标公司股份：<br>（1）目标公司未能在2026年12月31日前提交IPO申请并获受理或经投资人（指享有特殊权利的股东）与目标公司协商同意的其他年限内实现合格IPO的；<br>……<br>投资人中任一方向相应的回购义务人提出书面主张行使回购权后，相应的回购义务人应尽快以中国法律允许且目标公司无需承担义务的方式履行回购义务，包括但不限于相应的回购义务人或其指定第三方（指定第三方不包括目标公司）回购等。<br><b>其他特殊权利：</b> 股权转让限制、优先购买及随售权、优先认购权及反稀释、优先清算权、最优惠待遇、信息披露等 | 提交的首次公开发行上市申请材料被正式受理（以交易所出具受理函之日为准）之日立即终止，但附恢复生效条款 |

## 2、特殊权利安排条款清理情况

### （1）2022 年 12 月 12 日签订的《股份认购协议之补充协议》、2023 年 8 月 18 日签订的《股东协议书》中股东特殊权利安排解除情况

2023 年 12 月 18 日，发行人及实际控制人与相关股东签订了《全体股东协议书》，该协议书约定：“本协议的签署构成对《股份认购协议之补充协议》《股东协议书》及各方之前签订的股东权利义务相关合同/协议等的重述，《股份认购协议之补充协议》《股东协议书》及其他有关股东权利义务的合同/协议自本协议生效之日起自动终止且自始无效，各方确认自本协议生效日起，本协议为目标公司各股东之间关于股东权利及义务的唯一协议，全体股东对本协议中的权利义务安排、内容不存在异议。”

综上所述，自 2023 年 12 月 18 日《全体股东协议书》签订起，发行人实际控制人及相关股东于 2022 年 12 月 12 日签订的《股份认购协议之补充协议》、于 2023 年 8 月 18 日签订的《股东协议书》中约定的股份回购权等特殊权利条款已完成解除，并且自始无效。

### （2）2023 年 12 月 18 日签订的《全体股东协议书》中特殊权利安排解除情况

2025 年 6 月 10 日，发行人与相关股东签订了《<关于成都莱普科技股份有限公司之全体股东协议书>之补充协议》，本补充协议确认：

①《全体股东协议书》项下“第 1 条 股份回购”、“第 2 条 股份转让限制”、“第 3 条 优先购买权及随售权”、“第 4 条 优先认购权及反稀释权”、“第 5 条 优先清算权”、“第 6 条 最优惠待遇”、“第 7 条 信息披露”（合称“特殊权利”）自莱普科技提交的首次公开发行上市申请材料被正式受理（以交易所出具受理函之日为准）之日（简称“受理日”）立即终止，除前述条款外，如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所认定《全体股东协议书》项下存在其他性质为“对赌”或“类似对赌”的条款，则该等条款亦均终止。

②尽管有上述约定，各方依据本补充协议第 1.1 条所终止的特殊权利相关条款将在下列事项较早发生的一项发生之日全部自动恢复其完全效力，并视同该等特殊权利相关条款从未失效：1）莱普科技决议暂停或放弃首次公开发行或撤回

或撤销首次公开发行的申请；2）莱普科技的首次公开发行申请被中国证券监督管理委员会或上海证券交易所或其他证券监管机构撤回、退回、撤销、终止审查、不予批准或不予注册；3）莱普科技未能于受理日起三十六（36）个月内完成合格上市。

③尽管有上述约定，各方同意：如若因届时适用的法律法规或主管的上市监管部门对上述特殊权利的终止约定有新的监管指导要求（简称“新监管要求”），各方同意在合法合规的基础上，为配合新监管要求之目的，尽最大努力达成相关补充约定，以使得莱普科技满足新监管要求。

④各方确认，截至本补充协议签署之日，《全体股东协议书》所约定的特殊权利条款均未触发，未发生权利人向相关义务人实际主张行使特殊权利的情形；《全体股东协议书》项下不存在任何纠纷或可预见的潜在纠纷。

根据《<关于成都莱普科技股份有限公司之全体股东协议书>之补充协议》相关条款，自发行人提交的首次公开发行上市申请材料被正式受理（以交易所出具受理函之日为准）之日起，2023年12月18日《全体股东协议书》中约定的股份回购权等特殊权利条款立即终止；虽然附有恢复生效条款，但不涉及发行人作为回购义务人的相关条款。

### 3、对发行人的影响

#### （1）发行人不作为对赌条款当事人

各方于2023年12月18日签订的《全体股东协议书》明确约定：“各方确认，根据本协议的约定，目标公司在本协议下均不承担任何与对赌及其他特殊权利条款有关的义务，不是有关对赌及其他特殊权利条款的当事人”，上述条款排除了“目标公司/发行人”作为回购义务人的可能。

据此，发行人不作为对赌条款当事人。

#### （2）对赌条款不存在可能导致公司控制权变化的约定

根据《<关于成都莱普科技股份有限公司之全体股东协议书>之补充协议》，相关对赌条款的效力自发行人提交的首次公开发行上市申请材料被正式受理（以交易所出具受理函之日为准）之日起立即终止，仅在以下情形下恢复生效：1）

公司决议暂停或放弃首次公开发行或撤回或撤销首次公开发行的申请；2）公司的首次公开发行申请被中国证券监督管理委员会或上海证券交易所或其他证券监管机构撤回、退回、撤销、终止审查、不予批准或不予注册；3）公司未能于受理日起三十六（36）个月内完成合格上市。在本次发行上市申请审核期间及发行人成功上市后，发行人的实际控制人均不涉及业绩补偿及回购等义务，不会因此导致发行人控制权发生变化。

据此，对赌协议在审核期间及发行人上市后不存在可能导致公司控制权变化的约定。

### **（3）对赌协议不与市值挂钩**

发行人历史上涉及对赌条款的相关协议均不存在将市值作为对赌条件的约定，不存在与市值挂钩的情形。

### **（4）对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形**

各方于 2023 年 12 月 18 日签订的《全体股东协议书》约定：“各方确认，根据本协议的约定，目标公司在本协议下均不承担任何与对赌及其他特殊权利条款有关的义务，不是有关对赌及其他特殊权利条款的当事人。如交易所或届时公司已聘请的上市中介机构认定目标公司在本协议约定的特殊权利条款项下应承担义务，则该等义务于本协议生效时自始无效且不可恢复地终止，对目标公司不具有法律约束力（但对本协议其他条款的效力不产生影响），各方对此不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷”。

据此，对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

综上所述，截至本招股说明书签署日，发行人对特殊权利的清理情况符合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》的相关规定。

十三、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况

（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员简介

1、董事会成员简介

截至本招股说明书签署日，公司董事会成员名单及其简历如下：

| 序号 | 姓名  | 职务             | 提名人        | 本届任职期间             |
|----|-----|----------------|------------|--------------------|
| 1  | 叶向明 | 董事长            | 东骏投资       | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 2  | 毛冬  | 董事             | 东骏投资       | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 3  | 傅建伟 | 董事、审计委员会成员     | 东骏投资       | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 4  | 黄永忠 | 董事、总经理、核心技术人员  | 职工代表大会     | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 5  | 王晓峰 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 东骏投资       | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 6  | 王晓礼 | 董事             | 国家集成电路基金二期 | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 7  | 曹昱  | 独立董事、审计委员会成员   | 东骏投资       | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 8  | 蔡芸  | 独立董事、审计委员会成员   | 东骏投资       | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 9  | 黎明  | 独立董事           | 东骏投资       | 2024 年 8 月 21 日起三年 |

注：2024 年 8 月 21 日起黄永忠担任公司董事，提名人为东骏投资；2025 年 7 月 1 日，发行人职工代表大会选举黄永忠为职工董事。

（1）叶向明

叶向明简历详见本节之“八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）发行人实际控制人基本情况”之“1、叶向明的基本情况”。

（2）毛冬

毛冬简历详见本节之“八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）发行人实际控制人基本情况”之“2、毛冬的基本情况”。

（3）傅建伟

傅建伟先生，出生于 1961 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

四川大学半导体物理专业，本科学历，高级工程师。1982年8月至2000年3月，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所科研课题组长、技术处处长、所办主任、民品处处长、所长助理；2000年4月至2001年3月，担任东骏集团副总经理；2001年4月至今，担任东骏激光董事、总经理；2021年6月至今，担任东莞天戈执行事务合伙人；2023年5月至今，担任骏铭佳创执行董事、总经理；2003年12月至2018年5月，担任莱普有限总经理；2021年8月至今，担任公司董事。

#### （4）黄永忠

黄永忠先生，出生于1968年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学光学工程专业，博士研究生学历，高级工程师。1990年7月至2001年3月，担任中国兵器工业第二零九研究所工程师；2001年4月至2003年11月，历任东骏激光有限质量工程部、技术支持部主任；2010年2月至2018年6月，担任东骏激光副总经理；2021年6月至今，担任东莞莱普执行事务合伙人；2003年12月至今，历任莱普有限生产技术部主任、副总工程师、总工程师、副总经理、总经理等职，目前担任公司董事、总经理。

#### （5）王晓峰

王晓峰先生，出生于1976年6月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学微电子与固体电子学专业，博士研究生学历。2004年9月至2008年5月，担任三星电子半导体事业部高级工程师；2008年6月至2016年9月，历任中国科学院半导体研究所副研究员、研究员；2016年10月至2017年12月，担任中国科学院微电子研究所研究员；2018年1月至2022年12月，担任中国科学院半导体研究所研究员；2018年6月至今，担任北京润和微光科技有限公司董事长；2021年6月至今，担任东莞骏峰执行事务合伙人；2021年8月至今，担任公司董事；2023年1月至今，担任公司副总经理。

#### （6）王晓礼

王晓礼女士，出生于1995年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学工业工程专业，硕士研究生学历。2019年3月至2019年7月，担任香港大学工程学院研究助理；2019年7月至2023年3月，任职于国开证券股份有



限公司，历任经营管理部高级经理以及投资银行部高级经理、副总监；2023年3月至今，历任华芯投资管理有限责任公司主管、高级主管；2025年4月至今，担任上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）投资决策委员会委员、咨询委员会委员；2024年2月至今，担任公司董事。

#### （7）曹昱

曹昱女士，出生于1969年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本福冈大学商学专业（会计学方向），博士研究生学历。1990年9月至1994年2月，历任西南物理研究院出纳、会计；1994年3月至1996年3月，担任佛山普立华照相机有限公司（现佛山普立华科技有限公司）北京分公司财务经理；1996年4月至1999年11月，担任北京双语教育电子有限公司财务经理；1999年12月至2002年3月，担任北京华点通电子商务有限公司财务经理；2002年4月至2010年3月，就读于日本福冈大学；2008年4月至2011年8月，担任日本福冈国际大学、日本福冈大学讲师；2011年9月至今，任职于西南财经大学，目前担任会计学院教授；2016年9月至今，担任成都西煜百年商贸有限公司监事；2022年1月至今，担任新金路集团股份有限公司独立董事；2022年10月至今，担任成都瑞迪智驱科技股份有限公司独立董事；2024年2月至今，担任公司独立董事、审计委员会成员。

#### （8）蔡芸

蔡芸女士，出生于1977年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学经济法专业，硕士研究生学历。2000年7月至2004年2月，担任中国人民银行东莞市中心支行科员；2004年2月至2009年4月，担任中国银行业监督管理委员会东莞银监分局科员；2009年4月至2012年4月，担任佛山市经济贸易局工业科科长；2012年4月至2018年5月，历任佛山市卫生和计划生育局办公室科员、副主任；2018年6月至2019年6月，担任北京市盈科（佛山）律师事务所律师；2019年7月至2025年1月，担任中伦文德胡百全（前海）联营律师事务所合伙人律师；2022年11月至今，担任广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事；2025年1月至今，担任炜衡沛雄（前海）联营律师事务所合伙人律师；2024年2月至今，担任公司独立董事、审计委员会成员。

（9）黎明

黎明先生，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学微电子与固体电子学专业，博士研究生学历。2003 年 8 月至 2011 年 8 月，担任韩国三星电子半导体事业部高级工程师；2011 年 8 月至今，任职于北京大学，目前担任集成电路学院特聘副教授。2024 年 2 月至今，担任公司独立董事。

2、取消监事会前在任监事简介

2025 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案》。取消监事会前，公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。

取消监事会前，公司监事会成员名单及其简历如下：

| 序号 | 姓名  | 职务    | 提名人    | 本届任职期间                           |
|----|-----|-------|--------|----------------------------------|
| 1  | 刘钧伟 | 监事会主席 | 东骏投资   | 2024 年 8 月 21 日至 2025 年 6 月 28 日 |
| 2  | 何婉萍 | 监事    | 东骏投资   | 2024 年 8 月 21 日至 2025 年 6 月 28 日 |
| 3  | 刘辉涛 | 职工监事  | 职工代表大会 | 2024 年 8 月 21 日至 2025 年 6 月 28 日 |

（1）刘钧伟

刘钧伟先生，出生于 1989 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学会计专业，本科学历；2012 年 6 月至 2014 年 6 月，担任东骏集团审计助理；2014 年 7 月至 2020 年 6 月，担任成都东骏房地产开发有限公司审计专员；2020 年 7 月至今，担任东骏投资财务主管；2022 年 7 月至今，担任东骏激光监事会主席；2021 年 8 月至 2025 年 6 月，担任公司监事会主席。

（2）何婉萍

何婉萍女士，出生于 1963 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988 年 10 月至 1993 年 6 月，担任东莞市东港丝绸服装有限公司主管；1993 年 7 月至 2002 年 4 月，担任东莞柏丽日用化工制品有限公司财务经理；2002 年 4 月至 2020 年 6 月，担任东骏电器财务经理；2020 年 7 月至今，担任东骏投资财务经理、监事；2021 年 8 月至 2025 年 6 月，担任公司监事。

### （3）刘辉涛

刘辉涛先生，出生于 1986 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学机械工程专业，本科学历，目前广东工业大学智能制造技术专业博士研究生在读。2008 年 10 月至 2012 年 12 月，担任莱普有限销售经理；2013 年 1 月至 2015 年 6 月，担任深圳市韵腾激光科技有限公司市场总监；2015 年 7 月至 2018 年 1 月，担任深圳市中科光子科技有限公司副总经理；2018 年 2 月至 2020 年 10 月，担任广东华奕激光技术有限公司执行董事、经理；2018 年 5 月至 2019 年 9 月，担任广东华快光子科技有限公司董事；2018 年 8 月至今，担任广东佛智芯微电子有限公司董事；2019 年 1 月至今，担任广东工业大学国家重点实验室特聘研究员；2019 年 10 月至 2020 年 10 月，担任中山市名光智能科技有限公司监事；2019 年 10 月至 2022 年 12 月，担任得旭智能科技（佛山）有限公司监事；2020 年 12 月至今，任职于公司，目前担任深圳分公司负责人。

公司取消监事会后，监事会职责由董事会下设的审计委员会承担，公司审计委员会成员情况如下：

| 序号 | 姓名  | 审计委员会职务 | 本届任职期间             |
|----|-----|---------|--------------------|
| 1  | 曹昱  | 召集人     | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 2  | 蔡芸  | 委员      | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 3  | 傅建伟 | 委员      | 2024 年 8 月 21 日起三年 |

上述审计委员会成员简历详见本节之“十三、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事会成员简介”。

### 3、高级管理人员简介

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员名单及其简历如下：

| 序号 | 姓名  | 职务             | 本届任职期间             |
|----|-----|----------------|--------------------|
| 1  | 黄永忠 | 董事、总经理、核心技术人员  | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 2  | 王晓峰 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 3  | 潘岭峰 | 副总经理、核心技术人员    | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 4  | 何刘  | 副总经理、核心技术人员    | 2024 年 8 月 21 日起三年 |
| 5  | 唐昊  | 副总经理、董事会秘书     | 2024 年 8 月 21 日起三年 |

| 序号 | 姓名 | 职务   | 本届任职期间        |
|----|----|------|---------------|
| 6  | 郭红 | 财务总监 | 2024年8月21日起三年 |
| 7  | 杨博 | 副总经理 | 2024年8月21日起三年 |

### （1）黄永忠

黄永忠简历详见本节之“十三、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事会成员简介”之“（4）黄永忠”。

### （2）王晓峰

王晓峰简历详见本节之“十三、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事会成员简介”之“（5）王晓峰”。

### （3）潘岭峰

潘岭峰先生，出生于1980年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光信息科学与技术专业，本科学历。2002年7月至2003年10月，担任武汉华工正源光子技术有限公司工程师；2003年11月至2016年10月，担任中国科学院半导体研究所工程师；2016年11月至2017年12月，担任中国科学院微电子研究所工程师；2018年1月至2022年12月，担任中国科学院半导体研究所工程师；2023年1月至今，担任公司副总经理、晶圆装备事业部负责人。

### （4）何刘

何刘先生，出生于1969年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学无线电技术专业，本科学历，高级工程师。1991年7月至2002年7月，担任中国兵器装备集团公司西南兵工局下属单位重庆华光仪器厂技术员；2002年8月至2003年12月，担任东骏激光技术员；2003年12月至今，任职于公司，历任技术部主任、副总工程师、总工程师等职务，目前担任公司副总经理、封测微加装备事业部负责人。

### （5）唐昊

唐昊先生，出生于1983年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广

东财经大学会计学专业，硕士研究生学历。2006年9月至2011年9月，担任岳阳市烟草公司客户经理；2011年10月至2014年5月，担任四川成本调查监审局成本调查员；2014年6月至2020年2月，历任西南证券股份有限公司客户经理、四川分公司总经理助理、投行成都部高级经理；2020年3月至2022年11月，担任华西证券股份有限公司投行西南业务部高级副总裁；2022年12月至今，任职于公司，目前担任公司副总经理、董事会秘书。

#### （6）郭红

郭红女士，出生于1969年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学会计专业，大专学历，具有中国注册会计师资格。1989年7月至2000年7月，担任成都化肥厂质检、会计；2000年10月至2001年8月，担任四川兴大房地产开发有限公司会计主管；2001年11月至2021年7月，历任东骏激光财务部长、财务总监；2021年8月至今，担任公司财务总监。

#### （7）杨博

杨博先生，出生于1967年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原机械学院精细化工专业，本科学历。1992年7月至1997年4月，担任西安秦川机械厂工程师；1997年4月至1999年5月，担任东莞南城新科磁电制品厂生产主管；1999年6月至2002年4月，担任IBM技术产品有限公司生产经理；2002年4月至2004年5月，担任深圳市高科域新材料有限公司厂长；2004年5月至2004年12月，担任深圳市方向科技有限公司生产副总经理；2005年2月至2010年4月，担任联华实业（香港）有限公司副总经理；2010年11月至2013年9月，历任东骏激光总经理助理、副总经理；2013年10月至2014年10月，担任茂硕电源科技股份有限公司执行办副主任；2014年10月至2016年3月，担任深圳长城开发科技股份有限公司高级经理；2016年4月至2021年8月，担任成都长城开发科技股份有限公司高级经理；2021年8月至今，担任公司副总经理。

### 4、其他核心人员简介

公司其他核心人员为核心技术人员。截至本招股说明书签署日，公司共4名核心技术人员，其名单及其简历如下：

| 序号 | 姓名  | 职务             |
|----|-----|----------------|
| 1  | 黄永忠 | 董事、总经理、核心技术人员  |
| 2  | 王晓峰 | 董事、副总经理、核心技术人员 |
| 3  | 潘岭峰 | 副总经理、核心技术人员    |
| 4  | 何刘  | 副总经理、核心技术人员    |

### （1）黄永忠

黄永忠简历详见本节之“十三、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事会成员简介”之“（4）黄永忠”。

### （2）王晓峰

王晓峰简历详见本节之“十三、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事会成员简介”之“（5）王晓峰”。

### （3）潘岭峰

潘岭峰简历详见本节之“十三、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“3、高级管理人员简介”之“（3）潘岭峰”。

### （4）何刘

何刘简历详见本节之“十三、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“3、高级管理人员简介”之“（4）何刘”。

## （二）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员在公司、控股子公司以外的兼职情况如下：

| 序号 | 姓名  | 在发行人处职务 | 在外任职单位 | 在外任职职务 | 是否为发行人关联方 |
|----|-----|---------|--------|--------|-----------|
| 1  | 叶向明 | 董事长     | 东骏投资   | 总经理    | 是         |



| 序号 | 姓名  | 在发行人处<br>职务            | 在外任职单位                                 | 在外任职职务                    | 是否为发行人关<br>联方 |
|----|-----|------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|
|    |     |                        | 东骏激光                                   | 董事                        | 是             |
|    |     |                        | 北京鸿丰投资股份<br>有限公司                       | 监事会主席                     | 是             |
| 2  | 毛冬  | 董事                     | 东骏投资                                   | 执行董事                      | 是             |
|    |     |                        | 东骏激光                                   | 董事长                       | 是             |
|    |     |                        | 北京鸿丰投资股份<br>有限公司                       | 董事                        | 是             |
| 3  | 傅建伟 | 董事、审计<br>委员会成员         | 东骏激光                                   | 董事、总经理                    | 是             |
|    |     |                        | 骏铭佳创                                   | 执行董事、经理                   | 是             |
|    |     |                        | 东莞天戈                                   | 执行事务合伙人                   | 是             |
| 4  | 黄永忠 | 董事、总经<br>理、核心技<br>术人员  | 东莞莱普                                   | 执行事务合伙人                   | 是             |
| 5  | 王晓峰 | 董事、副总<br>经理、核心<br>技术人员 | 北京润和微光科技<br>有限公司                       | 董事长                       | 是             |
|    |     |                        | 东莞骏峰                                   | 执行事务合伙人                   | 是             |
| 6  | 王晓礼 | 董事                     | 华芯投资管理有限<br>责任公司                       | 高级主管                      | 否             |
|    |     |                        | 上海聚源聚芯集成<br>电路产业股权投资<br>基金中心（有限合<br>伙） | 投资决策委员会<br>委员、咨询委员<br>会委员 | 否             |
| 7  | 曹昱  | 独立董事、<br>审计委员会<br>成员   | 西南财经大学                                 | 教授                        | 否             |
|    |     |                        | 成都西煜百年商贸<br>有限公司                       | 监事                        | 是             |
|    |     |                        | 四川新金路集团股<br>份有限公司                      | 独立董事                      | 否             |
|    |     |                        | 成都瑞迪智驱科技<br>股份有限公司                     | 独立董事                      | 否             |
| 8  | 蔡芸  | 独立董事、<br>审计委员会<br>成员   | 炜衡沛雄（前海）<br>联营律师事务所                    | 合伙人律师                     | 否             |
|    |     |                        | 广东顺德农村商业<br>银行股份有限公司                   | 独立董事                      | 否             |
| 9  | 黎明  | 独立董事                   | 北京大学                                   | 长聘副教授                     | 否             |
| 10 | 刘钧伟 | 取消监事会<br>前在任监事<br>会主席  | 东骏投资                                   | 财务主管                      | 是             |
|    |     |                        | 东骏激光                                   | 监事                        | 是             |
| 11 | 何婉萍 | 取消监事会<br>前在任监事         | 东骏投资                                   | 财务经理、监事                   | 是             |
| 12 | 刘辉涛 | 取消监事会<br>前在任职工<br>监事   | 广东佛智芯微电子<br>有限公司                       | 董事                        | 是             |
|    |     |                        | 广东工业大学国家<br>重点实验室                      | 特聘研究员                     | 否             |

| 序号 | 姓名  | 在发行人处职务     | 在外任职单位         | 在外任职职务 | 是否为发行人关联方 |
|----|-----|-------------|----------------|--------|-----------|
| 13 | 潘岭峰 | 副总经理、核心技术人员 | 北京润和微光科技有限公司   | 董事     | 是         |
|    |     |             | 广东联峰励志光电科技有限公司 | 监事     | 否         |

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员除上述兼职外，无其他在发行人及其子公司以外的单位兼职的情况。

### （三）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事长叶向明系公司取消监事会前在任监事刘钧伟的父亲的姐姐的配偶，除此之外，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间不存在其他亲属关系。

### （四）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

毛冬为公司实际控制人之一，亦为公司董事。报告期内，毛冬存在因醉酒驾驶受到行政、刑事处罚情形。

2022年1月4日，广东省东莞市公安局交通警察支队出具《公安交通管理部门行政处罚决定书》（东公（交）行罚决字（2022）4419002900405262号），毛冬因于2021年12月15日晚实施醉酒驾驶机动车行为，根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定被处以吊销机动车驾驶证的行政处罚。

2022年6月23日，广东省东莞市第一人民法院出具《刑事判决书》（（2022）粤1971刑初2336号），毛冬因于2021年12月16日凌晨实施醉酒驾驶机动车行为，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，判决毛冬犯危险驾驶罪，判处有期徒刑一个月二十五日，缓刑三个月，并处罚金人民币16,000.00元。

截至本招股说明书签署日，上述毛冬所涉案件相关行政、刑事处罚，均已执行完毕，不属于涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查的情形。上述案件不属于《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行人实际控制人不得存在的经济刑事犯

罪或重大违法行为，亦不属于《公司法》规定的不得担任公司董事的相关情形，不会导致发行人不符合科创板发行上市的条件，不会影响毛冬在公司担任董事的任职资格，对发行人未来生产经营没有重大不利影响。

除以上情形，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

#### **（五）发行人与董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况**

公司与在公司担任具体职务并领取薪酬的非独立董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员签订了《劳动合同》或《返聘协议》，并签订了《保密协议》《知识产权和竞业禁止协议》；与独立董事签订了《独立董事聘用协议》。截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员其他核心人员与公司签订的上述合同均正常履行，不存在违约情形。

截至本招股说明书签署日，除上述情形外，公司不存在与董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议的情形。

#### **（六）发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况**

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务/亲属关系        | 直接持股数量(万股) | 间接持股数量(万股) | 合计持股数量(万股) | 合计持股数量占本次发行前股份比例(%) |
|----|-----|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1  | 叶向明 | 董事长            | -          | 679.9900   | 679.9900   | 14.1135             |
| 2  | 毛冬  | 董事             | -          | 679.9900   | 679.9900   | 14.1135             |
| 3  | 傅建伟 | 董事、审计委员会成员     | -          | 251.2492   | 251.2492   | 5.2148              |
| 4  | 黄永忠 | 董事、总经理、核心技术人员  | -          | 184.2298   | 184.2298   | 3.8238              |
| 5  | 王晓峰 | 董事、副总经理、核心技术人员 | -          | 195.0250   | 195.0250   | 4.0478              |

| 序号 | 姓名  | 职务/亲属关系                | 直接持股数量(万股) | 间接持股数量(万股) | 合计持股数量(万股) | 合计持股数量占本次发行前股份比例(%) |
|----|-----|------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|    |     | 员                      |            |            |            |                     |
| 6  | 刘钧伟 | 取消监事会前在任监事会主席          | -          | 112.7963   | 112.7963   | 2.3411              |
| 7  | 刘辉涛 | 取消监事会前在任职工监事           | -          | 38.1541    | 38.1541    | 0.7919              |
| 8  | 潘岭峰 | 副总经理、核心技术人员            | -          | 195.0250   | 195.0250   | 4.0478              |
| 9  | 何刘  | 副总经理、核心技术人员            | -          | 106.2864   | 106.2864   | 2.2060              |
| 10 | 唐昊  | 副总经理、董事会秘书             | -          | 25.0000    | 25.0000    | 0.5189              |
| 11 | 郭红  | 财务总监                   | -          | 43.6047    | 43.6047    | 0.9050              |
| 12 | 杨博  | 副总经理                   | -          | 32.7035    | 32.7035    | 0.6788              |
| 13 | 叶向忠 | 董事长叶向明的弟弟              | -          | 161.1375   | 161.1375   | 3.3445              |
| 14 | 刘嘉桦 | 取消监事会前在任监事何婉萍的女儿       | -          | 112.7963   | 112.7963   | 2.3411              |
| 15 | 刘弘  | 副总经理、核心技术人员何刘的配偶，发行人员工 | -          | 29.9782    | 29.9782    | 0.6222              |

截至本招股说明书签署日，发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形。

**（七）发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内的变动情况**

**1、董事变动情况**

最近两年，发行人董事变动情况如下：

| 序号 | 时间              | 董事人员                     | 变动情况                               | 变动原因            |
|----|-----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2024 年 1 月 1 日  | 叶向明、毛冬、傅建伟、黄永忠、王晓峰       | -                                  | -               |
| 2  | 2024 年 2 月 23 日 | 叶向明、毛冬、傅建伟、黄永忠、王晓峰、王晓礼、曹 | 经发行人 2024 年第一次临时股东大会决议，同意选举王晓礼、曹昱、 | 新增股东委派董事、新聘独立董事 |

| 序号 | 时间 | 董事人员    | 变动情况                                          | 变动原因 |
|----|----|---------|-----------------------------------------------|------|
|    |    | 昱、蔡芸、黎明 | 蔡芸、黎明等 4 人担任董事；其中，王晓礼为新增股东委派董事，曹昱、蔡芸、黎明为独立董事。 |      |

最近两年，发行人董事变动系新增股东委派董事、建立独立董事制度等原因导致，未对发行人造成重大不利影响。

2、取消监事会前在任监事变动情况

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 28 日，发行人监事会成员为刘钧伟、何婉萍、刘辉涛，该期间内发行人监事未发生变动。

2025 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的议案》，刘钧伟、何婉萍、刘辉涛不再担任监事。

自 2025 年 6 月审计委员会承接监事会职权至本招股说明书签署日，审计委员会成员未发生变化，为曹昱、蔡芸、傅建伟三人。

3、高级管理人员变动情况

2024 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日，发行人高级管理人员一直为黄永忠、王晓峰、潘岭峰、何刘、唐昊、郭红、杨博。

最近两年，发行人高级管理人员未发生变动。

4、其他核心人员变动情况

2025 年 6 月 28 日，发行人 2024 年年度股东大会审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》，综合考虑技术能力以及对公司研发贡献等因素，根据公司实际情况并结合学历背景、专业资质、科研成果、获奖情况、对公司研发的贡献等因素，同意认定黄永忠、王晓峰、潘岭峰、何刘 4 人为核心技术人员。

2024 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日，发行人核心技术人员黄永忠、王晓峰、潘岭峰、何刘一直为公司全职员工，未曾发生变化。

5、最近两年内董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员变动对公司的影响

最近两年内，发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核

心人员的历次变更均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

最近两年内，发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大不利变化，相关人员变动未对公司生产经营造成重大不利影响。

#### （八）发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况如下：

| 序号 | 姓名  | 在发行人处职务        | 对外投资企业名称      | 与发行人或发行人主营业务关系 | 出资额（万元） | 投资比例（%） |
|----|-----|----------------|---------------|----------------|---------|---------|
| 1  | 叶向明 | 董事长            | 东骏投资          | 发行人控股股东        | 690.00  | 50.00   |
| 2  | 毛冬  | 董事             | 东骏投资          | 发行人控股股东        | 690.00  | 50.00   |
| 3  | 傅建伟 | 董事、审计委员会成员     | 东莞天戈          | 发行人股东          | 349.50  | 75.15   |
|    |     |                | 东骏激光          | 发行人控股股东控制的其他企业 | 55.00   | 0.92    |
| 4  | 黄永忠 | 董事、总经理、核心技术人员  | 东莞莱普          | 发行人员工持股平台      | 253.50  | 29.17   |
|    |     |                | 东骏激光          | 发行人控股股东控制的其他企业 | 5.00    | 0.08    |
| 5  | 王晓峰 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 东莞骏峰          | 发行人员工持股平台      | 270.45  | 50.04   |
|    |     |                | 北京润和微光科技有限公司  | 与发行人或发行人主营业务无关 | 74.66   | 37.33   |
| 6  | 曹昱  | 独立董事           | 成都芬得利建筑材料有限公司 | 与发行人或发行人主营业务无关 | 55.00   | 55.00   |
|    |     |                | 成都西煜百年商贸有限公司  | 与发行人或发行人主营业务无关 | 20.00   | 40.00   |
| 7  | 刘钧伟 | 取消监事会前在任监事会主席  | 东莞聚慧          | 发行人股东          | 157.52  | 21.86   |
| 8  | 刘辉涛 | 取消监事会前在任职工监事   | 东莞莱普          | 发行人员工持股平台      | 52.55   | 6.05    |
|    |     |                | 深圳善聚缘半导体合伙企业  | 与发行人或发行人主营     | 50.00   | 12.50   |



| 序号 | 姓名  | 在发行人处职务     | 对外投资企业名称     | 与发行人或发行人主营业务关系 | 出资额（万元） | 投资比例（%） |
|----|-----|-------------|--------------|----------------|---------|---------|
|    |     |             | （有限合伙）       | 业务无关           |         |         |
| 9  | 潘岭峰 | 副总经理、核心技术人员 | 东莞骏峰         | 发行人员工持股平台      | 270.05  | 49.96   |
|    |     |             | 北京润和微光科技有限公司 | 与发行人或发行人主营业务无关 | 26.14   | 13.07   |
| 10 | 何刘  | 副总经理、核心技术人员 | 东莞莱普         | 发行人员工持股平台      | 146.25  | 16.83   |
| 11 | 唐昊  | 副总经理、董事会秘书  | 东莞莱普         | 发行人员工持股平台      | 37.50   | 4.32    |
| 12 | 郭红  | 财务总监        | 东莞莱普         | 发行人员工持股平台      | 60.05   | 6.91    |
|    |     |             | 东骏激光         | 发行人控股股东控制的其他企业 | 20.00   | 0.33    |
| 13 | 杨博  | 副总经理        | 东莞莱普         | 发行人员工持股平台      | 45.05   | 5.18    |

除上述情形外，发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员与其他核心人员不存在其他对外投资情况，发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的上述对外投资与发行人亦不存在利益冲突。

### （九）发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况

#### 1、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确认依据及所履行的程序

报告期内，在公司全职任职的非独立董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由工资、奖金、社会保险和住房公积金组成；未在公司全职任职的非独立董事、取消监事会前在任监事未在公司领取薪酬。公司向独立董事发放津贴，津贴的标准应当由董事会制订方案，股东会审议通过。

2024年1月，公司召开第一届董事会第十三次会议决议设立董事会薪酬与考核委员会。根据董事会薪酬与考核委员会相关工作细则，其主要职责权限为负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬以及股权激励等事项向董事会提出建议。

2、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬领取情况

（1）报告期内董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额情况

报告期内公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额及其占公司利润总额的比例情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度  | 2023 年度  | 2022 年度   |
|------|--------------|----------|----------|-----------|
| 薪酬总额 | 528.84       | 1,050.28 | 759.65   | 385.14    |
| 利润总额 | 595.98       | 5,488.47 | 2,500.61 | -1,187.79 |
| 占比   | 88.73%       | 19.14%   | 30.38%   | -32.42%   |

注：2025 年 6 月公司取消监事会，前职工监事刘辉涛已于 2025 年 6 月卸任；刘辉涛计入本表的薪酬至 2025 年 6 月止。

（2）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况

公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员 2024 年度从发行人及其关联企业领取收入的情况如下：

单位：万元

| 序号 | 姓名  | 职务                 | 2024年度在公司<br>领取薪酬金额 | 2024 年度是否在关联企<br>业领薪 |
|----|-----|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1  | 叶向明 | 董事长                | -                   | 是，在发行人控股股东东骏投资处领薪    |
| 2  | 毛冬  | 董事                 | -                   | 是，在发行人控股股东东骏投资处领薪    |
| 3  | 傅建伟 | 董事、审计委员会成员         | -                   | 是，在发行人关联方东骏激光处领薪     |
| 4  | 黄永忠 | 董事、总经理、核心技术<br>人员  | 135.64              | 否                    |
| 5  | 王晓峰 | 董事、副总经理、核心技<br>术人员 | 236.36              | 否                    |
| 6  | 王晓礼 | 董事                 | -                   | 否                    |
| 7  | 曹昱  | 独立董事、审计委员会成<br>员   | 8.33                | 否                    |
| 8  | 蔡芸  | 独立董事、审计委员会成<br>员   | 8.33                | 否                    |
| 9  | 黎明  | 独立董事               | 8.33                | 否                    |
| 10 | 刘钧伟 | 取消监事会前在任监事会<br>主席  | -                   | 是，在发行人控股股东东骏投资处领薪    |

| 序号 | 姓名  | 职务               | 2024年度在公司<br>领取薪酬金额 | 2024 年度是否在关联企<br>业领薪  |
|----|-----|------------------|---------------------|-----------------------|
| 11 | 何婉萍 | 取消监事会前在任监事       | -                   | 是，在发行人控股股东东<br>骏投资处领薪 |
| 12 | 刘辉涛 | 取消监事会前在任职工监<br>事 | 82.75               | 否                     |
| 13 | 潘岭峰 | 副总经理、核心技术人员      | 144.07              | 否                     |
| 14 | 何刘  | 副总经理、核心技术人员      | 102.84              | 否                     |
| 15 | 唐昊  | 副总经理、董事会秘书       | 112.37              | 否                     |
| 16 | 郭红  | 财务总监             | 113.93              | 否                     |
| 17 | 杨博  | 副总经理             | 97.31               | 否                     |

除领取上述薪酬外，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员未在发行人及其关联方享受其他待遇或退休金计划。

#### 十四、发行人已执行的股权激励及其他制度安排和执行情况

截至本招股说明书签署日，发行人未设置期权激励计划，存在已执行的股权激励计划。发行人通过设立东莞莱普、东莞骏峰两个员工持股平台实施员工股权激励。东莞莱普、东莞骏峰的基本情况详见本节之“八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“1、东莞莱普”及“4、东莞骏峰”。

##### （一）以东莞莱普为员工持股平台实施的员工股权激励

发行人以东莞莱普为员工持股平台实施了两期股权激励，具体情况如下：

##### 1、第一期股权激励计划

2021 年 11 月 1 日，莱普科技召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定成都莱普科技股份有限公司股权激励方案的议案》，制定了《成都莱普科技股份有限公司 2021-2023 年股权激励计划》（以下简称“第一期股权激励计划”）。

第一期股权激励计划的激励对象为实施股权激励时在公司任职的董事、高级管理人员、核心骨干员工以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，公司最终确定黄永忠等 17 名员工为具体激励对象，合计授予 537.00 万股份，具体情况如下：

| 序号 | 激励对象姓名 | 获授激励股份时在发行人处<br>任职情况 | 获授发行人股份数量（股） |
|----|--------|----------------------|--------------|
| 1  | 黄永忠    | 全职员工                 | 1,766,000    |
| 2  | 何刘     | 全职员工                 | 999,000      |
| 3  | 刘辉涛    | 全职员工                 | 349,000      |
| 4  | 郭红     | 全职员工                 | 399,000      |
| 5  | 杨博     | 全职员工                 | 299,000      |
| 6  | 刘弘     | 全职员工                 | 299,000      |
| 7  | 王德友    | 全职员工                 | 199,000      |
| 8  | 潘冬     | 全职员工                 | 199,000      |
| 9  | 陈永智    | 全职员工                 | 199,000      |
| 10 | 刘文建    | 全职员工                 | 99,000       |
| 11 | 彭杨     | 全职员工                 | 99,000       |
| 12 | 杨春兰    | 全职员工                 | 99,000       |
| 13 | 刘海志    | 全职员工                 | 99,000       |
| 14 | 刘强     | 全职员工                 | 89,000       |
| 15 | 周建芳    | 全职员工                 | 79,000       |
| 16 | 刘勇     | 全职员工                 | 49,000       |
| 17 | 王国坤    | 全职员工                 | 49,000       |
| 合计 |        |                      | 5,370,000    |

第一期股权激励计划对被激励对象设定了考核目标，考核期间为 2021-2023 年，激励对象的服务期自 2021 年 11 月授予激励股权起至 2023 年 12 月止，相关股份支付费用已在服务期内进行分摊确认。截至本招股说明书签署日，第一期股权激励计划的激励对象均已满足各年度考核目标，第一期股权激励计划已实施完毕。

## 2、第二期股权激励计划

2023 年 6 月 28 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《成都莱普科技股份有限公司关于<制定公司第二期股权激励方案>的议案》，制定《成都莱普科技股份有限公司第二期股权激励计划》（以下简称“第二期股权激励计划”）。

第二期股权激励计划的激励对象为实施股权激励时现任及拟任的公司董事、高级管理人员、核心骨干员工、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员

工，公司最终确定 19 名员工为具体激励对象，合计授予 68.00 万股份，具体情况如下：

| 序号 | 激励对象姓名 | 获授激励股份时在发行人处任职情况 | 获授发行人股份数量（股） |
|----|--------|------------------|--------------|
| 1  | 唐昊     | 全职员工             | 250,000      |
| 2  | 付志良    | 全职员工             | 200,000      |
| 3  | 张满强    | 全职员工             | 80,000       |
| 4  | 索朝君    | 全职员工             | 10,000       |
| 5  | 杨春兰    | 全职员工             | 10,000       |
| 6  | 彭杨     | 全职员工             | 10,000       |
| 7  | 郭朝勇    | 全职员工             | 10,000       |
| 8  | 龙捷     | 全职员工             | 10,000       |
| 9  | 钟县英    | 全职员工             | 10,000       |
| 10 | 徐云     | 全职员工             | 10,000       |
| 11 | 徐万宇    | 全职员工             | 10,000       |
| 12 | 薛易     | 全职员工             | 10,000       |
| 13 | 江柯苇    | 全职员工             | 10,000       |
| 14 | 赵磊     | 全职员工             | 10,000       |
| 15 | 杨林森    | 全职员工             | 10,000       |
| 16 | 董林     | 全职员工             | 10,000       |
| 17 | 杜培     | 全职员工             | 10,000       |
| 18 | 舒祖刚    | 全职员工             | 5,000        |
| 19 | 陈冬冬    | 全职员工             | 5,000        |
| 合计 |        |                  | 680,000      |

第二期股权激励计划约定激励对象自获授股份之日起在公司的服务期需满 5 年。激励对象自获授股份之日起未满 5 年从公司离职（与公司解除劳动合同/聘用合同或事实上已经不在公司任职）的，无论是主动还是被动离职，自该事实发生之日起，激励对象不再享有其在有限合伙企业的出资额及其派生权益，并应将其持有的有限合伙企业出资额（包括认缴尚未实际缴纳出资额，以及已经实际缴纳的出资额）转让给普通合伙人或公司董事会指定的第三方，转让价格为激励对象向有限合伙企业已实际缴纳的出资额。第二期股权激励计划相关股份支付费用已在服务期内进行分摊确认。

### 3、锁定期安排

#### （1）东莞莱普出具的股份锁定承诺

员工持股平台东莞莱普已出具《关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》，就其所持发行人股份的锁定期承诺，详情请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件三、与投资者保护相关的承诺”。

#### （2）股权激励计划约定的锁定期

第一期股权激励计划和第二期股权激励计划对于激励对象的锁定期安排约定如下：

“考核期/服务期届满之日前、公司股票在证券交易所挂牌交易之日（以下简称“上市日”）前，以及上市日 12 个月内（以下简称“锁定期”），除公司董事会书面同意外，有限合伙企业不得转让、质押或委托第三方管理其所持公司股份/股权，亦不得就该等股份/股权与任何第三方达成利益承诺、协议、安排。

除本股权激励计划另有规定或公司董事会书面同意外，自授予激励股份/股权之日起，锁定期届满之日止，激励对象不得转让或委托第三方管理其持有的有限合伙企业出资额及该等出资额对应的公司股份/股权，不得在其持有的有限合伙企业出资额及该等出资额对应的公司股份/股权之上设置任何担保或限制性权利，亦不得就其持有的有限合伙企业出资额及该等出资额对应的公司股份/股权与任何第三方达成其他协议安排，但因有限合伙企业持有公司股份/股权而根据中国证监会或证券交易所要求设置流通限制的情形除外。”

### 4、员工持股平台对外转让情况

2023 年 7 月 1 日，经发行人第一次董事会第十一次会议决议，同意黄永忠等 8 位第一期股权激励计划的激励对象对外转让所持有的合计 269,000 股激励股份，通过转让东莞莱普持有发行人的股份减持激励股份，前述 8 人激励股份的具体变动情况如下：

| 序号 | 激励对象名称 | 本次转让前持有的激励股份数量（股） | 本次转让的激励股份数量（股） | 本次转让后持有的激励股份数量（股） | 本次转让激励股份所对应的东莞莱普出资额（元） |
|----|--------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 1  | 黄永忠    | 1,766,000         | 76,000         | 1,690,000         | 114,000.00             |
| 2  | 王德友    | 199,000           | 49,000         | 150,000           | 73,500.00              |



| 序号 | 激励对象名称 | 本次转让前持有的激励股份数量（股） | 本次转让的激励股份数量（股） | 本次转让后持有的激励股份数量（股） | 本次转让激励股份所对应的东莞莱普出资额（元） |
|----|--------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 3  | 潘冬     | 199,000           | 49,000         | 150,000           | 73,500.00              |
| 4  | 何刘     | 999,000           | 24,000         | 975,000           | 36,000.00              |
| 5  | 刘弘     | 299,000           | 24,000         | 275,000           | 36,000.00              |
| 6  | 刘强     | 89,000            | 19,000         | 70,000            | 28,500.00              |
| 7  | 刘海志    | 99,000            | 19,000         | 80,000            | 28,500.00              |
| 8  | 周建芳    | 79,000            | 9,000          | 70,000            | 13,500.00              |
| 合计 |        | 3,729,000         | 269,000        | 3,460,000         | 403,500.00             |

上述激励股份转让事项已经发行人董事会审议通过，符合第一期股权激励方案约定的“除本股权激励计划另有规定或公司董事会书面同意外，自授予激励股份之日起，锁定期届满之日止，激励对象不得转让或委托第三方管理其持有的有限合伙企业出资额及该等出资额对应的公司股份”。

## （二）以东莞骏峰为员工持股平台实施的员工股权激励

### 1、授予和实施情况

2021年11月，出于吸引王晓峰、潘岭峰加入公司的考虑，发行人召开2021年第二次临时股东大会，同意东莞骏峰以1.50元/股的价格向公司新增359.00万股股本，当时王晓峰、潘岭峰为公司技术顾问。2023年1月，王晓峰、潘岭峰成为公司全职员工。王晓峰、潘岭峰通过认缴东莞骏峰出资额的方式取得了上述359.00万股公司股份，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 获授激励股份时在发行人处任职情况 | 目前在发行人处任职情况 | 获授发行人股份数量（股） |
|----|-----|------------------|-------------|--------------|
| 1  | 潘岭峰 | 技术顾问             | 全职员工        | 1,799,000    |
| 2  | 王晓峰 | 技术顾问             | 全职员工        | 1,791,000    |

公司授予王晓峰、潘岭峰的激励股份不涉及服务期安排，相关股份支付费用在授予当期一次性确认，本次股权激励已实施完毕。

### 2、锁定期安排

#### （1）东莞骏峰出具的股份锁定承诺

东莞骏峰均已出具《关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》，就其所持发行人股份的锁定期承诺，详情请参见本招股说明书“第十二节 附件”之

“附件三、与投资者保护相关的承诺”。

## （2）王晓峰、潘岭峰出具的股份锁定承诺

王晓峰、潘岭峰已出具《个人承诺函》，承诺：东莞骏峰 2021 年 11 月通过增资形式取得的莱普科技 359.00 万股股份为激励股份性质，其中，本人通过东莞骏峰间接持有 179.10 万股/179.90 万股莱普科技激励股份。本人通过东莞骏峰间接持有的莱普科技激励股份遵守公司《2021—2023 年股权激励计划》的相关约定。截至本承诺函出具日，本人未曾对外转让本人通过东莞骏峰间接持有的莱普科技激励股份。自本承诺函出具日起至公司股票在证券交易所挂牌交易之日（简称上市日）前、以及上市日 12 个月内，除公司董事会书面同意外，本人不得转让或委托第三方管理本人间接持有的莱普科技激励股份，不得在该等激励股份之上设置任何担保或限制性权利，亦不得就本人间接持有的莱普科技激励股份与任何第三方达成其他协议安排，但因根据中国证监会或证券交易所要求设置流通限制的情形除外。

## （三）股权激励对发行人的影响

### 1、对发行人经营状况的影响

通过进行员工股权激励，公司建立健全了长效激励机制，充分调动了高级管理人员与骨干员工的工作积极性，提高了公司的凝聚力，增强了公司竞争力。

### 2、对发行人财务状况的影响

为公允地反映股权激励对公司财务状况的影响，公司已就上述股权激励确认了股份支付费用。

报告期各期，公司确认的股份支付金额分别为 566.53 万元、682.58 万元、348.15 万元、**261.11** 万元。公司确认上述股份支付费用，减少了当期营业利润及净利润，但不影响公司现金流和净资产。

### 3、对发行人控制权变化的影响

因增资或股份转让等原因导致的员工持股平台所持有的发行人股份数量发生变动，未对发行人控制权造成影响。

十五、发行人员工情况

（一）员工人数及报告期内变化情况

报告期各期末，发行人员工人数及变化情况如下：

| 日期    | 2025. 9. 30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 人数（人） | 342         | 277        | 202        | 127        |

（二）员工构成

截至 2025 年 9 月 30 日，公司及控股子公司各类员工专业结构如下：

| 职能     | 人数（人） | 占总人数比例（%） |
|--------|-------|-----------|
| 研发人员   | 79    | 23. 10    |
| 管理人员   | 86    | 25. 15    |
| 销售人员   | 17    | 4. 97     |
| 售后服务人员 | 21    | 6. 14     |
| 生产人员   | 139   | 40. 64    |
| 合计     | 342   | 100. 00   |

截至 2025 年 9 月 30 日，公司及控股子公司各类员工受教育程度如下：

| 学历       | 人数（人） | 占总人数比例（%） |
|----------|-------|-----------|
| 硕士研究生及以上 | 28    | 8. 19     |
| 本科       | 178   | 52. 05    |
| 大专及以下    | 136   | 39. 77    |
| 合计       | 342   | 100       |

截至 2025 年 9 月 30 日，公司及控股子公司各类员工年龄分布如下：

| 年龄           | 人数（人） | 占总人数比例（%） |
|--------------|-------|-----------|
| 51 岁以上       | 15    | 4. 39     |
| 41 至 50 岁（含） | 39    | 11. 40    |
| 31 至 40 岁（含） | 124   | 36. 26    |
| 30 岁（含）以下    | 164   | 47. 95    |
| 合计           | 342   | 100       |

（三）员工社会保障情况

报告期各期末，发行人及其子公司缴纳社会保险、住房公积金员工人数相关

情况如下：

| 项目         | 社会保险     |         |          | 住房公积金    |         |          |
|------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
|            | 已缴纳人数（人） |         | 未缴纳人数（人） | 已缴纳人数（人） |         | 未缴纳人数（人） |
|            | 公司缴纳     | 委托第三方代缴 |          | 公司缴纳     | 委托第三方代缴 |          |
| 2025.9.30  | 330      | -       | 12       | 316      | -       | 26       |
| 2024.12.31 | 264      | -       | 13       | 256      | -       | 21       |
| 2023.12.31 | 193      | -       | 9        | 182      | -       | 20       |
| 2022.12.31 | 101      | 22      | 4        | 95       | 22      | 10       |

报告期内，为满足部分员工在工作地缴纳社会保险、公积金的需求，发行人委托第三方企业代缴江苏、广东员工的社会保险、住房公积金。发行人于 2022 年 7 月设立了控股子公司江苏莱普，并于 2023 年 3 月设立了深圳分公司；江苏莱普、深圳分公司已开立社会保险费和住房公积金账户，为所在地员工缴纳相关费用，发行人在上述地区的员工不再通过第三方企业代缴。

报告期各期末，发行人部分员工未通过公司缴纳社会保险、住房公积金的具体情况列示如下：

| 未缴纳社保、公积金原因        | 2025.9.30 |            | 2024.12.31 |            | 2023.12.31 |            | 2022.12.31 |            |
|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    | 未缴社保人数（人） | 未缴公积金人数（人） | 未缴社保人数（人）  | 未缴公积金人数（人） | 未缴社保人数（人）  | 未缴公积金人数（人） | 未缴社保人数（人）  | 未缴公积金人数（人） |
| 退休返聘，无须缴纳          | 7         | 7          | 6          | 6          | 4          | 4          | 1          | 1          |
| 新员工入职导致的社会保险手续办理迟延 | 3         | -          | 5          | -          | 3          | -          | 2          | -          |
| 新员工试用期内未缴纳住房公积金    | -         | 15         | -          | 12         | -          | 13         | -          | 7          |
| 员工个人原因自愿放弃缴纳       | 2         | 4          | 2          | 3          | 2          | 3          | 1          | 2          |
| 合计                 | 12        | 26         | 13         | 21         | 9          | 20         | 4          | 10         |

注：不含发行人委托第三方企业为员工代缴社会保险、住房公积金。

发行人及其子公司所在地的社会保险、住房公积金主管部门均已出具证明，确认发行人及其子公司在报告期内未因违反社会保险、住房公积金相关法律法规

而受到行政处罚。

发行人控股股东东骏投资已出具承诺：“若发行人及其子公司因任何社会保障及住房公积金相关法律法规执行情况受到追溯（包括但不限于经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金，受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持），本公司将无条件全额承担相关补缴、处罚的款项、利益相关方的赔偿或补偿款项、发行人及其子公司因此所支付的相关费用”。

## 第五节 业务与技术

### 一、发行人的主营业务、主要产品或服务基本情况

#### （一）发行人主营业务

莱普科技以先进精密激光技术及半导体创新工艺开发为核心，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。公司主要产品包括激光热处理设备与专用激光加工设备两大序列，已广泛应用于 12 英寸集成电路产线、先进封装产线，是国内少数同时为半导体前、后道工序提供前沿激光工艺设备的厂商。

先进精密激光技术贯穿应用于半导体制造及封装测试流程，具有低热预算、低应力、高精度、无接触、工艺时间灵活、工艺兼容性强等优势，可以精准选定工艺区域，是半导体 28nm 及以下制程、三维堆叠、同质集成、异构集成、Chiplets 等先进制程和先进封装的关键支撑技术之一。

莱普科技始终以用户需求为牵引，立足于自主创新，面向半导体产业有针对性地开展先进精密激光技术、创新工艺和设备的研发工作，并延伸布局至精密电子及 MLED 等产业。公司依托自身在光学、机械、电气、软件算法以及半导体创新工艺等领域的深耕积累和人才培育，已具备为客户批量化供应先进激光工艺设备与解决方案的技术实力，成功赋能下游半导体制造工艺优化及先进产品开发，并助力我国存储芯片产业在全球竞争中形成局部领先地位。同时，公司积极为国产零部件供应商提供产业验证机会，推动上游突破技术瓶颈、加速技术迭代。

莱普科技现已适配国内半导体产业技术特征开发了多款原创性产品，并推出多款对标国际一流水平的半导体专用激光工艺设备，打破国际厂商在国内市场长期垄断局面。报告期内，公司相关设备已部署于客户 A、客户 B、客户 C、华润微、士兰微、三安半导体、中车时代、客户 D、华天科技、达迩科技等主流半导体厂商的先进制程和先进封装产线，并成功应用于先进制程 3D NAND Flash 存储芯片、先进制程 DRAM 存储芯片、28nm 及以下先进制程逻辑芯片、SiC 功率芯片、沟槽栅型 IGBT 功率芯片、先进电源管理芯片、BSI-CCD 芯片量产，以及国产 HBM 芯片工艺研发等前沿应用场景。



莱普科技是国家高新技术企业和国家级“专精特新”重点小巨人企业，2024年四川省重点“小巨人”企业，入选“2024年成都市集成电路产业链链主企业”。自成立以来，公司已承担国家某部委应用专项，建成了四川省企业技术中心、四川省先进全固态激光工程技术研究中心，并与中国科学院半导体研究所、合作单位 A、合作单位 B 就半导体新型工艺开发建立合作研发机制。公司荣获集成电路创新联盟第六届和第七届“IC 创新奖-产业链合作奖”，是本奖项设立以来唯一获奖的激光热处理设备供应商，也是唯一连续获得本奖项的半导体设备供应商；公司另获中国通信工业协会“2020 年度半导体设备卓越创新奖”、客户 A “2024 年度优秀技术支持团队”、客户 A “协同创新奖”、客户 C “新锐突破奖”、客户 C “研发合作奖”、晶合集成“在地化突破奖”等奖项。

（二）发行人主要产品或服务

公司基于先进精密激光技术和半导体创新工艺开发激光工艺设备，主要应用于半导体先进制程和先进封装。

先进精密激光技术基于特定工艺要求选定适配激光器，采用折/反射式多元光学整形系统显著提升原始激光的精度、均匀性和效率；同时集成使用包括光学偏振调控系统、高重复性运动控制系统、闭环温控系统、扫描路径智能规划系统、时序控制系统等光学、机械、电气、软件算法子系统以优化激光能量控制水平，实现最小作用深度纳米级别、最高运动精度纳米级别、最短作用时间飞秒级别的工艺能力。

半导体工业中，先进精密激光技术在以 3D NAND Flash、DRAM、HBM 为代表的集成电路三维器件，28nm 及以下先进制程集成电路逻辑芯片，硅基以及第三代化合物半导体功率芯片制造等多个前沿应用场景中表现出卓越的工艺优势。公司依托先进精密激光技术面向半导体产业工艺需求开发了激光热处理设备和专用激光加工设备两大产品序列，为客户提供覆盖从制造到封装的多环节激光工艺解决方案，推动半导体产业迈向更高精度、更高效能以及更先进技术水平。

| 产品类别    | 产品名称             | 定位                                  | 功能与应用                             | 主要客户                             |
|---------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 激光热处理设备 | 激光诱导结晶设备（LIC）    | 自主创新，以原创性产品助力国家集成电路产业在存储芯片领域实现局部领先。 | 热处理工艺系半导体前道七大工艺步骤之一。先进精密激光技术凭借高度受 | 客户 A、<br>客户 B、<br>客户 C、<br>华虹公司、 |
|         | 激光诱导外延生长设备（LIEG） |                                     |                                   |                                  |

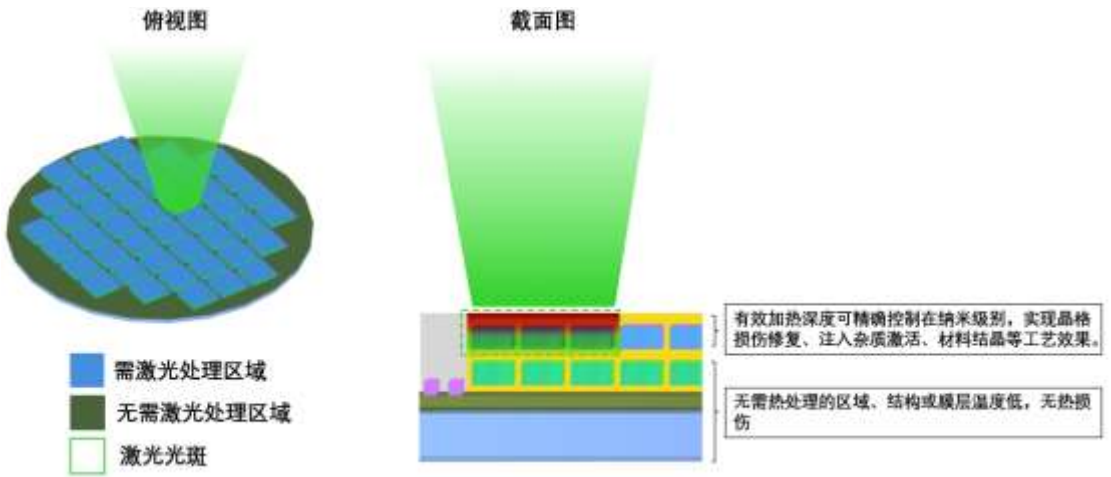
| 产品类别     | 产品名称             | 定位                                                          | 功能与应用                                                                                                                                                                                  | 主要客户                                                       |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          | 超浅结激光退火设备（USJLA） | 对标国际前沿技术水平推出的集成电路先进制程设备。                                    | 控和极高瞬时功率密度的特性，已大量应用于热处理工艺，满足半导体高端制程中对材料电学、力学性能更复杂、更精细的调控需求。<br>公司激光热处理设备最高可以在纳米尺度实现集成电路材料的精准修复/改性，或以极高效率实现功率芯片的退火处理。                                                                   | 晶合集成、中车时代、三安半导体、士兰微、华润微、客户 D、比亚迪半导体                        |
|          | IGBT 晶圆激光退火设备    | 对标国际前沿技术水平，助力客户降本增效、补齐产业关键短板。                               |                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|          | SiC 晶圆激光退火设备     |                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|          | BSI-CCD 晶圆浅结退火设备 | 安全备份，应对图像芯片领域潜在的供应链风险。                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| 专用激光加工设备 | 封测激光加工设备         | 对标国际前沿技术水平，助力客户降本增效、提高国际竞争力；积极探索先进精密激光工艺在先进封装等前沿应用场景的创新性应用。 | 利用先进精密激光技术代替传统刀具，基于最高兆瓦级的激光能量实现半导体等精密产品微米尺寸局部物料去除，以及复杂形状特征的高精度、高效率塑造。<br>激光的非接触、不受力加工方式高度契合硅、碳化硅、蓝宝石等硬脆材料，以及超薄晶圆等特殊形态加工对象；且激光高度受控、作用参数可调节性强等特性高度兼容各种规格、等级、形态的应用需求，是半导体等产业技术升级的核心驱动力之一。 | 客户 A、客户 C、长电科技、华天科技、达迩集团、比亚迪半导体、客户 D、佰维存储、先进半导体、菲尼克斯、华羿微电子 |
|          | 晶圆激光加工设备         |                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|          | 电子制造及其他加工设备      |                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                            |

1、激光热处理设备

热处理是半导体制造的关键工艺之一，用于在离子注入、薄膜沉积、金属化等工序后对材料进行晶格损伤修复、注入杂质激活和材料结晶改性等，从而调节其电性、物性等。

激光热处理属于先进精密热处理工艺范畴，是利用激光技术，选择适配波长、脉宽、重频及功率的激光，经过光学系统整形变换获得满足工艺要求的聚焦光斑，配合优化的激光位移路径照射并覆盖晶圆表面，在微观层面基于光子电子耦合、

光子声子耦合等方式使晶圆吸收激光光子能量后温度升高，实现所需的温度-深度、温度-时间分布，从而起到修复晶格损伤、激活注入杂质、无序晶格排列整齐化、形成欧姆接触等工艺目的。



相较于传统工艺，激光热处理工艺具备空间选择性强、处理周期短、灵活性强等特征，可以精准选定工艺区域，高度契合半导体微缩化、三维化、复杂化的发展趋势，是当前半导体高端制程热处理的主流工艺路线之一，并具备向其他制造环节横向拓展的潜力。

公司激光热处理设备已在逻辑芯片、存储芯片、功率芯片（含第三代化合物半导体）以及图像芯片等领域实现产业化应用并销往国内多家领先晶圆厂，是相关厂商高端工艺的核心设备之一。

| 产品名称          | 产品图片                                                                                | 技术特点                                                                                                                                         | 主要应用领域                         | 商业化阶段 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 激光诱导结晶设备（LIC） |  | 1、12 英寸先进制程集成电路量产设备，搭载自主研发的激光诱导能量调控光学整形系统；采用自定义并经深度优化的激光器；<br>2、热处理工艺深度控制于数十纳米级别；<br>3、具备诱导晶圆复杂表面形貌结构材料结晶的工艺能力；<br>4、可以调节三维集成电路复合材料的物理及电学性能。 | 某国产先进架构先进制程 3D NAND Flash 存储芯片 | 产业化应用 |

| 产品名称             | 产品图片                                                                                | 技术特点                                                                                                                                                                               | 主要应用领域               | 商业化阶段 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 激光诱导外延生长设备（LIEG） |    | <p>1、12 英寸先进制程集成电路量产设备，基于自主研发的光学系统开发，二维大尺寸平顶光斑能量分布均匀、尺寸自动调整、边缘陡直；采用自定义并经深度优化的激光器；</p> <p>2、通过诱发纳米级大深宽比沟槽或孔洞内非晶硅材料熔融并再结晶的方式消除空缝/空洞；</p> <p>3、可以增强三维集成电路沟槽或孔洞的导电能力，优化芯片频率、功耗等性能。</p> | 先进制程<br>DRAM 存储芯片    | 产业化应用 |
| 超浅结激光退火设备（USJLA） |   | <p>1、12 英寸先进制程集成电路量产设备，搭载自主研发的二维平顶光学整形系统；采用自定义并经深度优化的激光器；</p> <p>2、激活纳米级别深度的超浅结杂质、修复超低能离子注入造成的晶格损伤；</p> <p>3、严格控制杂质扩散深度，高效调控导电沟道载流子表面迁移率，显著提升导电性能。</p>                             | 28nm 及以下制程逻辑芯片       | 产业化应用 |
| IGBT 晶圆激光退火设备    |  | <p>1、整机设计面向功率芯片量产需求深度优化，基于自主研发的高均匀性一维平顶光斑整形等多项技术开发，光斑顶部均匀、长宽比可调；采用双腔大能量激光器、光束质量优化更适配光学系统；</p> <p>2、基于可见光波段激光，对背面减薄至数十微米的超薄 IGBT 晶圆实施精确退火工艺，加热区域控制在百纳米级别。</p>                       | 沟槽栅型 IGBT 功率芯片       | 产业化应用 |
| SiC 晶圆激光退火设备     |  | <p>1、整机设计面向功率芯片量产需求深度优化，基于自主研发的高均匀性平顶光斑整形、双光源自动切换等多项技术开发，兼容双波长、大能量激光器，产品适配度更高；</p> <p>2、针对性优化载台及腔室的控碳、控氧水平；</p> <p>3、百微米厚度 SiC 晶圆及</p>                                             | 第三代半导体材料碳化硅（SiC）功率芯片 | 产业化应用 |

| 产品名称                | 产品图片                                                                              | 技术特点                                                                                                                                                                                              | 主要应用领域       | 商业化阶段 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| BSI-CCD<br>晶圆浅结退火设备 |  | 纳米级别厚度金属薄膜的精密退火工艺能力,可以形成半导体-金属界面的良好欧姆接触,降低功耗。<br>1、基于自主研发的大长宽比线性平顶光学整形技术、高精度能量密度调控技术开发,宽方向尺寸仅数微米;利用单模紫外超短脉冲激光器,控制热扩散;<br>2、可以有效激活数十微米厚度 BSI-CCD 图像芯片晶圆注入杂质,扩散深度控制于 10 纳米以内;<br>3、增加图像芯片灵敏度、减小暗电流。 | BSI-CCD 图像芯片 | 产业化应用 |

## 2、专用激光加工设备

激光加工是通过各种传递、变换、控制手段将激光聚焦于目标区域后转化为热能,或凭借极大瞬态功率电离打断材料化学键,实现局部物料去除并赋予材料形状特征的微纳加工工艺。相比其他加工手段,激光加工具有无接触、无磨损、无切削力、无直接冲击、灵活调制、能量密度高、加工速度快、热影响和热变形小等优点,拥有更高效的微纳加工能力,高度适配小型化、超薄化的半导体器件制造需求,以及高硬度、高脆性、高熔点的新材料加工需求,已在半导体前/中/后道工艺环节、精密电子制造等领域逐步取代传统机械加工。

公司现已推出面向封测、晶圆制造、电子制造及其他领域应用需求的专用激光加工设备。

| 产品名称     | 产品图片                                                                                | 技术特点                                                                                                                                                | 主要应用领域                                 | 商业化阶段 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| 封测激光加工设备 |  | 1、利用激光高峰值功率、无接触压力、快速准确的特点,在半导体封装测试领域对各类封装体芯片(如塑胶、金属管壳、塑性基板等材料封装)进行标刻、切割、刻蚀、汽化等加工工艺;<br>2、公司激光标刻产品具备智能化、高适应性、高兼容性、高可靠性等特征,可以对加工对象实施安全、高效、无污染的激光加工工艺。 | 主要应用于分立器件在线高速激光标刻,框架、基板封装的激光标刻、切割及汽化剥离 | 产业化应用 |



| 产品名称          | 产品图片                                                                               | 技术特点                                                                                                                                                                                                                 | 主要应用领域                                                           | 商业化阶段 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 晶圆激光加工设备      |   | 1、面向晶圆制造领域，采用先进精密光学技术处理聚焦光斑，并适配不同类型激光器，对硅、碳化硅、Low-K等各类材料晶圆进行ID标刻、刻蚀、切割、键合及解键合等加工工艺；<br>2、公司产品具备多种激光运行与光束整形模式，可以基于不同波长、脉宽激光器以及光学整形系统的适配组合，获得单点、多点、多焦点、长焦深等多种光束分配模式，以及圆形平顶、线性平顶、矩形平顶等不同激光能量分布形貌，并配合其他设备模块以保证最佳加工质量和效率。 | 主要应用于功率芯片晶圆TAIKO环切割；Si/SiC晶圆及背面金属的激光标记、隐切、半切、全切及刻蚀开槽；解三维集成电路晶圆键合 | 产业化应用 |
| 电子制造及其他激光加工设备 |  | 1、面向电子制造、MLED等领域的精密、异形、复合材料的差异化加工需求；<br>2、应用紫外、绿色、红外波段的纳/皮秒激光以及先进光路整形设计技术、自动激光功率控制技术、振镜控制技术，并搭载高精度运动平台，以多种工作模式对蓝宝石、玻璃、PCB、陶瓷、塑料等材料进行标刻、切割、焊接等加工工艺。                                                                   | 主要应用于显示行业LED蓝宝石衬底、摄像头的镀膜玻璃、照明行业的陶瓷基板、存储SD卡、CCD摄像头的PCB基板的标刻、切割、焊接 | 产业化应用 |

### 3、升级改造及其他技术服务

随着国家半导体等产业的迅速发展，新材料、新工艺和制程技术的持续突破，晶圆厂、封测厂等客户对已有产线/设备的技术升级需求逐步增加。公司基于自身工艺技术和经验优势为客户提供设备升级改造等技术服务，主要包括对客户已有的晶圆、封测、精密电子激光工艺设备实施核心零部件/模块更换、改造、功能增强等服务。

### 4、主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入按产品或服务类别构成情况如下：



单位：万元

| 项目          | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|-------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|             | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 激光热处理设备     | 16,000.03    | 85.46%  | 24,429.21 | 87.90%  | 13,816.34 | 74.10%  | 3,467.26 | 48.05%  |
| 专用激光加工设备    | 2,589.78     | 13.83%  | 3,085.07  | 11.10%  | 4,059.67  | 21.77%  | 3,602.52 | 49.92%  |
| 升级改造及其他技术服务 | 132.39       | 0.71%   | 278.83    | 1.00%   | 768.41    | 4.12%   | 146.53   | 2.03%   |
| 合计          | 18,722.20    | 100.00% | 27,793.12 | 100.00% | 18,644.42 | 100.00% | 7,216.31 | 100.00% |

（三）主要经营模式

1、盈利模式

公司遵循市场化原则、坚持自主创新并结合客户生产工艺需求，主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，通过向半导体制造、半导体封装、精密电子及科研等领域客户销售激光系列设备或提供技术服务实现收入和利润。

2、研发模式

（1）研发体系

公司以推动产业升级为出发点，构建同步面向产业当前急迫需求与远期应用场景的正向研发体系。

公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式。自主研发体系主要由技术中心、事业部下属研发中心及子公司下属研发部门组成，其中技术中心关注前沿技术理论的原始开发，事业部及子公司关注前沿技术的持续开发并负责设备开发过程各类工程化技术研发，二者共同开展前沿工艺技术研究及新型设备开发，致力于为客户提供更具前瞻性、更高效的产业化激光工艺解决方案。

公司同时积极构筑产业链纵向交流协作机制，在经营过程中联合合作单位 A、合作单位 B、中国科学院半导体研究所等领先企业或机构开展覆盖先进半导体零部件、设备和制造工艺的多层次、多维度合作，进而打造产业链上下游协同发展体系。

基于科学的研发创新配置体系，公司研发强度逐年提升，已形成前瞻性基础研究与客户现时需求研发相结合、中长期科研目标与短期需求兼顾的正向研发机制。

## （2）研发流程

公司主要以新设备为载体开展研发项目。新品研发及产业化流程主要包括以下阶段：

### ① 预研及立项阶段

公司根据捕获的市场动态或承接的国家科研任务开展商业和技术层面的初步可行性研究，预研通过后则进一步明确研发目标，制定研发计划并分配研发资源，完成项目立项。

### ② 开发实现阶段

公司内部开展技术研究并搭建研发样机，或利用现有平台实现并验证新产品核心功能。本阶段的研发活动由公司主导；为精确匹配市场需求，公司可能基于潜在客户提供的晶圆样片、测试数据进一步优化技术方案。新技术经公司内部评议认定达到既定性能要求后，可开展产业化验证。

### ③ 产业化验证阶段

一般而言，公司在新技术具备产业化验证基础且取得较为明确的市场需求意向后开启产业化验证阶段，并结合客户的具体需求制造生产样机。本阶段公司主要围绕产业技术需求，针对设备的外围配套功能、生产效率、稳定性、一致性等多方面需求在前期基础上开展进一步研发活动，并配合客户进行设备产线验证。

生产样机经客户验收通过，且完成公司内部评议等必要流程，认定达到既定性能要求和商业化应用水平，标志新产品研发成功、相关技术成熟且具备大规模产业化应用基础，研发项目结项。

### ④ 产业化应用阶段

公司基于成熟技术批量生产设备产品，相关技术进入产业化应用阶段。本阶段公司围绕客户反馈的新型产业需求，或按照产品生命周期内正常升级节奏进行持续的改进性质研发活动。

### 3、采购模式

#### （1）采购内容

公司具备光、机、电、算四大系统的软硬件一体化研发整合能力，拥有激光热处理设备和专用激光加工设备两大类产品完整的系统级同步正向研发体系。基于此，公司主要采购零部件级原材料，包括光学类、电气类、机械类及其他零部件等，并自主完成各模组、系统、设备的研发、集成与调试，从而交付完整设备产品。

#### （2）采购流程

公司整体采用“以产定采”的采购模式，结合生产计划和现有库存情况实施采购。对于定制、交货周期较长的物料，采购部门每月结合生产部门的次月生产计划进行一定提前备货，并根据订单交付情况进行核对修正；对于常用的批量大的零部件，采购部门则一般在年度采购协议项下根据生产需求按批次采购、结算。

公司主要采用直接采购模式，对于通用标准零部件，公司根据型号需求进行统一采购；对于激光器、镜片、机架、钣金件、其他机械加工件等零部件，公司基于研发及设计方案向供应商提供图纸或者规格参数进行定制采购。少数情况下，公司委托具备专业资质或能力的供应商进行部分零部件的外协加工，主要为板卡贴片、镜头镀膜等。

公司建立了严格的采购管理体系，对供应商设置准入资格审查，并定期考核评估，以确保原材料采购价格合理，质量符合公司标准，交货期以及服务等满足公司生产节奏。采购相关部门严格遵照各项流程制度进行采购、合格原材料入库管理。

### 4、生产模式

#### （1）生产体系

公司主要基于自主生产体系制造设备产品。公司主要采用“以销定产”的生产模式，基于市场需求及交付时限制定生产计划，并弹性安排生产，实行按单生产、按需生产。

公司产品生产严格遵循生产工艺和作业规范。此外，公司持续推进产品生产

的标准化工作，针对客户确认的技术方案和功能、参数需求，公司产品生产主要基于前期研发定型的可复制模块进行聚合应用，或针对具体需求开展补充研发形成新型模块并应用于当前及未来设备，从而降低产品成本，实现对客户需求的高质高效响应。

## （2）质量控制体系

公司建立了严格的产品质量控制制度，并由采购部门、生产部门和质量中心共同落实，形成有效的产品质量控制体系。

公司在原材料采购和入库、产品生产、成品检测等多环节设置控制节点，以构筑产品质量的全链条保障体系。其中，采购部门负责供应商遴选及考核，生产部门主要负责生产过程的全方位测试调试以及完工后的自检，质量中心主要负责原材料入库以及整机完工后出货前的检验。

## （3）生产流程

市场营销部门获得的客户需求经审批通过后即传递至生产部门，由其建立相应生产项目、制定生产计划并安排生产任务。完成方案及设计评审并经确认符合客户需求的产品方案可投入生产，公司各相关部门进行原材料采购、模块及设备安装、调试、质量检验及入库管理。

公司具体生产流程，详见本节“一、发行人的主营业务、主要产品或服务基本情况”之“（六）主要产品的工艺流程”。

# 5、销售模式

## （1）销售渠道

公司主要产品具备复杂度高、专业性强、差异化明显等特征，因此公司采取以直销为主的销售模式。公司以四川省成都市为营销总基地，并在全国多地建立服务办公室以覆盖各区位客户。公司由专人对接终端客户的采购、研发、工程和使用等专业部门，以期对客户的工艺、配置、应用及运维等技术要求形成全方位快速响应能力，提升服务质效，同时贴近市场以把握市场即时动态。少数情况下，公司采用经销模式，基于经销商的渠道优势开拓市场。

直销模式下，对于已经批量供应的成熟产品，公司主要通过现有客户产线扩

张和迭代升级产生的复购需求，或基于公司品牌、现有成功应用案例推广产生的增量客户需求实现销售；对于新型产品，由于其主要满足半导体制造的前沿需求，客户相关工艺尚未验证定型，其技术开发与公司设备供应互为前提，因此公司一般在客户工艺开发阶段即深度介入，在此过程完成自身新型设备产品的研发、制造和销售。

## （2）验证程序

公司对新客户特定型号的首台设备销售一般需经过完整验证程序，包括设备装机、硬件验收、单步工艺验证、工艺整合验证等流程，对于部分客户，公司还需配合完成量产验证等流程；对于同一客户通过验证后同类产品的二次销售，产品型号及工艺的可靠性已经前序机台验证，因此公司一般仅需配合客户完成设备的单机可靠性、一致性验证等。

经安装、调试、培训完成且性能及技术参数均符合公司与客户双方约定要求的设备产品符合验收条件，公司取得客户出具相关验收报告（单）并将其作为收入确认依据。

## （3）定价及结算方式

公司与客户主要基于市场化公平交易原则协商定价，少数订单采用招投标定价形式。

公司主要采用“预付定金-发/到货款-验收款-质量保证金（若有）”的分步结算方式，具体付款条件及比例视客户订单规模、行业地位、信用状况以及商业谈判结果而定。一般而言，公司产品经客户验收后款项结算比例可达 90%，若有剩余款项则作为质量保证金待质保期结束收齐。

## 6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司当前采用的经营模式是在长期发展中逐步形成并不断优化的结果，高度适应国家产业政策、市场需求、行业发展趋势，以及公司自身主营业务、产品特点和研发生产能力。

报告期内，公司经营模式与主要影响因素均未发生重大变化，相关事项在可

预见的未来也将保持稳定。

#### **（四）成立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况**

公司自 2003 年成立以来一直专注于先进精密激光技术及相关设备研发，主要产品的演变和技术发展情况如下：

##### **1、自设立起即专注于激光工艺技术（2003 年-2008 年）**

激光技术是二十世纪与原子能、半导体及计算机齐名的四项重大发明之一，公司设立之初即充分意识到激光工艺技术在未来先进制造领域的巨大应用潜力及广阔市场前景，因此确立了以激光工艺技术为核心驱动的发展战略。

公司持续投入研发资源，汇聚激光技术专家与科研人才，全力攻克激光技术开发及应用难题。基于彼时国内制造业全面蓬勃发展的状况，公司研究并开发了若干项激光技术及其延伸产品，公司积极探索激光工艺技术在传统工业领域中的应用，推出了激光打标机、激光焊接机、激光切割机、激光内雕机等产品。

##### **2、响应国家产业需求，切入激光工艺半导体设备领域（2008 年-2020 年）**

受益于第三次半导体产业转移，中国大陆持续承接转移的半导体产能，并催生了大量微纳加工工艺需求。公司基于多年来对激光应用技术的开发与理解，准确把握行业发展趋势，并将业务重心聚焦至半导体领域，面向国家产业需求针对性开发激光工艺半导体设备。

2008 年，公司成功推出面向半导体封装测试领域的专用加工设备。此后，公司业务布局持续向半导体前道工艺延伸，于 2013 年在工艺平台上采用激光方式实现离子激活与扩散并形成了自有的硼离子注入激光激活技术；2014 年，公司在前述技术基础上自主研发了第一代光学系统，设计开发出适配的激光退火工艺，并于同年完成了原型机台的开发工作；2015 年，公司结合下游半导体器件制造过程中的定制化需求，开发出适配的深磷激活特色工艺，形成 6 寸/8 寸晶圆退火机台并进入客户量产线验证；2018 年，公司生产的硅基超浅结退火机设备以及 SiC 激光退火设备通过工艺验证；2019 年，公司 8 英寸 IGBT 激光退火机台通过量产验证。



### 3、完善业务布局，服务先进集成电路制造，实现业绩快速增长（2020 年至今）

2020 年后，全球以及我国集成电路产业的发展出现了新的趋势，主要表现在：第一，在技术层面，依赖 EUV 的传统路线面临物理瓶颈以及成本激增等问题，产业界加大了三维堆叠集成、新材料新器件等创新路线的研发，其中三维堆叠集成被认为是能够借助目前装备和工艺提供“超越摩尔”能力的最佳路线；第二，国际形势动荡变化，不可预测性加大，使得国内的集成电路产业立足国产材料供应商、国产装备供应商等开展研发和生产的迫切性加强，为国产装备企业带来发展契机。

基于前期在集成电路领域先进激光加工技术和装备方面的积累，以及与头部和客户的良好合作关系，公司主动积极布局先进集成电路制造领域业务。

2021 年，公司面向客户 A 某国产先进架构 3D NAND Flash 制造工艺需求开发激光诱导结晶设备（LIC）并于次年验证通过；2022 年，公司面向客户 C 先进制程 DRAM 制造工艺需求开发了激光诱导外延生长设备（LIEG）并于 2024 年验证通过；2023 年公司面向先进制程逻辑芯片制造工艺需求开发了超浅结激光退火设备（USJLA）并于 2024 年验证通过；2024 年公司面向先进制程逻辑芯片制造工艺需求开发了动态表面合金设备（DALA）并于 2025 年验证通过；2024 年公司面向三维集成电路制造需求开发了激光解键合设备并发往国内领先晶圆厂验证。前述设备成功助力我国集成电路产业前沿技术突破，并推动公司经营业绩快速增长。

长期以来持续的创新案例是公司自身技术实力与服务能力的有力佐证，公司已成为下游多家头部晶圆厂客户在创新工艺开发过程的重要伙伴之一。未来，公司将基于半导体等下游产业的激光热处理及激光加工需求进一步完善业务布局，持续推进产品矩阵的多元化发展与深度优化，协助客户创新突破、降本增效，并增强自身市场竞争能力、抗风险能力以及盈利能力。

#### （五）主要业务经营情况和核心技术产业化情况

莱普科技以先进精密激光技术为核心，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产和销售，并提供相关技术服务。报告期各期，公司主营业务收入分别为

7,216.31 万元、18,644.42 万元、27,793.12 万元和 **18,722.20 万元**，最近三年复合增长率达 96.25%；净利润分别为-938.22 万元、2,279.87 万元、5,491.16 万元和 **988.73 万元**，呈现出良好的成长性。

公司围绕先进精密激光技术的产业应用需求建立了覆盖光、机、电、算以及半导体工艺的全流程核心技术体系，面向半导体制造、封装测试、精密电子制造等行业推出多款技术产品，切实满足客户在集成电路先进制程等高端应用场景下低热预算、高空间精度且时域可调的热处理工艺需求，以及高精度、低热应力激光微纳加工工艺需求。

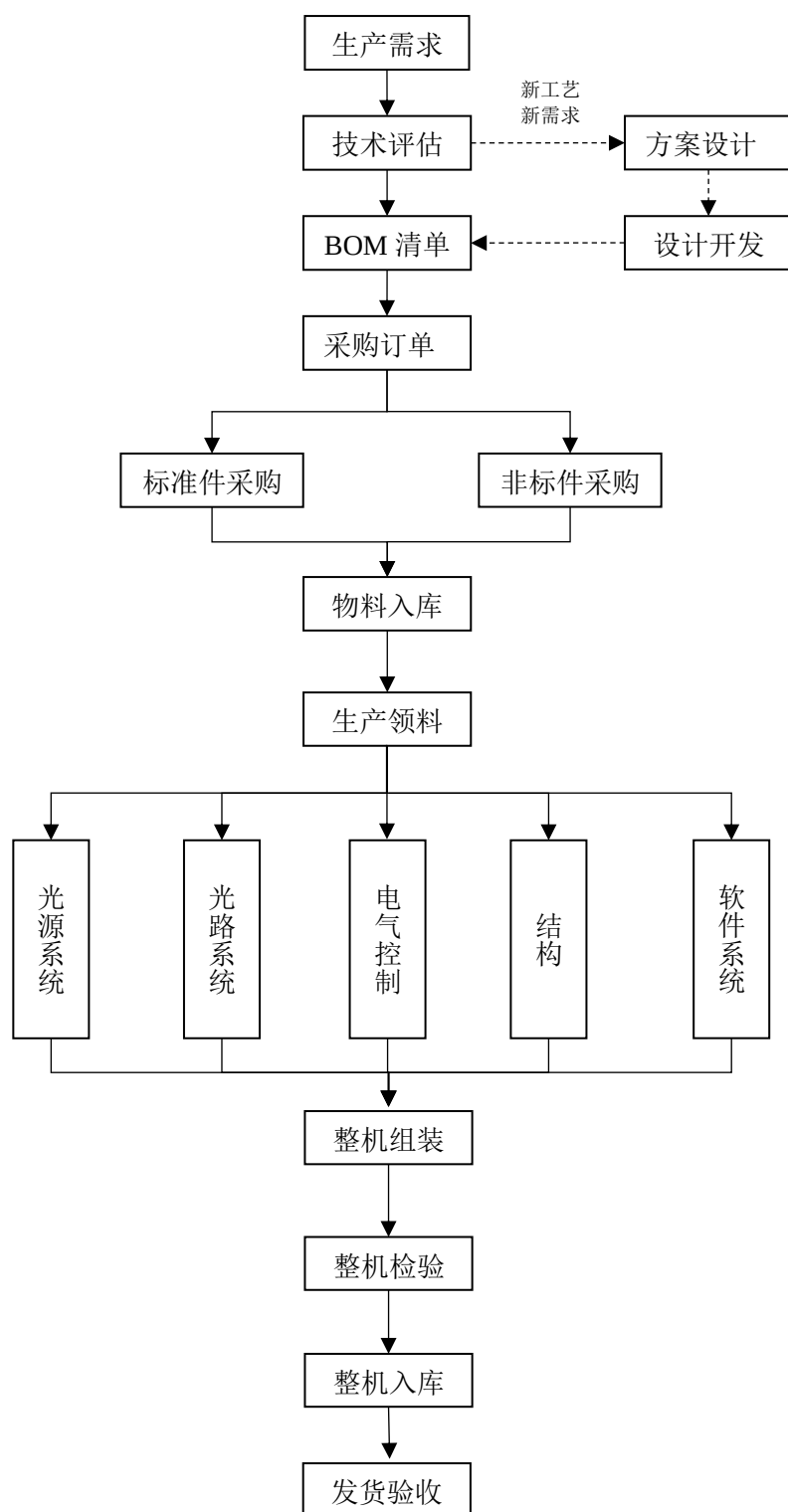
报告期内，公司核心技术的产业化随着公司设备产品对外交付及服务提供而持续得到实践与深化，其产生的收入占当期营业收入的比例情况如下表所示：

单位：万元

| 项目       | 2025 年 1-9 月     | 2024 年度       | 2023 年度       | 2022 年度       |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 核心技术产品收入 | <b>18,552.64</b> | 27,493.44     | 17,815.71     | 7,059.51      |
| 营业收入     | <b>19,046.49</b> | 28,102.42     | 19,075.73     | 7,414.56      |
| 占比       | <b>97.41%</b>    | <b>97.83%</b> | <b>93.39%</b> | <b>95.21%</b> |

（六）主要产品的工艺流程

公司主要产品为激光工艺半导体专用设备，产品工艺流程以模块化生产为主，兼具有系列化、标准化、柔性化的特点。公司基于模块间的聚合应用提高生产灵活性，缩短生产周期，同时也能够快速响应不同客户不同配置的需求，具体的工艺流程如下：



公司核心技术在生产流程中的具体使用情况和效果详见本节之“七、发行人核心技术及研发情况”之“（一）核心技术”之“2、发行人的技术先进性及具体表征”。

## （七）报告期内代表性的业务指标情况

报告期内，公司设备产量及销量、收入规模、研发投入等代表性业务指标呈现良好增长态势。公司主要代表性业务指标情况详见本招股说明书“第五节 业务及技术”之“四、发行人的销售情况和主要客户”和“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析”。

## （八）主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略

我国政府已将提升半导体产业链韧性和安全水平纳入国家顶层战略规划设计，“十四五”规划明确要求推动集成电路等产业创新发展；国务院及其下属部门也出台一系列半导体产业支持政策，旨在提升生产装备供给水平，强化关键产品自给保障能力。

2024 年，国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将集成电路装备列入鼓励类目录；工信部发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024 年版）》涵盖了热处理设备、激光切割设备，并且首次将激光退火装备列入目录。

公司从产业急迫需要和长远需求出发，以用户需求为牵引，面向半导体产业有针对性地开展先进精密激光技术、工艺和设备的研发工作，并延伸布局至精密电子及 MLED 等产业。公司所处的“专用设备制造业”位于半导体产业链上游核心环节，对于实现我国半导体产业发展、缓解供应链风险等国家经济发展战略具有重要意义，属于国家产业政策支持鼓励行业。公司主要产品面向半导体先进制程、先进封装领域，已应用于先进制程 3D NAND Flash 存储芯片、先进制程 DRAM 存储芯片、28nm 及以下制程逻辑芯片、SiC 功率芯片、沟槽栅型 IGBT 功率芯片量产，并助力国产 HBM 研发突破，能够切实支持和配合国家发展 AI、新能源、先进计算等新质生产力的重大战略实施。

## 二、发行人所属行业基本情况

### （一）发行人所属行业及其依据

公司所属行业为半导体专用设备行业，根据证监会《上市公司行业统计分类与代码》，公司隶属于“专用设备制造业”（行业代码：C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司隶属于“专用设备制造业”（行业代码：

C35）下的“半导体器件专用设备制造”（行业代码：C3562）；根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司隶属于“新一代信息技术产业”下的“集成电路制造行业”。

（二）发行人所属行业主管部门、行业监管机制、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门及监管体制

公司所处的半导体设备行业政府主管部门为发改委、工信部和科技部，行业自律组织为中国半导体行业协会和中国电子专用设备工业协会。

| 主管部门/<br>行业协会 | 主要职责                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发改委           | 主要负责组织拟订综合性产业政策，协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，研究制定行业发展战略、规划，指导行业结构调整与技术改造、审批和管理投资项目。                            |
| 工信部           | 主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。                                                        |
| 科技部           | 主要负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，牵头科研项目资金协调、评估、监管机制，拟订国家基础研究规划、政策和标准并组织实施，编制国家重大科技项目规划并监督实施等。                              |
| 中国半导体行业协会     | 主要负责贯彻落实政府产业政策，主要职责为落实产业及市场的调查、统计、研究和预测，对会员企业提供引导、咨询服务；贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议，并代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。 |
| 中国电子专用设备工业协会  | 主要负责向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息；代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见；做好政策导向、信息导向、市场导向工作；广泛开展经济技术交流和学术交流活动，发展与国外团体的联系，促进产业发展，推动产业国际化等。     |

发改委、工信部、科技部与中国半导体行业协会、中国电子专用设备工业协会共同构成了我国半导体设备行业的监管体系，各半导体设备企业在行业主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束引导下进行规范健康经营。

2、行业政策法规

为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，我国近年来推出了一系列鼓励和支持半导体产业链发展的政策，为半导体全产业链的发展营造了良好的政策环境。主要的行业政策法规如下：

| 政策名称                               | 颁布年份 | 颁布部门                    | 主要相关内容                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024 年版）》     | 2024 | 工信部                     | 热处理装备、激光退火装备、激光切割装备均已纳入首台（套）重大技术装备推广应用指导目录。                                                                                                                   |
| 《产业结构调整指导目录（2024 年本）》              | 2024 | 发改委                     | 第一类 鼓励类……二十八、信息产业……4. 集成电路：集成电路装备及关键零部件制造。                                                                                                                    |
| 《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》     | 2023 | 财政部、税务总局、发改委、工信部        | 国家鼓励的集成电路装备、材料、封装、测试企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。 |
| 《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》          | 2022 | 中共中央国务院                 | 提出全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。                                                                                                         |
| 《“十四五”数字经济发展规划》                    | 2022 | 国务院                     | 着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，提升产业链关键环节竞争力，完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。                                               |
| 《国民经济和社会 发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 | 2021 | 全国人大                    | 制定实施战略性科学计划和科学工程，瞄准前沿领域。其中，在集成电路领域，关注集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发、集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破，先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。                         |
| 《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》             | 2021 | 工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会 | 明确依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。                                                        |

3、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

近年来，国家针对半导体产业链出台了多项利好政策，并明确指出半导体产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。

在良好的政策环境下，公司及所处的半导体设备行业迎来历史性发展机遇：上游供应链能力及稳定性持续加强、下游需求旺盛，行业内公司获得财政、税收、人才培育、产业链协同等多方面直接支持。



公司将把握政策带来的发展契机，聚焦自主研发，面向市场持续推进技术升级与产品迭代，扩大经营规模，提高市场占有率，并与上下游协同合作构筑更具稳健性的国产半导体供应链体系。

### （三）发行人所属行业概况与发展态势

#### 1、半导体及其设备行业

##### （1）半导体产业概述

半导体器件通过材料和结构上的设计达到控制电流传输的目的，并以此为基础构建各类高效的信号、能量处理电路，连接了人类社会所需两大基础要素——信息和能源。这是半导体在当今社会广泛应用的根本原因，也为该产业的蓬勃兴盛注入了源源不绝的动力。

整体来看，中国大陆已然是全球最大的半导体消费市场，也是全球重要的半导体投资市场，但供应链若干环节的国产供应能力偏低，部分半导体高端器件和高端设备存在对外依存现象。

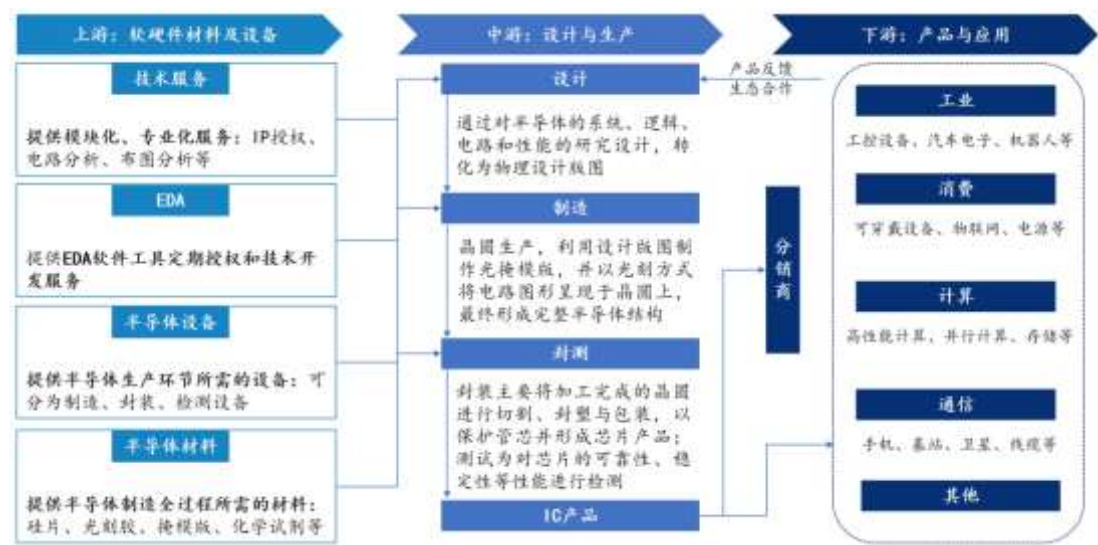
目前，中国大陆半导体产业界积极探索各种创新技术路线，主要包括新工艺（激光退火及改性、原子层刻蚀、原子层薄膜沉积、超低能离子注入等）、新结构（同质集成、异构集成、键合堆叠、光电集成、Chiplets 等）、新材料（用于逻辑芯片沟道填充的高迁移率材料金属锗、用于 NAND Flash 芯片制造的铁电材料、用于 DRAM 芯片制造的铟镓锌氧化物材料等）三个方面，从而实现先进工艺从无到有的突破。

激光工艺正在前述先进场景中持续展现应用潜力，并成为未来较长一段期间内助力前沿技术突破的重要工具。例如中国台湾半导体研究所在 IEDM 2021 上发布的采用纳秒绿光激光退火工艺实现多层锗单晶沟道，同时利用 USJLA 设备实现超浅结杂质激活从而制备多层 FinFET 结构芯片，最终与硅芯片实现了异构集成。类似的技术突破也将进一步提升激光半导体工艺等相关设备的重要性及需求量。

##### （2）半导体产业结构

半导体产业由上游的软硬件材料及设备供应、中游的设计与生产、下游的模

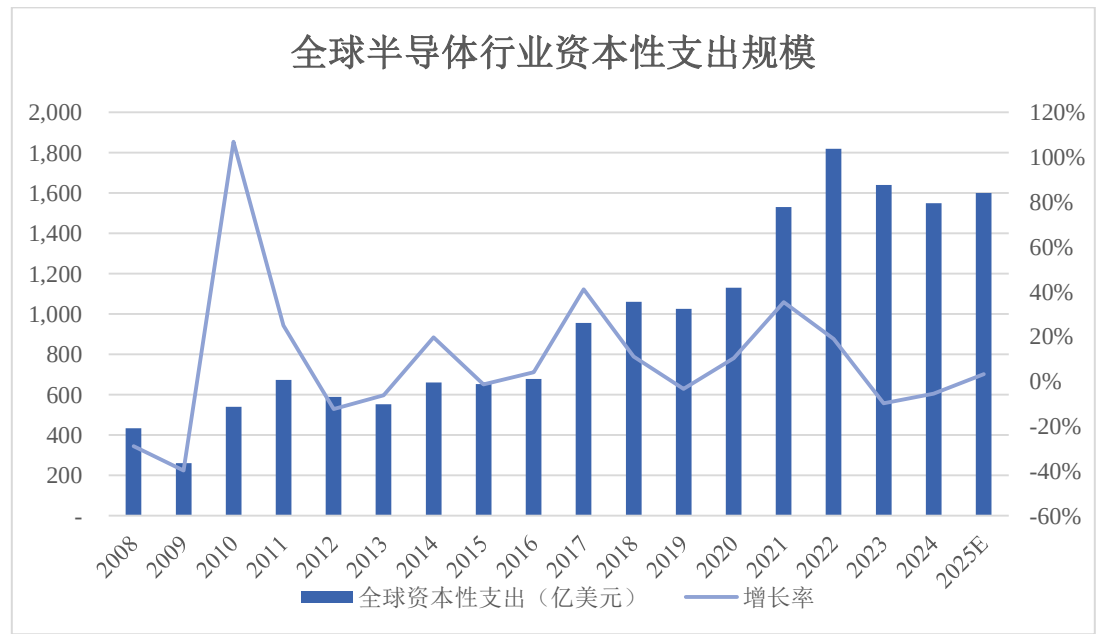
组制造与应用共同组成。



软件、材料及设备是半导体器件设计与生产的先决条件，其供应稳定性直接关联到整个行业的产出效率与创新能力。

（3）半导体行业投资趋势

近年来，半导体产业展现出显著的成长性，产业投资规模维持高位；加之半导体成为当前国际科技竞争的焦点之一，全球各主要国家/地区普遍采取了包括资金补贴在内的一系列举措以促进当地半导体产业发展，进一步推高了行业整体的投资规模。IC Insights 等机构数据显示，全球半导体行业资本性支出已常年维持于 1,600 亿美元水平。



数据来源：IC Insights；SC-IQ

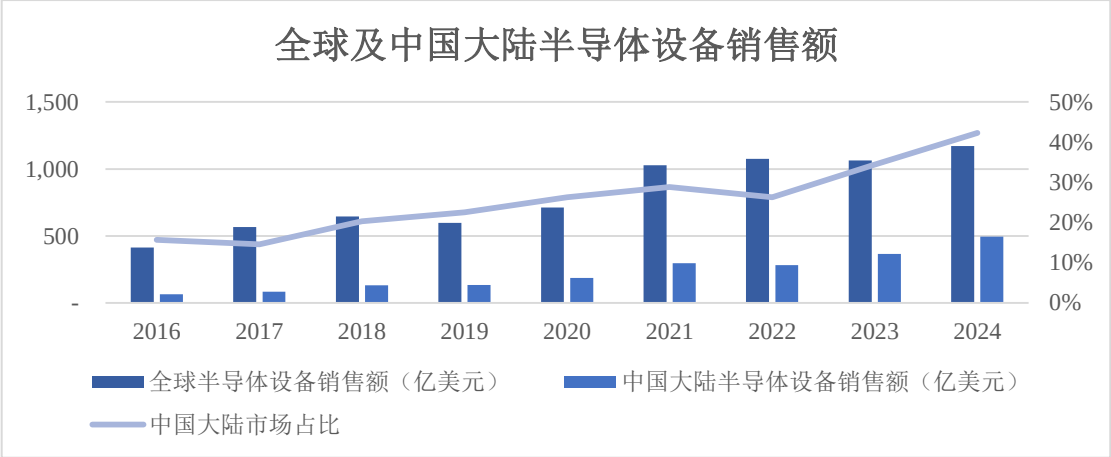
SEMI 报告显示，中国大陆将成为未来数年间全球半导体产能扩张的主要区域，2022 年至 2026 年，中国大陆计划运营的新晶圆厂数量为 44 个，占全球新经营晶圆厂比例达 40.37%。对于技术含量较高的集成电路，中国大陆产能也快速提升，Knometa Research 数据显示，2022 年至 2026 年，中国大陆集成电路产能全球占比将从 18.2% 上升至 22.3%，并预计在 2026 年超越中国台湾成为全球最大的集成电路供应地区。中国大陆的产能增长将带来大量设备增量需求及一定的存量替换需求。

#### （4）半导体设备行业发展情况

设备系半导体产业最主要的投资对象，通常占据产业总资本支出的 75%~80%。随着半导体产业资本性支出提升，以及先进制程工艺步骤增加导致设备需求量大幅增长（IBS 数据显示，万片晶圆产能的设备投资额已由 90nm 时代的 4.3 亿元增长至 3nm 时代的 43 亿元），半导体设备市场规模加速扩容。

2016 年起，智能手机、可穿戴设备等终端需求增长以及半导体制造工艺持续升级带动全球半导体产业投资规模整体呈现增长态势。2023 年，消费电子产品需求疲软，且前期大规模产能扩张导致部分未来需求提前释放，因此全球半导体设备市场规模有所收缩，SEMI 数据显示，当年全球半导体设备销售额为 1,062.5 亿美元。但随着晶圆厂建设项目稳步推进、产能扩张以及技术迁移，设备市场经历短暂下调后即重拾增长态势；加之在 AI 发展驱动下，HBM 等新型逻辑、存储、功率器件及三维堆叠、异构集成等新型先进封装需要的全新工艺技术将推动设备迭代换新，进一步拉高设备市场规模，2024 年全球半导体设备销售额达到 1,171.4 亿美元。

2021 年以来，中国大陆多年蝉联半导体设备最大单一市场地位。2024 年，中国大陆市场占比达到 42.30%，销售额为 495.5 亿美元。

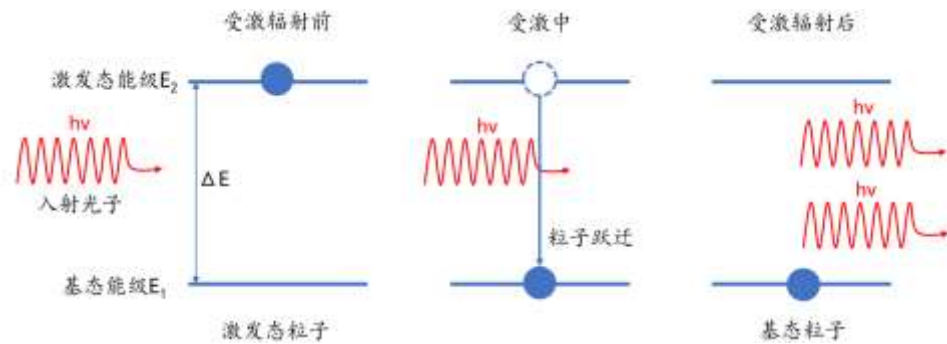


数据来源：SEMI

2、激光工艺半导体设备行业

(1) 激光设备行业

激光是粒子受激辐射产生的一种高度有序光束。物质中粒子吸收能量后跃迁到高能级  $E_2$  位置（下图左），此时若存在适当外来光子直接作用，粒子将由高能级向低能级  $E_1$  位置跃迁，并将能量以完全一致的频率、位相和传播方向的光子形式释放出来，从而加强外来光束并形成激光，因此激光具有单色性、方向性、相干性和高能量密度等特点。

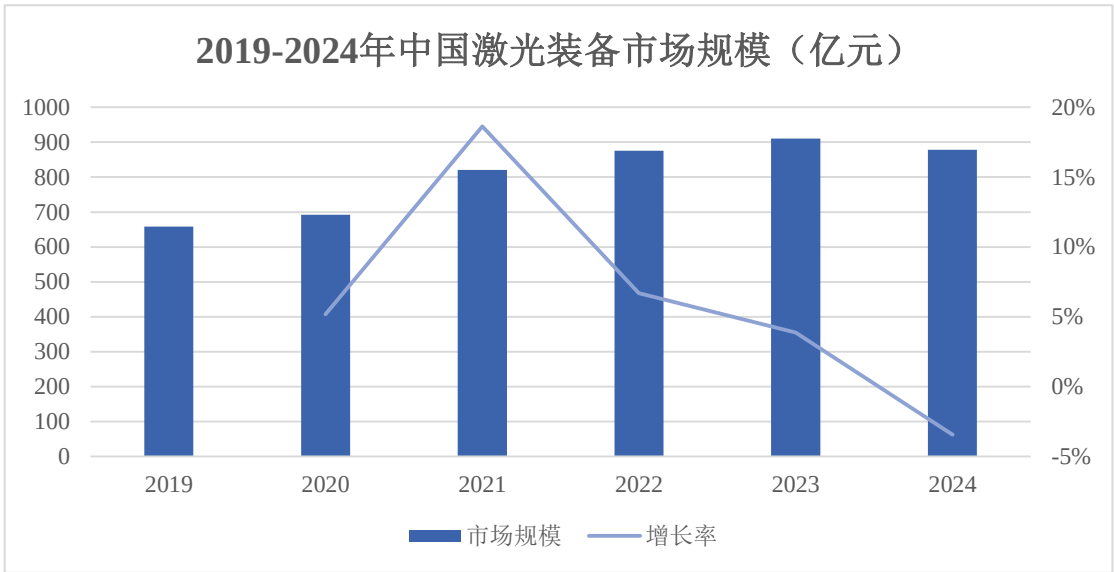


以激光为核心的技术具备显著工艺优势：

| 激光技术优势 | 说明                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 非接触式加工 | 基于精准的光路控制和高效的能量管理，该技术无需直接接触工件的材料即可加工，不会施加机械应力，避免机械变形且有利于达到工业粉尘/颗粒控制要求，防止污染。<br>高精度光学整形系统可调节激光焦点位置并穿透材料，在不破坏材料表面的情况下进行工件内部结构加工。 |
| 加工精度高  | 激光具备极强的方向性、稳定性和极窄的光谱，可以将能量引导集中于微米、纳米范围内，搭配高精度运动控制系统，可以保证良好的加工精度和加工一致性。                                                         |
| 作用时间短  | 经整形矫正且聚焦的激光具有局部瞬间加热的特性，同时搭配科                                                                                                   |

| 激光技术优势           | 说明                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 学的扫描路径规划，先进精密激光技术可以有效控制热损伤并提高工艺效率；或与其他工艺结合，实现工艺创新。                                                                               |
| 作用参数可调节性强、加工灵活性强 | 激光几乎可应用于所有类型材料，包括半导体、金属、高硬度、高脆性及高熔点材料。先进精密激光系统通过调节激光的光斑形状、位置、强弱、频率、偏振状态、发散角、均匀性等参数以影响材料的吸收特性和热效应，实现不同材料的不同工艺效果，进而满足各项制造工艺的个性化需要。 |
| 兼容性好             | 基于先进精密激光技术的以上优势以及其易于工业化的优势，先进精密激光设备与现有的半导体设备兼容性好，易于导入并用于量产。                                                                      |

2019 年以来中国激光设备市场规模整体快速增长，2024 年已达 878.73 亿元。



数据来源：《2024 中国激光产业发展报告》；《2025 中国激光产业发展报告》

凭借高度受控的特性及其在微纳加工领域的突出优势，激光技术已与包括半导体在内的先进制造业深度融合。目前，中国大陆厂商已在高精度机械制造、增材制造等高端工业场景中广泛应用激光技术，但激光技术在半导体领域的应用主要由境外厂商把持，如光刻、激光热处理等。

半导体与激光技术的融合应用突破是先进精密激光技术的蓝海市场，也是我国半导体产业迈向高端化的必经之路。

(2) 激光热处理设备行业

1) 热处理工艺概况

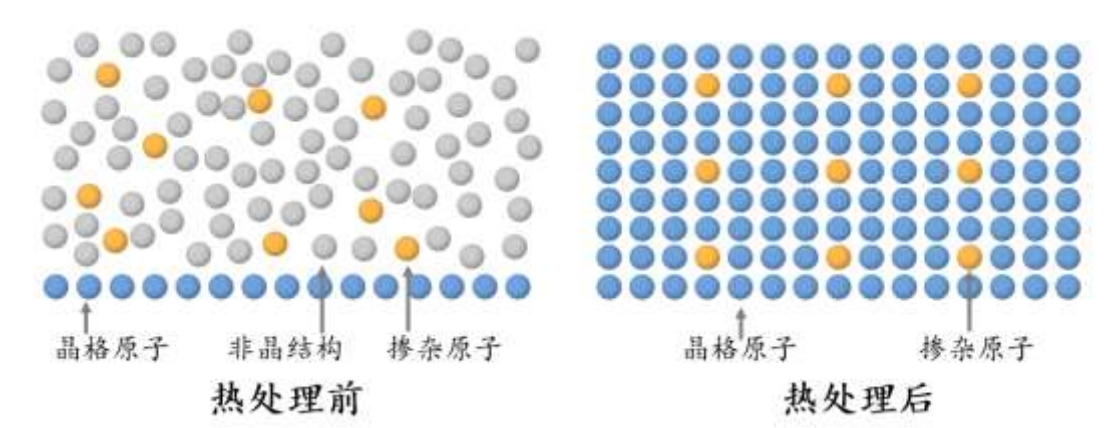
离子注入、薄膜沉积等半导体制造工艺可能会在材料中引入孔洞、杂质、位错等结构性缺陷，破坏材料晶格完整性和电学特性，导致性能无法达到器件制备



要求，且其内部残留应力也可能在后续制造过程中导致晶圆翘曲、破裂；金属化等制造工艺也会在实施过程引入结构缺陷，破坏材料体系并导致合金及电学连接无法匹配工艺要求。

热处理工艺通过控制半导体材料加热方式、强度、时间和位置等参数，利用热激活效应促使粒子运动，优化材料内部的电子和晶格结构以实现物理和化学性质的变化，可以有效处理离子注入、薄膜沉积、金属化等工艺导入的缺陷，从而改善半导体器件特性。

热处理工艺作用原理如下如所示：



以离子注入、薄膜沉积、金属化等半导体工艺为例，其对热处理需求的成因及具体效果说明如下：

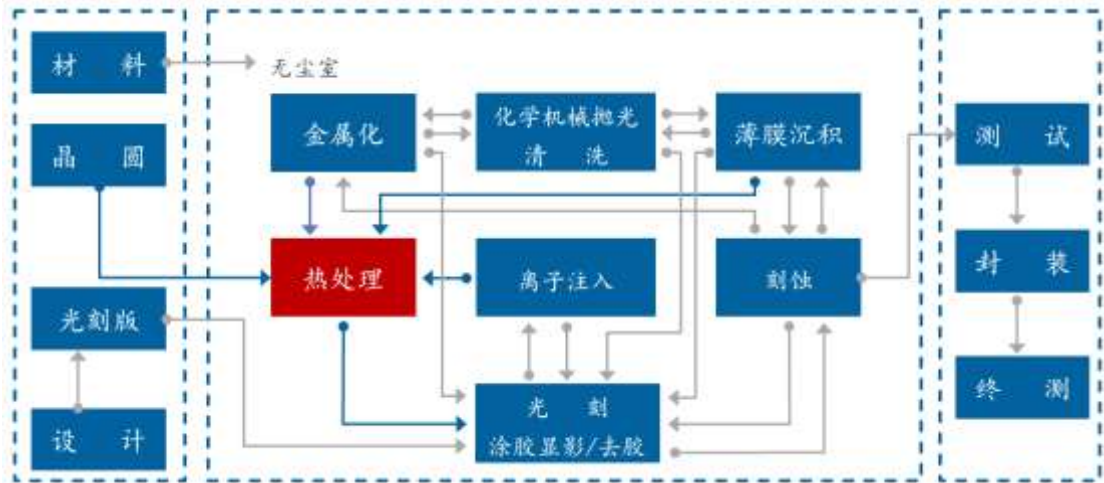
| 工艺   | 热处理需求                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 成因                                                                                                                                         | 主要效果                                                                                                        |
| 离子注入 | 半导体生产过程需要使用不同的离子掺杂以调控导电类型从而实现器件电学功能。<br>注入杂质离子时，高能量的入射离子会与半导体晶格上的原子发生碰撞，使得一些晶格原子发生位移，且杂质原子自身也处于间隙位置，造成大量的空位，导致注入区中的原子排列混乱或者变成非晶区，无法直接参与导电。 | 1、将掺杂离子移动至晶格原子位以提高晶体结晶质量并激活掺杂离子，提供电子或空穴等载流子；<br>2、修复离子注入带来的晶格损伤及位错；<br>3、定向调控离子的扩散以达到预期的离子分布。               |
| 薄膜沉积 | 通过物理或化学手段将材料沉积在基底上，从而创建半导体器件制造所需的薄膜结构。<br>由于不同层材料间晶格未完全匹配、热膨胀系数不同、沉积过程存在温度梯度、沉积速率不同等原因导致薄膜结构可能含有缺陷、内部应力或未完全结晶等问题。                          | 1、促使晶体再排列，消除缺陷和位错，提高晶体结晶质量，并减小晶格中的不均匀性和应力；<br>2、提供薄膜材料中的化学反应所需活化能，或促进合金形成；<br>3、改善薄膜与基底之间附着力，减少电路结构剥落和失效风险。 |



| 工艺  | 热处理需求                                                                                                |                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 成因                                                                                                   | 主要效果                                                                                                                 |
| 金属化 | 在晶圆表面沉积导电金属薄层后采用光刻和刻蚀工艺形成金属细线。<br>由于采用类似薄膜沉积的工艺，且金属细线应当具备良好的电接触性能、均匀的材料结构和长期稳定特性，因此金属化工艺存在同样的材料优化需求。 | 1、促使金属与半导体表面发生化学反应或形成更强的金属-半导体合金，提高附着力；<br>2、调整金属-半导体合金晶粒、取向、厚度、界面光滑度、组分等指标，降低接触电阻率；<br>3、消除表面颗粒状或不平整结构，提高表面均匀性和平整度。 |

近年来半导体制造对材料晶体结构和性能的要求不断提高，热处理工艺逐步成为半导体制造的必要工艺之一。此外，热处理还可用于扩散、氧化等用途，因此热处理已与光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗/抛光、金属化并列成为半导体前道七大工艺步骤，热处理设备也由此成为半导体产线的必要投资。

热处理与其他工艺之间的搭配应用情况如下图所示：



热处理设备在当前先进半导体制造中承担关键作用，其产业意义已被全球主要经济体所认识，美国和日本均有针对性地将热处理设备纳入出口管制范畴。相关举措不仅提高了我国半导体制造产业获取热处理设备的难度，也在一定程度上对我国热处理设备研发与制造带来了信息与技术封锁，中国大陆热处理设备厂商必须基于独立创新路径研制新品。

| 序号 | 时间               | 国家 | 文件                               | 说明                                      |
|----|------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 2023 年 5 月 23 日  | 日本 | 《外汇法》法令修正案                       | 将涉及先进芯片制造的 23 个半导体设备品类纳入出口管制，其中包含热处理设备。 |
| 2  | 2023 年 10 月 17 日 | 美国 | 《半导体制造物项的出口管制（Export Controls on | 列举的受限物料清单包含热处理设备。                       |

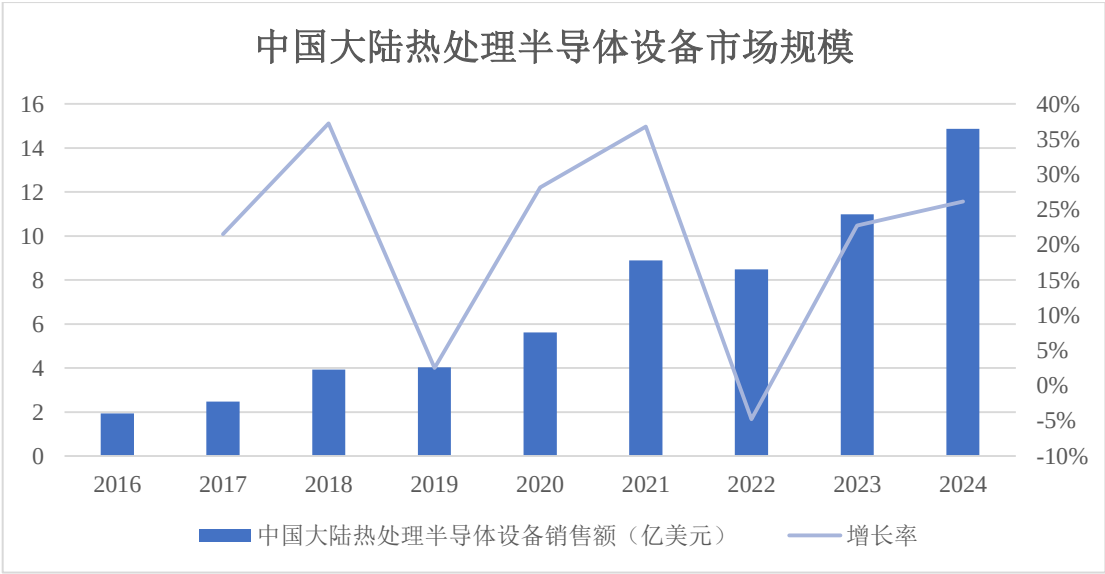
| 序号 | 时间              | 国家 | 文件                                  | 说明                                                |
|----|-----------------|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                 |    | Semiconductor Manufacturing Items）》 |                                                   |
| 3  | 2024 年 12 月 2 日 | 美国 | 《临时最终规则（Interim Final Rule）》        | 指出热处理设备是半导体制造过程调节材料性能的必要步骤，相关设备已纳入ECCN3B993 管制目录。 |

近年来，激光热处理等前沿热处理工艺还在持续突破传统应用边界，如半导体材料诱导相变、辅助外延生长、表面处理、超晶格动态调制等，并进一步抬升热处理工艺及相关设备的产业价值并拉动未来产业发展。IC Insights 数据显示，以常规热处理应用场景测算，在半导体设备市场中，热处理设备价值规模占比已达到 3%，整体与离子注入设备（3%）、清洗设备（4%）、CMP 设备（4%）和涂胶显影（3%）相近。



数据来源：IC Insights

结合 SEMI 数据测算，2024 年度中国大陆热处理半导体设备市场规模已达 14.87 亿美元，较前一年度增长 26.14%。



数据来源：IC Insights；SEMI

此外，根据海关总署数据，前道工艺设备中，热处理设备（商品编码：84862010）2024 年度进口额达到 148.80 亿元，仅次于三大主设备（光刻机、薄膜沉积设备以及刻蚀机），这体现了热处理设备对于半导体制造的重要意义，也凸显了我国热处理设备较高的对外依赖度。

2) 热处理工艺技术路线

目前，半导体热处理技术路线主要包括炉管热处理、快速热处理以及基于先进精密激光技术的激光热处理，三者对比说明如下：

| 技术路线 | 炉管热处理                                                                           | 快速热处理                                                                       | 激光热处理                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 示意   |                                                                                 |                                                                             |                                                                                     |
| 说明   | 将晶圆置于耐高温材料（如石英）制成的封闭长管形炉膛内，管炉周围包裹的电阻丝加热可以为晶圆提供热处理热量。                            | 使用大功率光源（如卤素灯），将光聚焦于晶圆上以实现快速加热。                                              | 特定波长、脉宽和功率的激光束经整形聚焦并扫描在目标表面，对材料局部进行瞬间加热，之后迅速冷却至室温。                                  |
| 特性   | 1、加热和冷却速度较慢（若干℃/S 量级）；<br>2、温度分布均匀，晶圆被整体加热，无法实现局部加热；<br>3、加热时间在分钟及小时量级，无法精确控制材料 | 1、加热和冷却速度较快（数百℃/S 量级）；<br>2、温度分布均匀，晶圆被整体加热，无法实现局部加热；<br>3、需要精确的控制手段以确保温度均匀； | 1、能量密度极高，局部加热速度极快，可控制于纳秒级（数千万℃/S 量级）；<br>2、可控性强，可以实现纳米层级的高精度的局部化加热；<br>3、穿透性可控，通过选择 |

| 技术路线 | 炉管热处理                                                  | 快速热处理                                          | 激光热处理                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | 扩散；<br>4、穿透性一般，主要依靠热传导和热对流实现热量传递；<br>5、工艺成熟，设备和操作成本较低。 | 4、穿透性一般，类似炉管热处理；<br>5、成本中等。                    | 合适的波长可以使得加热深度位于表面以下纳米至百微米范围内一定程度可控；<br>4、光斑尺寸灵活：最小数微米，最大可覆盖 12 寸晶圆；<br>5、成本较高。 |
| 温度范围 | 200~1000℃                                              | 600~1200℃                                      | 可突破 3000℃                                                                      |
| 时间窗口 | 小时级别                                                   | 秒级别，可达到毫秒级别                                    | 微秒级别，可达到纳秒量级                                                                   |
| 热预算  | 多（整体加热）                                                | 少（整体加热）                                        | 最少（局部定向加热）                                                                     |
| 应用场景 | 多用于深结扩散、材料生长、薄膜沉积等场合。如衬底已制备有热损伤阈值低的结构则不能使用炉管退火。        | 用于对单片晶圆材料进行快速加热和冷却，如衬底已制备有热损伤阈值低的结构则不能使用快速热退火。 | 适用于需要局部、高度定向、大功率、超短加热时间、低热损伤、低应力的加热，尤其是对于特定区域的精确处理。                            |

传统工艺场景大量使用的炉管热处理、快速热处理等技术存在以下缺陷：

- ①整体加热导致超薄片的翘曲增大，后续工艺实施难度增加（如光刻机难以对焦）且碎片几率提高；
- ②整体加热会对低熔点材料（如锡、铟）造成热损伤；
- ③功率密度不足，高熔点材料（如 SiC）热处理成本提高、工艺难度增大；
- ④无法有效控制热量扩散，无法应对超浅结杂质激活中的杂质扩散问题；
- ⑤热处理空域上不具备选择性，导致不必要层间应力的引入，对器件结构形成热损伤，尤其在三维异构集成器件的热处理过程中表现地更为明显。

因此，随着半导体器件制造工艺的精细化要求持续提升，特别是主流产品进入先进制程后，激光热处理工艺开始导入各类半导体制造，应用场景逐步拓宽。《三维集成电路制造技术》<sup>1</sup>一书即指出，集成电路三维技术未来发展面临的一大挑战也是热预算控制、器件热稳定性、额外的杂质热扩散等问题，激光技术在未来新型器件的热处理工艺中所占比例会越来越高。

<sup>1</sup> 《三维集成电路制造技术》系“十四五”时期国家重点出版物出版专项规划项目系列丛书之一，作者王文武博士曾任中国科学院微电子研究所副所长、研究员、博士生导师。

目前尚无权威机构对激光工艺在全球热处理工艺中渗透率数据进行调研或预测，若以激光热处理之激光退火工艺为例，QY Research 数据显示，2024 年全球晶圆激光退火设备市场规模为 9.10 亿美元，结合 SEMI 等机构数据综合测算，全球激光退火设备渗透率约 25.89%。2024 年-2030 年期间，全球激光退火设备市场规模增长率达 10.86%，超过未来一段期间内全球半导体设备市场规模整体增长率，预期激光退火设备将加速渗透，在 2030 年渗透率有望达到 32.93%。

3）激光热处理在半导体领域应用情况

激光热处理在半导体领域的成熟应用包括激光退火和激光材料改性，创新应用包括激光辅助刻蚀、激光辅助键合等，说明如下：

| 工艺     | 工艺原理及其应用说明                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 激光退火   | 利用激光热效应加剧晶格原子热运动，促进材料内部结构和组织的重排和重构、掺杂原子均匀地重新分布，在晶体结构层面改善晶格质量并优化材料性能，侧重离子注入等工序后的杂质激活、损伤修复等功能。                                                             |
| 激光材料改性 | 综合利用激光热效应、光化学效应，通过激光将能量辐照投射在特定区域，以光子能量引发化学键断裂形成化学变化，或快速加热（必要时熔化）表面材料，而后快速降温过程改善材料结晶特性或在熔化层液相外延生长出晶体薄膜，起增大晶粒尺寸、消除材料孔洞缺陷、界面缺陷等作用，侧重满足半导体三维结构更加严苛的材料电学性能要求。 |
| 激光辅助刻蚀 | 利用激光的热效应、光电效应、光化学效应等物理机制，结合激光的定点加热特性、时序可控特性并配合适当的光学系统，诱导触发、加速或调制刻蚀气体、刻蚀液体、刻蚀固体等刻蚀介质与硅或其它材料的反应，实现刻蚀功能。                                                    |
| 激光辅助键合 | 利用激光的光热效应，结合激光的无应力加工、定点加热特性、时序可控特性并配合适当的光学系统，透过晶圆材料和封装体，对异质结构封装的锡球触点加热至熔点，与下一层的金属实现熔接。由于激光辅助焊接具有作用时间快、温度闭环控制、非接触等特点，特别适合 2.5D/3D 异构集成结构的无翘曲和低应力焊接。       |

随着集成电路制造工艺的不断精细化，新兴工艺架构对材料的物理与化学性能要求日渐严苛，从而增加了材料退火和改性等热处理工艺需求；加之集成电路步入后摩尔时代，器件的二维尺寸接近物理极限，导致设计和制造转向三维集成，这一转变也导致热处理工艺面临更复杂、更精确也更多维的能量控制挑战。

对于分立器件，提升器件能量密度和长期稳定性，降低能量转换损耗是行业的一贯发展趋势，耐高电压、大电流的功率器件逐渐成为当下重点扩产对象，热处理作为优化材料结构和载流子分布的关键工艺也必须不断迭代以适应日渐复杂的器件结构和各类新型材料对激活效率和激活能的增长需求。



激光热处理技术是前述高端制程的必备工艺；此外，在 3D NAND Flash、SiC 功率芯片等产品制造中，基于激光热处理技术的制造方案还可以显著降低工艺综合成本。

激光热处理技术高度匹配前述半导体制造产业未来发展趋势的具体说明如下：

| 发展趋势   |           | 传统工艺痛点                                                                                                                                                                               | 激光热处理优势                                                                                                                                                           |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工艺节点推进 |           | 集成电路工艺尺寸微缩，导致结深等结构相应缩小。<br>热处理工艺必须在短时间内迅速升温至上千摄氏度后迅速降温，以较低的热预算使杂质进入晶格位置并修复缺陷，控制注入后的杂质再分布。<br>工艺节点进入 40nm 以下后，传统快速热退火工艺秒及亚秒级退火时间产生的热预算极易导致杂质扩散深度超出工艺要求，产生漏电、短沟效应等问题。                  | 激光退火时间可压缩至毫秒、微秒、纳秒甚至皮秒量级，且加热速率远超其他工艺，在有效激活并控制杂质扩散的同时不会破坏已形成电路结构。<br>同时激光退火技术采用局部加热方式，可以有效避免应力造成晶圆损伤或破片。<br>40nm 制程下，激光退火技术优势开始凸显，28nm 制程下，激光退火技术成为特定热处理工艺环节的主流技术。 |
|        |           | 部分集成电路内含微小孔状通道结构，随着器件工艺节点推进，相关结构的深宽比呈倍数增加，例如 DRAM 存储芯片工艺节点进入 1X nm 后 SNC 孔（用于电子流通）深宽比达到十倍乃至百倍，非晶硅填充到孔内后不可避免的存在缝隙、空洞等缺陷形态，将会影响接触电阻以及 DRAM 的整体性能。<br>传统热处理工艺难以在不损坏其他电路结构的前提下修复深孔结构内缺陷。 | 激光材料改性技术可以局部诱导硅重结晶，消除填充的非晶硅晶格缺陷，并诱导生长出近单晶或大晶粒多晶结构；同时，激光工艺热预算低的特性也会使得其热处理过程对其他区域的破坏性影响大幅降低，从而改善导电性能并提升 DRAM 等芯片性能。                                                 |
| 新结构    | 三维集成      | 温度敏感结构中（例如采用堆叠结构制造的晶体管结构），传统热处理工艺难以避免对敏感薄膜的损伤，从而影响器件特性甚至导致器件失效。                                                                                                                      | 激光退火，尤其是纳秒级激光退火时间更短，多采用脉冲形式，热预算极低，可以在不损害器件性能的前提下引入高温热处理工艺。                                                                                                        |
|        |           | 新型三维逻辑器件、新型三维存储器件（3D NAND Flash）可能存在超浅或超深非晶层熔融热处理需求，传统热处理工艺基于热传导、热扩散原理，难以在浅层处理过程控制热量扩散从而对其它器件区域造成不可逆损伤。                                                                              | 激光材料改性技术利用激光能量较高、可聚焦于局部区域且易于调制的特性，选择特定波长和入射角，控制激光焦点位置和能量吸收系数从而完成特定区域非晶层熔融热处理。                                                                                     |
|        | 沟槽栅型 IGBT | 通过对晶圆进行减薄、背面离子注入及退火工艺可以有效降低 IGBT 功耗、提高其开关速度并改善沟槽栅型 IGBT 导电性、机械强度和热稳定性，但传统背面热退火工艺实施温度应当低于 500℃以避免损坏                                                                                   | 激光热退火工艺可进行局域加热，保证晶圆正面处于较低温度同时在晶圆背面局域形成极高温，大幅度提高背面注入离子的激活率，并基                                                                                                      |



| 发展趋势 |         | 传统工艺痛点                                                                                                                                               | 激光热处理优势                                                                                     |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | 晶圆正面金属铝结构，在这一温度下注入杂质激活率有限，无法有效优化器件电学性能。                                                                                                              | 于热扩散原理实现较深激活和修复深度。<br>沟槽栅型 IGBT 推出以后，激光热退火工艺逐步成为其主流退火技术。                                    |
| 新材料  | SiC     | SiC 材料化学稳定性极高，须在 900℃以上条件下方能形成欧姆接触（电流可自由流通）；另外一方面，SiC 功率器件应用需要将 SiC 样片厚度减薄至百微米甚至更小以减小功耗，传统热处理方式因整体加热、热预算高等问题易出现样片翘曲、碎片等问题。                           | 纳秒级激光退火技术具备能量控制精准、瞬间脉冲功率高等的特点，且仅作用于特定吸收区，促进 Ni（镍）金属与 SiC 材料合金化并形成良好均一的欧姆接触，同时避免样片的翘曲、碎片等问题。 |
|      | 新金属（如钎） | 复杂集成电路中层间互联质量对集成电路性能的影响很大，为改善互联质量，新工艺中引入更多金属层。传统工艺围绕铜材料展开，进入 7nm 以下后，新金属（如钎）开始作为铜的替代品，以改善线路电阻并提高可靠性。<br>但是钎的熔点（2334℃）远高于铜（1083℃），传统热处理工艺难以供给足量的能量密度。 | 高能量的纳秒准分子激光材料改性技术可以显著增大钎等金属晶粒尺寸，并降低薄膜电阻以保障层间互联质量。                                           |

4）激光热处理设备市场规模及未来发展分析

逻辑芯片工艺制程进入 40nm 以下后激光热处理工艺技术优势开始显现，进入 28nm 以下后激光热处理工艺成为必备工艺之一； 3D NAND Flash 新架构下创新工艺、DRAM 的存储结构接触 SNC 工艺及字线接触 BLC 工艺必须采用激光热处理工艺，未来相关先进制程的产能建设将产生稳定的市场需求。SiC/GaN 等新材料、沟槽型 IGBT 等新结构的引入也将为激光热处理设备市场带来额外增量。

此外，随着集成电路结构向立体化发展，激光热处理技术因其高效性和精确性而得到广泛关注。在后摩尔时代，集成电路缩小单层线宽尺寸的边际效益逐渐减弱，三维堆叠、异构集成成为更具成本效益的技术路径。传统热处理基于热扩散、热对流原理，向堆叠集成结构内部输送能量必然导致外围电路过度升温；相比之下，激光热处理技术不仅加热时间短，而且可以实现能量的定向非接触传输，以较低的热预算对器件特定结构进行高效处理，高度匹配集成电路结构立体化发展趋势，将对传统热处理工艺形成一定程度的替代。

整体而言，激光热处理设备市场面临规模化和结构化的双重增长机遇：

| 增长类型  | 说明                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规模化增长 | 半导体作为当前社会经济运行基石，其规模与资本性支出将随经济发展而增长，这将为激光热处理设备市场带来持续的规模化增长；。                              |
| 结构化增长 | 随着集成电路先进制程的渗透率提升，新结构与新材料的持续引进则导致激光热处理工艺的应用占比增长，激光热处理技术应用边界持续突破，由此为激光热处理设备市场带来额外的结构化增长空间。 |

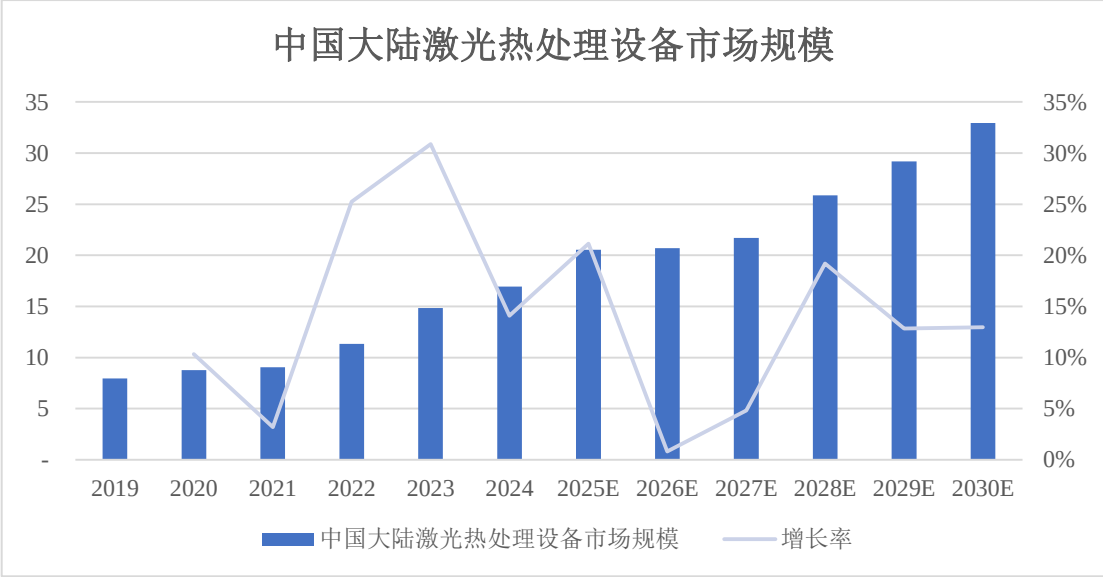
综上，激光热处理设备市场规模有望长期保持增长。

目前，激光热处理设备市场含激光退火设备市场与激光材料改性设备市场。QY Research 数据显示，2024 年全球激光退火设备市场销售额达到 9.10 亿美元，预计 2030 年将达到 16.89 亿美元；中国大陆是全球主要消费市场之一，2024 年市场规模为 1.95 亿美元，预计 2030 年将达到 4.30 亿美元。

激光材料改性方面，近年来，中国大陆领先半导体厂商在各自细分赛道内开发了具备先进水平的三维架构工艺，并产生了增量的激光材料改性需求。莱普科技基于热处理工艺开发了激光诱导结晶设备（LIC）、激光诱导外延生长设备（LIEG)等激光材料改性设备,热处理设备市场规模进一步扩容。结合 TrendForce、Morgan Stanly 等数据综合测算，2022 年-2030 年期间，相关市场规模各年介于 1~6 亿元。

综合测算，中国大陆激光热处理设备市场规模将由 2019 年的 7.96 亿元增长至 2030 年的 32.96 亿元，年复合增长率达 13.79%。

2024 年，中国大陆热处理设备市场，激光工艺技术路径渗透率达到 16.01%，仍低于全球平均水平（25.89%），预期存在较大的发展空间。



数据来源：QY Research；TrendForce；Morgan Stanly

注 1：2024 年及以前采用当年人民币兑美元平均汇率折算；2024 年以后采用 2024 年度人民币兑美元平均汇率折算；

注 2：激光材料改性设备市场仅以中国大陆领先厂商 2022 年及以后扩产需求谨慎测算。

除前述当前已明确的应用场景外，激光工艺技术凭借精度、效率、兼容性等方面突出优势将持续在半导体制造领域的应用挖掘。目前，集成电路工艺日渐复杂、创新迭代复杂度提升，激光热处理已逐步由过去的单步工艺转变为多步工艺、逐步替代传统热处理（含快速热处理），并在 CoWoS/HBM 等其他集成电路三维器件制造中展现工艺优势，市场规模有望进一步扩大。

（3）专用激光加工设备行业

1）激光加工工艺介绍及其在半导体领域应用情况

半导体制造过程涉及大量对晶圆或器件物理形态的高精密加工，如背面减薄、开槽、切割、钻孔、焊接、打标、解键合等，传统工艺主要是利用刀具、锯具、磨具等基于机械力对材料进行削除、切割、成型以赋予材料形状特征；激光加工则是利用激光束的高能量密度特性，通过光路整形将激光聚焦于目标区域后转化为热能并熔化、气化或升华材料，或凭借极大瞬态峰值功率电离打断材料的化学键，从而实现类似的材料切削、去除和成型等功能。

以切割工艺为例，传统机械加工与激光加工之对比说明如下：

| 技术路线 | 传统机械加工                                                                                                                                                                        | 激光加工                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 说明   | 刀具（刀片、刀轮等）物理上接触并削除材料从而实现所需的去除功能。                                                                                                                                              | 将激光能量于极短的时间内集中在微小区域，使固体升华、蒸发的全切割加工。                                                                                                                                                                 |
| 特性   | 1、精度通常较低，尤其在处理复杂形状和细小结构时可能有限；<br>2、对于厚度在 100μm 以下的晶圆，用刀具进行切割（划片）极易导致晶圆破碎；<br>3、由于刀片具有一定的厚度，由此刀具的切割（划片）线宽较大；<br>4、切割速度较慢：切割不同的晶圆片，需要更换不同的刀具；<br>5、旋转砂轮式切割需要刀片冷却水和切割水，后期运行成本较高。 | 1、具有较高的精度，特别适用于异形工件、较脆材料的加工，比如第三代半导体材料、超薄硅片的划片，避免传统刀片划片进给速度引发的破片风险；<br>2、激光可聚焦到亚微米量级，切口宽度和深度可控可调；<br>3、能量密度较高，切割速度较快，作用时间可以短到纳秒和皮秒，对芯片的电性影响也较小；<br>4、材料、形状兼容性较强；<br>5、非接触式加工，无直接冲击，不会产生崩刃、刀具磨损和水污染。 |
| 应用场景 | 传统较厚晶圆切割。                                                                                                                                                                     | 适应薄、脆、硬材料以及高精度、复杂形状的切割要求。                                                                                                                                                                           |

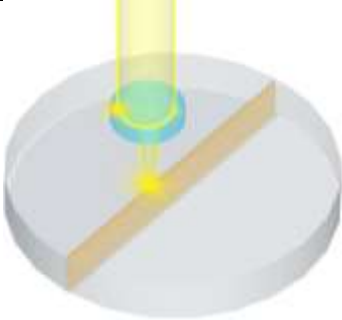
半导体的背面减薄、开槽、切割、钻孔、焊接、打标、解键合等工艺具备相似的应用原理，传统机械加工与激光加工技术路线在切割工艺中的对比情况可类比推广至其他工艺。

当前半导体技术持续演化，半导体制造所使用的晶圆尺寸增加（最高达 12 英寸）且厚度减少（最低为数十微米），器件则普遍朝向小型化、集成化发展，加之晶圆制造引入大量新材料、复合材料结构，种种因素均对半导体加工工艺提出极大挑战。传统接触性机械加工不仅在效率层面制约半导体产业扩张，而且其精度欠佳，极易在加工过程出现晶圆破裂、污染等问题；此外，机械加工的单一刀具也难以实现新型三维器件中由多种半导体材料组成的复合结构切割、钻孔等功能。先进精密激光技术凭借无接触、无磨损、无切削力、无直接冲击、灵活调制、能量密度高、加工速度快、热影响和热变形小等优点，高度适配小型化、超薄化半导体器件制造，以及高硬度、高脆性、高熔点、高复合度的新材料加工需求，已在多个半导体前道制造及后道先进封装环节取代传统机械加工工艺。此外，精密电子、MLED 等生产领域也存在大量的微纳加工、异型加工需求，先进精密激光技术在相关领域同样具有极强的适应性和丰富的应用场景，并已批量导入生产制造。

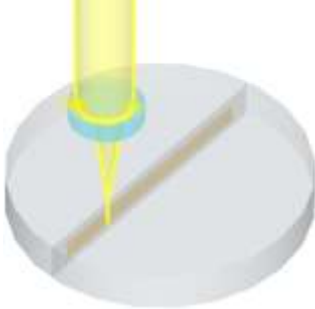
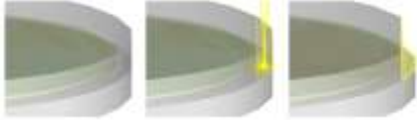
2) 激光加工工艺在三维半导体领域应用情况

2025 年以来，中国大陆在混合键合、TSV、国产类 CoWoS 封装等技术领域快

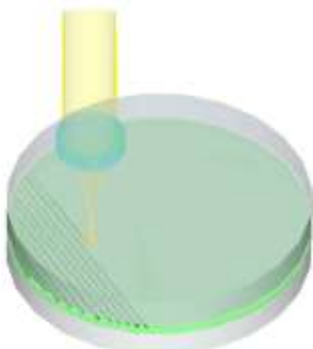
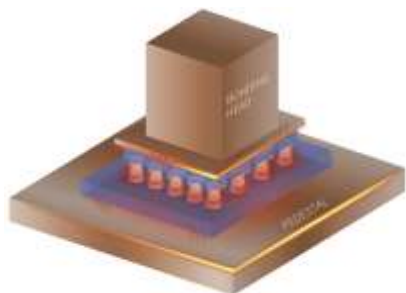
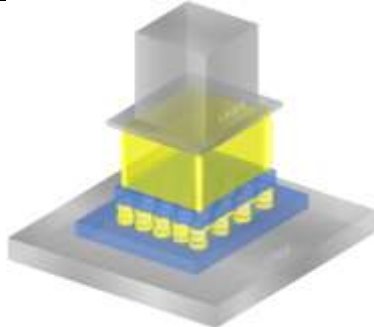
速突破，HBM 等三维芯片产能建设开始步入正轨，相应的堆叠晶圆、三维芯片修整、解键合、切割、立体芯片组装、良率修复以及新材料加工等创新需求逐步显现，而先进精密激光加工技术凭借良好的材料兼容性、热影响控制能力、空间精度和空间选择性优势在前述应用场景中表现出良好的技术适应性，相关产品技术示意说明如下表所示：

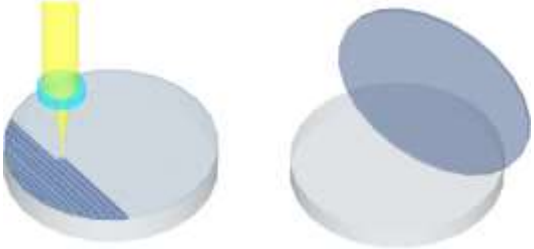
| 应用场景         | 新旧路线对比                                                                                             |                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 晶圆切割         | 传统主流技术（刀具）                                                                                         | 激光技术                                                                                                                    |
|              | 使用传统刀具机械切割晶圆，技术成熟、应用面广，但机械切割产生的机械应力会对良率造成较大损失，尤其在三维堆叠芯片、复合材料芯片、新材料芯片以及异形元件制造中，良率损失更加突出。            | 使用激光代替传统刀具，通过非接触干式加工，不仅可以降低刀具成本和超纯水等支出，而且显著提升洁净度（无碎屑）、工艺兼容性，特别适合超薄、硬脆、多层异质晶圆以及异形元件加工，在 2.5D/3D IC、HBM、大功率分立器件制造中应用场景丰富。 |
| 晶圆 Low-K 层开槽 |                  |                                      |
|              | 使用多种刀具，对晶圆上 Low-K 层与其他材料层分层开槽、切割，技术成熟、应用面广，但组合刀具成本较高，且对于 Low-K 材料的硬脆特性兼容性不足，边缘存在较大缺陷，致使良率损失、可靠性失效。 | 使用激光对晶圆上 Low-K 材料层开槽后使用刀具切割，可以保障切割边缘形貌，不仅有助于维护良率和可靠性，而且可以显著提升产能，在高端逻辑芯片、HBM、MEMS 制造中应用场景丰富。                             |
| 晶圆隐形         | 传统主流技术（暂无）                                                                                         | 激光技术                                                                                                                    |



| 应用场景 | 新旧路线对比                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 切割   | /                                                                                                                               | 使用激光的穿透性特征，将激光焦点调节于晶圆内部，并在其内部形成结构强度较低的局部改性层，而后基于机械方式受控裂片，可以实现高良率、高效率、高质量、高洁净的无损切割，并提高晶圆利用效率（切割缝几乎为0，提高单晶圆出片数），在超薄晶圆、TSV、异构集成等应用场景中兼容性极佳。                                    |
|      | /                                                                                                                               |                                                                                           |
| 晶圆修整 | 传统主流技术（刀具）                                                                                                                      | 激光技术                                                                                                                                                                        |
|      | 利用刀具对键合晶圆的外环进行修正，去除结构缺陷边缘，提升晶圆整体可靠性，技术成熟、应用面广，但利用刀具修整的边缘质量较差、产能较低、良率存在风险、刀具等耗材昂贵。此外，刀具修整会同步磨损载体晶圆，产生额外成本。                       | 使用激光代替传统刀具，不仅可以降低刀具成本、提升良率和产能，而且利用激光易于调制的特性可以有效优化加工精度控制，从而提升边缘质量。此外，利用不同材料对于各类激光波长的选择性吸收特征，可以通过选用特定波长激光完成定向加工，避免损伤载体晶圆，实现载体晶圆的重复利用，从而进一步降低成本，在 CoWoS、HBM 等立体工艺、芯片制造中应用场景丰富。 |
|      |                                              |                                                                                         |
| 解键合  | 传统主流技术（化学/加热/机械）                                                                                                                | 激光技术                                                                                                                                                                        |
|      | 利用化学方式（使用化学药剂溶解键合胶水）、加热方式（升温以使键合胶水恢复流动性）、机械方式（机械撕拉）从而剥离晶圆，技术成熟，但剥离过程可能破坏晶圆及其上晶体管，导致良率较低。此外，受限于键合胶水稳定性，键合晶圆无法采用高温工艺，致使晶圆工艺兼容性受限。 | 利用激光将能量直接定向作用于键合层，干式工艺无需大量超纯水，不存在因化学药剂使用而导致的额外污染，也不会引入额外的温度波动或机械作用影响。此外，由于激光可以作用于各类材料，键合层可以使用更具稳定性的材料，键合晶圆对高温工艺的耐受性更高，晶圆对各类高温工艺的兼容性提升，并在 HBM 等多层芯片制造中展现出良好的工艺优势。            |



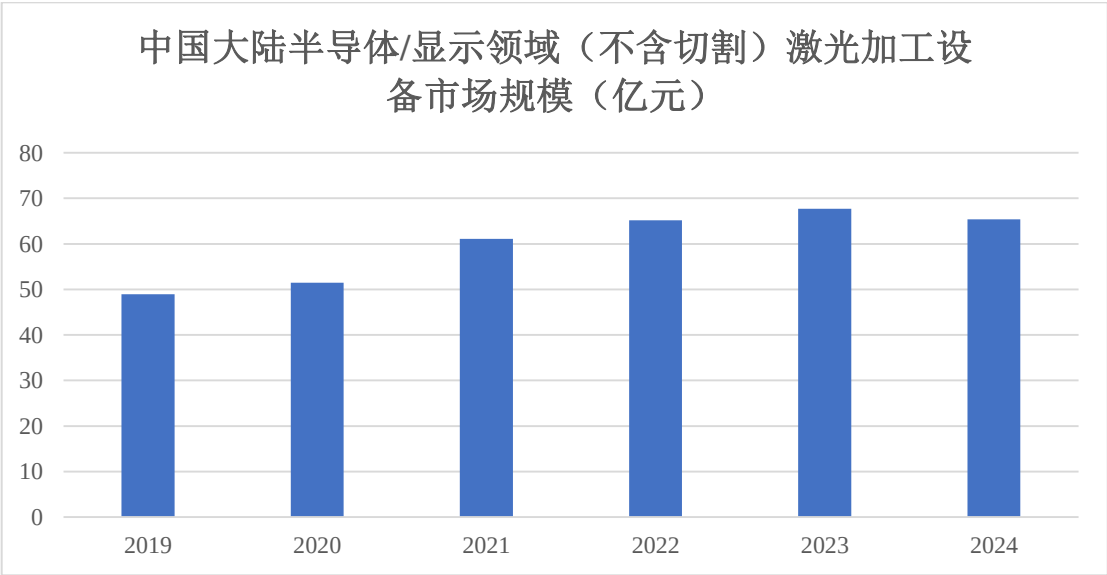
| 应用场景         | 新旧路线对比                                                                             |                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   |                                          |
| 立体芯片<br>组装   | 传统主流技术（回流焊/热压键合）                                                                   | 激光技术                                                                                                                       |
|              | 利用回流炉或贴片头加热芯片触点上锡膏，从而实现芯片组装贴合，但全域加热的方式可能导致热应力控制失效，并且回流焊工艺精度、密度不足，热压键合效率较低。         | 利用激光的穿透性和选择性特征，在芯片对准后将能量定向作用于触点上，实现全晶圆的触点局部快速加热从而完成立体芯片组装，精度、密度与效率均有效提高，在CoWoS、异构集成、HBM、超薄晶圆键合、MicroLED巨量转移等工艺场景下具备良好应用潜力。 |
|              |  |                                         |
| 玻璃基板<br>诱导钻孔 | 传统主流技术（暂无）                                                                         | 激光技术                                                                                                                       |
|              | /                                                                                  | 利用激光在玻璃内部形成改性区，再使用化学药剂选择性刻蚀，可以加工孔壁光滑、无热损伤、高深宽比、垂直度好、高密度通孔阵列，是当前高端玻璃基板钻孔主流方案，并应用于面板级封装中，是先进封装工艺进一步优化的重要基础技术。                |
|              | /                                                                                  |                                        |
| 晶圆减薄         | 传统主流技术（化学腐蚀/机械研磨）                                                                  | 激光技术                                                                                                                       |
|              | 利用化学药剂腐蚀或机械研磨方式去除晶圆部分材料从而实现减薄，但工艺效率较低，且可能引入额外药剂污染或机械应力，从而降低晶圆制造良率。                 | 利用激光将能量作用于晶圆内部，并精准制造改性层后剥离/去除一层晶圆材料从而实现减薄，不仅可以提高减薄效率，而且可以精准控制厚度，提高工艺精度。                                                    |

| 应用场景 | 新旧路线对比                                                                            |                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |

3) 专用激光加工设备市场规模及未来发展分析

如前所述，先进精密激光技术凭借较强的灵活性和较高的工作效率，对于传统半导体加工的降本增效具有重要意义，且其高精度特征匹配器件精细化、复杂化、三维化的发展趋势，因此在半导体加工领域具备广阔的应用前景。同时，消费电子等终端市场的需求增长也经由精密电子、MLED 等产业传导至专用激光加工设备行业，并成为市场增长的重要来源。

欧洲领先的光学技术贸易杂志，暨德国光子学会和德国应用光学学会官方出版物《Photonics Views》数据显示，中国工业激光设备市场占激光设备市场的比例为 62%，工业激光设备中有 12%用于半导体/显示领域（不含切割）；另结合《2024 中国激光产业发展报告》《2025 中国激光产业发展报告》中全国激光设备市场规模测算，2024 年我国半导体/显示领域（不含切割）激光加工设备市场规模达 65.38 亿元，2019 年至 2024 年期间年复合增长率达 5.96%。



数据来源：《2024 中国激光产业发展报告》；《2025 中国激光产业发展报告》；《Photonics Views》

先进精密激光技术基于工艺优势在各类新兴应用领域表现出良好的适应性，激光加工设备不仅可以对传统刀具等机械加工设备形成替代，也有望突破应用边界，相关市场可以随着中国大陆 HBM 等三维芯片产能建设持续放量而得到结构化增长。

### 3、发行人所属细分行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性

公司所属的半导体专用设备行业处于产业链的基石地位，对于推动产业链升级、终端应用拓展起到重要作用，是当前国际半导体供应链重构的焦点之一。

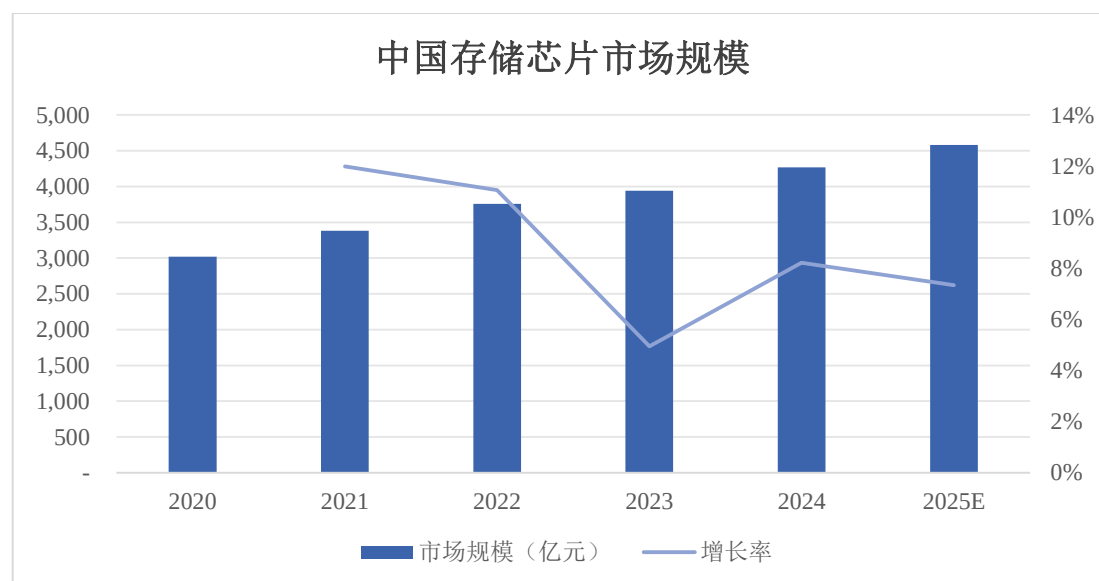
公司收入主要来源于半导体激光热处理设备与激光加工设备，前者帮助下游半导体厂商实现半导体产品电学特性增强、器件质量提高、芯片产出率有效提升，后者帮助下游半导体厂商以较低成本实现高精度形状特征的高效率塑造。

同时，公司在设备产品的产业化过程中也有效带动上游供应商突破核心技术和制造工艺问题，为上游半导体核心零部件、模块提供产业验证机会，最终形成产业链上下游一体化协同发展的新局面。

### 4、发行人下游行业概况及发展态势

#### （1）存储芯片

存储芯片是利用半导体电路保存二进制数据的一种集成电路，主要包括 NAND Flash（闪存）和 DRAM（内存）。存储芯片是半导体第二大细分市场，仅次于逻辑芯片，WSTS 数据显示，存储芯片市场占比约为 23%。人工智能、物联网、云计算以及消费电子等终端对于存储容量需求持续增长，推动存储芯片市场规模持续走高。



数据来源：中商产业研究院

中国存储芯片市场规模整体维持扩大趋势。由于存储芯片同时具有典型的大宗商品属性，产品标准化程度较高，可替代性强，因此在产量和需求变动影响下市场销售额可能表现出波动性。2023年下半年起，受益于前期减产、存储芯片应用场景不断扩展，以及数据中心及大模型人工智能催生大量高性能存储芯片需求，市场开始回暖，有望开启上行周期。

存储芯片所兼具的大宗商品特征与技术密集特征决定了相关厂商必须充分发挥规模效益以在盈利与研发之间取得平衡。国际巨头通过并购及大规模资本性支出建设了大量产能。近年来，中国大陆在闪存及内存芯片领域培育了多家代表性企业，并通过持续大规模扩产和技术创新与境外厂商直接竞争，存储芯片已成为中国大陆集成电路领域具备比较优势的长板产业。

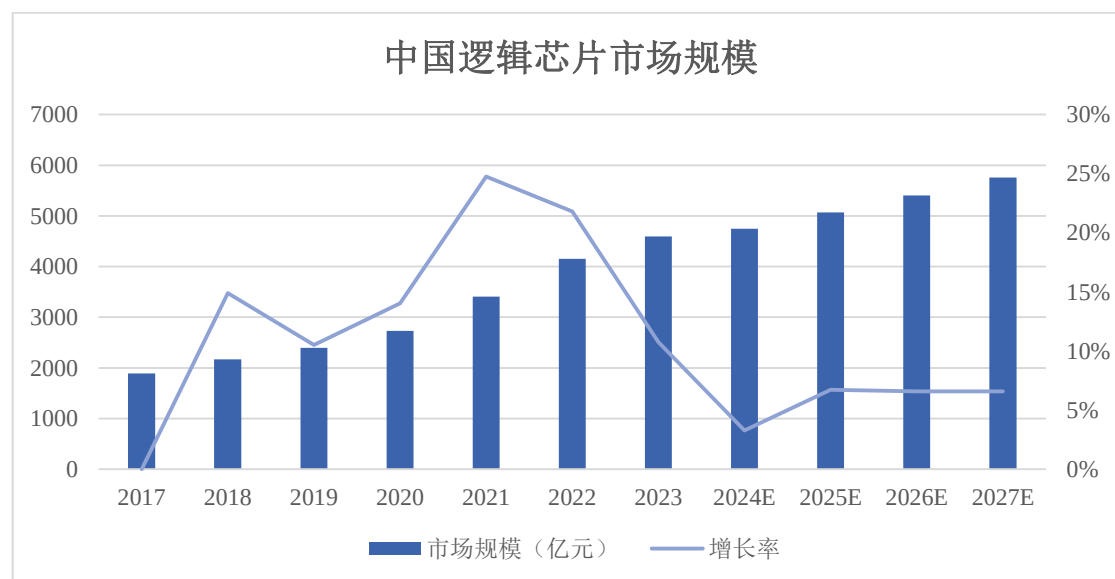
存储芯片一般采用 IDM 模式生产，各大厂商工艺特征明显。为满足高密度存储单元生产需求，厂商需专门对热处理等工艺加以优化，导致其对设备参数和功能的定制化需求进一步提高，进而增强了存储芯片晶圆厂与设备供应商的合作深度以及对设备的定制化需求。公司积极利用自身在激光工艺技术及半导体创新工艺方面的深厚积累，与境内领先的存储芯片厂商联合探索激光工艺技术在该领域的应用，已取得积极成效。

## （2）逻辑芯片

逻辑芯片是以二进制为原理实现运算与逻辑判断的一种集成电路，主要包括

CPU（中央处理器）、GPU（图形处理器）、ASIC（应用型专用集成电路）和 FPGA（现场可编程门阵列）等。

逻辑芯片是现代数字基建中数据信息处理能力的核心，是半导体最大的单一细分市场，WSTS 数据显示，逻辑芯片市场占比约为 31%。中国大陆基于巨大的经济体量长期维持较高的销售规模，SIA 数据显示，2024 年中国逻辑芯片市场规模达 4,748.1 亿元,且市场规模仍将长期保持增长态势。

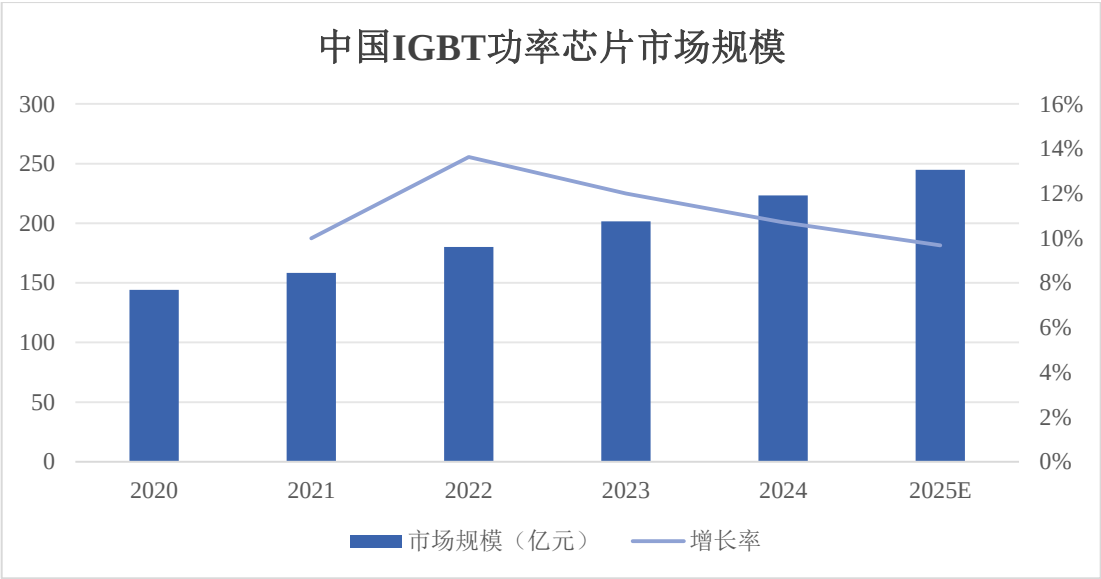


数据来源：SIA

逻辑芯片追求运算速度及成本，注重指令周期与功耗效率，必须不断提升集成度，因此制程和设计迭代速度快，当下最先进的 3nm 及以下量产工艺均用于生产逻辑芯片。生产工艺节点的微缩不仅对光刻等技术提出更严格要求，也对热处理等工艺过程的热量控制提出更严苛标准。激光工艺技术在热处理精度、效率等方面具备突出优势，因此成为先进制程逻辑芯片特定热处理工艺环节的主流技术路线。

### （3）硅基功率芯片 IGBT

硅基功率芯片 IGBT 是一种基于硅材料制造的半导体分立器件，用于电力系统中能量转换和控制。目前电力系统中 75% 以上的电能应用需要由其进行功率变换后才能供设备使用，IGBT 凭借导通压降低、开关速度快、饱和压降小等优点，在工业驱动、电机节能、轨道交通、新能源汽车等领域广泛应用，被称为电力电子行业里的“CPU”。近年来，我国 IGBT 市场规模持续增长。



数据来源：中商产业研究院

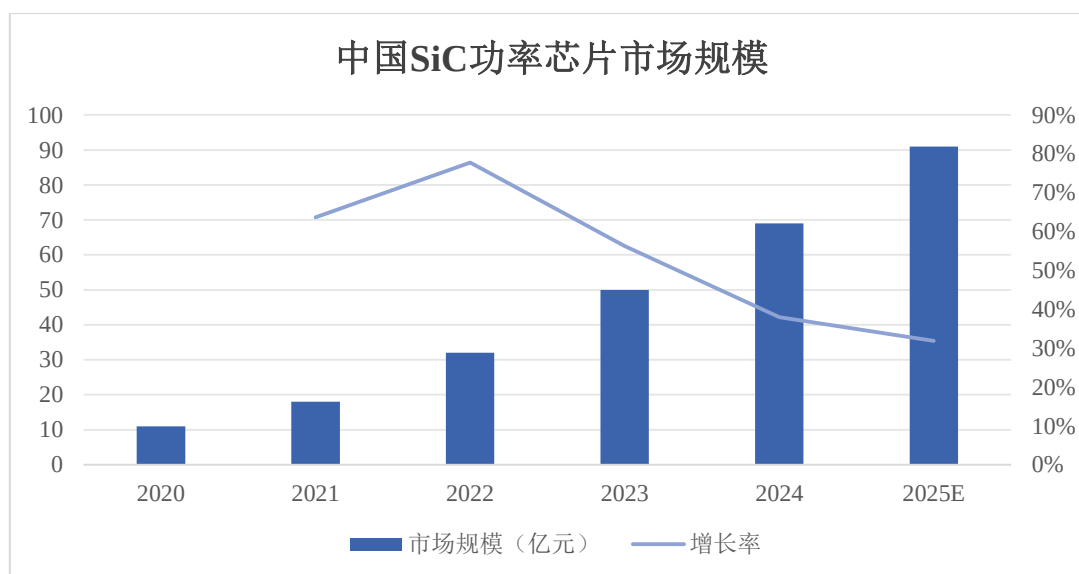
随着功率器件在高温、高压等严苛复杂环境下的应用增加，制造厂商通过不断改进结构细节、工艺特征、封装及散热设计以提高芯片的工作能力和长期可靠性。自问世以来，IGBT 技术不断迭代，共经历了七次大型技术演变，功率损耗等性能指标得到持续优化，其中，第三、四代 IGBT 工艺引入创新的沟槽设计，其结构、杂质浓度分布变得更加复杂，但也显著优化了性能指标、降低损耗，是目前使用最广泛的 IGBT 芯片技术。激光工艺契合 IGBT 沟槽设计对热处理精度的控制要求，是相关类型 IGBT 量产中的关键技术之一。

（4）第三代化合物半导体

第三代化合物半导体指 SiC（碳化硅）、GaN（氮化镓）等具有宽禁带（ $E_g > 2.3\text{eV}$ ）特性的新型半导体材料，由其制成的半导体器件一般具有高击穿电场、高饱和电子速度、高热导率、高电子密度、高迁移率、可承受大功率等特点。

SiC 的技术和成本优势明显，产业化进展较快，目前已广泛应用于新能源汽车、充电桩、轨道交通、光伏、风电等电力电子领域。中国大陆正积极布局第三代化合物半导体，智研咨询数据显示，2020 年中国大陆第三代化合物半导体市场规模仅为约 11 亿元，2024 年已跃升至 69 亿元。根据 TechInsights 数据，至 2029 年，中国大陆 SiC 市场将占全球一半。





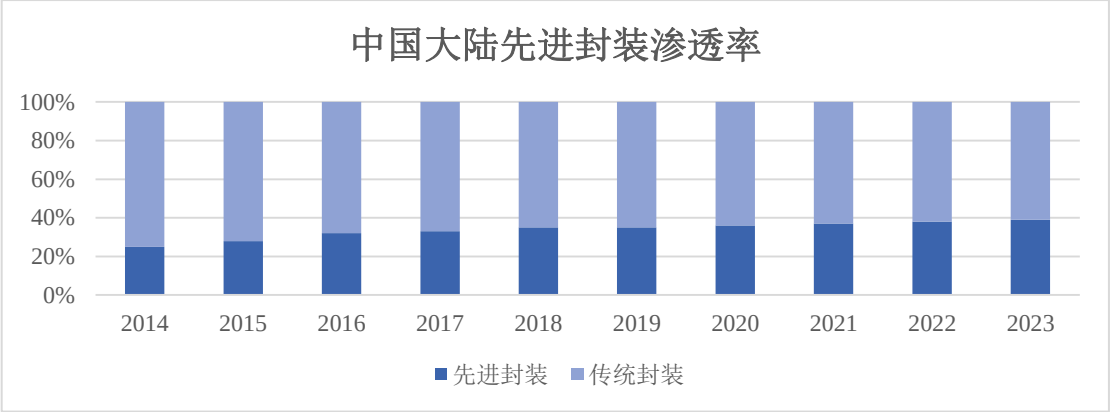
数据来源：Yole；Omdia

SiC 等第三代化合物半导体因其物理和化学性质高度稳定，所以在切割、CMP、热处理等工艺环节通常需要更高的能量密度，导致第三代化合物半导体相关的工艺设备需要定制化改造或者重新开发。激光工艺技术可以显著提升热处理的能量密度，是 SiC 等第三代化合物半导体热处理工艺的重要技术手段。

### （5）先进封装与三维集成

先进封装是指将不同芯片集成到同一封装内以实现更高效系统效率的技术，包括晶圆级封装（Wafer Level Package）、硅通孔（Through-Silicon Via）、芯粒（Chiplets）等。

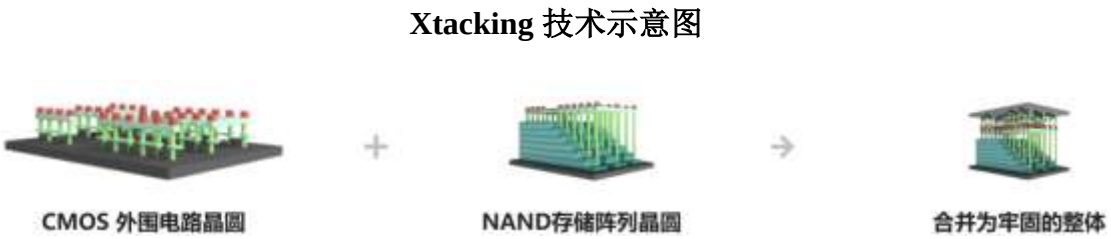
先进封装通过大幅提升电气互联密度对抗半导体物理极限，是缓解当前集成电路存储限制、功耗限制的有效途径。Yole 数据显示，中国大陆先进封装的渗透率持续上升，已自 2014 年的 25% 提升至 2023 年的 39%；2020 年相关市场规模已达 903 亿元，预计 2023 年达到 1,330 亿元。



数据来源：Yole

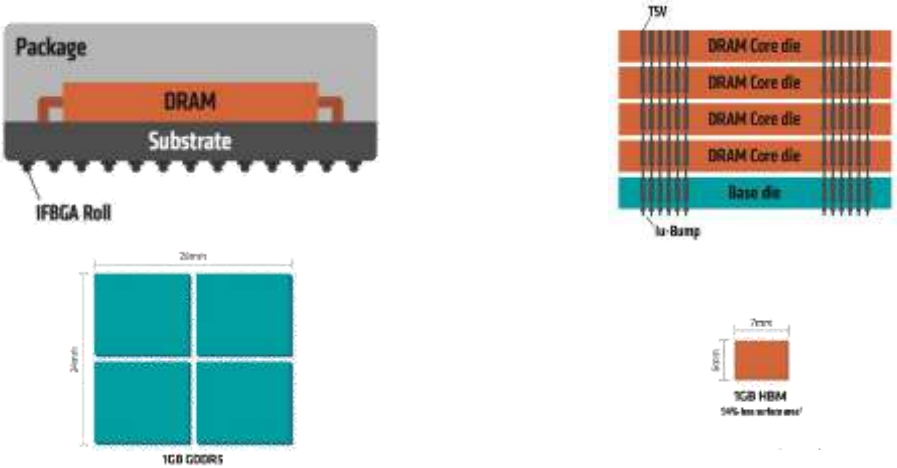
三维集成技术是当前先进封装领域的前沿技术，也是半导体技术未来的发展重心。“十四五”专项系列丛书《三维集成电路制造技术》指出，未来集成电路将通过结构创新、三维集成技术的突破逐步向完全 3D 的新结构、新技术和新系统过渡。

三维集成技术利用堆叠或互连等微加工技术在垂直方向上集成多颗芯片，可以在不改变芯片面积和工艺集成度的基础上有效提高晶体管密度、减少电路之间延迟、节约功耗并实现多样化芯片功能。长江存储科技有限责任公司 Xtacking 架构存储芯片和 HBM 是三维异构集成技术的典型应用。



图片来源：长江存储科技有限责任公司

传统 GDDR（左）与 HBM（右）结构示意及面积对比



图片来源：AMD

先进封装与前道工艺存在紧密联系，因此 CMP、刻蚀、热处理等设备的应用场景可以延伸至封装领域。此外，先进封装远超传统封装的工艺难度和成本也催生了大量新兴工艺设备需求，例如提供纳米级工艺精度的晶圆键合设备、电镀铜填充设备等，以及简化或取代传统工艺步骤、提高良率、降低成本的 TGV 激光钻孔、激光解键合、激光修整设备等。

#### （6）其他

公司结合图像芯片退火需求开发了相应的激光半导体设备。赛迪顾问数据显示，2022 年至 2025 年期间，中国传感器市场规模将自 3,171 亿元增长至 4,319 亿元，其中视觉/图像类型占比 5%，据此测算，同期中国图像芯片市场规模将自 159 亿元增长至 216 亿元。

公司专用激光加工设备还可应用于 MLED、平板显示、小尺寸异形滤光片、PCB 板等精密电子、精密光学加工领域，终端产品包括智能手机、可穿戴设备、个人电脑、精密仪器等众多品类。以消费电子为例，Statista 数据显示，我国消费电子市场规模将自 2016 年的约 2,400 亿美元增长至 2027 年的超 2,700 亿美元。

#### （7）主要客户扩产情况

公司现已成为客户 A、客户 B、客户 C、华润微、士兰微、三安半导体、中车时代、客户 D、华天科技、达迩科技等主流半导体厂商的唯一或主要激光工艺设备供应商。前述厂商在未来一段时间内仍将大规模扩充产能：机构数据显示，2025 年至 2030 年期间，中国大陆领先存储芯片厂商产能将增长 66%，且另有新增投资计划超 500 亿元；深圳市政府报告指出，将于 2025 年建成投产华润微 12 英寸集成电路生产线、比亚迪半导体三期四期等项目；士兰微在厦门总投资 70 亿元的士兰集宏一期项目也已于 2025 年封顶，计划到 2028 年底形成年产 42 万片 8 英寸 SiC 功率芯片的产能；中车时代则于 2022 年宣布拟投入 111 亿元用于功率芯片产能扩张，其中宜兴子项目部分产线已于 2024 年底开始进行工艺设备调试，并进入试生产阶段。

相关厂商的产能建设计划有望成为公司业绩的重要支持。

## （四）发行人所属行业主要壁垒

### 1、技术壁垒

半导体设备行业技术密集特征明显，产品的研发和制造是一项融合机械、化学、电子、信息、材料和能源等多学科尖端技术的复杂过程。

对于激光系列半导体设备，其往往包含由数十层透/折/反射式镜片组成的复杂光学模组，具备承载、固定、运动、调节等多功能的机械结构，由激光器、执行器、传感器、位移平台、探测器、控制器等多种硬件组成的庞杂电气系统，以及实现硬件的启动、运行、状态监测、调控、终止、联动和工艺智能化的软件平台，因此企业还应当对激光器、光学元件及光学系统、运动控制、机械结构、软硬件协调、工艺研发进行深入研究和优化，并与客户进行充分交流获取客户支持以将激光工艺引入工艺制程并完成整合，行业存在明显的技术壁垒。

### 2、人才壁垒

半导体设备行业技术更迭较快，要求高端半导体设备人才拥有雄厚的跨学科领域知识储备、丰富的半导体设备研发经验、全面的软硬件开发能力和设备产品综合测试能力，并且深刻理解下游制造工艺需求。

上述要求需要从业人员历经长期的理论学习和一线实践锻炼，相关人员难以在短期内大规模培育，因此，半导体设备行业内的高端人才供给相对稀缺，具有较高的人才壁垒。

### 3、客户验证壁垒

半导体设备的性能及稳定性直接影响下游客户最终产品的质量，一般需要经过长周期和高标准的认证程序才能被下游客户接受和使用。

此外，半导体设备普遍与客户的生产工艺深度绑定，验证周期长，验证成本和风险高，客户出于保障工艺稳定性和保护技术秘密的目的不会频繁更换设备供应商。

基于上述行业惯例，半导体设备行业存在较高的客户验证壁垒。

### 4、资金壁垒

一方面，半导体设备验证周期长、研发风险高，设备企业组建高水平技术研

发团队和维持高强度研发活动均需要前期大额资金投入；另一方面，半导体设备企业受到产能建设周期、生产备货等因素的影响，产业化落地过程较长，前期需要大量营运资金，因此半导体设备行业具备资本密集特征和较高的资金壁垒。

### （五）发行人所属行业周期性

公司所属的半导体设备行业属于半导体产业链上游，行业的短期发展受下游客户资本支出的直接驱动，并与宏观经济周期高度相关，因此呈现周期性波动态势。受益于终端需求增长、国家及社会支持力度加强等利好因素，叠加半导体工艺升级强化对先进精密激光技术需求，公司所处的激光热处理设备、专用激光加工设备行业有望表现出穿越周期的成长性。

### （六）发行人所属行业面临的机遇与挑战

#### 1、面临的机遇

##### （1）国家政策支持

近年来国家持续出台利好政策，进一步凸显半导体制造及设备行业的重要战略地位，同时从产业规划、财税支持、人才供应、产业链协同合作等多方面巩固行业良好发展的根基。公司面向下游领先的晶圆厂或封测厂商提供高性能半导体激光工艺设备，公司自身及下游客户所属行业均属于国家政策重点鼓励和支持的范畴，符合国家产业政策规划和经济发展方向，未来产业链上下游均面临良好发展机遇。

##### （2）半导体供应链重塑推动国产设备供应商业绩增长

中国大陆凭借巨大的终端需求市场规模和积极扩张的态势吸引大量投资，成为本轮半导体扩产周期的核心区域。SEMI 数据显示，2024 年中国大陆计划开始运营 18 个新晶圆厂，全球占比达 42.86%，相较于 2023 年的 11 个新晶圆厂有显著提升。

大规模区域产能建设叠加国际贸易风险推动了半导体供应链重塑进程，并为国产半导体设备供应商提供历史性发展机遇。中信研究所、芯谋研究数据显示，2023 年国内半导体设备公司总体营收增长超 17.6%，国产设备厂商供应占比达到 11.7%；2024 年营收预计将进一步增长超 27.5%，国产设备厂商供应占比达到

13.6%。

### （3）终端高性能半导体器件需求牵引先进精密激光技术渗透率提升

近年来以 AIGC 为代表的新兴数字技术成为推动半导体市场发展的主导力量，数字化基建蕴含的巨大算力、能源需求催生了海量新型高性能半导体器件需求。

新型高性能半导体器件通常有更复杂的微观结构，需要新的制造工艺实现。基于在精细微加工和微纳结构制造方面的突出优势，先进精密激光技术可以高效满足各类先进制程、新架构、新材料半导体器件制造工艺需求。因此受终端需求结构变动影响，相关技术渗透率有望持续提升，并为激光半导体工艺设备供应商带来更多增量需求。

## 2、面临的挑战

### （1）长期资金、高端人才供应有限

半导体设备行业是典型的资金技术密集型产业，对资金和高端人才需求量长期维持高位。由于国内半导体设备行业起步较晚，产业竞争优势尚未完全建立，投资风险与资本回报存在错配，且行业内高端技术人才较为缺乏，导致长期资金、高端人才供应有限，在一定程度上制约了行业的快速发展。

### （2）产业验证机会不足

境外设备供应商与客户经过长期验证磨合形成了大量成功案例，同时基于境外成熟供应链有助于半导体制造厂商尽快突破工艺研发瓶颈、控制良率并加速产业化。而国内半导体设备产业处于后发地位，产线验证机会有限，且需主动兼容境外厂商对标产品，产线验证难度较高。目前，国内设备厂商正积极利用供应链重塑的发展窗口期，发挥高度定制、本地稳定供应、快速响应以及性价比方面的优势主动寻求产业合作机会。

### （3）产业链仍处于变革早期阶段

半导体设备行业的发展是在上游供应支持、下游需求牵引以及同行业协调发展的基础上建立的。目前，产业链仍处于变革早期阶段，半导体激光工艺设备所依赖的上游核心零部件国产供应体系尚未达到完备状态，下游先进制程、异构集



成等相关技术的渗透率仍在爬升阶段，配套的国产高端设备也仍在突破当中，产业发展环境仍有优化空间。

（七）引用第三方数据的说明

公司招股说明书引用的行业数据来源于第三方机构发布的公开刊物、研究报告、统计或预测数据，以及相关学术书籍，公司在引用相关数据时已明确标注来源。

该等数据来源于不同机构，统计口径和方法可能存在差异，因此不具完全可比性。

三、发行人所属行业竞争格局

（一）发行人所处行业主要企业

公司以先进精密激光技术为核心，主要从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售，并提供相关技术服务。公司当前专注于中国大陆市场，并确立了“激光热处理设备和专用激光加工设备”双引擎可持续发展的战略。在中国大陆市场，与公司存在竞争关系的主要企业包括：

1、激光热处理领域

| 可比公司       | 成立年份 | 业务说明                                                                                  | 规模                                                                                       |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应用材料（AMAT） | 1967 | 总部位于美国硅谷，股票代码为AMAT.O。该公司主要提供半导体晶圆薄膜沉积设备，半导体薄片装配，蚀刻及离子注入设备和单芯片处理等半导体设备（含激光热处理设备）。      | 2025 财年（财年结束于2025 年 10 月 26 日）全年实现营业收入 283.68 亿美元，全球有大约 36,500 名员工。                      |
| 维易科（Veeco） | 1959 | 总部位于美国纽约州，股票代码为VECO.O。该公司主要提供离子束、激光退火、MOCVD、CVD、先进封装光刻、单晶圆湿法加工、MBE 和 ALD 技术及其解决方案。    | 2025 年度其全年实现营业收入 6.64 亿美元，全球有大约 1,265 名员工。                                               |
| 住友重工       | 1934 | 总部位于日本东京，股票代码为 6302.T。该公司的精密机械部门提供塑料加工机械，激光加工机械，低温冰箱，精密定位，放射线设备、超精密机床 NC 化及改装等通用机械设备。 | 2025 年度其全年实现营业收入 10,668.81 亿日元，其中工业机械和其他设备产品收入 2,226.23 亿日元，全球有大约 25,337 名员工（2024 年末数据）。 |
| 迪恩士（DNS）   | 1943 | 总部位于日本京都，股票代码为 7735.T。该公司主要从事半导体设备的制造和销售，共经营四个业务部门，包括半导体设备部门                          | 2024 财年（财年结束于2025 年 3 月 31 日）其全年实现营业收入                                                   |

| 可比公司                                  | 成立年份 | 业务说明                                                                               | 规模                                                                  |
|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                       |      | （含激光热处理设备）、图形和精密解决方案部门、精细技术解决方案部门和其他部门。                                            | 6,252.69 亿日元，其中半导体设备收入 5,195.10 亿日元。全球有大约 6,415 名员工。                |
| Digital Imaging Technology, Inc.（DIT） | 2005 | 总部位于韩国京畿道，股票代码为 110990.KS。该公司主要提供 AOI 解决方案、激光解决方案及其他。                              | 2024 年度其全年实现营业收入 1,166.55 亿韩元。全球有大约 206 名员工。                        |
| 伊欧激光（EO Technics）                     | 1993 | 总部位于韩国京畿道，股票代码为 039030.KS。该公司主要从事半导体激光打标机和激光应用设备的制造和分销。                            | 2024 财年（财年结束于 2025 年 3 月 31 日）其全年实现营业收入 3,209.45 亿韩元。全球有大约 634 名员工。 |
| 上海微电子                                 | 2002 | 总部位于中国上海。该公司致力于半导体装备、泛半导体装备以及高端智能装备等半导体设备（含激光热处理设备）的开发、设计、制造及技术服务。                 | 全国大约有 2,000 名员工。                                                    |
| 华卓精科                                  | 2012 | 总部位于中国北京，提供超精密运动平台、激光退火设备、晶圆键合设备、晶圆传输系统、主被动隔振器、静电卡盘、精密测量系统等整机设备，并进行半导体关键零部件的研发与制造。 | 2022 年度其全年营业收入 4.33 亿元，2020 年末有 402 名员工。                            |

数据来源：Wind

2、激光加工领域

| 可比公司                                                       | 成立年份  | 业务说明                                                                                        | 规模                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 迪思科（DISCO）                                                 | 1940  | 总部位于日本东京，股票代码为 6146.T。该公司主要提供切割锯，激光锯，磨床，抛光机，干蚀刻机，表面刨床，切割刀片，砂轮和干抛光轮等半导体制造设备，同时提供精密加工工具的相关服务。 | 2024 财年（财年结束于 2025 年 3 月 31 日）其全年实现营业收入 3,933.13 亿日元。全球有大约 4,553 名员工。 |
| Digital Imaging Technology, Inc.（DIT）<br>伊欧激光（EO Technics） | 参见上文。 |                                                                                             |                                                                       |
| ASMPT                                                      | 1975  | 总部位于新加坡，股票代码为 0522.HK。该公司是全球最大的半导体和发光二极管行业的集成和封装设备供应商，业务涵盖激光切割、开槽等设备。                       | 2024 年度其全年实现营业收入 132.29 亿港元。全球大约有 10,600 员工。                          |
| 联动科技                                                       | 1998  | 总部位于中国广东，股票代码为 301369.SZ。该公司主要提供半导体行业后道封装测试领域专用设备，包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备。            | 2024 年其全年实现营业收入 3.11 亿元，全国有大约员工 712 人。                                |

|      |      |                                                                    |                                             |
|------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 德龙激光 | 2005 | 总部位于中国江苏，股票代码为 688170.SH。该公司主营业务为高端工业应用精密激光加工设备及其核心器件激光器的研发、生产和销售。 | 2024 年其全年实现营业收入 7.15 亿元，全国有大约员工 1,006 人。    |
| 大族激光 | 1999 | 总部位于中国广东，股票代码为 002008.SZ。该公司是世界主要的激光加工设备生产厂商之一。                    | 2024 年其全年实现营业收入 147.71 亿元，全国有大约员工 16,866 人。 |

数据来源：Wind

3、财务可比公司

前述业务可比公司中，应用材料、维易科、住友重工、迪恩士、DIT、DISCO 等系境外公司，遵循的会计准则与境内存在差异，且其发展阶段不同于公司，财务数据可比性较弱；华卓精科、上海微电子均未上市，对应的财务信息披露范围有限；联动科技、德龙激光、大族激光聚焦于激光加工领域，与公司产品结构差异较大，财务数据可比性较弱。

为更好向投资者展现公司的财务状况与经营能力，公司结合自身业务、产品以及行业特点，另外选取 A 股聚焦半导体前道工艺设备的各细分领域龙头企业作为财务可比公司。

| 可比公司 | 成立年份 | 业务说明                                                                                                | 规模                                        |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 中微公司 | 2004 | 总部位于中国上海，股票代码为 688012.SH。该公司产品包括用于 IC 集成电路领域的等离子体刻蚀设备（CCP、ICP）、深硅刻蚀设备（TSV），以及用于 LED 芯片领域的 MOCVD 设备。 | 2024 年其全年实现营业收入 90.65 亿元。全球有大约 2,480 名员工。 |
| 芯源微  | 2002 | 总部位于中国辽宁，股票代码为 688037.SH。该公司产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机）。                      | 2024 年其全年实现营业收入 17.54 亿元。全球有大约 1,366 名员工。 |
| 拓荆科技 | 2010 | 总部位于中国辽宁，股票代码为 688072.SH。该公司主要提供高性能薄膜沉积设备。                                                          | 2024 年其全年实现营业收入 41.03 亿元。全球有大约 1,531 名员工。 |
| 华海清科 | 2013 | 总部位于中国天津，股票代码为 688120.SH。该公司主要产品为化学机械抛光（CMP）设备。                                                     | 2024 年其全年实现营业收入 34.06 亿元。全球有大约 1,917 名员工。 |
| 屹唐股份 | 2015 | 总部位于中国北京，股票代码为 688729.SH。该公司主要产品包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备等。                                           | 2024 年其全年实现营业收入 46.33 亿元。全球有大约 1,192 名员工。 |

（二）发行人所处行业竞争格局

1、激光热处理设备行业

目前，全球及中国大陆激光热处理设备市场主要被维易科、住友重工、迪恩士、应用材料等境外厂商占据。前述厂商凭借先发优势和雄厚资金技术实力深度参与到半导体领域激光热处理设备供应链塑造，是全球多家领先晶圆厂的主要供应商，其设备产品应用于最先进的 3nm 及以下逻辑芯片制造。QY Research 数据显示，2023 年，维易科、住友重工、迪恩士等第一梯队厂商占有大约全球 81% 的激光退火市场份额，以应用材料为代表的第二梯队厂商共占有 15% 份额，相关境外厂商合计占据超 96% 份额。

此外，各地区的半导体长板产业也催生了特色热处理工艺设备供应商。例如，韩国存储芯片产业全球领先，这一产业环境催生了 DIT、EO Technics 等面向存储芯片制造的特色激光热处理设备供应商，相关厂商凭借区位优势 and 高度定制化服务与当地晶圆厂深度绑定，双方技术高度互补，构筑协同发展根基并取得良好业绩。

中国大陆的上海微电子、华卓精科和莱普科技等国产厂商受益于近年来半导体设备的稳定供应需求，并且凭借性价比优势已在中国大陆市场竞争中占据一定市场份额。随着美、日等国将热处理设备纳入出口管制范围，以及国产技术不断突破，国产供应体系对国内晶圆厂激光热处理设备需求的满足能力逐步增强，国产厂商除推出对标境外同类产品的国产解决方案外，也针对国内半导体产业技术特征开发具有原创性的激光热处理设备产品，从而达到局部领先地位并完整占据相关增量市场。公司激光诱导结晶设备（LIC）、激光诱导外延生长设备（LIEG）系列产品即为这一模式下的典型案例。

目前，中国大陆市场主要激光热处理设备供应商涉足不同领域的具体情况如下：

| 细分领域 | 主要厂商(中国大陆) | 主要厂商（境外） | 供应链说明                                      |
|------|------------|----------|--------------------------------------------|
| 存储芯片 | 莱普科技       | -        | 公司面向国内主要存储芯片制造厂商的具体工艺需求开发专门设备产品，已占据主要市场份额。 |
| 逻辑芯片 | 华卓精科、上海微电  | 应用材料、维易科 | 目前先进制程逻辑芯片激光                               |

| 细分领域      | 主要厂商（中国大陆）      | 主要厂商（境外）  | 供应链说明                                           |
|-----------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|
|           | 子、莱普科技          |           | 热处理设备主要由境外厂商供应，中国大陆供应商近年来持续突破关键技术，已在部分产线实现量产应用。 |
| IGBT 功率器件 | 华卓精科、上海微电子、莱普科技 | 住友重工      | 中国大陆供应商基于性价比及区位优势，已占据主要市场份额。                    |
| SiC 功率器件  | 华卓精科、上海微电子、莱普科技 | 住友重工、迪恩士  |                                                 |
| 图像芯片      | 莱普科技            | 应用材料、住友重工 | 中国大陆仅少数图像芯片产线使用激光热处理工艺，目前主要由公司供应。               |

2、专用激光加工设备行业

在半导体等高端制造领域，专用激光加工设备类型丰富，技术门槛较高，国内厂商起步较晚，参与全球竞争的企业数量较少，目前半导体专用激光加工设备市场同样由迪思科、伊欧激光，ASMPT 等境外厂商主导。

中国大陆专注于半导体领域专用激光加工设备的企业较少，大部分激光设备厂商重点布局精密电子、机械加工等领域，近年来随着我国半导体产业发展逐步开拓相关加工业务，但产品对半导体加工特性需求的适应性仍有优化空间。近年来，包括公司在内的多家本土半导体设备厂商正积极从专用激光加工设备新产品研发、定制化服务等多方面提高自身竞争力，谋求高附加值销售。

同时，业界在半导体封装领域引入的三维堆叠、异构集成等先进封装工艺将推动半导体前道激光工艺向后道延伸，并有望重塑半导体专用激光加工设备市场竞争格局。由于先进封装工艺存在大量高精度、非接触性加工需求，如激光解键合、激光修整等，此类技术难度极高且与半导体前道制造工艺高度类似，因此相关设备的研发及推广主要由具备技术和经验优势的半导体前道激光工艺设备供应商推动。这一趋势有望提高公司等前道激光工艺设备供应商在专用激光加工设备市场份额。

（三）发行人市场地位

公司立足于先进精密激光技术，聚焦于高端装备板块，重点布局半导体领域激光热处理设备与专用激光加工设备市场。自设立以来，公司始终以国家战略需求及产业发展方向为指导，服务于我国半导体产业的工艺节点升级、结构创新、三维堆叠、异构集成以及关键材料突破等。



报告期内，公司作为半导体关键工艺设备供应商，成功助力多家知名半导体厂商在各自赛道内实现最新一代半导体产品量产，公司产品成功打破境外厂商垄断局面并在部分性能指标层面实现追平甚至超越，充分彰显公司领先的技术水平和较强的市场竞争力。

## 1、激光热处理行业

半导体制造工艺持续迭代，激光热处理设备逐渐成为先进半导体制造的必要投资。公司是国内少数专注于半导体激光热处理设备的厂商，产品布局相对完整，激光热处理设备的量产应用场景覆盖广度在国产设备厂商中居于领先地位。目前，公司激光热处理设备产品已在存储芯片、逻辑芯片、功率器件和图像芯片产线量产应用。

公司原创性产品激光诱导结晶设备（LIC）可用于某国产先进架构先进制程 3D NAND Flash 存储芯片创新工艺区域结晶制备，目前已批量交付客户 A 并用于量产；公司的激光诱导外延生长设备（LIEG）用于先进制程 DRAM 存储芯片 SNC&BLC 结构中非晶硅的孔洞消除及修复，目前已交付客户 C 并用于量产；公司的逻辑晶圆超浅结激光退火设备（USJLA）已交付给客户 A、客户 B、客户 C 以及其他境内领先的晶圆代工厂等客户，设备已完成产业化验证并用于量产或相关厂商的工艺导入；公司的逻辑晶圆动态表面合金设备（DALA）已交付客户 A 并通过验证；公司的硅基 IGBT 晶圆激光退火设备已批量交付中车时代、客户 E3、华润微、士兰微等国内龙头企业，SiC 晶圆激光退火设备已批量交付三安半导体、中车时代、上海瞻芯、士兰微等国内龙头企业，且均已稳定量产；公司的 BSI-CCD 晶圆浅结退火设备交付我国航天领域图像传感器生产单位客户 D、客户 F1，打破国外对我国航天领域的技术封锁。

目前，中国大陆激光热处理设备市场仍由境外厂商主导，公司基于多年发展和经营已逐步打破境外厂商垄断局面并占据一定市场份额。以公司各年度激光热处理设备收入并结合 QY Research 等机构数据测算，公司国内市占率已由 2022 年的约 3%增长至 2024 年的约 16%。根据集微咨询调研，在激光热处理领域，公司与华卓精科、上海微电子等境内同行业公司市场份额接近，境内厂商合计占据激光热处理设备近半市场份额。



在半导体热处理设备整体市场中，因先进制程、新结构、新材料应用渗透率尚处于提升阶段，致使公司当前市场占有率相对有限，约为 2.6%；此外，激光热处理技术与快速热处理技术在半导体精细电路结构制造领域均具备各自的具体应用场景，有基于此，测算得公司在对应的市场（含快速热处理设备、激光热处理设备）所占份额约为 3.3%。

凭借对半导体先进制程、新结构及新材料热处理需求的良好契合度，激光热处理技术路线应用规模正随前述技术的渗透率持续提升而快速扩大；同时基于精度、效率和能量密度，激光热处理技术正在持续突破应用边界，并有望在成本风险下降后对传统技术形成一定替代，公司正与中国大陆多家领先晶圆厂就前述应用场景开展合作，并取得良好进展。因此公司具备持续提高市场地位的技术基础和商务基础。

## 2、激光加工行业

公司围绕半导体器件制造需求已开发了较完善的专用激光加工设备产品序列，应用场景涵盖划片、标刻、解键合、去溢胶等。

公司专用激光加工设备产品的生产效率、稳定性及一致性等多项关键性能指标已接近国际对标机台水平，并在华天科技、长电科技、达迩科技、比亚迪半导体、佰维存储、菲尼克斯等知名厂商的后道封测环节实现产业化应用。

目前，专用激光加工设备市场竞争充分且客户需求较为分散，相较于传统激光设备厂商，公司前期发展资金供给不足、批量交付能力有限，因此公司报告期内专用激光加工设备整体市场占有率较低。

但随着器件精细化制造需求增长，半导体前后道工艺逐步融合并出现中道工艺（即先进封装），公司基于多年发展形成的先进精密激光相关核心技术和服务前道先进制程积累的工艺能力，针对当前半导体先进封装中三维堆叠、异构集成发展趋势开展激光剥离、激光隐形切割等新型设备研发，并与下游客户就国产 HBM 制造项目开展相关技术、工艺和设备验证工作。此类技术系业内前沿探索，目前仅东京电子、EV Group 等国际大厂实现设备产品少量出货，因此在专用激光加工设备的前沿应用领域，公司技术实力与创新能力已达到较高水平。

#### （四）发行人技术水平及特点

公司在半导体等应用领域具备成熟的激光工艺和技术设备研发能力，以及丰富的前后道工艺整合经验。公司在激光工艺设备领域持续突破，除对标国际厂商先进产品连续推出多款国产解决方案外，还基于正向研发路径为国内领先半导体制造厂商的独家工艺成功开发了创新性激光工艺设备。目前，公司以低热预算、高空间精度且时域可调的热处理工艺能力，和高精度、低热应力激光微纳加工工艺能力，赋能下游半导体制造等行业，既面向高端工艺需求，也同步满足产业竞争环境下的性价比需求。

公司核心技术全流程覆盖光、机、电、算各个环节，并涵盖下游制造工艺领域。公司产品和技术源于自研，公司具有自主定义激光器、光路整形系统、精密位移控制系统、自动化控制系统等激光设备核心模块的能力，在核心关键技术上拥有自主知识产权，可以较快迭代速度有力支持国家半导体等产业发展。具体而言，公司的技术水平及特点说明如下：

##### 1、光学

公司具备复杂光学系统搭建和全局优化能力，进而形成了各类激光光束整形及光学变换处理能力，可以精准调控光斑能量分布类型（高斯分布、一维平顶、二维平顶等）、边缘陡直度（陡直、光滑或边缘尺寸可调）、光斑形状（圆形、正方形、长方形、线形等）、光斑空间分布（一维分布、二维分布、三维分布）、光斑尺寸（最小可突破瑞利极限、最大尺寸可达数十 mm）。

为适配半导体、精密电子制造等不同应用场景的制造要求，激光波长、脉宽、重复频率、功率/能量、光束质量等多个参数均需与具体工艺紧密结合；同时，不同类型的激光器控制方式、运行条件、工作寿命等特点也直接决定着整机设备的性能、可靠性和运维成本，公司已掌握多项半导体行业专用激光器的应用技术。

考虑到半导体等应用领域的严苛工艺量产要求，公司不仅可以结合工艺特征自主定义激光器关键指标参数并基于光学系统高效利用激光能量，而且具备在设备长期运转过程保障激光器、光学系统高度可靠、稳定的监控检测技术能力和工程化技术能力。

## 2、机械

机械结构包括承载功能用机械结构、固定功能用机械结构、运动系统用机械结构、调节用机械结构。基于良好设计建模能力并且在多轮迭代过程中持续优化，公司激光工艺设备采用的各类机械结构实现了高可靠性、高稳定性、高精度、高易用性和高可维护性。

同时考虑到半导体等行业激光工艺设备的特点，公司面向激光损伤、光轴稳定、温度漂移等方面挑战开展针对性的机械结构优化设计，以保障光学、运动和调节等其他系统的可靠性。

## 3、电气

除个别工艺使用与晶圆尺寸相当的激光光斑并一次覆盖整个晶圆完成工艺外，绝大多数工艺条件下激光光斑尺寸远小于晶圆尺寸，需要快速精确控制光斑位置、速度和能量，公司具备精确控制光斑与晶圆之间的相对位移及其位移轨迹，精准调节相对位移过程中的激光光束焦点位置，稳定维持光斑之间重叠的集成电气控制能力，从而保证晶圆能完整、平稳地接受激光光斑照射。

目前，公司在保障产能的基础上最高可以将激光光斑与晶圆特定加工区域间相对位置偏差控制在微米级别，并借助运动控制系统与激光器之间的时序兼容实现步进式激光加工工艺功能。

## 4、软件算法

激光工艺设备的相关硬件包括激光器、执行器、传感器、位移平台、探测器、控制器等多种硬件类型，相关硬件的启动、运行、状态监测、调控、终止、联动等均通过软件系统实现。

公司在长期研发、迭代、测试、优化过程中积累了丰富的算法库，且进行完整的验证流程，目前公司基于自主研发的软件算法系统实现了设备软硬件的高度协调和设备整体的高度智能化运行。

## 5、工艺研发

设备研发、制造的最终目的是实现半导体等领域客户所需的工艺效果并用于稳定量产，因此行业内有“设备研发，工艺先行”的经验特征，设备研发必须基

于充分的工艺数据支持，工艺研发能力也是半导体工艺设备企业的关键能力之一。

公司技术团队在工艺研发领域具有二十多年积累，获得客户的广泛信任与支持，与客户合作成功开发了 BSI-CCD 图像芯片背面离子注入激光工艺技术、硅基 IGBT 功率芯片背面激光激活技术、SiC 功率芯片欧姆接触激光退火技术、3D NAND Flash 存储芯片创新工艺区域用非晶硅激光诱导结晶技术、DRAM 存储芯片 BLC&SNC 用非晶硅激光诱导外延生长技术、逻辑芯片前道超浅结激光退火技术、逻辑芯片前道动态表面合金激光退火技术、薄晶圆厚背金样片激光半切技术等多项工艺技术并均已用于设备量产。相关工艺的成功研发又进一步强化公司技术水平并巩固客户基础。

在成功研发并推出单步激光工艺基础上，公司以自身较强的技术能力、协调能力、服务意识以及与客户互信为基础，成功配合下游客户将单步工艺嵌入到工艺制程中并完成优化、整合，最终达到量产的目的。

（五）发行人与同行业可比公司对比情况

1、经营情况比较

2024 年度，公司实现营业收入 28,102.42 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司员工总数 277 人。可比公司（含业务可比公司、财务可比公司）的经营情况对比请参见本小节之“（一）发行人所处行业主要企业”。

报告期内，公司与财务可比公司之主要财务数据对比如下：

单位：万元

| 同行业公司 | 项目   | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度    | 2023 年度    | 2022 年度    |
|-------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 中微公司  | 营业收入 | 806,256.51   | 906,516.51 | 626,351.36 | 473,983.10 |
|       | 净利润  | 118,076.41   | 161,431.44 | 178,397.72 | 116,789.73 |
| 芯源微   | 营业收入 | 99,026.65    | 175,360.60 | 171,696.99 | 138,486.71 |
|       | 净利润  | -2,621.03    | 20,142.63  | 25,015.23  | 20,016.09  |
| 华海清科  | 营业收入 | 319,379.55   | 340,622.86 | 250,799.11 | 164,883.83 |
|       | 净利润  | 79,142.28    | 102,340.79 | 72,374.66  | 50,160.10  |
| 拓荆科技  | 营业收入 | 422,010.94   | 410,345.39 | 270,497.40 | 170,556.27 |
|       | 净利润  | 53,552.48    | 68,742.19  | 66,387.45  | 36,415.24  |
| 屹唐股份  | 营业收入 | 379,634.30   | 463,297.78 | 393,142.70 | 476,262.74 |

| 同行业公司 | 项目   | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度    | 2023 年度    | 2022 年度    |
|-------|------|--------------|------------|------------|------------|
|       | 净利润  | 51,562.93    | 54,080.21  | 30,941.93  | 38,252.22  |
| 平均值   | 营业收入 | 405,261.59   | 459,228.63 | 342,497.51 | 284,834.53 |
|       | 净利润  | 59,942.61    | 81,347.45  | 74,623.40  | 52,326.68  |
| 公司    | 营业收入 | 19,046.49    | 28,102.42  | 19,075.73  | 7,414.56   |
|       | 净利润  | 988.73       | 5,491.16   | 2,279.87   | -938.22    |

数据来源：Wind

2、公司和竞争对手技术实力及关键业务指标比较

根据公司取得的行业信息及公司自身情况，公司产品技术参数与竞争产品对比情况如下：

| 莱普科技             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 竞争对手指标             |      |           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|-----------|
| 设备种类             | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 主要竞争对手             | 指标   |           |
| 激光诱导结晶设备（LIC）    | 公司 LIC 主要满足客户 A 国产先进架构先进制程 3D NAND Flash 存储芯片特定区域结晶工艺需求。根据客户 A 回复，其仅向公司采购同类设备，因此暂无指标对比数据。<br>公司 LIC 产品已获以下认定/评价：<br>（1）四川省经济和信息化厅、四川省财政厅的“2022 年度四川省重大技术装备国内首台套”认定；<br>（2）四川省科技协同创新促进会出具的“整体国际先进、部分国际领先”评价；<br>（3）客户 A 出具的“质量稳定，使用效果良好，满足公司研发生产的需要，为公司带来新的效益增长点”评价。          |           |                    |      |           |
| 激光诱导外延生长设备（LIEG） | 公司 LIEG 主要满足客户 C 先进制程 DRAM 存储芯片特定区域外延生长工艺需求。根据客户 C 回复，其仅向公司采购同类设备；目前全球仅韩国 DIT 及韩国 EO Technics 推出同类产品，其中 DIT 设备仅供应韩国 SK 海力士，EO 设备仅供应韩国三星电子，未对国内销售，因此指标详细对比数据不可得。<br>公司 LIEG 产品已获以下认定/评价：<br>（1）四川省经济和信息化厅、四川省财政厅的“2024 年度四川省重大技术装备省内首台套”认定；<br>（2）四川省科技成果评价服务联盟成员单位的“国际先进”评价。 |           |                    |      |           |
| 超浅结激光退火设备（USJLA） | 温度波动                                                                                                                                                                                                                                                                         | <5℃       | 维易科（LSA101/LSA202） | 温度波动 | <10℃      |
|                  | 极限高温                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1390℃     |                    | 极限高温 | 1350℃     |
|                  | 运行功耗                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.8KW    |                    | 运行功耗 | 28.8KW    |
| IGBT 晶圆激光退火设备    | 兼容晶圆                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/8/12 英寸 | 华卓精科（UPLD 系列）      | 兼容晶圆 | 6/8/12 英寸 |
|                  | 退火深度                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7μm       |                    | 退火深度 | 7μm       |
|                  | 激活效率                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90%       |                    | 激活效率 | 90%       |

| 莱普科技             |                                                                                 |                                     | 竞争对手指标                                |                              |                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 设备种类             | 指标                                                                              |                                     | 主要竞争对手                                | 指标                           |                                     |
| SiC 晶圆激光退火设备     | 兼容晶圆                                                                            | 4/6/8 英寸                            | 华卓精科<br>(UP-SCLA02)                   | 兼 容 晶<br>圆                   | 4/6/8 英寸                            |
|                  | 氧含量                                                                             | <10ppm                              |                                       | 氧含量                          | <10ppm                              |
|                  | 接触方式                                                                            | 欧姆接触                                |                                       | 接 触 方<br>式                   | 欧姆接触                                |
| BSI-CCD 晶圆浅结退火设备 | 该设备系为客户 D 等特殊客户生产需求开发的产品线，同时产品特性及应用领域导致国外对我国封锁禁运，国际同类产品详细指标无法取得且不具备可比性，因此未进行对比。 |                                     |                                       |                              |                                     |
| 封测激光标刻机          | 最小打印线宽                                                                          | 0.018mm                             | 联动科技<br>(5W/10W/20W<br>连续光纤激光打标机)     | 最 小 打<br>印线宽                 | 0.018mm                             |
|                  | 最小字高                                                                            | 0.12mm                              |                                       | 最 小 字<br>高                   | 0.12mm                              |
|                  | 适用封装器件                                                                          | 各种半导体分立器件、IC 及金属封装器件                |                                       | 适 用 封<br>装器件                 | 各种半导体分立器件、IC 及金属封装器件                |
| 晶圆激光标刻机          | 最小打印线宽                                                                          | 0.015mm                             | 伊欧激光<br>(WTM200/300,<br>CSM3200/3300) | 最 小 打<br>印线宽                 | 0.018mm                             |
|                  | 最小字高                                                                            | 0.15mm                              |                                       | 最 小 字<br>高                   | 0.18mm                              |
|                  | 支持晶圆                                                                            | 4/6/8/12 寸                          |                                       | 支 持 晶<br>圆                   | 4/6/8/12 寸                          |
|                  | 打标精度                                                                            | <0.02mm                             |                                       | 打 标 精<br>度                   | <0.02mm                             |
| 封测激光去溢胶机         | 定位精度                                                                            | 0.02mm                              | 联动科技<br>(QH-APV5090)                  | 定 位 精<br>度                   | 0.02mm                              |
|                  | UPH                                                                             | 2-10K                               |                                       | UPH                          | 2-10K                               |
|                  | 自动变轨                                                                            | 180~270mm<br>(长)<br>30~100mm<br>(宽) |                                       | 自 动 变<br>轨                   | 180~270mm<br>(长)<br>50~100mm<br>(宽) |
|                  | 防反                                                                              | 是                                   |                                       | 防反                           | 是                                   |
| 精密电子激光切割机        | 最终加工重复定位精度                                                                      | ±0.02mm                             | 大族激光<br>(HDZ-UVC303O)                 | 最 终 加<br>工 重 复<br>定 位 精<br>度 | ±0.02mm                             |
|                  | 最小线宽                                                                            | 0.02mm                              |                                       | 最 小 线<br>宽                   | 0.03mm                              |
|                  | 重复定位精度                                                                          | ±0.002mm                            |                                       | 重 复 定<br>位精度                 | ±0.002mm                            |



## （六）发行人的竞争优势和劣势

### 1、公司的核心竞争优势

#### （1）技术和研发优势

公司扎根先进精密激光技术，经过多年研发和技术创新已积累了较多行业经验、知识产权。核心研发团队拥有多年激光技术、半导体工艺领域的研发、生产、销售和管理经验。公司已在多年研发过程形成具备完整自主知识产权的核心技术体系，具备紧跟行业趋势和下游工艺需求升级而不断迭代设备产品的研发实力。

#### （2）核心产品模块自主研发优势

公司核心技术全流程覆盖光、机、电、算各个环节，具有自主定义激光器、光路整形系统、精密位移控制系统、自动控制系统等激光设备核心模块的能力，核心部件的自主研发水平具备显著优势，并由此形成更灵活、更具针对性的整机设计和制造能力。

公司采用模块化、标准化架构设计，现有量产设备的技术对于其他先进应用领域具有良好的普适性。

#### （3）客户前沿技术需求快速响应优势

公司的主要竞争对手包括美国的维易科、应用材料和日本的住友重工等，对于这些境外竞争对手，公司具有区位优势，更加贴近中国大陆半导体产业链，且供应更加稳定。此外，公司专注于激光半导体设备业务，相对于多主业发展的竞争对手，业务专注度更高。

公司已逐步建立了一支人员稳定、技术基础扎实、拥有丰富行业应用经验，且同时具备市场经营理念的复合型人才队伍，可以对客户工艺开发、产品适配做出更积极响应。

#### （4）行业地位及客户基础优势

凭借优秀的产品力与服务质量，公司目前已成为多家境内一流半导体厂商的设备供应商，包括客户 A、客户 B、客户 C、华润微、士兰微、三安半导体、中车时代、客户 D、华天科技、达迩科技等，上述客户具有明显的规模优势、技术优势，预期未来经营状况稳定，导入其供应链有助于为公司长久发展提供持续业

绩支持。此外，通过领先客户的供应商体系认证对于公司品牌及产品推广也有积极的示范作用。

## **2、竞争劣势**

### **（1）融资渠道相对受限，资金实力较弱**

公司当前处于成长期阶段且尚未上市，主要依靠内部积累以及股东投资、贷款等融资方式，渠道相对受限，规模较小。与其他领先企业相比，公司在研发投入、人才引进、固定资产投资、市场开拓等方面存在一定差距。公司未来的技术验证、新品研发、产能和市场需求响应能力提升迫切要求拓宽融资渠道，寻求更多的资金支持，为产品创新提供持续稳定的推动力。

### **（2）业务起步时间较晚，面临一定认证壁垒**

半导体设备性能及稳定性直接影响下游客户产出质量，一般需要经过长周期、高标准的验证程序，业内存在较高的供应商认证壁垒。随着公司持续的研发创新投入及市场开拓，公司的客户认知度逐步提升。但国外知名半导体设备厂商基于先发优势，在多个细分市场领域与客户结成较为稳固的合作配套关系，公司业务起步时间较晚，目前与国外知名的竞争对手相比在市场认知度和客户资源层面还存在相对劣势，面临一定认证壁垒。

## **（七）发行人盈利能力或财务状况的主要影响因素分析**

### **1、主要产品特点**

公司主要产品为应用于先进制程和先进封装工序的激光工艺半导体设备，产品技术密集特征显著，价值量高。

目前，公司已面向客户 A、客户 B、客户 C、华润微、士兰微、三安半导体、中车时代、客户 D、华天科技、达迩科技等主流半导体厂商的先进制造和先进封装产线需求，成功推出多款先进激光热处理设备、专用激光加工设备，应用于先进制程 3D NAND Flash 存储芯片、先进制程 DRAM 存储芯片和 28nm 及以下先进制程逻辑芯片量产，以及国产 HBM 芯片激光加工验证测试等场景。

经营过程中，公司持续赋能下游半导体制造工艺优化及先进产品开发，助力我国半导体存储芯片等产业在全球竞争中形成局部领先地位，并在此过程实现良

好的业绩表现。

## 2、业务模式

公司主要产品具备复杂度高、专业性强、差异化明显等特征，因此公司采取以订单直销为主的销售模式。

直销模式下，公司由专人对接终端客户的采购、研发、工程和使用等专业部门，从而对客户的工艺、产品配置、应用及运维等技术要求形成全方位快速响应能力，提升服务质效；同时贴近市场以把握市场即时动态，为公司新品开发、客户开发策略提供准确信息支持，提高公司研发及销售效率。

## 3、行业竞争程度

公司主要从事的激光工艺半导体设备具备专业性强、行业壁垒高等特征，公司主要与应用材料、维易科等国际知名半导体设备厂商以及上海微电子、华卓精科等境内领先的半导体设备厂商竞争。以公司 2024 年度激光热处理设备收入并结合 QY Research 数据测算，公司国内市占率约为 16%。

公司立足于自主创新，通过持续技术革新与工艺优化，推出多款对标国际一流水平的半导体专用激光工艺设备，并适配国内半导体产业技术特征开发了原创性产品。公司基于完整的产品供应体系和原创性设备供应，已与客户 A、客户 B、客户 C 等境内领先的半导体领域客户建立稳固合作关系，除一般购销合作外，公司与下游客户开展多维度、深层次的合作研发，双方在商业、技术上形成密切合作关系，由此为公司业绩连续增长奠定坚实基础。

## 4、外部市场环境

热处理设备，尤其是应用于先进制程的激光热处理设备，其产业意义已被全球主要经济体所认识，美国和日本均有针对性地将热处理设备纳入出口管制范畴。相关举措提高了我国半导体制造产业获取热处理设备的难度，但也为公司发展提供良好的发展窗口。

报告期内，公司基于本地化供应链面向国内半导体产业升级需求连续推出多款高性能激光工艺半导体设备，大幅缓解多家国内知名晶圆厂的激光热处理设备供应受限的问题。基于在相关知名晶圆厂量产线的应用经验和成功案例，公司技

术水平与产品质量都在不断提高并缩小与全球领先水平的差距，由此为公司业绩增长带来机遇。

四、发行人的销售情况和主要客户

（一）主要产品销售情况

1、主要产品的产量、销量

公司产品模块化特征明显，生产环节主要包括模块组装及加工、测试、整装、调试、检验等。公司生产能力主要与生产人员配置、原材料供应相关，对固定资产的占用较少，因此产能具有一定弹性。

报告期各期，公司制造的主要产品的生产及销售出库数量情况如下：

| 单位：台         |          |      |      |         |
|--------------|----------|------|------|---------|
| 年度           | 产品种类     | 生产数量 | 出库数量 | 产销率     |
| 2025 年 1-9 月 | 激光热处理设备  | 19   | 18   | 94.74%  |
|              | 专用激光加工设备 | 255  | 243  | 95.29%  |
|              | 合计       | 274  | 261  | 95.26%  |
| 2024 年度      | 激光热处理设备  | 29   | 31   | 106.90% |
|              | 专用激光加工设备 | 136  | 143  | 105.15% |
|              | 合计       | 165  | 174  | 105.45% |
| 2023 年度      | 激光热处理设备  | 17   | 12   | 70.59%  |
|              | 专用激光加工设备 | 154  | 146  | 94.81%  |
|              | 合计       | 171  | 158  | 92.40%  |
| 2022 年度      | 激光热处理设备  | 9    | 11   | 122.22% |
|              | 专用激光加工设备 | 288  | 299  | 103.82% |
|              | 合计       | 297  | 310  | 104.38% |

公司产品具备复杂度高、专业性强等特征，普遍需要较长的验证与验收周期。报告期内公司经营规模持续扩大，但因验收周期较长，致使各期验收与生产存在一定时间错配。

为准确反映销售端对生产能力的利用水平，此处产销率以设备产品出库数量与生产数量之比表征。报告期各期，公司主要产品的产销率分别为 104.38%、92.40%、105.45%及 **95.26%**，保持在较高水平。2022 年度与 2024 年度产销率超过 100%，主要系前一期末生产的设备在本期出库导致。

2、主要产品的销售收入情况

报告期内，公司的主营业务收入按产品类别的构成如下：

单位：万元

| 项目          | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|-------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|             | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 激光热处理设备     | 16,000.03    | 85.46%  | 24,429.21 | 87.90%  | 13,816.34 | 74.10%  | 3,467.26 | 48.05%  |
| 专用激光加工设备    | 2,589.78     | 13.83%  | 3,085.07  | 11.10%  | 4,059.67  | 21.77%  | 3,602.52 | 49.92%  |
| 升级改造及其他技术服务 | 132.39       | 0.71%   | 278.83    | 1.00%   | 768.41    | 4.12%   | 146.53   | 2.03%   |
| 合计          | 18,722.20    | 100.00% | 27,793.12 | 100.00% | 18,644.42 | 100.00% | 7,216.31 | 100.00% |

3、主要产品的价格变动情况

公司主要产品的价格变动情况请参见本招股说明书“第六节 财务会计信息  
与管理层分析”之“六、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

4、主要产品销售模式

公司的主营业务收入按销售模式的构成请参见本招股说明书“第六节 财务  
会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”。

（二）报告期内主要客户

报告期内，公司对前五名客户的销售情况如下：

单位：万元

| 年度              | 序号 | 客户名称           | 营业收入金额    | 占比     |
|-----------------|----|----------------|-----------|--------|
| 2025 年<br>1-9 月 | 1  | 客户 A           | 11,294.94 | 59.30% |
|                 | 2  | 客户 C           | 2,664.00  | 13.99% |
|                 | 3  | 三安光电股份有限公司     | 585.80    | 3.08%  |
|                 | 4  | 客户 J           | 526.13    | 2.76%  |
|                 | 5  | 杭州士兰微电子股份有限公司  | 451.50    | 2.37%  |
|                 | 合计 |                | 15,522.37 | 81.50% |
| 2024 年度         | 1  | 客户 A           | 19,068.95 | 67.86% |
|                 | 2  | 客户 C           | 2,410.00  | 8.58%  |
|                 | 3  | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 882.81    | 3.14%  |
|                 | 4  | 达迩科技（成都）有限公司   | 582.93    | 2.07%  |

| 年度      | 序号 | 客户名称           | 营业收入金额    | 占比     |
|---------|----|----------------|-----------|--------|
|         | 5  | 江苏捷捷微电子股份有限公司  | 508.00    | 1.81%  |
|         | 合计 |                | 23,452.70 | 83.45% |
| 2023 年度 | 1  | 客户 A           | 8,177.49  | 42.87% |
|         | 2  | 华润微电子控股有限公司    | 1,419.25  | 7.44%  |
|         | 3  | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 1,216.42  | 6.38%  |
|         | 4  | 比亚迪半导体股份有限公司   | 925.32    | 4.85%  |
|         | 5  | 客户 E           | 829.78    | 4.35%  |
|         | 合计 |                | 12,568.27 | 65.89% |
| 2022 年度 | 1  | 客户 A           | 1,398.23  | 18.86% |
|         | 2  | 三安光电股份有限公司     | 1,040.71  | 14.04% |
|         | 3  | 天水华天科技股份有限公司   | 1,015.49  | 13.70% |
|         | 4  | 客户 D           | 869.03    | 11.72% |
|         | 5  | 达迩科技（成都）有限公司   | 634.20    | 8.55%  |
|         | 合计 |                | 4,957.66  | 66.86% |

注：以上数据已按照同一控制口径披露，下同。

公司存在股东及其关联方于主要客户中占有权益或任职的情况，具体如下：

①持有公司不足 5%股权的某股东的执行事务合伙人与客户 A(含与客户 A 受同一母公司控制下的客户 B)系同一控制下主体。报告期各期，发行人向客户 A（包括其同一控制下主体客户 B）销售收入分别为 1,398.23 万元、8,177.49 万元、19,068.95 万元和 11,294.94 万元，占公司营业收入比例分别为 18.86%、42.87%、67.86%和 59.30%。报告期内，发行人销售至客户 A（包括其同一控制下主体客户 B）的设备产品最终均投入其晶圆制造产线使用。②持有公司 1.12%和 0.35%股权的鼎创一号和鼎创二号同受株洲时代高新创业投资有限公司控制，株洲时代高新创业投资有限公司为公司客户株洲中车时代电气股份有限公司的控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司的合营企业。此外，公司客户株洲中车时代半导体股份有限公司、宜兴中车时代半导体有限公司为株洲中车时代电气股份有限公司控制的企业。

除上述情况外，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方、持有公司 5%以上股份的股东与上述客户不存在关联关系。

报告期内，公司与主要客户保持了良好的合作关系，凭借良好的产品质量、



性能和服务优势获得行业内主要客户的认可，为持续稳定的发展打下了坚实的基础。

五、发行人的采购情况和主要供应商

（一）原材料采购情况

1、报告期主要原材料

公司采购的各类原材料及其说明如下：

| 原材料种类 | 描述                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 光学类   | 激光器；光学元件（如反射镜片、分光镜片、透镜、偏振片等）；光学组件（如光学镜头、扩束镜模组、聚焦镜模组等）                        |
| 电气类   | 机械手；准直器；运动平台、晶圆装卸台、运动模组；振镜；测量仪/分析仪；功率探头；工控电脑、可编程控制器、驱动器、电机、传感器、开关、线缆、控制卡、板卡等 |
| 机械结构类 | 机加件、钣金件；机柜、吸盘、大理石；光学调整架；丝杆；导轨等                                               |
| 其他    | 包装箱、外购软件（如操作系统、测试软件等）、工具、耗材、夹具、劳保用品等                                         |

公司采购的原材料品种、型号和规格较多。公司与供应商的合作较为稳定。报告期内，公司的原材料采购情况如下：

单位：万元；不含税

| 原材料种类 | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|-------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|       | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 光学类   | 7,322.61     | 43.57%  | 6,216.22  | 39.50%  | 7,993.05  | 54.46%  | 3,592.68 | 45.54%  |
| 电气类   | 5,927.45     | 35.27%  | 6,009.31  | 38.19%  | 4,454.46  | 30.35%  | 2,926.81 | 37.10%  |
| 机械结构类 | 3,077.44     | 18.31%  | 2,874.30  | 18.26%  | 1,955.16  | 13.32%  | 1,225.99 | 15.54%  |
| 其他    | 477.26       | 2.84%   | 637.53    | 4.05%   | 274.28    | 1.87%   | 144.16   | 1.83%   |
| 合计    | 16,804.75    | 100.00% | 15,737.36 | 100.00% | 14,676.96 | 100.00% | 7,889.63 | 100.00% |

报告期内，公司各类原材料采购金额占采购总额的比例存在一定波动，主要系受当年采购计划、产品类型结构等因素的影响。

2、报告期主要原材料的采购数量及采购单价情况

报告期内，公司主要原材料的价格波动情况如下：

| 产品名称     | 价格指数 <sup>注1</sup>   |        |        |        |
|----------|----------------------|--------|--------|--------|
|          | 2025年1-9月            | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 气体激光器    | 76.80 <sup>注2</sup>  | 105.90 | 100    | -      |
| 高功率固体激光器 | 89.04                | 92.11  | 110.33 | 100    |
| 中功率固体激光器 | 95.01                | 99.73  | 101.50 | 100    |
| 铜镜镜片     | 200.32 <sup>注3</sup> | 169.46 | 186.23 | 100    |
| 高端机械手    | 96.46                | 115.03 | 121.56 | 100    |
| 直线电机平台   | 164.02               | 130.42 | 108.42 | 100    |
| 准直器      | 83.87                | 89.91  | 94.70  | 100    |
| 晶圆装卸台    | 90.11                | 93.30  | 104.84 | 100    |
| 激光光束测量仪  | 116.49               | 127.09 | 116.49 | 100    |
| 陶瓷吸盘     | 112.11               | 105.59 | 76.04  | 100    |

注 1：假设 2022 年为基期，价格指数为 100，2023 年及 2024 年价格指数以 2022 年采购均价为基数进行计算。其中，气体激光器于 2023 年开始采购，因此基期为 2023 年。

注 2：2025 年 1-9 月发行人采购的另一不同型号用于激光加工工艺的气体激光器，该型号气体激光器单价较低，导致发行人 2025 年 1-9 月采购的气体激光器价格指数降幅较大；剔除该型号气体激光器后，2025 年 1-9 月发行人采购的气体激光器价格指数为 98.13。

注 3：2025 年 1-9 月发行人采购的水冷柱面铜镜用于先进热处理设备光束整形，该镜片单价较高，导致发行人 2025 年 1-9 月采购的铜镜镜片价格指数增幅较大；此外，铜镜镜片需适配光路，定制化特征明显，因此报告期内价格指数波动较大。

（二）公司主要能源消耗情况

公司使用的主要能源为电能，公司所在地的能源供应稳定。报告期内，公司为生产经营采购电费的价格及其变动情况如下：

| 项目          | 2025年1-9月 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|
| 电费（万元）      | 164.73    | 100.79 | 78.83  | 40.42  |
| 用电量（万千瓦时）   | 240.06    | 130.66 | 97.98  | 48.98  |
| 平均单价（元/千瓦时） | 0.69      | 0.77   | 0.80   | 0.83   |

公司的核心技术在于产品结构设计、软件研发和优化及设备优化调试等方面，公司机器设备等固定资产规模较小，能源消耗与公司产量之间直接关联性较小。

（三）报告期内主要供应商

报告期内，公司向前五名供应商的原材料采购情况如下：

单位：万元，不含税

| 年度 | 序号 | 供应商名称 | 主要采购内容 | 金额 | 占比 |
|----|----|-------|--------|----|----|
|----|----|-------|--------|----|----|

| 年度              | 序号 | 供应商名称           | 主要采购内容 | 金额       | 占比     |
|-----------------|----|-----------------|--------|----------|--------|
| 2025 年<br>1-9 月 | 1  | 富通尼激光科技（东莞）有限公司 | 激光器    | 1,875.33 | 11.16% |
|                 | 2  | 供应商 A           | 激光器    | 1,306.33 | 7.77%  |
|                 | 3  | 武汉市善银科技有限公司     | 平台     | 1,194.53 | 7.11%  |
|                 | 4  | 北京锐洁机器人科技有限公司   | 机械手    | 1,168.93 | 6.96%  |
|                 | 5  | 北京卓镭激光技术股份有限公司  | 激光器    | 1,069.52 | 6.36%  |
|                 | 合计 |                 |        | 6,614.64 | 39.36% |
| 2024 年<br>度     | 1  | 富通尼激光科技（东莞）有限公司 | 激光器    | 2,287.22 | 14.53% |
|                 | 2  | 北京锐洁机器人科技有限公司   | 机械手    | 1,301.50 | 8.27%  |
|                 | 3  | 武汉市善银科技有限公司     | 平台     | 829.37   | 5.27%  |
|                 | 4  | 北京卓镭激光技术股份有限公司  | 激光器    | 582.02   | 3.70%  |
|                 | 5  | 供应商 A           | 激光器    | 579.64   | 3.68%  |
|                 | 合计 |                 |        | 5,579.74 | 35.46% |
| 2023 年<br>度     | 1  | 富通尼激光科技（东莞）有限公司 | 激光器    | 4,242.17 | 28.90% |
|                 | 2  | 供应商 A           | 激光器    | 1,642.11 | 11.19% |
|                 | 3  | 武汉市善银科技有限公司     | 平台     | 764.64   | 5.21%  |
|                 | 4  | 北京锐洁机器人科技有限公司   | 机械手    | 646.02   | 4.40%  |
|                 | 5  | 苏州权日智能科技有限公司    | 机械手    | 604.90   | 4.12%  |
|                 | 合计 |                 |        | 7,899.84 | 53.82% |
| 2022 年<br>度     | 1  | 富通尼激光科技（东莞）有限公司 | 激光器    | 1,220.16 | 15.47% |
|                 | 2  | 北京风启科技有限公司      | 激光器    | 686.83   | 8.71%  |
|                 | 3  | 苏州权日智能科技有限公司    | 机械手    | 604.41   | 7.66%  |
|                 | 4  | 安徽华创鸿度光电科技有限公司  | 激光器    | 525.66   | 6.66%  |
|                 | 5  | 武汉市善银科技有限公司     | 平台     | 494.93   | 6.27%  |
|                 | 合计 |                 |        | 3,531.99 | 44.77% |

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过 50%或严重依赖少数供应商的情形。

报告期内，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方、持有公司 5%以上股份的股东与上述供应商不存在关联关系。

## 六、发行人的主要资产情况

### （一）公司主要固定资产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，具体情况如下：

单位：万元

| 资产类型    | 原值        | 累计折旧     | 账面价值      | 成新率    |
|---------|-----------|----------|-----------|--------|
| 房屋及建筑物  | 30,803.04 | 670.28   | 30,132.76 | 97.82% |
| 机器设备    | 7,157.44  | 3,001.12 | 4,156.32  | 58.07% |
| 运输设备    | 120.45    | 33.70    | 86.75     | 72.02% |
| 办公设备及其他 | 642.41    | 166.33   | 476.08    | 74.11% |
| 合计      | 38,723.33 | 3,871.42 | 34,851.92 | 90.00% |

注：成新率=账面价值/原值。

### （二）公司主要无形资产

#### 1、商标

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人主要注册商标列示如下：

| 序号 | 权利人  | 商标                                                                                  | 注册号      | 有效期至       | 品类 | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|------|------|
| 1  | 莱普科技 |  | 38598320 | 2030.09.06 | 7  | 原始取得 | 无    |
| 2  | 莱普科技 |  | 38604415 | 2030.09.06 | 9  | 原始取得 | 无    |
| 3  | 莱普科技 |  | 38575673 | 2030.06.13 | 42 | 原始取得 | 无    |

#### 2、专利

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有 94 项已授权境内专利，其中 16 项为发明专利，68 项为实用新型专利，10 项为外观设计，无已授权境外专利。

发行人专利详细情况请见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件一、发行人已获授权专利情况”。

3、软件著作权

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有 43 项已授权软件著作权，详情请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件二、发行人软件著作权情况”。

4、土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人土地使用权情况列示如下：

| 序号 | 产权人  | 面积<br>(m²) | 坐落<br>位置             | 产权证书号                     | 用途   | 使用期限                  | 权利<br>类型  | 权利<br>性质 | 他项<br>权利 |
|----|------|------------|----------------------|---------------------------|------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | 莱普科技 | 26,446.30  | 四川省成都市高新区西园街道青龙村 3 社 | 川（2023）成都市不动产权第 0327410 号 | 工业用地 | 2023.10.13-2043.10.12 | 国有建设用地使用权 | 出让       | 抵押       |

2024 年 3 月，公司与交通银行股份有限公司成都高新区支行签订《固定资产贷款合同》（成交银 2024 年固贷字 060004 号）和《抵押合同》（成交银 2024 年抵字 060004 号），公司向交通银行股份有限公司成都高新区支行借款 34,600.00 万元，借款期限自 2024 年 3 月 14 日至 2035 年 3 月 12 日，公司以上表中的国有建设用地使用权作为银行借款抵押物。截至本招股说明书签署日，上述合同仍在正常履行中。

5、域名

截至本招股说明书签署日，发行人主要使用的域名为 la-ap.com，发行人子公司江苏莱普主要使用的域名为 laipu-js.com。

（三）公司租赁房产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司用于生产经营的主要租赁房产情况如下：

| 序号 | 承租方  | 出租方           | 房屋坐落                             | 租赁期限                  | 用途               |
|----|------|---------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1  | 莱普科技 | 深圳市公明下村股份合作公司 | 深圳市光明区公明街道办事处下村社区第三工业区 5 号       | 2025.07.15-2026.05.30 | 办公、研发、生产、仓储、员工宿舍 |
| 2  | 莱普科技 | 北京双融汇投资有限公司   | 北京市海淀区丹棱街 3 号电子大厦 B 座第 3 层 09 单元 | 2024.11.18-2026.11.30 | 办公               |

| 序号 | 承租方  | 出租方             | 房屋坐落                                    | 租赁期限                  | 用途          |
|----|------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 3  | 江苏莱普 | 苏州恒创科技园运营管理有限公司 | 苏州市工业园区唯亭葑亭大道502号泓创科技园1幢1楼101室、1幢2楼212室 | 2025.10.01-2027.10.24 | 办公、研发、生产、仓储 |

除前述租赁房产外，公司另存在向客户A的关联方租赁房产用于办公的情形，租赁期限为2024.10.01-2026.09.30。”

1、部分租赁房产的出租方未取得产权证书

截至本招股说明书签署日，发行人上述第1项租赁房产的出租方深圳市公明下村股份合作公司未取得不动产权证书等权属文件，租赁合同存在效力瑕疵，发行人在租赁期内存在无法持续使用该等房产的风险。前述未能取得相关产权证书的房产实际由深圳分公司作为厂房、员工宿舍使用，相关区域的租赁资源丰富，发行人可以在较短时间内找到符合条件的替代性房产，上述租赁房产未取得产权证书的瑕疵对发行人的生产经营不会构成重大不利影响。

截至本招股说明书签署日，发行人向客户A关联方租赁房产的出租方未提供不动产权证书等权属文件，相关房产主要用于发行人售后服务人员办公，可替代性强，如未来不能继续使用该等房产，发行人可以在较短时间内找到符合条件的替代性物业，不会对发行人的生产经营不会构成重大不利影响。

2、租赁房产未办理房屋租赁备案手续

发行人未就其承租上述房产办理房屋租赁备案手续，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，房屋租赁合同未办理租赁登记手续不会影响租赁合同的效力。报告期内，发行人未因上述租赁房屋未办理租赁备案手续而受到主管机关的行政处罚。

上述租赁房产所在地租赁市场成熟，若发生无法继续承租该等租赁房产的情形，可较为便捷地寻找到可替代的租赁房产，不会对发行人的持续经营构成重大不利影响。

此外，公司控股股东东骏投资对公司房产租赁事项自愿承诺如下：“若因本次发行上市前租赁的房产存在权属瑕疵等情形导致莱普科技及其控股子公司、分



公司无法继续按租赁协议约定租赁使用该等房产，或被相关主管部门处以行政处罚，东骏投资将自愿承担莱普科技因此遭受的损失”。

综上，发行人上述租赁房产的不规范情形不会对发行人的生产经营构成重大不利影响，不会构成本次发行的实质性障碍。

（四）公司主要业务资质、认证

截至本招股说明书签署日，发行人处于有效期内的主要业务资质、认证情况列示如下：

| 序号 | 资质/认证证书名称      | 主体   | 发证机构                         | 发证日期       | 证书有效期      |
|----|----------------|------|------------------------------|------------|------------|
| 1  | 高新技术企业证书       | 莱普科技 | 四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局 | 2023.12.12 | 三年         |
|    |                | 江苏莱普 | 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 | 2024.11.6  | 三年         |
| 2  | 质量管理体系认证证书     | 莱普科技 | 新世纪检验认证有限责任公司                | 2026. 1. 6 | 2029. 1. 5 |
|    |                | 江苏莱普 | 北京中安质环认证中心有限公司               | 2023.4.27  | 2026.4.26  |
| 3  | 环境管理体系认证证书     | 莱普科技 | 新世纪检验认证有限责任公司                | 2026. 1. 6 | 2029. 1. 5 |
| 4  | 职业健康安全管理体系认证证书 | 莱普科技 | 新世纪检验认证有限责任公司                | 2026. 1. 6 | 2029. 1. 5 |

七、发行人核心技术及研发情况

（一）核心技术

1、发行人拥有的核心技术

发行人核心技术均来源于自主研发。公司拥有的核心技术具体情况如下：

| 序号 | 核心技术名称      | 专利及其他保护措施   | 技术水平 | 应用和贡献情况 |          |
|----|-------------|-------------|------|---------|----------|
|    |             |             |      | 激光热处理设备 | 专用激光加工设备 |
| 1  | 多波长固态激光技术   | 已获授权专利 8 项  | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |
| 2  | 多波长光路整形技术   | 已获授权专利 11 项 | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |
| 3  | 高精度能量密度控制技术 | 已获授权专利 5 项  | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |

| 序号 | 核心技术名称          | 专利及其他保护措施   | 技术水平 | 应用和贡献情况 |          |
|----|-----------------|-------------|------|---------|----------|
|    |                 |             |      | 激光热处理设备 | 专用激光加工设备 |
| 4  | 复杂多变量协同监测检测技术   | 已获授权专利 7 项  | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |
| 5  | 半导体领域多用途激光加工技术  | 已获授权专利 46 项 | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |
| 6  | 半导体领域激光设备整机设计技术 | 已获授权专利 16 项 | 国际先进 | 已量产     | 已量产      |

2、发行人的技术先进性及具体表征

（1）多波长固态激光技术

多波长固态激光技术，是指针对半导体领域先进精密激光技术对激光波长、脉宽、重复频率、光束质量、光斑稳定性等参数的要求，在光学带宽调控技术、偏振调控技术、合束技术等底层技术方面开展工作，确认泵浦源、增益晶体、倍频晶体、三倍频晶体、谐振腔、声光或电光调制器等元件的最优参数范围，并集成为多波长固态激光技术体系，从而为半导体领域精密激光工艺及设备要求提供核心部件保障。

（2）多波长光路整形技术

多波长光路整形技术，是指针对半导体领域先进精密激光技术需求，采用微透镜光学、衍射光学、非曲面光学及其组合等方式，对不同波长激光器出射的光束进行扩束、准直、相位调控、强度调控、波前调控、合束或分束、聚焦、傅里叶变换等，从而将激光器出射的原始光束整形为满足工艺要求及量产要求的光斑，使之充分满足集成电路先进制程等工艺对聚焦光斑尺寸（um 至 cm 级别）、形状（方形并尺寸可调、圆形、线形、一维二维三维子光束阵列、贝塞尔、涡旋等）、顶部平滑度（<1%）、边缘陡直度（>99%）、焦深（最大焦深 mm 级别）、有效焦距以及稳定可靠量产的要求。为满足部分工艺要求，公司具备多路激光器联合控制的工艺能力，以实现更精确的温差、加热深度控制，目前公司最高可以精确控制 4 路激光器以满足集成电路先进制程工艺需求。公司在光路整形方面有 20 余年积累，从光路设计到元件加工到组装调试到测试优化的全技术链条均自主掌控。

### （3）高精度能量密度控制技术

能量密度是半导体领域精密激光加工极为重要的工艺参数，直接影响工艺效果及生产良率。在多波长光路整形技术的基础上，公司通过空间约束、边缘锐利技术对聚焦光斑内的能量密度均匀性进行进一步提升，将光斑内的能量密度均匀性提升至>99%的水平，而后配合偏振调控技术、光束指向稳定技术、能量密度实时原位监测及调控技术等，最终实现对能量密度的高精度及高稳定性控制，精度达到5%量级，为工艺结果的片内均匀性、片间批间重复性以及多型号产品的稳定量产奠定技术基础。

### （4）复杂多变量协同监测检测技术

为了满足半导体领域精密激光加工及稳定可靠量产的要求，公司采用了多种监测及检测技术，空间时间上分为原位实时监测检测、按需监测检测、必须监测检测三大类，通过集成多种传感器、信号处理放大滤波电路、通讯接口电路等实现了运行软件对设备关键运行参数（包括激光器功率及其稳定性、激光光轴中心稳定性、光斑形状尺寸及能量分布稳定性、焦点稳定性、位移系统稳定性、光学系统稳定性、传送装置稳定性、晶圆完整性等关键参数）的准确、完整、快速、高效监测检测以及数据处理分析，并结合良好的光学、机械预先设计提供一定容错空间，克服设备长期运行过程中由于光学等元件损耗导致的精度下滑，从而保证设备工作的长期稳定可靠。目前，公司设备长期运行精度可以维持于纳米级别，激光脉宽可以卡控于纳秒级别。

### （5）半导体领域多用途激光加工技术

半导体领域激光精密加工技术按照激光与材料的作用效果可分为激光调材、激光增材、激光减材等三大类型。针对客户的具体需求及其归属工艺类型的自身特点，公司从激光器、光学系统、位移系统、激光轨迹控制系统、工艺气氛及压强控制系统等方面开展工作，结合公司多年在半导体领域激光精密加工技术方面的积累，研发出满足客户工艺要求的原型机，并在原型机上开展工艺及测试表征，根据测试表征结果与客户沟通反馈进行优化，最终开发成功面向某国产先进架构3D NAND Flash存储芯片创新工艺区域的非晶硅激光诱导结晶技术、面向DRAM的非晶硅激光诱导外延生长技术并用于量产（国内首次），开发成功面向背照式

图像传感器的超浅结杂质激光激活技术并用于量产（国内首次，激活后杂质峰值扩散深度 $<10\text{nm}$ ），开发成功硅基功率器件背面杂质激光激活技术并用于我国高铁芯片量产，开发成功碳化硅欧姆接触激光退火技术并用于量产，开发成功超薄硅化物激光退火技术、非晶硅薄膜连续激光结晶技术等多项工艺技术。

### **（6）半导体领域激光精密加工设备整机设计技术**

在上述技术的基础上，公司基于在激光设备领域 20 余年的深厚积累，从材料、元器件、模块、整机、备件等方面着手，集成光学整形技术、机械结构设计技术、电气控制技术、软件算法技术等进行设备的整机设计，同时设计上充分考虑半导体产业对设备量产稳定性、可靠性、设备间匹配性以及售后服务维修响应速度及效果的要求，采取有针对性的设计，对设计结果进行充分的验证后用于设备整机。

## **3、核心技术在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况**

公司核心技术广泛应用于主营业务中，报告期内，核心技术产品收入占营业收入比例具体情况请参见本节之“一、（五）主要业务经营情况和核心技术产业化情况”。

## **4、核心技术的保护措施**

### **（1）专利保护**

公司拥有的核心技术是公司长远发展的关键，公司高度重视对核心技术的保护。为加强对技术资料保密工作的统一管理，防止技术泄密，公司依据国家标准制定了《专利及政府资助项目奖励管理办法》，建立了有效的知识产权保护管理体系。管理方面，公司尊重知识产权，设立独立的知识产权管理部门对知识产权相关问题进行统一管理。专利申请上，对产品进行有效的知识产权布局，保证公司的技术研发成果可以及时、高效地申请知识产权保护。目前，公司已针对核心技术实施专利申请并技术秘密保护。

### **（2）保密与竞业禁止制度**

公司建立了严格的保密制度，公司与在公司担任具体职务并领取薪酬的非独立董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员签订《劳动合同》

或《返聘协议》并同时签订了《保密协议》《知识产权和竞业禁止协议》，明确保密的范围、手段及违约责任，以防止因人员流动而造成泄密，致使企业遭受重大损失。

（3）股权激励

为了建立长效激励机制，充分调动技术研发人员的积极性，吸引和留住优秀专业人才，有效地将股东利益、公司利益和技术研发人员个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，公司实施员工股权激励计划，主要的技术研发人员间接持有公司的股份。

（二）科研实力和成果情况

1、公司获得重要荣誉、奖项

（1）行业荣誉

| 序号 | 级别 | 名称                           | 获得年份 | 颁发单位                     |
|----|----|------------------------------|------|--------------------------|
| 1  | 行业 | 科学技术奖一等奖                     | 2025 | 中国机械工业集团有限公司             |
| 2  | 行业 | 新质生产力科技创新成果库证书               | 2025 | 中国生产力促进中心协会              |
| 3  | 行业 | 在地化突破奖                       | 2025 | 晶合集成                     |
| 4  | 行业 | 2025 年度最佳产品质量奖               | 2025 | 瞻芯电子                     |
| 5  | 行业 | 2025 协同创新奖                   | 2025 | 客户 A                     |
| 6  | 行业 | 2024 优秀技术支持团队                | 2024 | 客户 A                     |
| 7  | 行业 | 第七届“IC 创新奖-产业链合作奖”           | 2024 | 中国集成电路创新联盟               |
| 8  | 行业 | 第六届“IC 创新奖-产业链合作奖”           | 2023 | 中国集成电路创新联盟               |
| 9  | 行业 | 2023 研发合作奖                   | 2023 | 客户 C                     |
| 10 | 行业 | 2022 新锐突破奖                   | 2022 | 客户 C                     |
| 11 | 行业 | 2020 年度优秀供应商奖                | 2021 | 成都赛力康电气有限公司              |
| 12 | 行业 | 2020 年度半导体设备卓越创新奖            | 2020 | 中国通信工业协会                 |
| 13 | 行业 | Year 2019 Excellent Supplier | 2019 | NK MEASURING INSTRUMENTS |
| 14 | 行业 | Year 2018 Excellent Supplier | 2018 | 上海凯虹科技电子有限公司             |
| 15 | 行业 | 2017 年度优秀供应商                 | 2017 | 天水华天科技股份有限公司             |

注：“IC 创新奖-产业链合作奖”旨在表彰在推进集成电路产业链上下游及产学研合作方面作出突出贡献的单位和团队，除公司外，其他获得该奖项的机构包括海思半导体有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、华海清科股份有限公司、拓荆科技股份有限公司等国内知

名半导体厂商；公司是本奖项设立以来唯一获奖的激光热处理设备供应商，也是唯一连续获得本奖项的半导体设备供应商。

(2) 政府部门荣誉

| 序号 | 级别 | 名称                                                    | 获得年份 | 颁发单位                                                     |
|----|----|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 国家 | 国家高新技术企业（子公司）                                         | 2024 | 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局                             |
| 2  | 国家 | 国家高新技术企业（母公司）                                         | 2023 | 四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局                             |
| 3  | 国家 | 专精特新“小巨人”企业                                           | 2023 | 工业和信息化部                                                  |
| 4  | 省级 | 四川企业技术创新能力百强发展报告入围企业<br>四川企业技术创新能力百强<br>四川企业发明专利拥有量百强 | 2025 | 四川省企业联合会、四川省企业家协会、四川省企业发展促进中心                            |
| 5  | 省级 | 四川省新一轮第一批建议支持的重点“小巨人”企业                               | 2024 | 四川省经济和信息化厅                                               |
| 6  | 省级 | 四川省制造业标志性产品链主企业-激光技术设备                                | 2024 | 四川省制造强省建设领导小组办公室                                         |
| 7  | 省级 | 四川省企业技术中心                                             | 2023 | 四川省经济和信息化厅、四川省发展和改革委员会、四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局、成都海关 |
| 8  | 省级 | 四川省“专精特新”中小企业                                         | 2022 | 四川省经济和信息化厅                                               |
| 9  | 省级 | 四川省先进全固态激光工程技术研究中心                                    | 2020 | 四川省科学技术厅                                                 |
| 10 | 市级 | 成都市工业设计中心                                             | 2024 | 成都市经济和信息化局                                               |
| 11 | 市级 | 成都市产业建圈强链人才计划“集成电路产业链链主企业”                            | 2024 | 成都市经济和信息化局                                               |
| 12 | 市级 | 成都市企业技术中心                                             | 2022 | 成都市经济和信息化局                                               |

2、公司承担的重大科研项目

(1) 国家某部委应用专项

基于自身研发实力和前期新品研发的成功案例，报告期内公司作为唯一责任单位承担国家某部委应用专项，实施周期 2023 年至 2024 年，项目含中央预算内投资 5,968 万元。

1) 项目内容

本项目需开发满足逻辑芯片退火工艺要求的激光退火装备，完成工艺验证并



用于量产。

莱普科技曾于2021年与客户合作成功开发12英寸激光热处理装备，产品具有良好的稳定性和工艺结果，相关设备是公司技术实力的有力证明，也为公司积累下丰厚的晶圆制造设备开发经验。

2023年，公司收到该部委下发的《任务责任书》，开始承担本项目，计划到2024年12月31日完成激光退火装备的工艺验证并用于用户单位量产，对标进口设备。

公司在本项目所研发的激光退火装备采用模块化、标准化架构设计，对28nm及以下先进制程的数字逻辑芯片加工制造具有良好的普适性。

## 2) 项目进展

截至本招股说明书签署日，**本项目已通过验收。**

### (2) 2023 年度四川省省级工业发展资金产业基础攻关任务项目

为提高国家集成电路制造竞争力，加速实现我国集成电路成熟及先进制程方面的供应链保障水平，公司申报并承担2023年度四川省省级工业发展资金产业基础攻关任务项目《面向芯片先进制程的激光退火技术与制造装备研制》，实施周期为2022年至2024年，并获财政资金支持1,000.00万元。

## 1) 项目内容

本项目主要针对集成电路28nm及以下制程节点的高效激光退火装备开展装备研发设计和技术工艺攻关等方面研究，以应对相关设备的供应受限。

公司作为中国大陆从事面向集成电路先进制程的激光退火技术和装备研发企业，产品应用领域覆盖完整性居于国内领先地位，具备顺利实施、完成本项目并在后续推广的技术基础。2023年10月，四川省经济和信息化厅公示2023年产业基础领域揭榜攻关项目名单，公司作为揭榜单位承担本项目。

## 2) 项目进度

截至本招股说明书签署日，**本项目已通过验收。**

### （三）正在从事的主要研发项目

截至本招股说明书签署日，公司正在从事的主要研发项目的基本情况如下：

| 项目名称                      | 研究成果及应用场景                             | 项目进展    | 项目预算<br>(万元)    |
|---------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|
| 12 寸晶圆激光诱导结晶设备与工艺         | 应用于3D NAND Flash存储芯片制造的激光诱导结晶设备（LIC）。 | 产业化应用阶段 | 2,000.00        |
| 12 寸 DRAM 晶圆激光诱导外延生长设备与工艺 | 应用于先进制程DRAM存储芯片制造的激光诱导外延生长设备（LIEG）。   | 产业化应用阶段 | 3,000.00        |
| 12 寸逻辑晶圆 CO2 激光退火设备与工艺    | 应用于先进制程逻辑芯片制造的超浅结激光退火设备（USJLA）。       | 产业化应用阶段 | 15,000.00       |
| 新一代晶圆激光开槽划片设备             | 应用于先进封装、精密电子等领域的激光切割划片设备等。            | 在研      | <b>6,678.00</b> |
| 3D-IC 异构集成激光设备与工艺         | 应用于3D-IC的激光解键合设备、激光辅助键合设备（LAB）等。      | 在研      | 4,700.00        |
| 12 寸逻辑晶圆动态表面退火设备与工艺       | 应用于先进制程逻辑芯片制造的动态表面合金设备（DALA）。         | 产业化应用阶段 | 2,000.00        |
| 12 寸晶圆整片单步激光退火设备研发        | 应用于集成电路（含逻辑芯片、存储芯片）制造的整片单步激光退火设备。     | 在研      | 2,000.00        |
| 先进制程节点 mask 特征尺寸修正技术及设备开发 | 应用于先进制程光罩修正的激光工艺设备。                   | 在研      | 3,000.00        |

### （四）研发投入情况

#### 1、研发投入占比情况

报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2025 年 1-9 月     | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度  |
|-------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 研发投入        | <b>3,784.97</b>  | 5,873.72  | 2,395.18  | 1,528.13 |
| 营业收入        | <b>19,046.49</b> | 28,102.42 | 19,075.73 | 7,414.56 |
| 研发投入占营业收入比例 | <b>19.87%</b>    | 20.90%    | 12.56%    | 20.61%   |

#### 2、研发投入的构成

报告期内，公司的研发投入构成情况详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析”之“（五）期间费用分析”之“3、研发费用”。

### （五）合作研发情况

公司长期立足于技术创新，具备与自身业务及经营规模相匹配的自主研发能力。近年来，公司积极联合产、学、研机构开展多领域、多方位的技术交流与合作，以促进产业供求融合，推动原始创新成果产业化落地，并加速突破产业面临的关键短板。

报告期内，公司与外部机构主要合作研发情况如下：

| 序号 | 合作方             | 合作项目                 | 合作期限                    | 权利义务划分约定                                                                   | 保密措施        |
|----|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 中国科学院<br>半导体研究所 | 第三代半导体材料工艺及装备开发联合实验室 | 2019年6月18日-2022年6月17日   | 一方独立完成的研究成果及其形成的知识产权原则上由研制方独立持有；双方共同完成的研究成果及形成的知识产权由双方共有。                  | 合作协议包含保密条款  |
| 2  |                 | 新型光学与装备技术联合实验室       | 2023年8月4日-2026年8月3日     |                                                                            |             |
| 3  | 合作单位 A          | 某纳秒级激光退火机台开发项目       | 不适用                     | 与半导体工艺、方法、制程，以及半导体制造相关的算法和软件的知识产权归合作方所有；与半导体制造设备硬件相关的知识产权归属于公司与合作方 A 共同所有。 | 已签订《共同保密合同》 |
| 4  |                 | 某激光退火设备研发、改进和验证      | 不适用                     | 基于一方成果的基础开发而产生，或一方独立完成的研究成果及其形成的知识产权该方单独所有；双方共同完成的研究成果及形成的知识产权由双方共有。       |             |
| 5  |                 | 某激光工艺技术及设备           | 不适用                     | 与半导体工艺相关的知识产权归合作方所有，与半导体工艺无关的设备硬件知识产权归公司所有，与半导体工艺相关的设备硬件知识产权归双方共有。         |             |
| 6  | 合作单位 B          | 某激光诱导外延生长工艺及技术       | 2022年11月24日-2027年11月23日 | 公司独立利用设备产生的知识产权及其申请权归公司所有；与合作方产品相关的知识产权及其申请权归合作方 B 所有；其他双方共同合作开发过程中产生的知识产权 | 合作协议包含保密条款  |

| 序号 | 合作方               | 合作项目                 | 合作期限                    | 权利义务划分约定                                                                                                                                                | 保密措施       |
|----|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                   |                      |                         | 归双方共同所有。                                                                                                                                                |            |
| 7  |                   | 某激光剥离设备              | 2024年7月19日-2029年7月18日   | 一方不依赖于对方背景知识产权且独立研发的前景知识产权由该方单独所有，否则由双方共同所有。                                                                                                            |            |
| 8  | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 | 共建四川省先进全固态激光工程技术研究中心 | 2020年12月25日-2024年12月24日 | 中国工程物理研究院应用电子学研究所作为依托单位，主要在科研经费争取、科研管理、成果转化及科研基础条件保障等方面为中心提供支持；莱普科技作为公司，主要在成果转化、市场营销、技术服务等方面提供支撑。<br>双方在开展合作的过程中，应尊重各方的权益，承诺各自提供的材料的真实有效性，并为之承担相应的法律责任。 | 合作协议包含保密条款 |
| 9  | 电子科技大学            | 四川省科技成果转化项目产学研联合协议书  | 2024年1月1日-2025年12月31日   | 双方享有协议所约定的成果权益；按协议约定获得研究经费；按照协议约定制定并实施研究计划，接受对方的监督、检查；合法有效地使用研究经费，接受主管部门财务审计；按照协议约定向对方提供研究成果和技术资料，共同完成项目验收。                                             | 合作协议包含保密条款 |

（六）研发人员情况

1、研发人员占比

报告期各期末，公司研发人员数量及占公司员工总数的比例情况如下：

| 项目                   | 2025年<br>9月30日 | 2024年<br>12月31日 | 2023年<br>12月31日 | 2022年<br>12月31日 |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 研发人员数量（人）            | 79             | 62              | 32              | 26              |
| 员工总数（人）              | 342            | 277             | 202             | 127             |
| 研发人员占员工总数比例          | 23.10%         | 22.38%          | 15.84%          | 20.47%          |
| 本科及以上学历研发人员数量（人）     | 67             | 48              | 24              | 18              |
| 本科及以上学历研发人员占研发人员总数比例 | 84.81%         | 77.42%          | 75.00%          | 69.23%          |

公司将研发相关部门主要直接从事产品及技术研究等具体技术性研发工作，且当期研发工时占比不低于 50%的相关技术人员认定为研发人员。公司认定的研发人员中不包括从事后勤服务的文秘、前台、餐饮、安保等与研发活动无直接关系的人员。此外，公司总经理黄永忠系公司核心研发力量，鉴于黄永忠同时承担公司全面管理工作，基于谨慎性原则未将其认定为研发人员，且其薪酬未予计入研发费用。

综上，研发人员的认定符合《监管规则适用指引——发行类第 9 号》的相关规定。

## 2、核心技术人员情况

截至本招股说明书出具日，公司认定了 4 名核心技术人员，其专业背景、对公司研发活动贡献及符合核心技术人员认定标准的情况如下：

| 姓名  | 职务             | 核心人员认定标准     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | 理工科本科以上学历    | 学历背景构成、取得的专业资质、获得奖项情况                                                                                                                                                                                                                                       | 重要科研成果、对公司研发的贡献、认定为核心技术人员的依据                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 黄永忠 | 董事、总经理、核心技术人员  | 光学工程博士       | <p>博士研究生学历，2011 年毕业于四川大学光学工程专业；2001 年开始从事工业激光加工技术、装备和器件研发，具有 20 余年激光材料和技术开发经验，是公司 <b>48 项</b> 专利的发明人之一。</p> <p>获国家政府特殊津贴，四川省重点集成电路强雁人才，成都市紧缺人才和高端人才 B 类，四川省先进全固态激光工程技术中心专家委员会副主任。</p> <p>获国家技术发明三等奖 1 次，部级科技进步二等奖 1 次，第六届、第七届中国集成电路创新联盟 IC 创新奖项目团队主要成员。</p> | <p>公司创始人之一，现任公司董事、总经理，主导整体运营，深度参与公司激光工艺设备相关核心技术的研发及管理。</p> <p>带领研发团队完成了激光标刻、冲击强化、激光退火、激光外延结晶和外延生长等多项技术研发；</p> <p>主导公司 IGBT、SiC 激光退火项目整机开发，并负责激光、光学系统设计、调试和工艺验证；主导公司激光诱导结晶设备开发，负责激光光学系统、实时监控系統、整机系统集成的研发、调试和验证工作；参与激光诱导外延结晶设备开发，负责光学系统方案设计、实验验证工作；主导公司激光标刻、切割、钻孔、检测等多个激光加工应用项目的技术开发、实验验证工作。</p> |
| 王晓峰 | 董事、副总经理、核心技术人员 | 微电子学与固体电子学博士 | <p>博士研究生学历，研究员，2004 年毕业于北京大学微电子学与固体电子学专业；20 余年半导体行业从业经验，15 年激光退火行业开发设计经验，是公司 <b>22 项</b> 专利的发明人之一。</p>                                                                                                                                                      | <p>现任公司董事、副总经理，主导公司技术研发方向，制定公司研发计划及产品路线，主持公司研发工作，组建并管理公司研发团队，与客户开展技术交流，了解客户需求并制定行动计划以实现客户需求。</p> <p>公司激光诱导结晶技术、激光诱导外延生长技术、IGBT 杂质激光激活技术、SiC 欧</p>                                                                                                                                              |



| 姓名  | 职务          | 核心人员认定标准   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             | 理工科本科以上学历  | 学历背景构成、取得的专业资质、获得奖项情况                                                                                                                            | 重要科研成果、对公司研发的贡献、认定为核心技术人员的依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |             |            | 四川省集成电路头雁人才，四川天府峨眉计划领军人才，成都市蓉漂计划人才，湖北省 3551 计划人才，第六届、第七届中国集成电路创新联盟 IC 创新奖项目团队主要成员， <b>个人获中国机械工业集团有限公司科学技术奖一等奖。</b>                               | <p>姆接触激光退火技术、超浅结杂质激光退火技术、激光解永久键合技术核心开创人员。</p> <p>激光诱导结晶技术方面：带领团队对激光诱导结晶光学系统技术、激光诱导结晶技术、激光诱导结晶机理研究、测试表征技术等进行攻关，成功实现公司激光诱导结晶技术量产。</p> <p>激光诱导外延生长技术方面：带领团队针对激光诱导外延生长用激光器技术、激光器与光学系统适配技术、激光诱导外延生长技术、激光诱导外延机理研究等进行攻关，成功实现公司激光诱导外延生长技术设备量产。</p> <p>IGBT 杂质激活技术方面：带领团队对 IGBT 用激光器技术、光学系统技术、杂质激光激活技术、IGBT 机台匹配技术等进行攻关，成功实现 IGBT 杂质激活技术设备量产。</p> <p>SiC 欧姆接触激光退火方面：带领团队针对 SiC 欧姆接触激光退火用激光器、光学系统、金属与 SiC 合金机理、SiC 欧姆接触激光退火测试表征技术等进行攻关，成功实现公司 SiC 欧姆接触激光退火技术设备量产。</p> <p>超浅结杂质激光退火技术方面：带领团队针对超浅结杂质激光退火用激光器技术、光学系统技术、超浅结杂质激光激活技术及测试表征技术等进行攻关，成功实现公司超浅结杂质激光退火技术设备量产。</p> |
| 潘岭峰 | 副总经理、核心技术人员 | 光信息科学与技术学士 | 本科学历，2002 年毕业于华中科技大学光信息科学与技术专业；具有近 20 年半导体领域从业经验，近 10 年衍射光学设计加工及应用经验、近 10 年激光退火领域从业经验，是公司 <b>10 项</b> 专利的发明人之一。第六届、第七届中国集成电路创新联盟 IC 创新奖项目团队主要成员。 | 现任公司副总经理、晶圆装备事业部负责人，主导了公司 IGBT 激光退火设备光学系统的研发，包括设计、安装以及调试，显著增强了退火后均匀性；开发了针对碳化硅激光退火设备的光学整形技术；领导了激光诱导结晶设备光学系统的开发工作，增强了光斑边缘的陡直度，确保了多台设备间的适配性和一致性；成功领导并完成了激光诱导外延生长设备光学系统的研发、组装和验证工作，大幅提升了该设备的核心技术水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 何刘  | 副总经理、核心技术人员 | 无线电技术学士    | 本科学历，1991 年毕业于北京理工大学无线电技术专业；具有 30 余年激光器、激光装备的开发设计经验，15 年半导体行业激光装备及解决方案的工作经验，从                                                                    | <p>公司创始人之一，现任公司副总经理、封测微加装备事业部负责人，构建了公司的研发体系和架构。</p> <p>参与公司晶圆激光热处理装备的研发，包括设计、装配以及验证，使公司的激光热处理设备应用于晶圆制造的创新工艺中；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| 姓名 | 职务 | 核心人员认定标准  |                                                                         |                                                                                                                                                                             |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | 理工科本科以上学历 | 学历背景构成、取得的专业资质、获得奖项情况                                                   | 重要科研成果、对公司研发的贡献、认定为核心技术人员的依据                                                                                                                                                |
|    |    |           | 工作以来，一直从事工业控制软件开发、硬件控制开发以及自动化电气的控制设计等专业工作。<br>是公司 <b>44 项</b> 专利的发明人之一。 | 主导了封测领域的激光装备的电气设计、软件设计，工艺验证。<br>带领研发团队，完成激光标记、切割、去溢料、晶圆划片等激光装备，在国内主要半导体封测厂家得到了广泛的应用并处于行业领先地位；开发了激光专用控制硬件及软件，解决半导体行业的激光控制的实时控制和高稳定性需求，应用于单头，多头的激光加工；独立开发完成公司专用硬件控制卡的设计和软件编程。 |

核心技术人员的其他情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”。

### 3、对核心技术人员的约束激励机制

公司与核心技术人员签订《保密协议》，约定相关人员在相关信息已被合法披露前需要对任职期间涉及的商业秘密、技术秘密、其它秘密履行保密义务。公司与关键核心技术人员签订《知识产权和竞业禁止协议》，约定相关人员在离职后 2 年内不得从事与公司存在竞争关系的业务，或加入与公司存在竞争关系的其他用人单位。

为提升核心技术人员创新积极性，并进一步加强核心研发团队的稳定性，公司实施员工股权激励计划并将核心技术人员纳入激励范畴。截至本招股说明书签署日，核心技术人员持有公司股份情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、（六）发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况”。

### 4、报告期内核心技术人员变动情况及对发行人的影响

报告期内，除新增核心技术人员王晓峰、潘岭峰外，公司核心技术人员未发生变动，核心技术团队人员稳定，不存在重大不利变化。

## （七）技术创新的机制、安排及技术储备

### 1、技术创新机制及安排

公司致力于研究和生产世界领先的激光半导体设备，始终坚持自我创新，建立了与现代企业制度相适应的创新管理体制，对技术创新作了合理安排，主要措施如下：

#### （1）高度重视技术研发人才的培养

技术研发是科技创新企业不断进步的推动力，技术研发人才是技术进步与革新的根本，也是企业发展的核心竞争力。公司高度重视技术研发人才的培养，制定了相关培训制度，使现有员工的技能得以完善和充实，并具备多方面的才干；为晋升或纵向发展创造条件，使现有员工具备更高水平的工作能力。培训以日常经营和管理工作为对象，以企业内部的培训教育为主体，以企业外部的培训进修作为补充。公司通过邀请行业内知名技术专家进行技术交流，带来业内先进的技术方向和思想，同时为员工提供技术学习和交流的机会，提升技术研发人员的专业技能。

#### （2）建立技术带头人制度

半导体生产设备作为半导体产业的核心环节，其研发具有较高的进入门槛和经验积累。但国内半导体产业较世界先进水平尚有差距，半导体生产设备领域的人才及技术积累均较为薄弱。为了加快先进激光半导体设备的研发进度，提高研发成功率，公司建立技术带头人制度，引进行业内技术专家作为专业技术带头人，带领公司研发团队攻克技术难点及满足客户个性化技术要求。通过具体的项目实践，快速培养激光半导体设备专业技术人才，建立起一支研发经验和产线调试经验丰富的研发团队。

#### （3）加强知识产权保护，激发自主创新

为鼓励公司技术创新，保护公司自主知识产权，加强公司对知识产权的管理，公司与主要人员签订了《保密协议》《知识产权和竞业禁止协议》，并制定了《专利及政府资助项目奖励管理办法》，鼓励员工在进行新产品设计和研发项目进行专利、软件著作权、政府项目资助等体现自主知识产权的申报工作，对完成申报并获批专利、软件著作权等知识产权的员工给予奖金。

公司执行业绩激励管理制度，业绩考核指标与科技创新、专业技术水平紧密相关，员工激励与个人工作质量、效率情况紧密相关，创新发明能力是业绩考核中重要评分因素。将创新与员工业绩考核、激励等事项挂钩，有效地激励了技术研发人员的自主创新行为。

## 2、技术储备

公司紧紧围绕半导体产业发展对激光设备的要求，以国内半导体制造业当前及未来的需求为牵引，面向客户的生产线在产、在建及未来建设情况，与客户紧密交流、深度合作进行研发。

公司立足于先进精密激光技术，技术攻关重点长期聚焦于以创新性激光工艺满足集成电路先进制程、三维堆叠、异构集成等前沿领域的应用需求。目前，公司基于市场技术动态**和行业技术发展趋势**，并在核心技术人员的前瞻性引领下持续扩充核心技术体系的内涵，已面向逻辑电路领域开发并储备了 28nm 以下工艺节点核心激光设备配件多元化技术、BEOL（Back end of line，主要用于金属层互联）后功能性薄膜物性及电性激光调控工艺技术；面向存储芯片，公司开发并储备了 3D NAND Flash 刻蚀用硬掩膜激光硬化工艺技术，先进制程 DRAM 超薄硅化物激光退火工艺技术；面向 HBM 等新型三维器件开发并储备激光修整、自选择激光剥离减薄、**多层堆叠及超薄晶圆激光切割**等工艺技术。

未来公司将持续加大研发投入，对现有技术进行迭代、优化并进行技术固化，同时积极探索半导体等应用领域的创新性激光工艺应用，推动公司产品矩阵的持续多元化发展和深度优化。

## 八、发行人生产经营涉及的环境污染及处理情况

### （一）环境保护情况

公司主要从事激光工艺半导体设备的研发、生产和销售，不属于《企业环境信息依法披露管理办法》第七条、第八条规定的应披露环境信息的企业，不存在法律法规强制披露的环境信息。

公司产品不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录范围，所属行业不属于重污染行业。

报告期内，公司研发及生产的主要环节包括产品设计、设计方案验证、设备组装、设备清洁、设备检测、设备调试、设备质检，不包含元器件、零部件制造或能源生产。在此过程，公司仅产生少量废气、废水、固体废物和噪声等，具体处理方式说明如下：

（1）废水：主要为员工日常生活产生的生活污水，通过接入园区排污管网排放，由园区集中处理。

（2）废气：主要为小规格零部件焊接产生的少量锡烟，以及使用乙醇清洁设备和零部件产生的少量挥发性气体，通过吸烟管道吸入并经烟雾净化器过滤净化。

（3）固体废物：主要为材料包装物、生活垃圾等，通过送至园区统一堆放点，由园区集中处理。

（4）噪音：主要为装配过程金属碰撞和电气设备运行过程产生的少量噪音，依靠厂房结构可实现自然减震消音。

报告期内，公司环保相关的支出主要为完善空气质量、清洁等用途，投入金额较低。

报告期内，公司及子公司不存在因违反环保方面的法律、法规和规范性文件而受处罚情况。

## （二）安全生产情况

公司研发及生产的主要环节不存在高危险情形。

公司高度重视生产过程中的安全工作，认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规和规范性文件，已确立以总经理为主要负责人的安全管理组织体系，公司主要负责人及安全管理人员已经取得安全培训合格证。公司建立健全了各类安全管理制度，并通过加强对员工的安全教育和管理技术培训、向员工发放合适的劳保用品、对生产设备进行及时维护和维修等方式保障安全生产经营秩序。

报告期内，公司不存在因违反安全生产方面的法律、法规和规范性文件而受处罚情况。

## 九、发行人的境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司未在境外设立独立经营主体，亦不存在境外生产经营或拥有境外资产情况。

## 第六节 财务会计信息与管理层分析

### 一、财务会计信息

本节披露或引用的财务会计信息，非经特别说明，均引自公司经致同会计师事务所审计的财务报告。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司报告期内经致同会计师事务所审计的财务报表及附注的主要内容，如无特殊说明，有关财务数据均指合并报表口径。公司提示投资者关注和阅读本招股说明书附件之财务报告及审计报告全文，以获取全部的财务会计信息。

公司在进行财务状况及盈利能力分析时，选取 A 股聚焦半导体前道工艺设备的细分领域龙头企业中微公司（688012.SH）、芯源微（688037.SH）、拓荆科技（688072.SH）、华海清科（688120.SH）、屹唐股份（688729.SH）作为可比公司。可比公司的相关信息均来自其公开披露资料，公司不对其准确性、真实性作出判断。

#### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：万元

| 项目            | 2025. 9. 30      | 2024.12.31       | 2023.12.31       | 2022.12.31       |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金          | 13,829.78        | 13,624.19        | 19,800.09        | 5,395.58         |
| 交易性金融资产       | -                | -                | 3,008.49         | -                |
| 应收票据          | 266.75           | 781.24           | 323.15           | 255.63           |
| 应收账款          | 7,815.95         | 11,173.87        | 4,726.18         | 3,776.53         |
| 应收款项融资        | 2.00             | 3.92             | 675.72           | 78.73            |
| 预付款项          | 1,211.28         | 1,685.24         | 904.20           | 695.98           |
| 其他应收款         | 329.95           | 194.98           | 144.07           | 1,267.91         |
| 存货            | 27,895.87        | 18,472.20        | 13,334.44        | 9,043.63         |
| 合同资产          | 526.48           | 298.79           | 719.49           | 278.08           |
| 其他流动资产        | 20,666.26        | 18,206.09        | 11,313.76        | 883.25           |
| <b>流动资产合计</b> | <b>72,544.30</b> | <b>64,440.53</b> | <b>54,949.60</b> | <b>21,675.33</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产          | 34,851.92        | 2,958.95         | 3,210.95         | 897.34           |



| 项目                   | 2025. 9. 30         | 2024.12.31        | 2023.12.31       | 2022.12.31       |
|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                 | -                   | 28,371.75         | 2,856.24         | -                |
| 使用权资产                | 402. 86             | 435.98            | 494.85           | 707.66           |
| 无形资产                 | 925. 31             | 959.22            | 918.45           | 14.20            |
| 长期待摊费用               | 167. 64             | 303.04            | 469.53           | 572.86           |
| 递延所得税资产              | 2, 260. 47          | 1,867.72          | 805.13           | 628.68           |
| 其他非流动资产              | 3, 101. 64          | 3,303.58          | 2,904.37         | 112.07           |
| <b>非流动资产合计</b>       | <b>41, 709. 84</b>  | <b>38,200.22</b>  | <b>11,659.52</b> | <b>2,932.81</b>  |
| <b>资产总计</b>          | <b>114, 254. 14</b> | <b>102,640.75</b> | <b>66,609.12</b> | <b>24,608.15</b> |
| <b>流动负债：</b>         |                     |                   |                  |                  |
| 短期借款                 | 1, 000. 76          | 1,102.37          | 3,103.33         | 5,506.81         |
| 应付账款                 | 8, 818. 84          | 8,906.98          | 1,460.14         | 2,331.92         |
| 预收款项                 | -                   | -                 | 7.08             | -                |
| 合同负债                 | 11, 363. 32         | 5,858.66          | 4,278.19         | 6,717.25         |
| 应付职工薪酬               | 1, 766. 36          | 2,053.65          | 1,162.19         | 639.78           |
| 应交税费                 | 202. 02             | 545.12            | 23.68            | 49.53            |
| 其他应付款                | 296. 33             | 207.50            | 80.23            | 1,742.76         |
| 一年内到期的非流动负债          | 6, 437. 92          | 4,305.16          | 1,221.18         | 244.80           |
| 其他流动负债               | 2, 319. 60          | 2,380.92          | 1,261.93         | 704.74           |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>32, 205. 16</b>  | <b>25,360.35</b>  | <b>12,597.96</b> | <b>17,937.60</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                     |                   |                  |                  |
| 长期借款                 | 20, 461. 16         | 16,969.32         | 4,000.00         | -                |
| 租赁负债                 | 163. 55             | 146.59            | 274.47           | 471.78           |
| 递延收益                 | 6, 968. 00          | 6,968.00          | 2,387.00         | -                |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>27, 592. 71</b>  | <b>24,083.91</b>  | <b>6,661.47</b>  | <b>471.78</b>    |
| <b>负债合计</b>          | <b>59, 797. 87</b>  | <b>49,444.26</b>  | <b>19,259.43</b> | <b>18,409.37</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |                     |                   |                  |                  |
| 股本                   | 4, 818. 00          | 4,818.00          | 4,818.00         | 2,887.25         |
| 资本公积                 | 43, 468. 94         | 43, 207. 83       | 42, 859. 68      | 5, 919. 39       |
| 盈余公积                 | 461. 16             | 461.16            | -                | -                |
| 未分配利润                | 5, 816. 76          | 4, 782. 52        | -320. 60         | -2, 624. 26      |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>54, 564. 86</b>  | <b>53,269.51</b>  | <b>47,357.08</b> | <b>6,182.38</b>  |
| 少数股东权益               | -108. 58            | -73.02            | -7.39            | 16.40            |

| 项目         | 2025. 9. 30  | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 股东权益合计     | 54, 456. 28  | 53,196.49  | 47,349.69  | 6,198.77   |
| 负债及所有者权益总计 | 114, 254. 14 | 102,640.75 | 66,609.12  | 24,608.15  |

## 2、合并利润表

单位：万元

| 项目                    | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度   |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入               | 19, 046. 49  | 28,102.42 | 19,075.73 | 7,414.56  |
| 减：营业成本                | 9, 192. 68   | 12,697.65 | 10,577.27 | 4,263.40  |
| 税金及附加                 | 206. 28      | 43.07     | 29.62     | 127.23    |
| 销售费用                  | 994. 92      | 1,214.41  | 1,054.55  | 820.16    |
| 管理费用                  | 3, 018. 49   | 2,808.59  | 2,491.54  | 1,470.92  |
| 研发费用                  | 3, 784. 97   | 5,873.72  | 2,395.18  | 1,528.13  |
| 财务费用                  | 336. 73      | 174.99    | 125.77    | 287.38    |
| 其中：利息费用               | 414. 41      | 281.36    | 177.19    | 95.30     |
| 利息收入                  | 102. 99      | 134.13    | 172.79    | 5.75      |
| 加：其他收益                | 261. 47      | 600.83    | 349.03    | 43.38     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 264. 75      | 307.41    | 71.42     | 5.52      |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   | -            | -         | 8.49      | -         |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）     | 72. 63       | -335.95   | -31.86    | -50.81    |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     | -1, 493. 25  | -336.76   | -289.73   | -100.85   |
| 资产处置收益（亏损以“－”号填列）     | 37. 38       | 0.45      | -         | -2.20     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 655. 38      | 5,525.97  | 2,509.15  | -1,187.62 |
| 加：营业外收入               | 1. 09        | 0.06      | 2.48      | 0.00      |
| 减：营业外支出               | 60. 50       | 37.56     | 11.01     | 0.18      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 595. 98      | 5,488.47  | 2,500.61  | -1,187.79 |
| 减：所得税费用               | -392. 75     | -2.69     | 220.74    | -249.57   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 988. 73      | 5,491.16  | 2,279.87  | -938.22   |
| （一）按经营持续性分类           |              |           |           |           |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 988. 73      | 5,491.16  | 2,279.87  | -938.22   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -            | -         | -         | -         |

| 项目                         | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度  | 2023 年度  | 2022 年度 |
|----------------------------|--------------|----------|----------|---------|
| （二）按所有权归属分类                |              |          |          |         |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,034.24     | 5,564.28 | 2,303.67 | -879.62 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | -45.52       | -73.12   | -23.79   | -58.60  |
| 五、其他综合收益的税后净额              | -            | -        | -        | -       |
| 六、综合收益总额                   | 988.73       | 5,491.16 | 2,279.87 | -938.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 1,034.24     | 5,564.28 | 2,303.67 | -879.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | -45.52       | -73.12   | -23.79   | -58.60  |
| 七、每股收益                     |              |          |          |         |
| （一）基本每股收益（元/股）             | 0.21         | 1.15     | 0.63     | -0.33   |
| （二）稀释每股收益（元/股）             | 0.21         | 1.15     | 0.63     | -0.33   |

3、合并现金流量表

单位：万元

| 项目              | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度   |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |              |           |           |           |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 30,156.71    | 26,231.51 | 15,466.43 | 10,163.96 |
| 收到的税费返还         | 413.40       | 69.04     | 61.07     | 140.88    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 355.73       | 4,009.97  | 2,131.28  | 216.66    |
| 经营活动现金流入小计      | 30,925.84    | 30,310.53 | 17,658.78 | 10,521.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 16,813.93    | 16,659.41 | 14,880.76 | 8,652.05  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,579.95     | 5,228.58  | 3,500.27  | 1,991.77  |
| 支付的各项税费         | 1,039.24     | 538.56    | 548.06    | 1,353.52  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 2,866.06     | 4,681.38  | 2,002.06  | 1,351.43  |
| 经营活动现金流出小计      | 26,299.18    | 27,107.94 | 20,931.15 | 13,348.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 4,626.66     | 3,202.59  | -3,272.37 | -2,827.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |              |           |           |           |
| 收回投资收到的现金       | 17,000.00    | 30,000.00 | 9,000.00  | 1,650.00  |

| 项目                        | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度    | 2023 年度    | 2022 年度   |
|---------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 取得投资收益收到的现金               | 292.60       | 136.10     | 69.59      | 7.79      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.75         | 0.24       | 0.10       | 0.30      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00         | 21.76      | -          | -         |
| 投资活动现金流入小计                | 17,293.36    | 30,158.10  | 9,069.69   | 1,658.09  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,693.52     | 18,413.62  | 9,882.02   | 609.77    |
| 投资支付的现金                   | 19,000.00    | 36,000.00  | 22,000.00  | 1,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 26,693.52    | 54,413.62  | 31,882.02  | 1,609.77  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,400.16    | -24,255.52 | -22,812.34 | 48.32     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |              |            |            |           |
| 吸收投资收到的现金                 | 9.95         | 7.50       | 38,188.47  | 4,462.50  |
| 取得借款收到的现金                 | 5,690.39     | 18,169.32  | 8,100.00   | 5,500.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 93.47        | 173.00     | 1,125.00   | 1,400.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,793.81     | 18,349.82  | 47,413.47  | 11,362.50 |
| 偿还债务支付的现金                 | 100.00       | 4,200.00   | 5,500.00   | 800.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 569.93       | 460.55     | 175.15     | 89.64     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 149.16       | 462.34     | 1,973.27   | 3,091.10  |
| 筹资活动现金流出小计                | 819.09       | 5,122.89   | 7,648.41   | 3,980.74  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,974.72     | 13,226.93  | 39,765.05  | 7,381.76  |
| 四、汇率变动对现金的影响              | -12.16       | 2.47       | 5.19       | -2.33     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 189.06       | -7,823.54  | 13,685.54  | 4,600.50  |
| 加：期初现金及现金等价物的余额           | 11,257.59    | 19,081.12  | 5,395.58   | 795.08    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 11,446.64    | 11,257.59  | 19,081.12  | 5,395.58  |

（二） 审计意见

致同会计师对本次申报的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（致同审字（2026）第 510A001232 号）。致同会计师认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司在 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 9 月 30

日的合并及母公司财务状况以及 2022 年、2023 年度、2024 年度和 **2025 年 1-9 月**的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （三）关键审计事项

关键审计事项是致同会计师根据职业判断，认为对 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 **2025 年 1-9 月**财务报表最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，致同会计师不对这些事项单独发表意见。

#### 1、收入确认

##### （1）事项描述

公司主要从事激光热处理设备和专用激光加工设备的生产、销售业务，2022 年度、2023 年度、2024 年度和 **2025 年 1-9 月**营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元、28,102.42 万元和 **19,046.49 万元**。

由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且营业收入确认期间存在潜在错报的固有风险较高，因此致同会计师将收入确认确定为关键审计事项。

##### （2）审计应对

致同会计师执行的审计程序包括：

1) 了解与营业收入确认相关的内部控制，评价这些控制的设计有效性，并测试关键内部控制的运行有效性；

2) 以抽样方式检查销售合同或订单，了解了主要合同条款或条件，评价营业收入确认政策是否符合企业会计准则规定；

3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因，分析波动的合理性；

4) 以抽样方式检查与营业收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户验收单等，评价营业收入的确认是否符合公司的会计政策；

5) 抽样选取客户就各期销售额及应收账款余额进行函证，对未回函的客户

执行替代测试：

6) 选取样本走访主要客户及主要经销商的部分终端客户，以核实营业收入的真实性和业务实质；

7) 结合市场公开信息所获取的主要客户工商资料，了解其主要股东、董事、监事和高级管理人员情况，进一步核实该等客户与公司是否存在关联关系；

8) 针对报告期内每一期资产负债表日前后确认的营业收入，选取样本，核对至发货单、运输单、客户验收单等文件，评价营业收入是否确认在恰当期间；

9) 选取样本检查报告期内每一期资产负债表日后的销售退回记录，确定会计处理是否正确；

10) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中恰当列报和披露。

## 2、存货

### （1）事项描述

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 9,210.29 万元、13,722.56 万元、19,078.74 万元和 **29,528.66 万元**，存货跌价准备分别为 166.66 万元、388.11 万元、606.53 万元和 **1,632.79 万元**，账面价值分别为 9,043.63 万元、13,334.44 万元、18,472.20 万元和 **27,895.87 万元**。

由于公司存货金额重大，各期末存货余额占总资产的比例较高，部分存放于客户处，且存货跌价准备的计提涉及公司管理层的重大判断，因此致同会计师将存货的存在性与跌价准备的计提识别为关键审计事项。

### （2）审计应对

致同会计师执行的审计程序包括：

1) 了解与存货相关的内部控制，评价这些控制的设计有效性，并测试关键内部控制的运行有效性；

2) 询问公司相关人员，了解有关存货存放地点的情况，比较不同时期的存货存放地点清单，以确定是否存在因仓库变动而未将存货纳入盘点范围的情况；

3) 实施监盘程序，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序



并观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货的数量和状态等并执行抽盘程序；

4) 选取样本，向客户就发出商品进行函证，对未回函客户的发出商品执行替代测试；

5) 以抽样的方式对各期资产负债表日发出商品的发货记录进行测试，并检查资产负债表日后的客户验收单，结合实施的监盘程序，验证发出商品在各期资产负债表日的存在性；

6) 结合存货监盘，识别是否存在库龄较长、型号陈旧或者毁损情形，评价管理层存货跌价准备计提的充分性；

7) 选取样本，评价管理层对存货估计售价、存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费等所作估计的合理性，分析存货跌价准备计提的充分性和适当性；

8) 按照公司存货跌价准备计提政策对存货跌价准备计算表进行重新计算，测试管理层对存货可变现净值计算的准确性；

9) 检查与存货相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### **（四）与财务会计信息相关的重要性水平**

公司根据自身所处行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在性质方面，公司会评估业务是否属于经常性业务，是否会对公司报告期及未来的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响等；在金额方面，公司将在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项的标准确定为“超过公司各年度利润总额的 5%”。

#### **（五）财务报表编制基础、合并范围及变化情况**

##### **1、财务报表的编制基础**

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露规

定编制财务报表。

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

## 2、合并财务报表范围及变化情况

报告期内，公司合并财务报表范围内的合并主体具体情况如下：

| 子公司全称        | 持股比例 |    | 取得方式               |
|--------------|------|----|--------------------|
|              | 直接   | 间接 |                    |
| 江苏莱普激光技术有限公司 | 70%  | -  | 2022 年 7 月 18 日新设立 |

## 二、重要会计政策及会计估计

### （一）收入确认和计量

#### 1、收入确认和计量的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列

迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

（5）客户已接受该商品或服务；

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2、收入确认和计量的具体方法

### （1）商品销售合同

本公司与客户之间的商品销售合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

#### 1）设备销售合同

本公司主要销售激光热处理设备和专用激光加工设备。本公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的专用设备交付给买方并经其验收合格，获得客户确认的验收证明时确认收入。

本公司基于为所销售设备提供的产品质量保证相关售后服务计提相应的预计负债。

#### 2）备件销售合同

本公司按照销售合同约定将产品交付给客户并经客户签收或验收时确认收入。

### （2）服务合同

本公司与客户之间的服务合同包含对客户商品进行维修、改造、升级、维保等履约义务。维修、改造、升级等服务合同属于在某一时点履行的履约义务，本

公司在合同约定的服务完成交付并经客户验收时点确认收入。维保服务合同属于在某一时段履行的履约义务，在合同约定服务期限内确认收入。

## （二）成本核算

本公司生产部门在市场部门接收到销售订单或明确的客户采购需求后在ERP系统中生成生产订单，并根据生产订单对应的设备BOM表发起领料申请或材料请购申请。领料申请或材料请购申请经审批后，由库管部门直接或在所请购原材料采购入库后发料至特定生产订单。本公司生产成本包括直接材料、直接人工、制造费用及其他费用。

### 1、直接材料

直接材料是生产及安装调试过程中实际耗用的直接用于产品生产的原材料。本公司根据特定生产订单对应的领料记录，按照月末一次加权平均计价法，归集该生产订单的已领用材料成本。

### 2、直接人工

直接人工主要为公司及设备生产、安装调试及提供服务过程中所发生的人工成本。

### 3、制造费用及其他费用

制造费用是指在生产过程中发生的无法直接归集至特定生产订单的成本支出，如生产管理或辅助人员薪酬、水电费、价值较低的包装耗材及折旧摊销费等。本公司按照工时比例将制造费用分摊至各生产订单。其他费用包括运费、差旅费等。

本公司在产品安装调试完成后将各类生产成本归集至存货，在产品完成销售时将存货结转为营业成本。

## （三）金融工具

### 1、金融工具的确认和终止确认

金融工具，是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- （3）金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## 2、金融工具的分类和计量

### （1）金融资产的分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 1）以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。



管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

## （2）金融负债的分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 2）以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 3、金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 4、金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资、《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产、租赁应收款、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）等项目进行减值会计处理并确认损失准备。

#### （1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

#### 1) 应收票据、应收账款、合同资产

对于应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目   | 组合类别                        | 预期信用损失确定依据                                                           |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 应收票据 | (1) 银行承兑汇票<br>(2) 商业承兑汇票    | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。     |
| 应收账款 | (1) 应收客户款<br>(2) 应收合并范围内关联方 | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应 |

| 项目   | 组合类别      | 预期信用损失确定依据                                                       |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|      |           | 应收账款的账龄自确认之日起计算。                                                 |
| 合同资产 | (1) 质量保证金 | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

## 2) 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目    | 组合类别                                                                    | 预期信用损失确定依据                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款 | (1) 应收押金和保证金<br>(2) 员工备用金<br>(3) 应收退税款<br>(4) 关联方往来款<br>(5) 合并范围内关联方往来款 | 本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。 |

## (四) 存货

### 1、存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资和合同履约成本。

### 2、发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、委托加工物资发出时采用加权平均法计价。在产品、库存商品、发出商品和合同履约成本发出时采用个别认定法计价。

### 3、存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### （五）固定资产

#### 1、固定资产初始确认与计量

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

#### 2、固定资产折旧

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。本公司各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率情况如下：

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|---------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 10-20   | 3.00   | 4.85-9.70  |
| 机器设备及器具 | 年限平均法 | 2-10    | 3.00   | 9.70-48.50 |
| 运输设备    | 年限平均法 | 2-10    | 3.00   | 9.70-48.50 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5-10    | 3.00   | 9.70-19.40 |

#### 3、固定资产减值

本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当固定资产可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当

期损益，同时计提相应的资产减值准备。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### 4、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### （六）在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。本公司在建工程转为固定资产的具体标准如下：

| 类别       | 结转为固定资产的标准和时点 |
|----------|---------------|
| 房屋及建筑物   | 开始使用或通过竣工验收孰早 |
| 需安装的机器设备 | 完成安装调试并通过验收   |

#### （七）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销的具体方法如下：

| 类别    | 使用寿命      | 使用寿命的确定依据                     | 摊销方法 |
|-------|-----------|-------------------------------|------|
| 土地使用权 | 土地使用权的有效期 | 不动产权证书载明的使用期限                 | 直线法  |
| 软件    | 一般不超过 5 年 | 考虑合同的约定，及相关法律法规的规定，参考历史经验进行估计 | 直线法  |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法



进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## （八）预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- 1、该义务是本公司承担的现时义务；
- 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- 3、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## （九）股份支付

### 1、股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他

方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## （十）租赁

### 1、租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

### 2、本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

#### （1）使用权资产

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前

提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。本公司将满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 3、本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬

的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### （1）融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

### （2）经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### （3）租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：1）该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：1）假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；2）假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则

第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## （十一）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## （十二）重大会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正

### 1、会计政策的变更

#### （1）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕



31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，本公司选择提前执行。执行上述会计政策对公司 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表无影响。

## （2）执行财会〔2022〕13 号

2022 年 5 月，财政部发布了财会〔2022〕13 号文件，对于适用财会〔2022〕13 号文件规定情形的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用财会〔2020〕10 号文件规范的简化方法进行会计处理。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同继续采用简化方法。在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。上述简化方法对公司 2022 年合并利润的影响金额为 53.55 万元。

## 2、会计估计的变更

本公司本报告期未发生会计估计变更。

## 3、前期会计差错更正

本公司本报告期无前期会计差错更正。

## （十三）主要会计政策或会计估计与同行业可比公司差异情况

公司收入确认与计量的具体方法与同行业可比公司相比不存在重大差异，具体情况如下：

| 可比公司 | 收入确认具体方法                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中微公司 | 1、销售商品：专用设备产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户调试确认验收后，确认收入；备品备件产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。<br>2、提供劳务：提供维修服务按照合同约定的服务期进度确认收入。                                                                                                                       |
| 芯源微  | 1、销售商品：将产品移交给客户并完成安装调试，客户验收无误，取得验收报告后确认收入。<br>2、提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完成工作的测量确定。                                                                                                                     |
| 拓荆科技 | 1、针对专用设备销售，根据合同约定将专用设备产品运至约定交货地点，经安装调试完毕、客户确认验收并且取得验收单后，确认收入。<br>2、针对备品备件销售，按照协议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。                                                                                                                                 |
| 华海清科 | 1、设备销售：当设备可用于客户生产或达到客户预定使用状态，取得客户验收单，相关的经济利益很可能流入时确认收入。<br>2、耗材销售：送达至客户，取得客户签收单，相关的经济利益很可能流入时确认收入。<br>3、技术服务：服务完成，取得客户确认函，相关的经济利益很可能流入时确认收入。                                                                                                |
| 屹唐股份 | 1、销售商品<br>公司生产产品并销售予各地客户。公司将专用设备产品按照协议合同规定运至约定交货地点后：（1）当根据合同约定需要由公司进行安装调试的，由客户调试确认验收后，确认收入。专用设备产品经客户调试验收确认后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。（2）当根据合同约定不需要由公司进行安装调试的，由客户确认接收后，确认收入。专用设备产品交付后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。公司备品备件产品按照协 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>议合同规定运至约定交货地点，由客户确认接收后，确认收入。备品备件产品交付后，客户具有自行使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成本。公司已收或应收客户对价而应向客户转让产品的义务列示为合同负债。</p> <p>2、提供服务</p> <p>公司对外提供劳务，根据合同约定在服务期限内确认收入。公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成本。公司已收或应收客户对价而应向客户提供服务的义务列示为合同负债。</p> <p>3、特许权使用费</p> <p>主要系被许可方使用公司授权的知识产权生产及销售产品，按规定费率向公司支付特许权使用费产生的收入。公司根据合同或协议规定的收费方法计算确定的金额，定期与被许可方对账后确认收入。</p> |
| 本公司 | <p>1、商品销售</p> <p>（1）设备销售：本公司主要销售激光热处理设备和专用激光加工设备。本公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的专用设备交付给买方并经其验收合格，获得客户确认的验收证明时确认收入。本公司基于为所销售设备提供的产品质量保证相关售后服务计提相应的预计负债。</p> <p>（2）备件销售：本公司按照销售合同约定将产品交付给客户并经客户签收或验收时确认收入。</p> <p>2、服务合同</p> <p>本公司与客户之间的服务合同包含对客户商品进行维修、改造、升级、维保等履约义务。维修、改造、升级等服务合同属于在某一时点履行的履约义务，本公司在合同约定的服务完成交付并经客户验收时点确认收入。维保服务合同属于在某一时段履行的履约义务，在合同约定服务期限内确认收入。</p>                            |

三、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

根据证监会[2008]43 号公告《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》及相关规定，公司编制了报告期《非经常性损益明细表》，并经致同会计师审核。根据致同会计师出具的《非经常性损益明细表审核报告》（致同专字（2026）第 510A001450 号），公司报告期内非经常性损益明细如下：

单位：万元

| 非经常性损益明细                                                    | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 非流动性资产处置损益                                                  | 37.38        | 0.45    | -       | -2.20   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）               | 133.60       | 591.58  | 90.29   | 42.99   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允 | 264.75       | 307.41  | 79.91   | 5.52    |

| 非经常性损益明细                                               | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度  | 2023 年度  | 2022 年度 |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|
| 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |              |          |          |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  | -            | -        | -        | 1.03    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                    | 2.60         | -        | -        | -       |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                               | -            | -        | -9.46    | -       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     | -59.41       | -37.51   | -8.53    | -0.18   |
| 非经常性损益合计                                               | 378.92       | 861.93   | 152.20   | 47.16   |
| 减：所得税影响金额                                              | 56.84        | 132.14   | 25.75    | 7.07    |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益                                        | 322.08       | 729.79   | 126.45   | 40.09   |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益                                    | 315.41       | 729.72   | 126.41   | 40.38   |
| 归属于少数股东的非经常性损益                                         | 6.67         | 0.08     | 0.04     | -0.30   |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润                                  | 718.83       | 4,834.56 | 2,177.26 | -920.00 |

报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助以及理财产品的投资收益，对公司盈利能力稳定性和持续性不构成重大影响。

四、主要税项

（一）主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率（%） |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6、13  |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                                 | 7     |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                                 | 3     |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额                                                 | 2     |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                  | 15、20 |

公司及子公司分别适用的所得税率情况如下：

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
| 莱普科技   | 15       |
| 江苏莱普   | 20、15    |

## （二）税收优惠及批文

### 1、企业所得税

#### （1）高新技术企业税收优惠

公司于 2020 年 12 月 3 日取得了《高新技术企业证书》（证书编号：GR202051003526），认定有效期三年。2023 年 12 月 12 日，公司高新技术企业续审合格，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202351004265），认定有效期三年。根据高新技术企业有关税收优惠政策，公司报告期内适用的企业所得税税率为 15%。公司子公司江苏莱普于 2024 年 11 月 6 日取得了《高新技术企业证书》（证书编号：GR202432001708），认定有效期三年。江苏莱普 2024 年度、2025 年 1-9 月适用企业所得税税率为 15%。

#### （2）小型微利企业税收优惠

报告期内，江苏莱普符合小型微利企业的标准。2022 年度、2023 年度，根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）和《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），江苏莱普减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

#### （3）研发费用企业所得税加计扣除

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 13 号和财政部、税务总局公告 2023 年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。公司在 2022 年度、2023 年度，子公司江苏莱普报告期内计算应纳税所得额时，符合上述规定的研发费用按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除。

根据财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部公告 2023 年第 44 号），集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按



规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。2024 年度、2025 年 1-9 月，公司作为集成电路装备企业，按照前述税收优惠政策将符合规定的研发费用按照实际发生额的 120%计算研发费用企业所得税加计扣除金额。

2、增值税及附加

（1）增值税税收优惠

根据《财政部、税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）规定，公司属于集成电路装备企业，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，江苏莱普 2024 年度、2025 年 1-9 月随同机器设备一并销售的嵌入式软件产品符合财税〔2011〕100 号软件产品的界定，按现行税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

（2）附加税税收优惠

报告期内，江苏莱普符合小型微利企业标准，根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）规定，按 50%减征城市维护建设税、教育附加费和地方教育附加费。

（三）税收政策的变化情况及税收优惠政策对发行人经营成果的影响

报告期内，公司适用的税收政策不存在重大变化，相关税收优惠政策对公司经营成果不构成重大影响。

五、主要财务指标

（一）主要财务指标

| 项目           | 2025 年 1-9 月<br>/2025. 9. 30 | 2024 年度<br>/2024.12.31 | 2023 年度<br>/2023.12.31 | 2022 年度<br>/2022.12.31 |
|--------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率（倍）      | 2.25                         | 2.54                   | 4.36                   | 1.21                   |
| 速动比率（倍）      | 1.39                         | 1.81                   | 3.30                   | 0.70                   |
| 资产负债率（母公司口径） | 51.50%                       | 47.51%                 | 28.51%                 | 74.04%                 |



| 项目                        | 2025 年 1-9 月<br>/2025. 9. 30 | 2024 年度<br>/2024.12.31 | 2023 年度<br>/2023.12.31 | 2022 年度<br>/2022.12.31 |
|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产负债率（合并口径）               | 52.34%                       | 48.17%                 | 28.91%                 | 74.81%                 |
| 利息保障倍数（倍）                 | 6.45                         | 16.81                  | 21.10                  | -5.51                  |
| 应收账款周转率（次/年）              | 1.89                         | 3.33                   | 4.18                   | 2.48                   |
| 存货周转率（次/年）                | 0.38                         | 0.77                   | 0.92                   | 0.60                   |
| 息税折旧摊销前利润（万元）             | 3,695.07                     | 7,960.23               | 3,737.92               | -524.71                |
| 归属于发行人股东的净利润（万元）          | 1,034.24                     | 5,564.28               | 2,303.67               | -879.62                |
| 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 718.83                       | 4,834.56               | 2,177.26               | -920.00                |
| 研发投入占营业收入的比例              | 19.87%                       | 20.90%                 | 12.56%                 | 20.61%                 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元）          | 0.96                         | 0.66                   | -0.68                  | -0.98                  |
| 每股净现金流量（元）                | 0.04                         | -1.62                  | 2.84                   | 1.59                   |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元）         | 11.33                        | 11.06                  | 9.83                   | 2.14                   |

注：上述财务指标计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债；

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

3、资产负债率=总负债/总资产；

4、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出；

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；

6、存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；

7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计入损益的折旧与摊销；

8、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入；

9、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

11、归属于发行人股东的每股净资产=归属于公司普通股股东的期末净资产/期末普通股份总数。

（二）净资产收益率和每股收益

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求，报告期内公司净资产收益率和每股收益如下：

| 时间           | 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） |      |
|--------------|-------------------------|---------------|-----------|------|
|              |                         |               | 基本        | 稀释   |
| 2025 年 1-9 月 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.82          | 0.21      | 0.21 |
|              | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.24          | 0.14      | 0.14 |

| 时间      | 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>（%） | 每股收益（元/股） |       |
|---------|-------------------------|-------------------|-----------|-------|
|         |                         |                   | 基本        | 稀释    |
| 2024 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 11.06             | 1.15      | 1.15  |
|         | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.61              | 1.00      | 1.00  |
| 2023 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.98              | 0.63      | 0.63  |
|         | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.44              | 0.59      | 0.59  |
| 2022 年度 | 归属于公司普通股股东的净利润          | -43.35            | -0.33     | -0.33 |
|         | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -45.34            | -0.35     | -0.35 |

注：上述财务指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率=  $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益=  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益=  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

六、经营成果分析

（一）经营成果概览及逻辑分析

1、经营情况概览

报告期内，公司主要经营成果情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-9 月 |    | 2024 年度 |    | 2023 年度 |    | 2022 年度 |
|----|--------------|----|---------|----|---------|----|---------|
|    | 金额           | 增幅 | 金额      | 增幅 | 金额      | 增幅 | 金额      |

| 项目    | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度   |
|-------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|       | 金额           | 增幅      | 金额        | 增幅      | 金额        | 增幅      | 金额        |
| 营业收入  | 19,046.49    | 107.71% | 28,102.42 | 47.32%  | 19,075.73 | 157.27% | 7,414.56  |
| 营业毛利  | 9,853.81     | 108.63% | 15,404.76 | 81.27%  | 8,498.46  | 169.69% | 3,151.16  |
| 营业利润  | 655.38       | 149.89% | 5,525.97  | 120.23% | 2,509.15  | 311.28% | -1,187.62 |
| 净利润   | 988.73       | 157.42% | 5,491.16  | 140.85% | 2,279.87  | 343.00% | -938.22   |
| 综合毛利率 | 51.74%       | 0.23%   | 54.82%    | 10.27%  | 44.55%    | 2.05%   | 42.50%    |

注：2025 年 1-9 月增长率基于 2024 年 1-9 月数据（未经审计）计算得到。

2022-2024 年，公司营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元和 28,102.42 万元，年复合增长率为 94.68%，实现了快速增长；净利润分别为-938.22 万元、2,279.87 万元和 5,491.16 万元，呈现快速增长趋势。2025 年 1-9 月，公司营业收入及净利润较 2024 年同期亦实现了较大幅度增长。

2、经营成果逻辑分析

报告期内，公司取得经营成果的主要逻辑如下：

（1）激光工艺设备行业需求增长，为公司业绩增长提供了良好的外部环境

公司立足于先进精密激光技术，聚焦于设备板块，重点布局半导体领域激光热处理设备与专用激光加工设备市场。

QY Research 等机构数据显示，中国大陆激光热处理设备市场规模将由 2019 年的 7.96 亿元增长至 2030 年的 32.96 亿元，年复合增长率达 13.79%；中国科学院武汉文献情报中心等机构数据显示，中国大陆专用激光加工设备规模将由 2019 年的 48.96 亿元增长至 2024 年的 65.38 亿元，年复合增长率达 5.96%。激光工艺设备行业需求增长，为公司持续发展和业绩增长提供了较为有利的产业环境。

（2）公司是境内领先的半导体领域激光热处理设备和专用激光加工设备供应商，可满足下游行业龙头企业的采购需求，在境内知名半导体厂商中建立了良好的口碑

公司目前已成为境内领先的半导体用激光热处理设备和专用激光加工设备供应商。近年来，受外部环境、产业政策及半导体行业发展周期的影响，公司下游行业应用高速发展、市场需求持续旺盛。

报告期内，公司的相关设备已广泛部署于客户 A、客户 B、客户 C、华润微、

士兰微、三安半导体、中车时代、客户 D、华天科技、达迩科技等主流半导体厂商的先进制程和先进封装产线。公司凭借产品优异创新性能和长期技术研发，打破国际厂商在半导体专用激光设备领域对国内市场的长期垄断局面，与国际厂商直接竞争，部分原创性产品助力我国半导体存储芯片产业在全球竞争中形成局部领先地位。

（3）公司基于先进精密激光技术不断推出新产品，实现营业收入持续增长

2022 年公司首台 LIC 设备实现验收，同时首台 LIEG 设备顺利进入客户端验证；2023 年，公司首台 USJLA 设备发往下游客户验证；2024 年公司首台 USJLA、LIEG 设备实现验收。随着激光热处理设备产品线的丰富、新客户的拓展、设备销售数量的增加，公司报告期内实现了营业收入的持续增长。

（二）营业收入分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|--------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|        | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 主营业务收入 | 18,722.20    | 98.30%  | 27,793.12 | 98.90%  | 18,644.42 | 97.74%  | 7,216.31 | 97.33%  |
| 其他业务收入 | 324.29       | 1.70%   | 309.30    | 1.10%   | 431.31    | 2.26%   | 198.25   | 2.67%   |
| 合计     | 19,046.49    | 100.00% | 28,102.42 | 100.00% | 19,075.73 | 100.00% | 7,414.56 | 100.00% |

公司主营业务收入主要包括激光热处理设备、专用激光加工设备等专用设备销售及衍生的升级改造及其他技术服务收入。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 97.33%、97.74%、98.90%和 **98.30%**，主营业务突出。

公司其他业务收入主要包括配件销售及零星加工服务收入，占营业收入的比例相对较低。

2、主营业务收入按业务类型分析

报告期内，公司的主营业务收入按业务类型列示如下：

单位：万元

| 项目          | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|-------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|             | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 激光热处理设备     | 16,000.03    | 85.46%  | 24,429.21 | 87.90%  | 13,816.34 | 74.10%  | 3,467.26 | 48.05%  |
| 专用激光加工设备    | 2,589.78     | 13.83%  | 3,085.07  | 11.10%  | 4,059.67  | 21.77%  | 3,602.52 | 49.92%  |
| 升级改造及其他技术服务 | 132.39       | 0.71%   | 278.83    | 1.00%   | 768.41    | 4.12%   | 146.53   | 2.03%   |
| 合计          | 18,722.20    | 100.00% | 27,793.12 | 100.00% | 18,644.42 | 100.00% | 7,216.31 | 100.00% |

受益于下游行业景气度提升、客户资本性支出上升以及公司持续研发推出新产品、市场开拓情况良好等因素，公司报告期内主营业务收入实现快速上升。

报告期内，公司应用于存储芯片、逻辑芯片、功率器件等半导体制造领域的激光热处理设备产品线不断丰富、升级，销售数量持续增长，**激光热处理设备销售收入持续增长，其占公司主营业务收入的比例整体亦有所提高。**

3、主要产品的销量和平均单价分析

（1）激光热处理设备

报告期内，公司激光热处理设备的销售数量及单价情况按产品类别列示如下：

单位：万元，台，万元/台

| 项目   |      | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度  |
|------|------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 销售数量 | 数量   | 15           | 18        | 16        | 5        |
|      | 变动比例 | 150.00%      | 12.50%    | 220.00%   | -        |
| 销售单价 | 均价   | 1,066.67     | 1,357.18  | 863.52    | 693.45   |
|      | 变动比例 | -6.87%       | 57.17%    | 24.53%    | -        |
| 销售收入 | 金额   | 16,000.03    | 24,429.21 | 13,816.34 | 3,467.26 |
|      | 变动比例 | 132.82%      | 76.81%    | 298.48%   | -        |

注：2025 年 1-9 月变动比例基于 2025 年 1-9 月数据（未经审计）计算得到。

报告期内，随着设备销售数量和销售单价的整体增长，公司激光热处理设备业务销售收入呈现快速上升趋势。报告期各期，公司激光热处理设备业务收入分别为 3,467.26 万元、13,816.34 万元、24,429.21 万元和 **16,000.03 万元**。

报告期各期，公司激光热处理设备的销售数量分别为 5 台、16 台、18 台和 **15 台**。设备销量增长的原因为报告期内公司 LIC、LIEG、USJLA 等新设备推出

并陆续通过客户验证，同时客户开发得到进一步拓展。

随着 LIC、LIEG、USJLA 等复杂度及单价相对较高的先进制程集成电路激光热处理设备产品销售占比的提升，报告期内，公司激光热处理设备产品平均单价整体有所提升。报告期各期，公司激光热处理设备的平均单价分别为 693.45 万元/台、863.52 万元/台、1,357.18 万元/台和 **1,066.67 万元/台**。**2025 年 1-9 月**，公司激光热处理设备平均单价较 2024 年全年有所下滑，主要是因为：一方面，在下游客户半导体制造及公司自身设备制造工艺成熟度提升、客户设备采购数量增加、市场竞争加剧等因素的影响下，公司 LIC、USJLA 和 IGBT 激光热处理设备的平均销售单价存在一定程度的下滑；另一方面，2025 年 1-9 月，公司所销售的 LIEG、USJLA 等高单价先进制程集成电路激光热处理设备收入占激光热处理设备业务收入的比例由 2024 年的 43.76%下降至 16.65%。

（2）专用激光加工设备

报告期内，公司专用激光加工设备的销售数量及单价情况按产品类别列示如下：

单位：万元，台，万元/台

| 项目   |      | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度  | 2023 年度  | 2022 年度  |
|------|------|--------------|----------|----------|----------|
| 销售数量 | 数量   | 116          | 141      | 164      | 341      |
|      | 变动比例 | 36.47%       | -14.02%  | -51.91%  | -        |
| 销售单价 | 均价   | 22.33        | 21.88    | 24.75    | 10.56    |
|      | 变动比例 | 6.65%        | -11.61%  | 134.31%  | -        |
| 销售收入 | 金额   | 2,589.78     | 3,085.07 | 4,059.67 | 3,602.52 |
|      | 变动比例 | 45.54%       | -24.01%  | 12.69%   | -        |

注：2025 年 1-9 月变动比例基于 2024 年 1-9 月数据（未经审计）计算得到。

报告期各期，公司专用激光加工设备的销售金额分别为 3,602.52 万元、4,059.67 万元、3,085.07 万元和 **2,589.78 万元**，整体相对稳定。

报告期各期，公司专用激光加工设备销售数量分别为 341 台、164 台、141 台和 **116 台**，均价分别为 10.56 万元/台、24.75 万元/台、21.88 万元/台和 **22.33 万元/台**。2023 年，公司专用激光加工设备销量较 2022 年大幅下降，同时平均销售价格大幅上升，主要是因为 2022 年单价较低的分立器件专用激光标刻机产品销量较高，2023 年公司将有限的生产资源集中于单价较高的产品，分立器件



专用激光标刻机销量大幅下降。2024 年，公司专用激光加工设备销量及整体销售收入较 2023 年下滑，主要是因为受下游行业资本性支出周期性波动的影响，公司应用于封测领域的激光加工设备销售有所减少。2025 年 1-9 月，公司专用激光加工设备销售收入较 2024 年同期增加 45.54%，主要是因为当期激光标刻设备销售收入较 2024 年 1-9 月大幅提高：在差异化竞争的策略下，公司 2025 年 1-9 月激光标刻设备产品平均单价较 2024 年 1-9 月提高 75.97%，同时因新客开发、客户扩产等原因，公司 2025 年 1-9 月激光标刻设备销量较 2024 年同期增加 20 台。

（3）升级改造及其他技术服务

报告期内，公司升级改造及其他技术服务主要系基于激光热处理设备、专用激光加工设备销售业务衍生的改造、升级等技术服务，金额及占主营业务收入比例较低。

4、主营业务收入按销售模式分析

报告期内，公司的主营业务收入按销售模式列示如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|----|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|    | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 直销 | 18,569.95    | 99.19%  | 27,205.21 | 97.88%  | 18,134.49 | 97.26%  | 6,549.81 | 90.76%  |
| 经销 | 152.26       | 0.81%   | 587.90    | 2.12%   | 509.93    | 2.74%   | 666.50   | 9.24%   |
| 合计 | 18,722.20    | 100.00% | 27,793.12 | 100.00% | 18,644.42 | 100.00% | 7,216.31 | 100.00% |

报告期内，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。报告期各期，直销模式下的主营业务收入金额分别为 6,549.81 万元、18,134.49 万元、27,205.21 万元和 18,569.95 万元，占主营业务收入的比例分别为 90.76%、97.26%、97.88%和 99.19%。

公司激光热处理设备整体具有技术难度高、定制化程度高、单台售价高等特点，需由设备厂商配合下游晶圆制造厂商提供定制开发、安装调试等综合服务，一般均采用直销模式开展销售。报告期内，公司仅在 2024 年通过经销模式销售 1 台 SiC 晶圆激光退火设备，设备收入为 292.04 万元，占当年激光热处理设备收

入总额的比例为 1.20%。

与激光热处理设备相比，公司专用激光加工设备标准化程度较高、技术难度相对较低，主要采用直销模式，也基于经销商的渠道优势开展少量经销销售。报告期各期，公司通过经销模式销售的激光加工设备收入分别为 666.50 万元、509.93 万元、295.87 万元和 **152.26 万元**，占当期激光加工设备收入比例分别为 18.50%、12.56%、9.59%和 **5.88%**。

报告期内，公司经销销售均为买断式经销。经销销售模式下，公司将产品出售给经销商，由经销商自主定价销售给下游终端客户。

5、主营业务收入分区域分析

报告期内，公司的主营业务收入分区域构成情况如下：

单位：万元

| 项目     |    | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|--------|----|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|        |    | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 中国大陆   | 华中 | 12,274.90    | 65.56%  | 19,075.46 | 68.63%  | 10,395.32 | 55.76%  | 2,438.94 | 33.80%  |
|        | 华东 | 3,869.70     | 20.67%  | 6,604.66  | 23.76%  | 3,869.77  | 20.76%  | 1,315.24 | 18.23%  |
|        | 华南 | 1,093.32     | 5.84%   | 1,093.14  | 3.93%   | 2,011.60  | 10.79%  | 631.42   | 8.75%   |
|        | 西南 | 1,097.87     | 5.86%   | 787.95    | 2.84%   | 1,094.83  | 5.87%   | 1,584.97 | 21.96%  |
|        | 西北 | 41.77        | 0.22%   | 216.15    | 0.78%   | 974.56    | 5.23%   | 1,052.83 | 14.59%  |
|        | 东北 | -            | 0.00%   | 15.75     | 0.06%   | 84.96     | 0.46%   | 33.63    | 0.47%   |
|        | 华北 | 339.65       | 1.81%   | -         | -       | -         | -       | 159.29   | 2.21%   |
| 中国大陆以外 |    | 5.00         | 0.03%   | -         | -       | 213.38    | 1.14%   | -        | -       |
| 合计     |    | 18,722.20    | 100.00% | 27,793.12 | 100.00% | 18,644.42 | 100.00% | 7,216.31 | 100.00% |

注：中国大陆包括保税区。

公司产品以中国大陆销售为主，主要集中在下游半导体制造商客户所在的华中、华东、华南和西南地区。报告期各期，公司华中、华东、华南、西南地区的主营业务收入金额分别为 5,970.56 万元、17,371.52 万元、27,561.21 万元和 **18,335.79 万元**，占主营业务收入比例分别为 82.74%、93.17%、99.17%和 **97.94%**。

6、主营业务收入季节性分析

报告期内，公司的主营业务收入按季节划分情况如下：

单位：万元

| 项目  | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|-----|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|     | 金额           | 比例      | 金额        | 比例      | 金额        | 比例      | 金额       | 比例      |
| 一季度 | 3,623.28     | 19.35%  | 515.73    | 1.86%   | 2,306.05  | 12.37%  | 946.69   | 13.12%  |
| 二季度 | 5,116.52     | 27.33%  | 2,592.11  | 9.33%   | 2,955.70  | 15.85%  | 1,493.14 | 20.69%  |
| 三季度 | 9,982.40     | 53.32%  | 5,796.20  | 20.85%  | 5,542.35  | 29.73%  | 2,187.31 | 30.31%  |
| 四季度 | -            | -       | 18,889.07 | 67.96%  | 7,840.32  | 42.05%  | 2,589.17 | 35.88%  |
| 合计  | 18,722.20    | 100.00% | 27,793.12 | 100.00% | 18,644.42 | 100.00% | 7,216.31 | 100.00% |

2022-2024 年，公司第四季度主营业务收入金额分别为 2,589.17 万元、7,840.32 万元和 18,889.07 万元，占全年主营业务收入的比例分别为 35.88%、42.05% 和 67.96%。

一般来说，公司下游客户通常于年初制定资本性支出计划，此后陆续开展采购、安装和验收活动，导致公司设备销售收入确认存在一定的季节性特征，营业收入相对集中于下半年，尤其是第四季度。在前述季节性特征基础上，由于公司激光热处理设备单价较高、报告期内总体销售数量有限、相关收入占营业收入比例较高，公司单台激光热处理设备的生产、交货及验收时点和周期往往对公司营业收入在全年各季度之间的分布产生较大影响。

公司同行业可比公司收入确认季节性分析的具体情况如下：

| 可比公司 | 项目  | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------|-----|--------------|---------|---------|---------|
| 中微公司 | 一季度 | 26.96%       | 17.71%  | 19.53%  | 20.02%  |
|      | 二季度 | 34.57%       | 20.33%  | 20.81%  | 21.58%  |
|      | 三季度 | 38.47%       | 22.72%  | 24.18%  | 22.60%  |
|      | 四季度 | -            | 39.25%  | 35.48%  | 35.80%  |
|      | 合计  | 100.00%      | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 芯源微  | 一季度 | 27.80%       | 13.93%  | 16.79%  | 13.27%  |
|      | 二季度 | 43.81%       | 25.63%  | 23.73%  | 23.15%  |
|      | 三季度 | 28.39%       | 23.44%  | 29.75%  | 28.34%  |
|      | 四季度 | -            | 37.01%  | 29.73%  | 35.25%  |
|      | 合计  | 100.00%      | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 拓荆科技 | 一季度 | 16.79%       | 11.50%  | 14.88%  | 6.30%   |
|      | 二季度 | 29.51%       | 19.38%  | 22.23%  | 24.37%  |

| 可比公司 | 项目  | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------|-----|--------------|---------|---------|---------|
|      | 三季度 | 53.69%       | 24.64%  | 25.83%  | 27.46%  |
|      | 四季度 | -            | 44.49%  | 37.06%  | 41.87%  |
|      | 合计  | 100.00%      | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 华海清科 | 一季度 | 28.57%       | 19.97%  | 24.57%  | 21.13%  |
|      | 二季度 | 32.47%       | 23.96%  | 24.65%  | 22.37%  |
|      | 三季度 | 38.96%       | 28.04%  | 24.16%  | 25.24%  |
|      | 四季度 | -            | 28.03%  | 26.62%  | 31.26%  |
|      | 合计  | 100.00%      | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 屹唐股份 | 一季度 | 未披露          | 21.84%  | 19.60%  | 15.31%  |
|      | 二季度 | 未披露          | 23.27%  | 24.01%  | 22.75%  |
|      | 三季度 | 34.62%       | 26.76%  | 24.75%  | 22.22%  |
|      | 四季度 | -            | 28.13%  | 31.64%  | 39.71%  |
|      | 合计  | 100.00%      | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均值  | 一季度 | 25.03%       | 16.99%  | 19.07%  | 15.21%  |
|      | 二季度 | 35.09%       | 22.51%  | 23.09%  | 22.84%  |
|      | 三季度 | 39.88%       | 25.12%  | 25.73%  | 25.17%  |
|      | 四季度 | -            | 35.38%  | 32.11%  | 36.78%  |
|      | 合计  | 100.00%      | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

数据来源：可比公司招股说明书、定期公告；因数据可得性原因，2025 年 1-9 月可比公司各季度营业收入占比平均值计算未包含屹唐股份。

2022 年、2023 年，公司主营业务收入在各季度之间的分布与同行业可比公司相比不存在重大差异。2024 年，公司第四季度主营业务收入占全年的比例为 67.96%，高于同行业可比公司，主要是因为公司首台 USJLA、LIEG 设备经过较长时间的验证周期后在 2024 年第四季度得到了下游客户最终验证通过。

（三）营业成本分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本的构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2025 年 1-9 月 |        | 2024 年度   |        | 2023 年度   |        | 2022 年度  |        |
|--------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
|        | 金额           | 占比     | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     | 金额       | 占比     |
| 主营业务成本 | 9,048.97     | 98.44% | 12,523.09 | 98.63% | 10,431.18 | 98.62% | 4,228.46 | 99.18% |

| 项目     | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|--------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|        | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 其他业务成本 | 143.70       | 1.56%   | 174.57    | 1.37%   | 146.08    | 1.38%   | 34.94    | 0.82%   |
| 合计     | 9,192.68     | 100.00% | 12,697.65 | 100.00% | 10,577.27 | 100.00% | 4,263.40 | 100.00% |

报告期各期，公司营业成本分别为 4,263.40 万元、10,577.27 万元、12,697.65 万元和 **9,192.68 万元**，与公司营业收入的增长相匹配。报告期各期，公司主营业务成本占营业成本的比例分别为 99.18%、98.62%、98.63%和 **98.44%**。

## 2、主营业务成本分产品分析

报告期内，公司主营业务成本按产品类别分类情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|-------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|             | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 激光热处理设备     | 6,763.66     | 74.75%  | 9,742.47  | 77.80%  | 6,439.10  | 61.73%  | 1,453.54 | 34.38%  |
| 专用激光加工设备    | 2,185.43     | 24.15%  | 2,542.41  | 20.30%  | 3,429.99  | 32.88%  | 2,637.44 | 62.37%  |
| 升级改造及其他技术服务 | 99.89        | 1.10%   | 238.21    | 1.90%   | 562.10    | 5.39%   | 137.48   | 3.25%   |
| 合计          | 9,048.97     | 100.00% | 12,523.09 | 100.00% | 10,431.18 | 100.00% | 4,228.46 | 100.00% |

报告期各期，公司主营业务成本主要为激光热处理设备和专用激光加工设备的生产成本及费用，合计占主营业务成本比例分别为 96.75%、94.61%、98.10%和 **98.90%**，与激光热处理设备和专用激光加工设备收入在主营业务收入中的占比相匹配。

## 3、主营业务成本分类别分析

报告期内，公司主营业务成本按照成本性质划分的具体情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2025 年 1-9 月 |        | 2024 年度  |        | 2023 年度  |        | 2022 年度  |        |
|------|--------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|      | 金额           | 占比     | 金额       | 占比     | 金额       | 占比     | 金额       | 占比     |
| 直接材料 | 6,564.81     | 72.55% | 9,074.05 | 72.46% | 7,687.23 | 73.69% | 2,884.87 | 68.23% |
| 直接人工 | 646.03       | 7.14%  | 866.78   | 6.92%  | 651.17   | 6.24%  | 209.07   | 4.94%  |
| 制造费用 | 837.27       | 9.25%  | 1,113.67 | 8.89%  | 1,100.27 | 10.55% | 745.22   | 17.62% |

| 项目    | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         | 2022 年度  |         |
|-------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|       | 金额           | 占比      | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      | 金额       | 占比      |
| 运输成本  | 55.03        | 0.61%   | 72.43     | 0.58%   | 53.85     | 0.52%   | 26.10    | 0.62%   |
| 售后服务费 | 945.84       | 10.45%  | 1,396.16  | 11.15%  | 938.67    | 9.00%   | 363.20   | 8.59%   |
| 合计    | 9,048.97     | 100.00% | 12,523.09 | 100.00% | 10,431.18 | 100.00% | 4,228.46 | 100.00% |

报告期各期，公司主营业务成本中的直接材料、直接人工及制造费用占主营业务成本总额的比例分别为 90.79%、90.49%、88.27%和 **88.94%**，是公司主营业务成本的主要构成部分。

报告期各期，公司主营业务成本构成整体较为稳定。2022 年，公司主营业务成本中的制造费用占比相对较高，主要是因为 2022 年公司生产及业务规模较小，生产管理、后勤等辅助生产人员人工成本，折旧摊销费用及办公费等相对固定的制造费用占主营业务成本总额相对较高。随着生产规模的快速扩大，2023 年及 2024 年，公司主营业务成本中制造费用及其他的占比相应下降。

报告期各期，公司主营业务成本中的售后服务费分别为 363.20 万元、938.67 万元、1,396.16 万元和 **945.84 万元**，占各期主营业务成本的比例分别为 8.59%、9.00%、11.15%和 **10.45%**。公司按照所销售设备产品收入金额的 5%计提售后服务费。报告期内，随着公司所销售设备产品整体单价和毛利率水平的提高，售后服务费金额及其占主营业务成本的比例**整体有所上升**。

（四）毛利及毛利率分析

1、毛利分析

报告期内，公司营业毛利总体情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度  |         | 2022 年度  |         |
|--------|--------------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|        | 金额           | 比例      | 金额        | 比例      | 金额       | 比例      | 金额       | 比例      |
| 主营业务毛利 | 9,673.23     | 98.17%  | 15,270.03 | 99.13%  | 8,213.23 | 96.64%  | 2,987.85 | 94.82%  |
| 其他业务毛利 | 180.59       | 1.83%   | 134.73    | 0.87%   | 285.23   | 3.36%   | 163.31   | 5.18%   |
| 合计     | 9,853.81     | 100.00% | 15,404.76 | 100.00% | 8,498.46 | 100.00% | 3,151.16 | 100.00% |

报告期各期，公司营业毛利金额分别为 3,151.16 万元、8,498.46 万元、



15,404.76 万元和 **9,853.81 万元**，其中主营业务毛利占营业毛利总额的比例分别为 94.82%、96.64%、99.13%和 **98.17%**，是公司毛利的主要来源。

报告期内，公司主营业务毛利按业务类型的构成情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2025 年 1-9 月    |                | 2024 年度          |                | 2023 年度         |                | 2022 年度         |                |
|-----------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|           | 金额              | 比例             | 金额               | 比例             | 金额              | 比例             | 金额              | 比例             |
| 激光热处理设备   | <b>9,236.38</b> | <b>95.48%</b>  | 14,686.75        | 96.18%         | 7,377.24        | 89.82%         | 2,013.71        | 67.40%         |
| 专用激光加工设备  | <b>404.35</b>   | <b>4.18%</b>   | 542.66           | 3.55%          | 629.68          | 7.67%          | 965.08          | 32.30%         |
| 升级改造与技术服务 | <b>32.50</b>    | <b>0.34%</b>   | 40.62            | 0.27%          | 206.31          | 2.51%          | 9.06            | 0.30%          |
| 合计        | <b>9,673.23</b> | <b>100.00%</b> | <b>15,270.03</b> | <b>100.00%</b> | <b>8,213.23</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,987.85</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期，公司主营业务毛利主要来源于激光热处理设备、专用激光加工设备销售，该两项业务的毛利金额分别为 2,978.79 万元、8,006.93 万元、15,229.41 万元和 **9,640.72 万元**，占主营业务毛利总额的比例分别为 99.70%、97.49%、99.73%和 **99.66%**。

公司 2023 年、2024 年激光热处理设备销售业务毛利金额及占其主营业务毛利总额的比例大幅提高，与主营业务收入构成变化相匹配。

2、毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率的总体情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2025 年 1-9 月    |               | 2024 年度          |               | 2023 年度         |               | 2022 年度         |               |
|------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|      | 毛利金额            | 毛利率           | 毛利金额             | 毛利率           | 毛利金额            | 毛利率           | 毛利金额            | 毛利率           |
| 主营业务 | <b>9,673.23</b> | <b>51.67%</b> | 15,270.03        | 54.94%        | 8,213.23        | 44.05%        | 2,987.85        | 41.40%        |
| 其他业务 | <b>180.59</b>   | <b>55.69%</b> | 134.73           | 43.56%        | 285.23          | 66.13%        | 163.31          | 82.38%        |
| 合计   | <b>9,853.81</b> | <b>51.74%</b> | <b>15,404.76</b> | <b>54.82%</b> | <b>8,498.46</b> | <b>44.55%</b> | <b>3,151.16</b> | <b>42.50%</b> |

报告期各期，公司综合毛利率分别为 42.50%、44.55%、54.82%和 **51.74%**，整体呈现上升趋势。综合毛利率的波动主要受公司报告期内整体产销规模、产品结构变化和各类产品毛利率变动的影响。**2025 年 1-9 月，公司综合毛利率较 2024 年全年有所下滑，主要是因为 2025 年 1-9 月公司激光热处理设备、专用激光加**

工设备业务毛利率较 2024 年全年均存在小幅下滑，此外，2025 年 1-9 月公司较高毛利率的激光热处理设备业务占主营业务收入的比例较 2024 年全年亦小幅下滑 2.44%。

（1）主营业务毛利率分析

报告期内，公司各项主营业务毛利率的具体情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2025 年 1-9 月 |        | 2024 年度   |        | 2023 年度  |        | 2022 年度  |        |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|             | 毛利金额         | 毛利率    | 毛利金额      | 毛利率    | 毛利金额     | 毛利率    | 毛利金额     | 毛利率    |
| 激光热处理设备     | 9,236.38     | 57.73% | 14,686.75 | 60.12% | 7,377.24 | 53.40% | 2,013.71 | 58.08% |
| 专用激光加工设备    | 404.35       | 15.61% | 542.66    | 17.59% | 629.68   | 15.51% | 965.08   | 26.79% |
| 升级改造及其他技术服务 | 32.50        | 24.55% | 40.62     | 14.57% | 206.31   | 26.85% | 9.06     | 6.18%  |
| 合计          | 9,673.23     | 51.67% | 15,270.03 | 54.94% | 8,213.23 | 44.05% | 2,987.85 | 41.40% |

1）激光热处理设备

报告期内，公司激光热处理设备业务按产品类别划分的毛利率具体情况如下：

| 项目              | 2025 年 1-9 月 |        | 2024 年度 |        | 2023 年度 |        | 2022 年度 |        |
|-----------------|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|                 | 收入占比         | 毛利率    | 收入占比    | 毛利率    | 收入占比    | 毛利率    | 收入占比    | 毛利率    |
| 先进制程集成电路激光热处理设备 | 87.03%       | 63.09% | 87.88%  | 65.36% | 58.59%  | 66.31% | 40.33%  | 64.04% |
| 其他激光热处理设备       | 12.97%       | 21.74% | 12.12%  | 22.13% | 41.41%  | 35.13% | 59.67%  | 54.05% |
| 合计              | 100.00%      | 57.73% | 100.00% | 60.12% | 100.00% | 53.40% | 100.00% | 58.08% |

公司激光热处理设备包括先进制程集成电路激光热处理设备和其他激光热处理设备。报告期内，公司先进制程集成电路激光热处理设备包括激光诱导结晶设备（LIC）、激光诱导外延生长设备（LIEG）和超浅结激光退火设备（USJLA），主要用于先进制程存储、逻辑芯片制造过程中的退火与材料改性，具有高技术含量、高研发投入、高技术壁垒的特征，毛利率相对较高且波动较小。报告期内，公司先进制程集成电路激光热处理设备整体业务规模与占比持续增长。其他激光

热处理设备包括 IGBT 晶圆激光退火设备、SiC 晶圆激光退火设备和 BSI-CCD 晶圆浅结退火设备。与先进制程集成电路激光热处理设备相比，公司其他激光热处理设备销售受市场竞争的影响相对较大，毛利率较低且波动较大。

报告期各期，公司激光热处理设备的毛利率分别为 58.08%、53.40%、60.12% 和 **57.73%**。2023 年，公司激光热处理设备的毛利率较 2022 年下降 4.68%，主要是因为受市场竞争、商务谈判等因素影响，公司 IGBT 晶圆激光退火设备、SiC 晶圆激光退火设备毛利率较低。随着激光诱导外延生长设备（LIEG）、超浅结激光退火设备（USJLA）等高复杂度、高毛利率新产品的推出并得到客户验证，公司 2024 年激光热处理设备业务毛利率提升至 60.12%。**公司 2025 年 1-9 月激光热处理设备毛利率较 2024 年全年下滑 2.39%，主要是因为 LIC、USJLA、IGBT 激光热处理设备销售单价有所下滑。**

2) 专用激光加工设备

报告期内，公司专用激光加工设备业务按产品类别划分的毛利率具体情况如下：

| 项目            | 2025 年 1-9 月   |               | 2024 年度        |               | 2023 年度        |               | 2022 年度        |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               | 收入占比           | 毛利率           | 收入占比           | 毛利率           | 收入占比           | 毛利率           | 收入占比           | 毛利率           |
| 封测激光加工设备      | <b>39.33%</b>  | <b>13.04%</b> | 41.68%         | 17.25%        | 53.44%         | 13.74%        | 81.44%         | 27.41%        |
| 晶圆激光加工设备      | <b>27.78%</b>  | <b>13.56%</b> | 22.08%         | 24.78%        | 26.97%         | 24.96%        | 12.58%         | 26.31%        |
| 电子制造及其他激光加工设备 | <b>32.89%</b>  | <b>20.42%</b> | 36.24%         | 13.61%        | 19.59%         | 7.34%         | 5.98%          | 19.30%        |
| 合计            | <b>100.00%</b> | <b>15.61%</b> | <b>100.00%</b> | <b>17.59%</b> | <b>100.00%</b> | <b>15.51%</b> | <b>100.00%</b> | <b>26.79%</b> |

报告期内，公司专用激光加工设备按照应用领域可划分为封测激光加工设备、晶圆激光加工设备和电子制造及其他激光加工设备。根据下游应用场景、具体激光加工工艺、客户所需配置的不同，公司专用激光加工设备的价格、成本和毛利率可能存在较大差异。报告期内，受到规模效应不足、市场竞争等因素的影响，公司专用激光加工设备业务毛利率整体较低且波动性较大。

报告期各期，公司专用激光加工设备的毛利率分别为 26.79%、15.51%、17.59% 和 **15.61%**。2023 年，专用激光加工设备毛利率较 2022 年下滑约 10%，主要是因

为一方面，公司在开发新产品过程中发生了较高的材料、人工成本，导致 2023 年封测领域激光加工设备毛利率较 2022 年下滑 13.67%；另一方面，受到市场竞争因素影响，2023 年公司电子制造及其他激光加工设备销售价格及毛利率亦下滑超 10%。

2024 年，随着公司专用激光加工设备产品结构优化，毛利率较高的激光开封、激光去溢料、三光检查、基板和玻璃激光切割设备销售占比有所提高，公司封测领域及电子制造领域激光加工设备毛利率均有所提升，带动专用激光加工设备整体毛利率水平略有提高。

尽管 2025 年 1-9 月公司激光标刻设备在差异化竞争策略下销售单价有所提高，但公司激光切割设备销售单价较 2024 年同期有所下滑，同时单价和毛利率较高的激光去溢料机设备销量较低，导致公司 2025 年 1-9 月应用于封测和晶圆制造领域的激光加工设备毛利率有所下滑，专用激光加工设备整体毛利率较 2024 年全年下滑 1.98%。

### 3) 升级改造及其他技术服务

升级改造及其他技术服务主要系基于激光热处理设备、专用激光加工设备销售业务衍生的改造、升级等技术服务，服务内容主要包括公司设备产品核心零部件更新更换、为满足客户工艺或制程升级而对产品设备进行技术改造及工艺调试等。受具体服务内容及其所耗费材料、人工等差异的影响，不同升级改造及其他技术服务项目的毛利率差异较大。报告期内公司升级改造及其他技术服务业务规模及对主营业务毛利率的影响整体较小。

### （2）其他业务毛利率分析

公司其他业务收入主要包括配件销售及零星加工服务收入，占报告期各期营业收入比例均低于 3%。报告期各期，公司其他业务毛利率分别为 82.38%、66.13%、43.56%和 55.69%。2022-2024 年，其他业务毛利率整体呈下降趋势，主要是因为公司其他业务中毛利率相对较低的配件销售业务占比提高。2025 年 1-9 月，公司配件销售业务毛利率整体有所提高，因而公司 2025 年 1-9 月其他业务毛利率较 2024 年全年提高 12.13%。

3、可比公司对比分析

报告期内，公司毛利率与可比公司的对比情况如下：

| 名称      | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 中微公司    | 39.10%       | 41.06%  | 45.83%  | 45.74%  |
| 芯源微     | 34.52%       | 37.67%  | 42.53%  | 38.40%  |
| 拓荆科技    | 33.28%       | 41.69%  | 51.01%  | 49.27%  |
| 华海清科    | 44.09%       | 43.20%  | 46.02%  | 47.72%  |
| 屹唐股份    | 37.36%       | 37.39%  | 35.03%  | 28.52%  |
| 可比公司平均值 | 37.67%       | 40.20%  | 44.08%  | 41.93%  |
| 本公司     | 51.74%       | 54.82%  | 44.55%  | 42.50%  |

数据来源：可比公司招股说明书、定期公告

受产品结构、市场竞争等多种因素影响，可比公司毛利率存在一定差异。2022 年、2023 年，公司综合毛利率水平与可比公司相比不存在重大差异，2024 年和 2025 年 1-9 月，公司毛利率高于可比公司平均水平。

报告期内，公司激光诱导结晶设备（LIC）、激光诱导外延生长设备（LIEG）和超浅结激光退火设备（USJLA）等先进制程集成电路激光热处理设备因设备首创性较高、国际厂商竞品设备采购难度较大等原因整体毛利率较高，拉高公司报告期内综合毛利率水平。该影响在先进制程集成电路激光热处理设备业务占比较高的 2024 年和 2025 年 1-9 月尤为显著。

（五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用的构成情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度   |         | 2023 年度  |         | 2022 年度  |         |
|------|--------------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|      | 金额           | 占营业收入比例 | 金额        | 占营业收入比例 | 金额       | 占营业收入比例 | 金额       | 占营业收入比例 |
| 销售费用 | 994.92       | 5.22%   | 1,214.41  | 4.32%   | 1,054.55 | 5.53%   | 820.16   | 11.06%  |
| 管理费用 | 3,018.49     | 15.85%  | 2,808.59  | 9.99%   | 2,491.54 | 13.06%  | 1,470.92 | 19.84%  |
| 研发费用 | 3,784.97     | 19.87%  | 5,873.72  | 20.90%  | 2,395.18 | 12.56%  | 1,528.13 | 20.61%  |
| 财务费用 | 336.73       | 1.77%   | 174.99    | 0.62%   | 125.77   | 0.66%   | 287.38   | 3.88%   |
| 合计   | 8,135.11     | 42.71%  | 10,071.71 | 35.84%  | 6,067.04 | 31.81%  | 4,106.60 | 55.39%  |

报告期各期，公司期间费用的总额分别为 4,106.60 万元、6,067.04 万元、10,071.71 万元和 **8,135.11 万元**，占营业收入的比例分别为 55.39%、31.81%、35.84%和 **42.71%**。2023 年，公司营业收入规模较 2022 年快速扩大，由此产生的规模效应导致公司期间费用占营业收入的比例大幅下降。2024 年，公司期间费用率较 2023 年上升 4.03%，主要是因为 2024 年公司研发费用金额上升。**2025 年 1-9 月**，公司期间费用率与 2023 年、2024 年全年相比相对较高，主要是因为公司营业收入存在第四季度占比较高的季节性特征，而期间费用按公司经营活动开展的具体需求发生，在全年的分布较为平均，因而 1-9 月期间费用率高于全年水平。

1、销售费用

（1）销售费用明细

报告期内，公司销售费用的具体情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度  |         | 2023 年度  |         | 2022 年度 |         |
|----------|--------------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
|          | 金额           | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额      | 占比      |
| 职工薪酬     | 460.02       | 46.24%  | 687.24   | 56.59%  | 526.05   | 49.88%  | 353.53  | 43.10%  |
| 业务招待费    | 145.39       | 14.61%  | 148.53   | 12.23%  | 188.42   | 17.87%  | 201.36  | 24.55%  |
| 维修费      | 168.43       | 16.93%  | 140.41   | 11.56%  | 85.21    | 8.08%   | 75.46   | 9.20%   |
| 广告宣传费    | 96.53        | 9.70%   | 106.82   | 8.80%   | 63.25    | 6.00%   | 19.60   | 2.39%   |
| 差旅交通费    | 59.61        | 5.99%   | 67.09    | 5.52%   | 89.74    | 8.51%   | 56.73   | 6.92%   |
| 股份支付     | 11.48        | 1.15%   | 15.30    | 1.26%   | 36.43    | 3.45%   | 31.33   | 3.82%   |
| 咨询、中标服务费 | 7.28         | 0.73%   | 16.80    | 1.38%   | 38.09    | 3.61%   | 36.69   | 4.47%   |
| 其他       | 46.17        | 4.64%   | 32.22    | 2.65%   | 27.36    | 2.59%   | 45.46   | 5.54%   |
| 合计       | 994.92       | 100.00% | 1,214.41 | 100.00% | 1,054.55 | 100.00% | 820.16  | 100.00% |

报告期各期，公司销售费用分别为 820.16 万元、1,054.55 万元、1,214.41 万元和 **994.92 万元**，占营业收入的比例分别为 11.06%、5.53%、4.32%和 **5.22%**。公司销售费用主要包括职工薪酬、业务招待费、维修费和广告宣传费。

1) 职工薪酬

公司销售费用中的职工薪酬包括销售人员的工资、奖金、社保、住房公积金



及福利费等，系销售费用的重要构成部分。报告期内，公司销售费用中的职工薪酬分别为 353.53 万元、526.05 万元、687.24 万元和 **460.02 万元**。随着公司业务规模的扩大、营业收入的增长，公司销售人员的数量及人均薪酬均有所增长，从而导致了职工薪酬总额的上升。

## 2) 业务招待费

报告期各期，公司销售费用中的业务招待费分别为 201.36 万元、188.42 万元、148.53 万元和 **145.39 万元**。**2022-2024 年，公司业务招待费的金额及占销售费用的比例**有所下降，主要原因包括：①伴随公司业务的发展，报告期内公司逐步建立了较为稳定的客户结构，客户复购成为公司业绩增长的重要贡献因素，公司销售招待活动有所减少；②根据报告期内公司业务结构及客户体系的变化，公司相应制定了更为多元的营销策略，在销售招待活动的基础上更多地通过参与行业展会、加强广告宣传等方式增加品牌影响力、拓展下游客户。**2025 年 1-9 月，公司业务招待费占销售费用的比例略有上升，主要系销售人员为推广新产品，面向行业重点客户业务接洽活动的频率和力度有所提升。**

## 3) 维修费

维修费系公司向客户提供维修服务产生的费用，随着公司业务规模扩大，维修费用金额有所增加。报告期各期，公司销售费用中的维修费分别为 75.46 万元、85.21 万元、140.41 万元和 **168.43 万元**。

## 4) 广告宣传费

公司销售费用中的广告宣传费主要包括会议展览费及宣传设计服务费等。报告期各期，公司销售费用中的广告宣传费分别为 19.60 万元、63.25 万元、106.82 万元和 **96.53 万元**。为进一步提升自身品牌影响力，公司报告期内参与行业展会的次数逐年上升，广告宣传渠道也不断拓展，因此相应支出逐年增加。

## （2）可比公司对比情况

公司与可比公司的销售费用率对比分析如下：

| 公司简称    | 销售费用率        |         |         |         |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
|         | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| 中微公司    | 3.98%        | 5.28%   | 7.85%   | 8.62%   |
| 芯源微     | 8.52%        | 5.12%   | 8.27%   | 7.50%   |
| 拓荆科技    | 6.23%        | 7.06%   | 10.41%  | 11.27%  |
| 华海清科    | 4.68%        | 3.59%   | 5.38%   | 6.08%   |
| 屹唐股份    | 6.47%        | 6.00%   | 7.04%   | 5.10%   |
| 可比公司平均值 | 5.97%        | 5.41%   | 7.79%   | 7.71%   |
| 本公司     | 5.22%        | 4.32%   | 5.53%   | 11.06%  |

数据来源：可比公司招股说明书、定期公告

2022 年，公司营业收入规模较小，因销售拓展和客户服务对销售人员数量的需求具有一定刚性，当年公司的销售费用率高于可比公司平均值；2023 年、2024 年、2025 年 1-9 月，公司营业收入快速增长，规模效应下销售费用率下降，销售费用率趋于与可比公司相近水平。

2、管理费用

（1）管理费用明细

报告期内，公司管理费用的具体情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2025 年 1-9 月 |         | 2024 年度  |         | 2023 年度  |         | 2022 年度  |         |
|-------|--------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|       | 金额           | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      |
| 职工薪酬  | 1,324.47     | 43.88%  | 1,687.14 | 60.07%  | 1,167.62 | 46.86%  | 770.91   | 52.41%  |
| 咨询服务费 | 531.63       | 17.61%  | 394.53   | 14.05%  | 345.49   | 13.87%  | 52.28    | 3.55%   |
| 折旧摊销费 | 711.68       | 23.58%  | 202.66   | 7.22%   | 186.69   | 7.49%   | 69.35    | 4.71%   |
| 股份支付  | 102.23       | 3.39%   | 136.49   | 4.86%   | 393.80   | 15.81%  | 351.30   | 23.88%  |
| 业务招待费 | 104.11       | 3.45%   | 128.31   | 4.57%   | 141.75   | 5.69%   | 19.21    | 1.31%   |
| 房租物业费 | 24.92        | 0.83%   | 17.10    | 0.61%   | 16.09    | 0.65%   | 25.30    | 1.72%   |
| 差旅交通费 | 75.67        | 2.51%   | 59.23    | 2.11%   | 59.05    | 2.37%   | 37.34    | 2.54%   |
| 会务费   | 46.22        | 1.53%   | 49.40    | 1.76%   | 46.03    | 1.85%   | 11.96    | 0.81%   |
| 办公费   | 39.56        | 1.31%   | 44.67    | 1.59%   | 50.77    | 2.04%   | 33.30    | 2.26%   |
| 专利申请费 | 13.56        | 0.45%   | 44.37    | 1.58%   | 42.56    | 1.71%   | 40.33    | 2.74%   |
| 其他    | 44.45        | 1.47%   | 44.70    | 1.59%   | 41.70    | 1.67%   | 59.62    | 4.05%   |
| 合计    | 3,018.49     | 100.00% | 2,808.59 | 100.00% | 2,491.54 | 100.00% | 1,470.92 | 100.00% |

报告期各期，公司管理费用分别为 1,470.92 万元、2,491.54 万元、2,808.59 万元和 **3,018.49 万元**，占营业收入的比例分别为 19.84%、13.06%、9.99%和 **15.85%**。公司管理费用主要包括职工薪酬、咨询服务费、折旧摊销费、股份支付和业务招待费等。

### 1) 职工薪酬

公司管理费用中的职工薪酬主要包括管理、财务、采购、人力、后勤等相关员工的工资、奖金、社保、住房公积金、福利费等，系公司管理费用的重要组成部分。报告期各期，公司管理费用中的职工薪酬分别为 770.91 万元、1,167.62 万元、1,687.14 万元和 **1,324.47 万元**，呈逐年上升的趋势，主要系随着公司业务规模的扩大、营业收入的增长，管理、财务、采购、人力、后勤等相关员工数量及人均薪酬均有所提高。

### 2) 咨询服务费

管理费用中的咨询服务费主要包括 IPO 中介机构服务费、法律顾问费等。报告期各期，管理费用中的咨询服务费分别为 52.28 万元、345.49 万元、394.53 万元和 **531.63 万元**。2023 年、2024 年及 **2025 年 1-9 月**，管理费用中的咨询服务费金额较高，主要系因筹划上市而发生的 IPO 中介机构服务费较高。

### 3) 折旧摊销费

管理费用中的折旧摊销费主要系办公场地、办公设备及车辆的折旧摊销。报告期各期，管理费用中的折旧摊销费分别为 69.35 万元、186.69 万元、202.66 万元和 **711.68 万元**。随着公司业务规模的扩大，折旧摊销费呈现上升趋势。**2025 年 1-9 月**，公司折旧摊销费大幅提升，主要是因为当期“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房转固，房屋及建筑物、办公设备的折旧费用大幅上升。

### 4) 业务招待费

管理费用中的业务招待费主要系管理层进行来宾招待、业务洽谈、对外联络等活动时所发生的礼品费、餐饮费等费用。报告期各期，管理费用中的业务招待费分别为 19.21 万元、141.75 万元、128.31 万元和 **104.11 万元**。2023 年起，管理费用中的业务招待费金额上升，主要系随着公司的业务规模扩大，公司品牌影

响力及行业知名度上升，公司来宾招待、业务洽谈、对外联络活动增加，相应支出增加。

（2）可比公司对比情况

公司与可比公司的管理费用率对比分析如下：

| 公司简称    | 管理费用率        |         |         |         |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
|         | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| 中微公司    | 3.82%        | 5.31%   | 5.49%   | 4.98%   |
| 芯源微     | 20.10%       | 14.22%  | 10.60%  | 10.24%  |
| 拓荆科技    | 4.94%        | 5.12%   | 6.98%   | 4.75%   |
| 华海清科    | 6.28%        | 5.61%   | 5.69%   | 6.09%   |
| 屹唐股份    | 4.89%        | 5.09%   | 5.38%   | 4.17%   |
| 可比公司平均值 | 8.01%        | 7.07%   | 6.83%   | 6.05%   |
| 本公司     | 15.85%       | 9.99%   | 13.06%  | 19.84%  |

数据来源：可比公司招股说明书、定期公告

报告期内，公司的管理费用率整体高于可比公司平均值，主要是因为公司收入规模相对小于可比公司，而管理费用中基本职能部门人员薪酬、日常办公费、折旧与摊销等固定费用存在一定的刚性。**2022-2024 年**，随着收入规模不断提高，公司管理费用率呈逐年下降的趋势；**2025 年 1-9 月**，由于当期“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房转固，管理费用中的折旧摊销费上升，公司管理费用率上升。

3、研发费用

（1）研发费用明细

报告期内，公司研发费用的具体情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2025 年 1-9 月 |        | 2024 年度  |        | 2023 年度 |        | 2022 年度 |        |
|---------|--------------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|
|         | 金额           | 占比     | 金额       | 占比     | 金额      | 占比     | 金额      | 占比     |
| 专业机构服务费 | 314.22       | 8.30%  | 1,976.66 | 33.65% | 242.24  | 10.11% | 266.08  | 17.41% |
| 职工薪酬    | 1,424.83     | 37.64% | 1,710.08 | 29.11% | 879.97  | 36.74% | 476.30  | 31.17% |
| 折旧摊销费   | 1,288.37     | 34.04% | 1,337.10 | 22.76% | 579.30  | 24.19% | 228.79  | 14.97% |
| 材料费     | 397.99       | 10.52% | 480.84   | 8.19%  | 453.54  | 18.94% | 353.12  | 23.11% |

|       |          |         |          |         |          |         |          |         |
|-------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 差旅交通费 | 219.65   | 5.80%   | 186.68   | 3.18%   | 88.05    | 3.68%   | 71.62    | 4.69%   |
| 股份支付  | 110.66   | 2.92%   | 159.87   | 2.72%   | 143.59   | 5.99%   | 124.07   | 8.12%   |
| 其他    | 29.25    | 0.77%   | 22.49    | 0.38%   | 8.50     | 0.36%   | 8.15     | 0.53%   |
| 合计    | 3,784.97 | 100.00% | 5,873.72 | 100.00% | 2,395.18 | 100.00% | 1,528.13 | 100.00% |

报告期各期，公司研发费用分别为 1,528.13 万元、2,395.18 万元、5,873.72 万元和 **3,784.97 万元**，占营业收入的比例分别为 20.61%、12.56%、20.90%和 **19.87%**，最近三年累计研发投入金额及占最近三年累计营业收入的比例为 17.95%；最近三年研发投入复合增长率 96.05%。

公司研发费用主要包括专业机构服务费、职工薪酬、折旧摊销费和材料费等。

### 1) 专业机构服务费

报告期内，公司研发费用中的专业机构服务费分别为 266.08 万元、242.24 万元、1,976.66 万元和 **314.22 万元**。具体情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度  | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-----------|--------------|----------|---------|---------|
| 验证费       | -            | 1,559.13 | 129.93  | -       |
| 共建联合实验室费用 | 145.63       | 194.17   | 80.91   | 48.54   |
| 技术支持费     | 89.42        | 188.28   | 15.41   | 13.98   |
| 其他技术服务费   | 79.17        | 35.08    | 15.99   | 203.56  |
| 合计        | 314.22       | 1,976.66 | 242.24  | 266.08  |

#### ① 验证费

验证费系公司承担国家某部委应用专项过程中，根据项目任务书要求委托用户单位客户 A 对公司最新研发的 USJLA 设备进行验证而发生的支出，相关费用在验证期限内逐月计入研发费用。公司承担的国家某部委应用专项的具体情况请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“七、发行人核心技术及研发情况”之“（二）科研实力和成果情况”之“2、公司承担的重大科研项目”。

#### ② 共建联合实验室费用

公司与中国科学院半导体所共建实验室，根据签订的合作协议提供运行经费。共建联合实验室项目的具体情况请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“七、发行人核心技术及研发情况”之“（五）合作研发情况”。

### ③技术支持费

技术支持费系公司委托激光器等零部件供应商为公司提供关键零部件使用培训、国产供应链能力验证而发生的支出，具有偶发性特征。2024 年以来，公司进一步强化基于国产供应链的设备方案研发，开展包括激光器、大功率射频板条、高可靠性机加工件在内的多款核心零部件国产供应能力测试，因此发生较大额技术支持费。

### ④其他技术服务费

其他技术服务费用主要包括专家顾问、设备认证、测试服务采购、委外研发等发生的支出。

## 2) 职工薪酬

公司研发费用中的职工薪酬主要包括参与研发活动人员的工资、奖金、社保、住房公积金、福利费等，系公司研发费用的重要组成部分。报告期各期，公司研发费用中的职工薪酬分别为 476.30 万元、879.97 万元、1,710.08 万元和 **1,424.83 万元**，呈逐年上升的趋势，主要系随着公司业务规模的扩大，公司持续加大研发投入，从事研发活动的人员数量及人均薪酬有所提高。2024 年以来，公司研发费用中的职工薪酬大幅增加，主要是因为一方面，公司通过招募持续增补研发团队；另一方面，公司“12 寸逻辑晶圆 CO2 激光退火设备与工艺”（国家某部委应用专项相关）、“新一代晶圆激光开槽划片设备”、“3D-IC 异构集成激光设备与工艺”等研发项目进入关键阶段，“12 寸晶圆整片单步激光退火设备研发”、“先进制程节点 mask 特征尺寸修正技术及设备开发”等前沿研发项目陆续立项，公司技术人员整体研发投入有所提高。

## 3) 折旧摊销费

报告期各期，公司研发费用中的折旧摊销费分别为 228.79 万元、579.30 万元、1,337.10 万元和 **1,288.37 万元**。报告期内，公司持续加大研发投入，公司用于研发活动的固定资产数量及金额增加，折旧摊销费逐年上升，随着公司各研发项目逐步深入，研发精细度和复杂性日渐提高，研发活动对专业软硬件设施的数量与规格需求进一步提升。2024 年以来，公司折旧摊销费金额呈现较大幅度增长，主要系因公司承担的国家某部委应用专项和其他面向先进制程、三维堆



叠等前沿领域的研发项目使用了多款专用高价值激光器、检测设备、工艺实验平台等固定资产并计提折旧导致。

4) 材料费

公司研发费用中的材料费系研发活动中的直接材料支出。报告期内，材料费分别为 353.12 万元、453.54 万元、480.84 万元和 **397.99 万元**。报告期内，公司持续加大研发投入，研发材料费投入亦呈现增长趋势。

(2) 可比公司对比情况

公司与可比公司的研发费用率对比分析如下：

| 公司简称    | 研发费用率         |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 2025 年 1-9 月  | 2024 年度       | 2023 年度       | 2022 年度       |
| 中微公司    | <b>22.25%</b> | 15.64%        | 13.04%        | 12.77%        |
| 芯源微     | <b>18.96%</b> | 16.92%        | 11.52%        | 10.99%        |
| 拓荆科技    | <b>11.49%</b> | 18.42%        | 21.29%        | 22.21%        |
| 华海清科    | <b>11.78%</b> | 11.22%        | 12.12%        | 13.14%        |
| 屹唐股份    | <b>14.48%</b> | 15.47%        | 15.47%        | 11.13%        |
| 可比公司平均值 | <b>15.79%</b> | <b>15.53%</b> | <b>14.69%</b> | <b>14.05%</b> |
| 本公司     | <b>19.87%</b> | <b>20.90%</b> | <b>12.56%</b> | <b>20.61%</b> |

数据来源：可比公司招股说明书、定期公告

公司高度重视技术研发和产品创新，基于先进精密激光技术，不断开拓新产品以满足客户的工艺需求，持续保持较高的研发投入。

2023 年，公司营业收入快速增长，研发费用虽亦有增长但增速不及营业收入，规模效应下研发费用率下降。报告期内，公司研发费用占营业收入比例整体高于可比公司，主要原因系公司尚处于发展阶段，营业收入规模较小，同时投入较多资源用于研发以构筑竞争优势。

(3) 主要研发项目情况

报告期内，公司的研发费用对应的主要项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                      | 项目整体预算    | 目前实施进度 | 研发费用         |          |          |         |
|----|---------------------------|-----------|--------|--------------|----------|----------|---------|
|    |                           |           |        | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度  | 2023 年度  | 2022 年度 |
| 1  | 12 寸逻辑晶圆 CO2 激光退火设备与工艺    | 15,000.00 | 产业化应用  | 1,530.91     | 3,967.21 | 1,066.53 | 295.25  |
| 2  | 新一代晶圆激光开槽划片设备             | 6,678.00  | 在研     | 612.43       | 591.39   | 459.17   | 203.51  |
| 3  | 3D-IC 异构集成激光设备与工艺         | 4,700.00  | 在研     | 595.89       | 555.87   | 28.13    | -       |
| 4  | 12 寸 DRAM 晶圆激光诱导外延生长设备与工艺 | 3,000.00  | 产业化应用  | 277.93       | 272.50   | 119.91   | 185.02  |
| 5  | 先进制程节点 mask 特征尺寸修正技术及设备开发 | 3,000.00  | 在研     | 102.39       | -        | -        | -       |
| 6  | 12 寸晶圆激光诱导结晶设备与工艺         | 2,000.00  | 产业化应用  | 193.14       | 215.24   | 282.02   | 589.57  |
| 7  | 12 寸逻辑晶圆动态表面退火设备与工艺       | 2,000.00  | 产业化应用  | 108.33       | 200.01   | 249.35   | -       |
| 8  | 12 寸晶圆整片单步激光退火设备研发        | 2,000.00  | 在研     | 302.32       | -        | -        | -       |
| 9  | 第三代半导体激光处理设备与工艺           | 780.00    | 产业化应用  | 35.59        | 35.10    | 71.87    | 203.97  |

#### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用的主要构成如下：

单位：万元

| 项目        | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-----------|--------------|---------|---------|---------|
| 利息费用      | 572.47       | 473.48  | 177.19  | 95.30   |
| 减：资本化利息费用 | 158.07       | 191.69  | -       | -       |
| 减：利息收入    | 102.99       | 134.56  | 172.79  | 5.75    |
| 汇兑损益      | 12.15        | -2.87   | -8.91   | -17.83  |
| 银行手续费     | 0.64         | 0.39    | 0.28    | 1.05    |
| 关联方资金占用息  | 1.19         | 1.63    | 59.97   | 125.52  |
| 筹资费用及贴现息  | 0.72         | 8.90    | 41.67   | 58.37   |
| 租赁负债利息    | 10.62        | 19.71   | 28.37   | 30.73   |
| 合计        | 336.73       | 174.99  | 125.77  | 287.38  |

报告期各期，公司财务费用分别为 287.38 万元、125.77 万元、174.99 万元和 336.73 万元，占营业收入的比例较低，主要包括利息费用、租赁负债利息、关联方资金占用息和筹资费用及贴现息等。2024 年起，公司新增“全国总部暨

集成电路装备研发制造基地项目”建设专门借款，公司在该专门借款项下提取的借款金额较大，因此利息费用金额增加幅度较大。

### （1）资本化利息费用

公司于 2024 年度、2025 年 1-9 月分别产生借款利息资本化金额 191.69 万元、158.07 万元，系“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”建设专用借款利息资本化。

为支持“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”建设，2024 年 3 月，公司与交通银行成都高新区支行签署《固定资产借款合同》。该专门借款额度共计 34,600.00 万元，借款期限为 2024 年 3 月 14 日至 2035 年 3 月 12 日。截至 2024 年末、2025 年 9 月 30 日，公司在该专门借款项下分别累计提取 15,009.32 万元、19,903.58 万元。“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”已于 2025 年 8 月全部转固。2025 年 9 月起，该专门借款项下发生的利息不再进行资本化。

公司借款费用资本化的确认原则参见本节之“二、重要会计政策及会计估计”之“（六）在建工程”。

### （2）关联方资金占用息

报告期各期，公司财务费用中的关联方资金占用息分别为 125.52 万元、59.97 万元、1.63 万元和 1.19 万元，为公司向东骏激光、东骏投资等关联方资金拆借所产生的资金占用费，具体情况请参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方与关联交易情况”之“（二）报告期内关联交易情况”之“4、重大偶发性关联交易”之“（1）关联方资金拆借”。

### （3）筹资费用及贴现息

报告期各期，财务费用中的筹资费用及贴现息金额分别为 58.37 万元、41.67 万元、8.90 万元和 0.72 万元，主要为融资担保公司担保费用及票据贴现利息费用。

## （六）影响经营成果的其他项目分析

### 1、其他收益

报告期内，公司其他收益的具体构成如下：

单位：万元

| 项目           | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 政府补助         | 133.60       | 591.58  | 90.29   | 42.99   |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 0.15         | 2.36    | 1.32    | 0.40    |
| 增值税进项税加计抵减   | 118.32       | -       | 257.42  | -       |
| 增值税返还        | 9.39         | 6.89    | -       | -       |
| 合计           | 261.47       | 600.83  | 349.03  | 43.38   |

报告期各期，公司政府补助金额分别为 42.99 万元、90.29 万元、591.58 万元和 133.60 万元。报告期内，公司政府补助具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目                           | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | 类型    |
|----|------------------------------|--------------|---------|---------|---------|-------|
| 1  | 四川省新一轮第一批建议支持的重点“小巨人”企业奖补    | -            | 285.00  | -       | -       | 与收益相关 |
| 2  | 成都高新区科技创新局关于连续瞪羚企业认定奖励       | 30.00        | -       | 30.00   | -       | 与收益相关 |
| 3  | 成都高新区科技创新局“天府峨眉计划”资助资金       | -            | 55.00   | -       | -       | 与收益相关 |
| 4  | 成都高新区科技创新局省级科技计划项目专项资金       | -            | 50.00   | -       | -       | 与收益相关 |
| 5  | 四川省科技成果转移转化示范项目专项资金          | -            | 40.00   | -       | -       | 与收益相关 |
| 6  | 成都市经济和信息化局关于国家级专精特新“小巨人”企业奖励 | -            | 30.00   | -       | -       | 与收益相关 |
| 7  | 产业技术创新平台建设奖励                 | -            | 30.00   | -       | -       | 与收益相关 |
| 8  | 四川省科学技术厅关于创新产品的补贴            | -            | -       | 30.00   | -       | 与收益相关 |
| 9  | 成都高新区科技创新局“天府科创贷”融资成本补助      | -            | 21.19   | -       | -       | 与收益相关 |
| 10 | 成都高新区科技创新局等关于新纳入上市后备库企业补贴    | 20.00        | -       | -       | -       | 与收益相关 |
| 11 | 成都高新区管委会鼓励企业成为国家级专精特新“小巨人”补贴 | -            | 20.00   | -       | -       | 与收益相关 |
| 12 | “蓉漂计划”创新人才资助                 | 15.00        | 20.00   | -       | -       | 与收益相关 |

| 序号 | 项目                             | 2025 年<br>1-9 月 | 2024 年<br>度 | 2023 年<br>度 | 2022 年<br>度 | 类型    |
|----|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 13 | 成都高新区市场监督管理局关于购买专利执行保险的补贴      | -               | 18.00       | -           | -           | 与收益相关 |
| 14 | 高新技术企业认定奖补                     | 25.00           | -           | -           | 5.00        | 与收益相关 |
| 15 | 成都市科学技术局、成都市财政局关于研发准备金制度财政奖补资金 | -               | -           | -           | 4.43        | 与收益相关 |
| 16 | 科技保险补贴、科技金融资助、贷款补贴、科技专利保险补贴    | 24.92           | 21.32       | 24.20       | 32.00       | 与收益相关 |
| 17 | 稳岗补贴、用工补贴、扩岗补助                 | 10.53           | 1.07        | 6.09        | 1.56        | 与收益相关 |
| 18 | 成都高新区管委会鼓励企业申报认定“首台套”奖励        | 5.00            | -           | -           | -           | 与收益相关 |
| 19 | 苏州市“科创指数惠”政策补贴                 | 3.15            | -           | -           | -           | 与收益相关 |
| 合计 |                                | 133.60          | 591.58      | 90.29       | 42.99       | -     |

其中，“四川省科技成果转化示范项目专项资金”属于科研项目政府补助，具体情况如下：

单位：万元

| 科研项目的名称                         | 科研项目的类别       | 实施周期                   | 总预算    | 财政预算金额 |
|---------------------------------|---------------|------------------------|--------|--------|
| 面向国产存储芯片制造应用的激光退火装备（LA2540G）产业化 | 四川省科技成果转化示范项目 | 2024 年 1 月-2025 年 12 月 | 300.00 | 50.00  |

2、投资收益

报告期各期，公司投资收益分别为 5.52 万元、71.42 万元、307.41 万元和 264.75 万元，均为存单利息及结构性存款收益等理财收益。

3、资产及信用减值损失（损失以“-”号填列）

报告期内，公司主要资产减值损失及信用减值损失情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|
| 信用减值损失      | 72.63        | -335.95 | -31.86  | -50.81  |
| 其中：应收账款坏账损失 | 63.94        | -303.77 | -33.63  | -22.24  |
| 应收票据坏账损失    | 0.34         | -3.30   | -1.06   | -       |
| 其他应收款坏账损失   | 8.35         | -28.88  | 2.84    | -28.57  |

| 项目        | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-----------|--------------|---------|---------|---------|
| 资产减值损失    | -1,493.25    | -336.76 | -289.73 | -100.85 |
| 其中：存货跌价准备 | -1,475.80    | -348.12 | -280.38 | -101.64 |
| 合同资产减值损失  | -17.45       | 11.36   | -9.35   | 0.79    |

报告期各期，公司信用减值损失分别为-50.81 万元、-31.86 万元、-335.95 万元和 **72.63 万元**，均为应收账款、应收票据及其他应收款坏账损失；公司资产减值损失分别为-100.85 万元、-289.73 万元、-336.76 万元和**-1,493.25 万元**，均为存货、合同资产减值损失。截至 2025 年 9 月 30 日，公司存货跌价准备计提金额大幅提升，主要是因为：（1）公司 2022 年向客户客户 C 发出的一台 LIEG 设备因设备发出后客户进行了工艺调整，经与公司友好协商，客户 C 于 2025 年 12 月将该台设备退回，相关情况具有偶发性。针对该台设备，公司后续拟进行改造后对外出售，结合预计可出售价格公司对该台设备评估计提跌价准备 638.38 万元；（2）受下游销售价格波动的影响，公司针对 SiC 晶圆激光退火设备、IGBT 晶圆激光退火设备计提了跌价准备。

#### 4、营业外收支

报告期各期，公司营业外收入的具体情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|
| 非流动资产毁损报废利得 | -            | -       | 1.68    | -       |
| 其他          | 1.09         | 0.06    | 0.80    | 0.00    |
| 合计          | 1.09         | 0.06    | 2.48    | 0.00    |

报告期各期，公司营业外收入分别为 0.00 万元、2.48 万元、0.06 万元和 **1.09 万元**，主要为非流动资产毁损报废利得。

报告期各期，公司营业外支出的具体情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|
| 非公益性捐赠支出    | -            | 19.00   | 10.00   | -       |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1.27         | 15.66   | 0.41    | 0.17    |
| 其他          | 59.22        | 2.91    | 0.61    | 0.00    |



|    |       |       |       |      |
|----|-------|-------|-------|------|
| 合计 | 60.50 | 37.56 | 11.01 | 0.18 |
|----|-------|-------|-------|------|

报告期各期，公司营业外支出分别为 0.18 万元、11.01 万元、37.56 万元和 60.50 万元，主要包括对外捐赠支出和非流动资产毁损报废损失。

5、税金及附加

报告期各期，公司税金及附加金额分别为 127.23 万元、29.62 万元、43.07 万元和 206.28 万元，主要包括房产税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、土地使用税、印花税和车船使用税等。2025 年 1-9 月，公司“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”相关房产税税额为 178.09 万元，导致该期间公司税金及附加整体金额大幅上升。

（七）纳税情况

公司主要涉税税种包括增值税和企业所得税，报告期内主要涉税税种的应缴和实缴情况如下：

单位：万元

| 税项    | 期间           | 期初未交数   | 本期应交数    | 本期已交数    | 期末未交数   |
|-------|--------------|---------|----------|----------|---------|
| 企业所得税 | 2025 年 1-9 月 | 487.53  | -        | 586.29   | -98.76  |
|       | 2024 年度      | -94.32  | 1,059.90 | 478.05   | 487.53  |
|       | 2023 年度      | -300.89 | 397.20   | 190.63   | -94.32  |
|       | 2022 年度      | -98.76  | -        | 202.13   | -300.89 |
| 增值税   | 2025 年 1-9 月 | -496.93 | 191.55   | 11.99    | -317.36 |
|       | 2024 年度      | -496.61 | 9.20     | 9.52     | -496.93 |
|       | 2023 年度      | -199.88 | 3.75     | 300.48   | -496.61 |
|       | 2022 年度      | -75.72  | 896.23   | 1,020.39 | -199.88 |

报告期内，公司适用的税收政策稳定，未发生重大不利变化，公司税收政策及税收优惠情况请参见本节之“四、主要税项”。

七、资产质量分析

（一）资产构成及其变化分析

报告期各期末，公司资产按流动性划分的构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|----|-----------|------------|------------|------------|
|----|-----------|------------|------------|------------|

|       | 金额                | 占比             | 金额                | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
|-------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 流动资产  | <b>72,544.30</b>  | <b>63.49%</b>  | 64,440.53         | 62.78%         | 54,949.60        | 82.50%         | 21,675.33        | 88.08%         |
| 非流动资产 | <b>41,709.84</b>  | <b>36.51%</b>  | 38,200.22         | 37.22%         | 11,659.52        | 17.50%         | 2,932.81         | 11.92%         |
| 资产总计  | <b>114,254.14</b> | <b>100.00%</b> | <b>102,640.75</b> | <b>100.00%</b> | <b>66,609.12</b> | <b>100.00%</b> | <b>24,608.15</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司资产总额分别为 24,608.15 万元、66,609.12 万元、102,640.75 万元和 **114,254.14 万元**，呈现快速增加趋势，主要是因为：一方面，公司经营规模扩大及股权融资带来货币资金、应收账款、存货等经营性流动资产的增加；另一方面，随着公司“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”的建设推进，公司在建工程、**固定资产**等非流动资产规模迅速扩大。

## （二）流动资产结构及其变化分析

报告期各期末，公司流动资产的构成情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2025.9.30        |                | 2024.12.31       |                | 2023.12.31       |                | 2022.12.31       |                |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|         | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 货币资金    | <b>13,829.78</b> | <b>19.06%</b>  | 13,624.19        | 21.14%         | 19,800.09        | 36.03%         | 5,395.58         | 24.89%         |
| 交易性金融资产 | -                | -              | -                | -              | 3,008.49         | 5.47%          | -                | -              |
| 应收票据    | <b>266.75</b>    | <b>0.37%</b>   | 781.24           | 1.21%          | 323.15           | 0.59%          | 255.63           | 1.18%          |
| 应收账款    | <b>7,815.95</b>  | <b>10.77%</b>  | 11,173.87        | 17.34%         | 4,726.18         | 8.60%          | 3,776.53         | 17.42%         |
| 应收款项融资  | <b>2.00</b>      | <b>0.00%</b>   | 3.92             | 0.01%          | 675.72           | 1.23%          | 78.73            | 0.36%          |
| 预付款项    | <b>1,211.28</b>  | <b>1.67%</b>   | 1,685.24         | 2.62%          | 904.20           | 1.65%          | 695.98           | 3.21%          |
| 其他应收款   | <b>329.95</b>    | <b>0.45%</b>   | 194.98           | 0.30%          | 144.07           | 0.26%          | 1,267.91         | 5.85%          |
| 存货      | <b>27,895.87</b> | <b>38.45%</b>  | 18,472.20        | 28.67%         | 13,334.44        | 24.27%         | 9,043.63         | 41.72%         |
| 合同资产    | <b>526.48</b>    | <b>0.73%</b>   | 298.79           | 0.46%          | 719.49           | 1.31%          | 278.08           | 1.28%          |
| 其他流动资产  | <b>20,666.26</b> | <b>28.49%</b>  | 18,206.09        | 28.25%         | 11,313.76        | 20.59%         | 883.25           | 4.07%          |
| 流动资产合计  | <b>72,544.30</b> | <b>100.00%</b> | <b>64,440.53</b> | <b>100.00%</b> | <b>54,949.60</b> | <b>100.00%</b> | <b>21,675.33</b> | <b>100.00%</b> |

公司流动资产是资产的主要构成部分。报告期各期末，公司流动资产分别为 21,675.33 万元、54,949.60 万元、64,440.53 万元和 **72,544.30 万元**，占资产总额

的比例分别为 88.08%、82.50%、62.78%和 **63.49%**。公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付账款、存货和其他流动资产。报告期各期末，前述资产合计占流动资产的比例分别为 91.32%、91.14%、98.02%和 **98.45%**。

## 1、货币资金

报告期各期末，公司的货币资金明细如下：

单位：万元

| 项目     | 2025.9.30        |                | 2024.12.31       |                | 2023.12.31       |                | 2022.12.31      |                |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
|        | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额              | 占比             |
| 库存现金   | -                | -              | -                | -              | 4.48             | 0.02%          | 15.25           | 0.28%          |
| 银行存款   | <b>11,446.64</b> | <b>82.77%</b>  | 11,257.58        | 82.63%         | 19,076.64        | 96.35%         | 5,380.34        | 99.72%         |
| 其他货币资金 | <b>2,346.97</b>  | <b>16.97%</b>  | 2,345.80         | 17.22%         | 661.08           | 3.34%          | -               | -              |
| 存款应计利息 | <b>36.17</b>     | <b>0.26%</b>   | 20.81            | 0.15%          | 57.89            | 0.29%          | -               | -              |
| 合计     | <b>13,829.78</b> | <b>100.00%</b> | <b>13,624.19</b> | <b>100.00%</b> | <b>19,800.09</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,395.58</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 5,395.58 万元、19,800.09 万元、13,624.19 万元和 **13,829.78 万元**，占各期末流动资产的比例分别为 24.89%、36.03%、21.14%和 **19.06%**，是公司流动资产的重要组成部分。2023 年末，公司银行存款金额增加，主要由公司业务规模持续增长以及股权融资资金到账所致。

报告期各期末，公司使用受到限制的货币资金分别为 0 万元、661.08 万元、2,345.80 万元、**2,346.97 万元**，均为公司收到的政府补助款及利息。相关政府补助项目的具体情况请参见本节“八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（三）非流动负债构成及其变化分析”之“3、递延收益”。

## 2、交易性金融资产

2023 年末，公司交易性金融资产余额为 3,008.49 万元，占当期末流动资产的比例分别为 5.47%，为公司购买的银行理财产品。

## 3、应收票据及应收款项融资

### （1）应收票据

报告期内，公司应收票据明细情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 118.31    | 404.11     | 287.82     | 255.63     |
| 商业承兑汇票 | 152.45    | 381.49     | 36.40      | -          |
| 小计     | 270.77    | 785.60     | 324.22     | 255.63     |
| 减：坏账准备 | 4.02      | 4.36       | 1.06       | -          |
| 合计     | 266.75    | 781.24     | 323.15     | 255.63     |

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 255.63 万元、323.15 万元、781.24 万元和 **266.75 万元**，占各期末流动资产的比例分别为 1.18%、0.59%、1.21% 和 **0.37%**。应收票据坏账准备均系商业承兑汇票相关，公司按照账龄连续计算原则计提坏账准备。

## （2）应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资金额分别为 78.73 万元、675.72 万元、3.92 万元和 **2.00 万元**，占流动资产的比例分别为 0.36%、1.23%、0.01% 和 **0.00%**。公司将既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的，由信用等级较高的银行承兑的银行承兑汇票划分至应收款项融资列报。报告期各期末，公司的应收款项融资均为银行承兑汇票，因其发生信用风险损失的概率较低，公司未计提坏账准备。

## 4、应收账款

### （1）应收账款余额变动分析

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---------------|-----------|------------|------------|------------|
| 应收账款账面余额      | 8,386.12  | 11,807.98  | 5,056.52   | 4,073.24   |
| 减：坏账准备        | 570.17    | 634.11     | 330.34     | 296.71     |
| 应收账款账面价值      | 7,815.95  | 11,173.87  | 4,726.18   | 3,776.53   |
| 营业收入          | 19,046.49 | 28,102.42  | 19,075.73  | 7,414.56   |
| 应收账款账面余额/营业收入 | 44.03%    | 42.02%     | 26.51%     | 54.94%     |

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 3,776.53 万元、4,726.18 万元、11,173.87 万元和 **7,815.95 万元**，占各期末流动资产的比例分别为 17.42%、8.60%、17.34% 和 **10.77%**；公司应收账款账面余额占各期营业收入比例分别为 54.94%、

26.51%、42.02%和 **44.03%**。

通常情况下，公司一般与客户约定在订立合同、设备到货、设备验收、质保期满等关键节点分批收取设备款。但对于技术难度高、无销售先例的首台设备，由于相关设备能否最终满足使用要求存在不确定性，部分客户可能选择前期不支付进度款，而在最终设备验收后一次性付款。2022 年度、2024 年度，公司期末应收账款账面余额占当期营业收入的比例相对较高，主要是因为 2022 年、2024 年部分单价较高的首台设备销售在最终验收（确认收入和应收账款）前客户付款进度较慢：（1）2022 年 12 月，公司向客户 A 销售的首台 LIC 设备验收通过并确认收入，相应合同金额截至 2022 年末均作为应收账款列示（不同于复购设备合同约定的“到货后 60 天内付款 90%、验收后付款 10%”，公司向客户 A 销售的首台设备的信用条款为“验收通过后 30 天内支付全款”），导致 2022 年末应收账款账面余额占当年营业收入比例较高；（2）2024 年 12 月，公司分别销售给客户 A、客户 C 的首台 USJLA 设备和首台 LIEG 设备通过验收，对应的设备合同金额均作为应收账款在 2024 年末列示，导致 2024 年末应收账款账面余额占当年营业收入比例较高。

2025 年 8 月，公司向客户 C 销售的首台设备在设备验收通过并在试用期满获得正式采购订单后确认收入。截至 2025 年 9 月 30 日，公司向客户 C 销售首台设备的销售款尚未收回，该台设备单价较高，因此，截至 2025 年 9 月 30 日，公司应收账款账面余额占当期营业收入比例较高。

（2）应收账款余额前五名客户情况

报告期各期末，公司应收账款前五名客户余额及占比情况如下：

单位：万元

| 序号          | 客户名称          | 账面余额     | 占应收账款比例 |
|-------------|---------------|----------|---------|
| 2025. 9. 30 |               |          |         |
| 1           | 客户 C3         | 3,010.32 | 35.90%  |
| 2           | 客户 A          | 596.26   | 7.11%   |
| 3           | 厦门士兰集宏半导体有限公司 | 390.23   | 4.65%   |
| 4           | 理念光电（湖北）有限公司  | 301.91   | 3.60%   |
| 5           | 达迩科技（成都）有限公司  | 300.78   | 3.59%   |
| 合计          |               | 4,599.50 | 54.85%  |

| 序号                | 客户名称            | 账面余额            | 占应收账款比例       |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>2024.12.31</b> |                 |                 |               |
| 1                 | 客户 A            | 5,057.69        | 42.83%        |
| 2                 | 客户 C3           | 2,723.30        | 23.06%        |
| 3                 | 客户 E3           | 349.20          | 2.96%         |
| 4                 | 浙江芯微泰克半导体有限公司   | 298.80          | 2.53%         |
| 5                 | 宜兴中车时代半导体有限公司   | 249.00          | 2.11%         |
| 合计                |                 | <b>8,677.99</b> | <b>73.49%</b> |
| <b>2023.12.31</b> |                 |                 |               |
| 1                 | 华润微电子（重庆）有限公司   | 558.00          | 11.04%        |
| 2                 | 客户 D4           | 342.60          | 6.78%         |
| 3                 | 株洲中车时代半导体股份有限公司 | 306.56          | 6.06%         |
| 4                 | 长沙比亚迪半导体有限公司    | 290.00          | 5.74%         |
| 5                 | 浙江芯微泰克半导体有限公司   | 273.90          | 5.42%         |
| 合计                |                 | <b>1,771.06</b> | <b>35.03%</b> |
| <b>2022.12.31</b> |                 |                 |               |
| 1                 | 客户 A            | 1,580.00        | 38.79%        |
| 2                 | 天水华天科技股份有限公司    | 491.13          | 12.06%        |
| 3                 | 四川遂宁市利普芯微电子有限公司 | 364.72          | 8.95%         |
| 4                 | 上海英晓实业有限公司      | 208.88          | 5.13%         |
| 5                 | 华天科技（宝鸡）有限公司    | 178.39          | 4.38%         |
| 合计                |                 | <b>2,823.12</b> | <b>69.31%</b> |

报告期各期末，公司应收账款前五名客户余额分别为 2,823.12 万元、1,771.06 万元、8,677.99 万元和 **4,599.50 万元**，合计占比分别为 69.31%、35.03%、73.49% 和 **54.85%**。2023 年，公司销售给客户 A 的设备均为 LIC 复购设备，相关合同约定的信用条款均为“到货后 60 天内付款 90%、验收后付款 10%”，大部分设备款在验收当年均已收回，因此 2023 年末，公司应收客户 A 款项金额较低，应收账款在各客户之间分布较为分散，应收账款前五名客户合计占比较低。

截至 2024 年末，公司应收客户 A、客户 C 款项分别为 5,057.69 万元、2,723.30 万元，分别为公司向客户 A 销售的首台设备和向客户 C 销售的首台设备的销售款。相关设备单价及设备销售收入占公司整体销售收入比例较高，导致 2024 年末公司应收款项欠款方相对集中，前五名欠款方应收账款占比高达 73.49%。



2025 年 1-9 月，公司向客户 A 销售的设备均为复购设备，大部分设备款已在设备完成验收前收回，因此截至 2025 年 9 月 30 日，公司应收客户 A 账款金额较低。总体来看，截至 2025 年 9 月 30 日，公司应收客户 A 账款金额较 2024 年末大幅下降，公司前五名应收账款欠款方合计占比较 2024 年末有所降低。

公司应收账款客户主要为行业知名企业，资金实力雄厚、商业信誉良好，相关应收账款回收不存在重大风险。

（3）应收账款账龄分析及坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款账龄情况如下：

单位：万元

| 账龄              | 2025. 9. 30 |         | 2024.12.31 |         | 2023.12.31 |         | 2022.12.31 |         |
|-----------------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                 | 账面余额        | 占比      | 账面余额       | 占比      | 账面余额       | 占比      | 账面余额       | 占比      |
| 6 个月以内（含 6 个月）  | 6,085.64    | 72.57%  | 9,688.20   | 82.05%  | 3,899.59   | 77.12%  | 2,822.54   | 69.29%  |
| 7 个月-1 年（含 1 年） | 983.18      | 11.72%  | 345.84     | 2.93%   | 112.52     | 2.23%   | 754.26     | 18.52%  |
| 1-2 年（含 2 年）    | 870.75      | 10.38%  | 1,397.25   | 11.83%  | 848.64     | 16.78%  | 233.38     | 5.73%   |
| 2-3 年（含 3 年）    | 223.63      | 2.67%   | 188.02     | 1.59%   | 41.71      | 0.82%   | 49.00      | 1.20%   |
| 3-4 年（含 4 年）    | 63.36       | 0.76%   | 35.18      | 0.30%   | 20.35      | 0.40%   | 69.88      | 1.72%   |
| 4-5 年（含 5 年）    | 25.03       | 0.30%   | 20.35      | 0.17%   | 36.40      | 0.72%   | 79.46      | 1.95%   |
| 5 年以上           | 134.53      | 1.60%   | 133.12     | 1.13%   | 97.30      | 1.92%   | 64.73      | 1.59%   |
| 小计              | 8,386.12    | 100.00% | 11,807.98  | 100.00% | 5,056.52   | 100.00% | 4,073.24   | 100.00% |
| 坏账准备            | 570.17      | 6.80%   | 634.11     | 5.37%   | 330.34     | 6.53%   | 296.71     | 7.28%   |
| 合计              | 7,815.95    |         | 11,173.87  |         | 4,726.18   |         | 3,776.53   |         |

报告期各期末，公司应收账款的账龄主要在 2 年及以内，合计占应收账款账面余额的比例分别为 93.54%、96.13%、96.81%和 94.68%，整体账龄较短。

报告期各期末，公司应收账款按类别计提坏账准备情况如下：

单位：万元

| 2025. 9. 30 |      |    |      |      |      |
|-------------|------|----|------|------|------|
| 项目          | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|             | 金额   | 占比 | 金额   | 计提比例 |      |

| 按单项计提坏账准备  | 60.30     | 0.72%   | 60.30  | 100.00% | -         |
|------------|-----------|---------|--------|---------|-----------|
| 按组合计提坏账准备  | 8,325.82  | 99.28%  | 509.87 | 6.12%   | 7,815.95  |
| 其中：账龄组合    | 8,325.82  | 99.28%  | 509.87 | 6.12%   | 7,815.95  |
| 合计         | 8,386.12  | 100.00% | 570.17 | 6.80%   | 7,815.95  |
| 2024.12.31 |           |         |        |         |           |
| 项目         | 账面余额      |         | 坏账准备   |         | 账面价值      |
|            | 金额        | 占比      | 金额     | 计提比例    |           |
| 按单项计提坏账准备  | 62.90     | 0.53%   | 62.90  | 100.00% | -         |
| 按组合计提坏账准备  | 11,745.08 | 99.47%  | 571.21 | 4.86%   | 11,173.87 |
| 其中：账龄组合    | 11,745.08 | 99.47%  | 571.21 | 4.86%   | 11,173.87 |
| 合计         | 11,807.98 | 100.00% | 634.11 | 5.37%   | 11,173.87 |
| 2023.12.31 |           |         |        |         |           |
| 项目         | 账面余额      |         | 坏账准备   |         | 账面余额      |
|            | 金额        | 占比      | 金额     | 计提比例    |           |
| 按单项计提坏账准备  | -         | -       | -      | -       | -         |
| 按组合计提坏账准备  | 5,056.52  | 100.00% | 330.34 | 6.53%   | 4,726.18  |
| 其中：账龄组合    | 5,056.52  | 100.00% | 330.34 | 6.53%   | 4,726.18  |
| 合计         | 5,056.52  | 100.00% | 330.34 | 6.53%   | 4,726.18  |
| 2022.12.31 |           |         |        |         |           |
| 项目         | 账面余额      |         | 坏账准备   |         | 账面余额      |
|            | 金额        | 占比      | 金额     | 计提比例    |           |
| 按单项计提坏账准备  | -         | -       | -      | -       | -         |
| 按组合计提坏账准备  | 4,073.24  | 100.00% | 296.71 | 7.28%   | 3,776.53  |
| 其中：账龄组合    | 4,073.24  | 100.00% | 296.71 | 7.28%   | 3,776.53  |
| 合计         | 4,073.24  | 100.00% | 296.71 | 7.28%   | 3,776.53  |

报告期各期末，公司按照应收账款账龄组合计提坏账准备的具体情况如下：

单位：万元

| 账龄          | 2025. 9. 30 |        | 2024.12.31 |        | 2023.12.31 |        | 2022.12.31 |        |
|-------------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|             | 坏账准备        | 计提比例   | 坏账准备       | 计提比例   | 坏账准备       | 计提比例   | 坏账准备       | 计提比例   |
| 6个月以内（含6个月） | 60.86       | 1.00%  | 96.88      | 1.00%  | 39.00      | 1.00%  | 28.23      | 1.00%  |
| 7个月-1年（含1年） | 49.16       | 5.00%  | 17.29      | 5.00%  | 5.63       | 5.00%  | 37.71      | 5.00%  |
| 1-2年（含2年）   | 130.61      | 15.00% | 200.15     | 15.00% | 127.30     | 15.00% | 35.01      | 15.00% |

| 账龄           | 2025. 9. 30 |          | 2024.12.31 |         | 2023.12.31 |         | 2022.12.31 |         |
|--------------|-------------|----------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|              | 坏账准备        | 计提比例     | 坏账准备       | 计提比例    | 坏账准备       | 计提比例    | 坏账准备       | 计提比例    |
| 2-3 年（含 3 年） | 73. 50      | 45. 00%  | 84.61      | 45.00%  | 18.77      | 45.00%  | 22.05      | 45.00%  |
| 3-4 年（含 4 年） | 41. 19      | 65. 00%  | 22.87      | 65.00%  | 13.23      | 65.00%  | 45.42      | 65.00%  |
| 4-5 年（含 5 年） | 20. 02      | 80. 00%  | 16.28      | 80.00%  | 29.12      | 80.00%  | 63.57      | 80.00%  |
| 5 年以上        | 134. 53     | 100. 00% | 133.12     | 100.00% | 97.30      | 100.00% | 64.73      | 100.00% |
| 合计           | 509. 87     | 6. 12%   | 571.21     | 4.86%   | 330.34     | 6.53%   | 296.71     | 7.28%   |

公司结合应收账款历史坏账损失记录、主要客户资信状况及其业务发展情况，合理判断预期信用损失率。在确定公司报告期各期末应收账款预期信用损失率的基础上，公司对同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例进行了对比分析，基于谨慎性原则及行业惯例，公司最终确定了报告期各期末应收账款坏账准备计提比例。公司对预期信用损失的确定方法请参见本节之“二、重要会计政策及会计估计”之“（三）金融工具”。

公司应收账款的坏账准备计提政策与可比公司的对比情况如下：

| 账龄      | 本公司     | 中微公司    | 芯源微     | 拓荆科技    | 华海清科    | 屹唐股份    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6 个月以内  | 1.00%   | 1.00%   | 5.00%   | 1.00%   | 1.00%   | 1.00%   |
| 7-12 个月 | 5.00%   | 5.00%   | 5.00%   | 5.00%   | 5.00%   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 15.00%  | 15.00%  | 10.00%  | 15.00%  | 15.00%  | 15.00%  |
| 2 至 3 年 | 45.00%  | 20.00%  | 30.00%  | 20.00%  | 20.00%  | 50.00%  |
| 3 至 4 年 | 65.00%  | 30.00%  | 50.00%  | 30.00%  | 30.00%  | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 80.00%  | 50.00%  | 80.00%  | 50.00%  | 50.00%  | 100.00% |
| 5 年以上   | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

数据来源：可比公司招股说明书、定期公告

如上表所示，公司的应收账款坏账计提比例相较于可比公司不存在重大差异，坏账计提政策谨慎。

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025. 9. 30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|----|-------------|------------|------------|------------|
|----|-------------|------------|------------|------------|

|              | 金额       | 占比      | 金额       | 占比      | 金额     | 占比      | 金额     | 占比      |
|--------------|----------|---------|----------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,154.76 | 95.33%  | 1,596.88 | 94.76%  | 902.81 | 99.85%  | 680.85 | 97.83%  |
| 1-2 年（含 2 年） | 50.59    | 4.18%   | 88.04    | 5.22%   | 1.04   | 0.12%   | 15.09  | 2.17%   |
| 2-3 年（含 3 年） | 5.60     | 0.46%   | 0.32     | 0.02%   | 0.34   | 0.04%   | 0.04   | 0.01%   |
| 3 年以上        | 0.32     | 0.03%   | -        | -       | -      | -       | -      | -       |
| 合计           | 1,211.28 | 100.00% | 1,685.24 | 100.00% | 904.20 | 100.00% | 695.98 | 100.00% |

公司预付款项性质主要为预付货款。报告期各期末，公司预付款项分别为 695.98 万元、904.20 万元、1,685.24 万元和 **1,211.28 万元**，占各期末流动资产的比例分别为 3.21%、1.65%、2.62%和 **1.67%**，主要为账龄 1 年以内的预付款项。

## 6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款的情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|
| 押金及保证金   | 364.65    | 253.02     | 173.51     | 138.27     |
| 应收关联方往来款 | -         | -          | -          | 1,124.88   |
| 应退税款     | 0.71      | 0.40       | -          | -          |
| 备用金      | 15.12     | 0.44       | 0.86       | 37.90      |
| 小计       | 380.48    | 253.86     | 174.37     | 1,301.05   |
| 减：坏账准备   | 50.53     | 58.88      | 30.30      | 33.14      |
| 合计       | 329.95    | 194.98     | 144.07     | 1,267.91   |

报告期各期末，公司其他应收款金额分别为 1,267.91 万元、144.07 万元、194.98 万元和 **329.95 万元**，占各期末流动资产的比例分别为 5.85%、0.26%、0.30%和 **0.45%**，主要包括应收关联方往来款、押金及保证金、备用金和应退税款。

2022 年末，其他应收款中的应收关联方往来款主要为应收股东分红退款，详细情况请参见本节之“八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（五）股利分配情况”。

报告期各期末，公司其他应收款账龄及坏账准备的具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|----|-----------|------------|------------|------------|
|----|-----------|------------|------------|------------|

|           | 金额     | 占比      | 金额     | 占比      | 金额     | 占比      | 金额       | 占比      |
|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------|---------|
| 1年以内（含1年） | 275.90 | 72.51%  | 109.12 | 42.99%  | 80.37  | 46.09%  | 1,238.44 | 95.19%  |
| 1-2年（含2年） | 51.31  | 13.48%  | 57.63  | 22.70%  | 53.54  | 30.71%  | 62.30    | 4.79%   |
| 2-3年（含3年） | 8.33   | 2.19%   | 49.65  | 19.56%  | 40.16  | 23.03%  | 0.30     | 0.02%   |
| 3年以上      | 44.95  | 11.81%  | 37.46  | 14.76%  | 0.30   | 0.17%   | -        | -       |
| 小计        | 380.48 | 100.00% | 253.86 | 100.00% | 174.37 | 100.00% | 1,301.05 | 100.00% |
| 减：坏账准备    | 50.53  | 13.28%  | 58.88  | 23.19%  | 30.30  | 17.38%  | 33.14    | 2.55%   |
| 合计        | 329.95 |         | 194.98 |         | 144.07 |         | 1,267.91 |         |

## 7、存货

### （1）存货构成情况

报告期各期末，公司存货账面价值具体构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2025.9.30 |         | 2024.12.31 |         | 2023.12.31 |         | 2022.12.31 |         |
|--------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|        | 金额        | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      |
| 原材料    | 5,505.29  | 19.74%  | 3,763.85   | 20.38%  | 3,969.76   | 29.77%  | 1,310.22   | 14.49%  |
| 在产品    | 5,488.31  | 19.67%  | 3,003.84   | 16.26%  | 2,481.88   | 18.61%  | 1,538.09   | 17.01%  |
| 库存商品   | 999.28    | 3.58%   | 317.81     | 1.72%   | 1,486.72   | 11.15%  | 612.30     | 6.77%   |
| 发出商品   | 15,850.79 | 56.82%  | 11,375.88  | 61.58%  | 5,361.67   | 40.21%  | 5,564.36   | 61.53%  |
| 委托加工物资 | 2.70      | 0.01%   | 7.38       | 0.04%   | 18.58      | 0.14%   | -          | -       |
| 合同履约成本 | 49.49     | 0.18%   | 3.45       | 0.02%   | 15.83      | 0.12%   | 18.65      | 0.21%   |
| 合计     | 27,895.87 | 100.00% | 18,472.20  | 100.00% | 13,334.44  | 100.00% | 9,043.63   | 100.00% |

公司存货主要由原材料、在产品和发出商品构成。报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 9,043.63 万元、13,334.44 万元、18,472.20 万元和 **27,895.87 万元**，占各期末流动资产的比例分别为 41.72%、24.27%、28.67%和 **38.45%**，是流动资产的重要组成部分。

公司整体采用“以销定产”、“以产定采”的生产与采购模式，同时基于保持安全库存的需求进行适当备货。

随着客户范围的拓展和经营规模的扩大，公司存货规模，尤其是发出商品规模增长较快。报告期各期末，公司发出商品均为发往客户处尚未验收的设备产品。

根据业务流程，公司设备产品发往客户现场后，需经历安装、调试及各项指标验证后方可完成验收。受到公司设备复杂程度与定制化程度、客户产线建设进度、内部验收流程与标准等因素的影响，公司激光热处理设备和专用激光加工设备的验收周期存在波动。

公司存货中的委托加工物资规模较小，主要为委托生产的 PCB 板等材料。合同履约成本为未验收的设备改造、配件销售、设备维修等业务的成本。

受到公司整体业务规模扩大、下游客户对公司设备验收周期等因素的影响，公司截至 2025 年 9 月 30 日的原材料、在产品及发出商品等各类存货金额较 2024 年末均存在较大幅度增加。

(2) 存货跌价准备计提情况

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2025. 9. 30 |          |           |
|--------|-------------|----------|-----------|
|        | 账面余额        | 存货跌价准备   | 账面价值      |
| 原材料    | 5,685.95    | 180.66   | 5,505.29  |
| 在产品    | 5,595.92    | 107.61   | 5,488.31  |
| 库存商品   | 1,215.38    | 216.10   | 999.28    |
| 发出商品   | 16,950.47   | 1,099.68 | 15,850.79 |
| 委托加工物资 | 2.70        | -        | 2.70      |
| 合同履约成本 | 78.23       | 28.74    | 49.49     |
| 合计     | 29,528.66   | 1,632.79 | 27,895.87 |
| 项目     | 2024.12.31  |          |           |
|        | 账面余额        | 存货跌价准备   | 账面价值      |
| 原材料    | 3,883.50    | 119.65   | 3,763.85  |
| 在产品    | 3,034.41    | 30.57    | 3,003.84  |
| 库存商品   | 504.05      | 186.24   | 317.81    |
| 发出商品   | 11,645.68   | 269.81   | 11,375.88 |
| 委托加工物资 | 7.38        | -        | 7.38      |
| 合同履约成本 | 3.71        | 0.27     | 3.45      |
| 合计     | 19,078.74   | 606.53   | 18,472.20 |
| 项目     | 2023.12.31  |          |           |



|        | 账面余额       | 存货跌价准备 | 账面价值      |
|--------|------------|--------|-----------|
| 原材料    | 4,060.11   | 90.35  | 3,969.76  |
| 在产品    | 2,587.34   | 105.46 | 2,481.88  |
| 库存商品   | 1,594.34   | 107.62 | 1,486.72  |
| 发出商品   | 5,442.17   | 80.50  | 5,361.67  |
| 委托加工物资 | 18.58      | -      | 18.58     |
| 合同履约成本 | 20.02      | 4.19   | 15.83     |
| 合计     | 13,722.56  | 388.11 | 13,334.44 |
| 项目     | 2022.12.31 |        |           |
|        | 账面余额       | 存货跌价准备 | 账面价值      |
| 原材料    | 1,355.23   | 45.01  | 1,310.22  |
| 在产品    | 1,600.89   | 62.80  | 1,538.09  |
| 库存商品   | 626.47     | 14.17  | 612.30    |
| 发出商品   | 5,606.32   | 41.96  | 5,564.36  |
| 合同履约成本 | 21.38      | 2.73   | 18.65     |
| 合计     | 9,210.29   | 166.66 | 9,043.63  |

报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为 166.66 万元、388.11 万元、606.53 万元和 **1,632.79 万元**，占存货账面余额的比例分别为 1.81%、2.83%、3.18% 和 **5.53%**，公司存货质量状况良好。公司存货按照成本与可变现净值孰低原则计量，结合产品预计售价及在手订单情况等因素，对成本大于可变现净值的存货计提跌价准备，跌价计提情况符合公司实际情况，公司的存货跌价准备计提充分。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司针对发出商品计提的存货跌价准备较 2024 年末大幅增加，具体情况参见本节之“六、经营成果分析”之“（六）影响经营成果的其他项目分析”之“3、资产及信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

## 8、合同资产

报告期各期末，公司的合同资产情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 合同质保金  | 631.81    | 390.29     | 745.63     | 327.37     |
| 减：减值准备 | 25.12     | 7.67       | 19.03      | 9.68       |
| 小计     | 606.69    | 382.62     | 726.60     | 317.68     |

|                   |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| 减：列示为其他非流动资产的合同资产 | 80.21  | 83.82  | 7.10   | 39.60  |
| 合计                | 526.48 | 298.79 | 719.49 | 278.08 |

合同资产主要核算公司销售设备的质保金。报告期各期末，公司的合同资产账面价值分别为 278.08 万元、719.49 万元、298.79 万元和 **526.48 万元**，占流动资产的比例分别为 1.28%、1.31%、0.46%和 **0.73%**。公司将到期时间一年以上的合同资产作为其他非流动资产列示。

9、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2025.9.30 |         | 2024.12.31 |         | 2023.12.31 |         | 2022.12.31 |         |
|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|         | 账面价值      | 占比      | 账面价值       | 占比      | 账面价值       | 占比      | 账面价值       | 占比      |
| 预缴所得税   | 98.76     | 0.48%   | -          | -       | 94.32      | 0.83%   | 300.89     | 34.07%  |
| 预缴增值税   | 329.65    | 1.60%   | 508.80     | 2.79%   | 508.80     | 4.50%   | 208.32     | 23.59%  |
| 增值税进项税  | 491.30    | 2.38%   | 552.62     | 3.04%   | 708.81     | 6.27%   | 374.04     | 42.35%  |
| 预付上市费用  | 669.81    | 3.24%   |            |         |            |         |            |         |
| 定期存单及利息 | 19,076.73 | 92.31%  | 17,144.68  | 94.17%  | 10,001.83  | 88.40%  | -          | -       |
| 合计      | 20,666.26 | 100.00% | 18,206.09  | 100.00% | 11,313.76  | 100.00% | 883.25     | 100.00% |

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 883.25 万元、11,313.76 万元、18,206.09 万元和 **20,666.26 万元**，占各期末流动资产的比例分别为 4.07%、20.59%、28.25%和 **28.49%**，主要包括预缴增值税、预缴所得税、增值税进项税、定期存单及利息及预付上市费用。截至 2025 年 9 月 30 日，公司其他流动资产较 2024 年末增加 2,460.17 万元，主要是因为定期存单及利息金额增加 1,932.05 万元且新增预付上市费用 669.81 万元。

（三）非流动资产构成及其变化分析

报告期各期末，公司非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.9.30 |    | 2024.12.31 |    | 2023.12.31 |    | 2022.12.31 |    |
|----|-----------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
|    | 金额        | 占比 | 金额         | 占比 | 金额         | 占比 | 金额         | 占比 |

|         |           |         |           |         |           |         |          |         |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| 固定资产    | 34,851.92 | 83.56%  | 2,958.95  | 7.75%   | 3,210.95  | 27.54%  | 897.34   | 30.60%  |
| 在建工程    | -         | -       | 28,371.75 | 74.27%  | 2,856.24  | 24.50%  | -        | -       |
| 使用权资产   | 402.86    | 0.97%   | 435.98    | 1.14%   | 494.85    | 4.24%   | 707.66   | 24.13%  |
| 无形资产    | 925.31    | 2.22%   | 959.22    | 2.51%   | 918.45    | 7.88%   | 14.20    | 0.48%   |
| 长期待摊费用  | 167.64    | 0.40%   | 303.04    | 0.79%   | 469.53    | 4.03%   | 572.86   | 19.53%  |
| 递延所得税资产 | 2,260.47  | 5.42%   | 1,867.72  | 4.89%   | 805.13    | 6.91%   | 628.68   | 21.44%  |
| 其他非流动资产 | 3,101.64  | 7.44%   | 3,303.58  | 8.65%   | 2,904.37  | 24.91%  | 112.07   | 3.82%   |
| 非流动资产合计 | 41,709.84 | 100.00% | 38,200.22 | 100.00% | 11,659.52 | 100.00% | 2,932.81 | 100.00% |

报告期各期末，公司非流动资产分别为 2,932.81 万元、11,659.52 万元、38,200.22 万元和 41,709.84 万元，呈现快速增长趋势，占资产总额的比例分别为 11.92%、17.50%、37.22%和 36.51%。

## 1、固定资产

### （1）固定资产构成情况

报告期各期末，公司固定资产的具体分类情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2025.9.30  |          |      |           |
|---------|------------|----------|------|-----------|
|         | 原值         | 累计折旧     | 减值准备 | 账面价值      |
| 房屋及建筑物  | 30,803.04  | 670.28   | -    | 30,132.76 |
| 机器设备    | 7,157.44   | 3,001.12 | -    | 4,156.32  |
| 运输工具    | 120.45     | 33.70    | -    | 86.75     |
| 办公设备及其他 | 642.41     | 166.33   | -    | 476.08    |
| 合计      | 38,723.33  | 3,871.42 | -    | 34,851.92 |
| 项目      | 2024.12.31 |          |      |           |
|         | 原值         | 累计折旧     | 减值准备 | 账面价值      |
| 机器设备    | 4,822.08   | 2,177.22 | -    | 2,644.86  |
| 运输工具    | 122.42     | 25.02    | -    | 97.40     |
| 办公设备及其他 | 327.30     | 110.62   | -    | 216.69    |
| 合计      | 5,271.80   | 2,312.85 | -    | 2,958.95  |
| 项目      | 2023.12.31 |          |      |           |
|         | 原值         | 累计折旧     | 减值准备 | 账面价值      |

|         |                 |                 |      |                 |
|---------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
| 机器设备    | 3,989.11        | 1,032.18        | -    | 2,956.93        |
| 运输工具    | 95.57           | 15.55           | -    | 80.02           |
| 办公设备及其他 | 235.66          | 61.65           | -    | 174.00          |
| 合计      | <b>4,320.33</b> | <b>1,109.38</b> | -    | <b>3,210.95</b> |
| 项目      | 2022.12.31      |                 |      |                 |
|         | 原值              | 累计折旧            | 减值准备 | 账面价值            |
| 机器设备    | 1,226.92        | 460.39          | -    | 766.53          |
| 运输工具    | 30.92           | 6.22            | -    | 24.69           |
| 办公设备及其他 | 137.29          | 31.17           | -    | 106.12          |
| 合计      | <b>1,395.12</b> | <b>497.78</b>   | -    | <b>897.34</b>   |

公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为897.34万元、3,210.95万元、2,958.95万元和**34,851.92万元**。报告期内，随着公司经营规模扩大，公司经营所需机器设备及办公设备有所增加。**2025年9月30日，公司固定资产账面价值大幅增加，主要系“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房产于2025年1-9月转固，导致房屋及建筑物金额大幅上升。**

## （2）固定资产折旧政策及同行业分析比较

公司固定资产折旧采用年限平均法计提，并于每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。报告期内，公司与可比公司固定资产折旧政策的对比情况如下：

| 公司名称 | 资产类别     | 折旧方法  | 折旧年限   | 净残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|------|----------|-------|--------|---------|-------------|
| 发行人  | 房屋及建筑物   | 年限平均法 | 10-20年 | 3       | 4.85-9.70   |
|      | 机器设备     | 年限平均法 | 2-10年  | 3       | 9.70-48.50  |
|      | 运输工具     | 年限平均法 | 2-10年  | 3       | 9.70-48.50  |
|      | 办公设备及其他  | 年限平均法 | 5-10年  | 3       | 9.70-19.40  |
| 中微公司 | 房屋及建筑物   | 年限平均法 | 10-30年 | 5       | 3.17-9.50   |
|      | 机器设备     | 年限平均法 | 3-7年   | 0-5     | 13.57-33.33 |
|      | 计算机及电子设备 | 年限平均法 | 3-10年  | 5       | 9.50-31.67  |
|      | 办公设备     | 年限平均法 | 3年     | 0       | 33.33       |
|      | 运输工具     | 年限平均法 | 5年     | 5       | 19.00       |
| 芯源微  | 房屋及建筑物   | 年限平均法 | 20年    | 5       | 4.75        |

| 公司名称 | 资产类别   | 折旧方法  | 折旧年限    | 净残值率（%） | 年折旧率（%）      |
|------|--------|-------|---------|---------|--------------|
|      | 机器设备   | 年限平均法 | 5-10 年  | 5       | 9.50-19.00   |
|      | 电子设备   | 年限平均法 | 5 年     | 5       | 19.00        |
|      | 办公设备   | 年限平均法 | 5 年     | 5       | 19.00        |
|      | 运输工具   | 年限平均法 | 10 年    | 5       | 9.50         |
| 拓荆科技 | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年    | 5       | 4.75         |
|      | 通用设备   | 年限平均法 | 3-5 年   | 5       | 19.00-31.67  |
|      | 专用设备   | 年限平均法 | 5-10 年  | 5       | 9.50-19.00   |
|      | 运输工具   | 年限平均法 | 4 年     | 5       | 23.75        |
| 华海清科 | 机器设备   | 年限平均法 | 10 年    | 3       | 9.70         |
|      | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-40 年 | 3       | 2.43-3.23    |
|      | 电子设备   | 年限平均法 | 3 年     | 3       | 32.33        |
|      | 办公设备   | 年限平均法 | 5 年     | 3       | 19.40        |
|      | 器具工具家具 | 年限平均法 | 5 年     | 3       | 19.40        |
|      | 运输设备   | 年限平均法 | 4 年     | 3       | 24.25        |
| 屹唐股份 | 房屋建筑物  | 年限平均法 | 20-40 年 | 0-5     | 2.38-5.00    |
|      | 机器设备   | 年限平均法 | 3-10 年  | 0-5     | 9.50-33.33   |
|      | 办公设备   | 年限平均法 | 1-5 年   | 0-5     | 19.00-100.00 |
|      | 运输工具   | 年限平均法 | 4-6 年   | 0-5     | 15.83-25.00  |

数据来源：可比公司招股说明书、定期公告

公司固定资产折旧政策符合公司业务特点及生产经营模式，与同行业可比公司相比不存在重大差异。

2、在建工程

报告期各期末，公司在建工程情况如下：

单位：万元

| 项目                  | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目 | -         | 27,574.98  | 2,856.24   | -          |
| 在安装调试设备             | -         | 131.48     | -          | -          |
| 自制研发固定资产            | -         | 665.29     | -          | -          |
| 合计                  | -         | 28,371.75  | 2,856.24   | -          |

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 0.00 万元、2,856.24 万元、28,371.75 万元和 0.00 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 0.00%、24.50%、

74.27%和 0.00%。

公司“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”建设内容主要为新建公司总部及研发生产基地。2023 年末、2024 年末，公司通过“在建工程”科目归集核算该项目达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括基建施工费、安装费、设计费、监理费、土地使用权摊销和资本化的项目专项贷款利息费用等。公司“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房建设及装修工程分别已于 2025 年 3 月、2025 年 8 月达到预定可使用状态并转入固定资产。

2024 年末，公司在建工程中在安装调试设备主要为报告期内公司购置的尚未达到预定可使用状态的机器设备。

2024 年末，公司在建工程中自制研发固定资产为公司搭建的 1 台 USJLA 超浅结激光退火设备，后续拟用于国产供应链验证、设备持续改进和新工艺开发等研发课题中。该台设备于 2025 年 3 月搭建完成并转入固定资产。

报告期各期末，公司未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 707.66 万元、494.85 万元、435.98 万元和 402.86 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 24.13%、4.24%、1.14%和 0.97%，均为房屋及建筑物的租赁。

4、无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

| 单位：万元 |           |            |            |            |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 项目    | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
| 土地使用权 | 665.05    | 692.76     | 729.70     | -          |
| 软件    | 260.27    | 266.46     | 188.74     | 14.20      |
| 合计    | 925.31    | 959.22     | 918.45     | 14.20      |

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 14.20 万元、918.45 万元、959.22 万元和 925.31 万元，占各期末非流动资产的比例分别为 0.48%、7.88%、2.51%和 2.22%。公司无形资产中土地使用权的具体情况请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、发行人的主要资产情况”之“（二）公司主要无形资产”



之“4、土地使用权”。

报告期各期末，公司无形资产均处于正常使用状态，不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 5、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 572.86 万元、469.53 万元、303.04 万元和 **167.64 万元**，占各期末非流动资产的比例分别为 19.53%、4.03%、0.79% 和 **0.40%**。长期待摊费用包括公司装修费、阿里云服务和电力设备维护费。

## 6、递延所得税资产、递延所得税负债

报告期各期末，公司未经抵消的递延所得税资产构成情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2025.9.30       |                | 2024.12.31      |                | 2023.12.31    |                | 2022.12.31    |                |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|           | 金额              | 占比             | 金额              | 占比             | 金额            | 占比             | 金额            | 占比             |
| 资产减值准备    | <b>342.39</b>   | <b>14.55%</b>  | 196.73          | 10.02%         | 115.33        | 12.96%         | 75.93         | 10.33%         |
| 内部交易未实现利润 | <b>16.59</b>    | <b>0.71%</b>   | 21.57           | 1.10%          | 24.25         | 2.73%          | 8.45          | 1.15%          |
| 可抵扣亏损     | <b>188.83</b>   | <b>8.03%</b>   | 94.22           | 4.80%          | 61.77         | 6.94%          | 446.70        | 60.79%         |
| 政府补助      | <b>1,045.20</b> | <b>44.42%</b>  | 1,045.20        | 53.23%         | 358.05        | 40.25%         | -             | -              |
| 租赁负债      | <b>57.34</b>    | <b>2.44%</b>   | 64.85           | 3.30%          | 73.52         | 8.26%          | 107.49        | 14.63%         |
| 固定资产加速折旧  | <b>281.21</b>   | <b>11.95%</b>  | 187.76          | 9.56%          | 78.80         | 8.86%          | 35.87         | 4.88%          |
| 预计负债      | <b>314.92</b>   | <b>13.39%</b>  | 284.66          | 14.50%         | 138.63        | 15.58%         | 43.87         | 5.97%          |
| 应付职工薪酬    | <b>106.30</b>   | <b>4.52%</b>   | 68.48           | 3.49%          | 39.24         | 4.41%          | 16.52         | 2.25%          |
| 合计        | <b>2,352.78</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,963.48</b> | <b>100.00%</b> | <b>889.59</b> | <b>100.00%</b> | <b>734.83</b> | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司递延所得税资产余额分别为 734.83 万元、889.59 万元、1,963.48 万元和 **2,352.78 万元**，主要系因可抵扣亏损、政府补助、资产减值准备、应付职工薪酬、固定资产加速折旧及预计负债等产生的可抵扣暂时性差异形成。

报告期各期末，公司未经抵消的递延所得税负债构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025.9.30 |    | 2024.12.31 |    | 2023.12.31 |    | 2022.12.31 |    |
|----|-----------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
|    | 金额        | 占比 | 金额         | 占比 | 金额         | 占比 | 金额         | 占比 |

| 项目                | 2025.9.30 |         | 2024.12.31 |         | 2023.12.31 |         | 2022.12.31 |         |
|-------------------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                   | 金额        | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      |
| 交易性金融资产<br>公允价值变动 | 31.88     | 34.54%  | 30.37      | 31.71%  | 10.23      | 12.11%  | -          | -       |
| 使用权资产产生<br>的暂时性差异 | 60.43     | 65.46%  | 65.40      | 68.29%  | 74.23      | 87.89%  | 106.15     | 100.00% |
| 合计                | 92.31     | 100.00% | 95.76      | 100.00% | 84.46      | 100.00% | 106.15     | 100.00% |

报告期各期末，公司递延所得税负债余额分别为 106.15 万元、84.46 万元、95.76 万元和 **92.31 万元**，主要系因使用权资产确认产生的可抵扣暂时性差异形成。报告期各期末，公司以抵消后净额列示的递延所得税资产金额分别为 628.68 万元、805.13 万元、1,867.72 万元和 **2,260.47 万元**。

### 7、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 112.07 万元、2,904.37 万元、3,303.58 万元和 **3,101.64 万元**，占各期末非流动资产的比例分别为 3.82%、24.91%、8.65%和 **7.44%**，具体情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 长期资产预付款   | 921.76    | 1,160.28   | 2,897.27   | 72.47      |
| 合同资产      | 80.21     | 83.82      | 7.10       | 39.60      |
| 大额定期存单及利息 | 2,099.67  | 2,059.48   | -          | -          |
| 合计        | 3,101.64  | 3,303.58   | 2,904.37   | 112.07     |

长期资产预付款主要为公司因“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”而预付的工程建设相关款项。公司将一年以上的合同资产及大额定期存单及利息作为其他非流动资产列示。

### （四）资产周转能力分析

报告期各期，公司主要资产周转情况指标如下：

| 项目         | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------------|--------------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次） | 1.89         | 3.33    | 4.18    | 2.48    |
| 存货周转率（次）   | 0.38         | 0.77    | 0.92    | 0.60    |

#### 1、应收账款周转能力分析

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 2.48 次、4.18 次、3.33 次和 **1.89**

次。2023 年，公司应收账款周转率较 2022 年较大幅度提高，主要是因为公司 2023 年激光热处理设备收入占比提升较大，而该类设备产品下游客户主要为国内领先晶圆制造商，与公司约定的信用条款以“在签订合同、发货、到货等设备验收前时点即收取大部分合同金额”为主。由于第四季度收入占比较高、期末应收账款金额较大，2024 年公司应收账款周转率较 2023 年有所下降。2025 年 1-9 月，公司应收账款周转率与 2024 年全年相比较低，主要是因为公司 2025 年 1-9 月营业收入规模较 2024 年全年相比较小，而因向客户 A、客户 C 销售首台 USJLA、LIEG 设备等原因，公司截至 2024 年末与 202 年 9 月 30 日的应收账款规模较大。

2、存货周转能力分析

报告期各期，公司存货周转率分别为 0.60 次、0.92 次、0.77 次和 0.38 次。报告期内，公司存货周转率整体较为稳定，存在小幅波动。公司整体采用“以销定产”、“以产定采”的生产与采购模式，同时基于保持安全库存的需求进行适当备货，报告期各期末存货主要以尚未验收的设备发出商品为主。受到公司设备复杂程度与定制化程度、客户产线建设进度、内部验收流程与标准等因素的影响，公司设备的验收周期存在一定差异，报告期各期公司产品及客户结构的差异导致存货周转率存在一定波动性。2025 年 1-9 月，公司存货周转率较低，主要是因为公司 2025 年 1-9 月营业收入规模较 2024 年全年相比较小，公司期末存货余额亦有所增长。

3、可比公司对比分析

报告期内，公司资产周转情况指标与可比公司的对比情况如下：

| 项目                 | 名称      | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------------------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 应收账款<br>周转率<br>(次) | 中微公司    | 4.68         | 6.98    | 6.83    | 8.15    |
|                    | 芯源微     | 1.97         | 3.00    | 3.90    | 5.24    |
|                    | 拓荆科技    | 3.19         | 3.99    | 6.71    | 9.24    |
|                    | 华海清科    | 4.40         | 5.67    | 5.40    | 6.20    |
|                    | 屹唐股份    | 10.39        | 10.46   | 6.96    | 10.63   |
|                    | 可比公司平均值 | 4.93         | 6.02    | 5.96    | 7.89    |
|                    | 发行人     | 1.89         | 3.33    | 4.18    | 2.48    |
| 存货周转               | 中微公司    | 0.64         | 0.92    | 0.86    | 0.96    |

| 项目   | 名称      | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 率（次） | 芯源微     | 0.30         | 0.63    | 0.69    | 0.79    |
|      | 拓荆科技    | 0.37         | 0.40    | 0.38    | 0.52    |
|      | 华海清科    | 0.50         | 0.67    | 0.56    | 0.45    |
|      | 屹唐股份    | 0.66         | 0.85    | 0.84    | 1.38    |
|      | 可比公司平均值 | 0.49         | 0.69    | 0.67    | 0.82    |
|      | 发行人     | 0.38         | 0.77    | 0.92    | 0.60    |

数据来源：可比公司招股说明书、定期公告

应收账款周转率主要与公司与客户约定的信用条款相关，受下游客户情况、行业惯例、竞争情况等因素影响。对于价格较低的专用激光加工设备，其技术难度相对较低，市场竞争更为激烈，与该类客户约定的信用条件较为宽松，应收账款回款周期较长；对于用于晶圆制造等领域的激光热处理设备，其技术难度更高，客户为领先半导体制造商，参与国际竞争，对供应商付款条款参照国际企业，通常应收账款回收周期较短。此外，对于技术难度高、无销售先例的首台设备，验收前相关设备能否最终满足使用要求存在不确定性，因此部分客户可能选择前期不支付进度款，而在验收后一次性付款，该情形可能导致应收账款金额较大，应收账款周转率下降。

2022 年，公司新增实现用于先进制程集成电路制造的激光热处理设备销售，但销售规模及销售收入占比仍然较低，价格较低的专用激光加工设备收入占比较高，应收账款周转率较低。2023 年，随着公司对中国大陆领先晶圆厂的销售收入增加，公司应收账款周转率显著提升。2024 年 12 月，公司分别销售给客户 A、客户 C 的首台 USJLA 设备、首台 LIEG 设备通过验收，该设备销售信用条款约定的收款时点较晚，导致 2024 年末应收账款账面余额较高，2024 年应收账款周转率下降。2025 年 1-9 月，公司应收账款周转率与 2024 年全年相比较低，主要是因为公司 2025 年 1-9 月营业收入规模较 2024 年全年相比较小，而因首台设备销售原因公司截至 2024 年末与 2025 年 9 月 30 日的应收账款金额较大。

公司报告期内应收账款周转率整体低于可比公司平均水平，主要是因为一方面，报告期内公司整体业务规模较小的情况存在较多无销售先例的首台设备销售而该等设备的收款时点一般较晚；另一方面，受到行业惯例、市场竞争等因素影

响，公司与部分专用激光加工设备客户所约定的信用条款较为宽松。

报告期内，公司存货周转率与同行业可比公司相比不存在重大差异。

## 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

### （一）负债构成及其变化分析

报告期各期末，公司负债按流动性划分的构成情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2025. 9. 30 |         | 2024.12.31 |         | 2023.12.31 |         | 2022.12.31 |         |
|-------|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|       | 金额          | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      |
| 流动负债  | 32,205.16   | 53.86%  | 25,360.35  | 51.29%  | 12,597.96  | 65.41%  | 17,937.60  | 97.44%  |
| 非流动负债 | 27,592.71   | 46.14%  | 24,083.91  | 48.71%  | 6,661.47   | 34.59%  | 471.78     | 2.56%   |
| 负债总计  | 59,797.87   | 100.00% | 49,444.26  | 100.00% | 19,259.43  | 100.00% | 18,409.37  | 100.00% |

报告期各期末，公司负债总额分别为 18,409.37 万元、19,259.43 万元、49,444.26 万元和 59,797.87 万元。

### （二）流动负债构成及其变化分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2025. 9. 30 |        | 2024.12.31 |        | 2023.12.31 |        | 2022.12.31 |        |
|-----------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|           | 金额          | 占比     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     |
| 短期借款      | 1,000.76    | 3.11%  | 1,102.37   | 4.35%  | 3,103.33   | 24.63% | 5,506.81   | 30.70% |
| 应付账款      | 8,818.84    | 27.38% | 8,906.98   | 35.12% | 1,460.14   | 11.59% | 2,331.92   | 13.00% |
| 预收账款      | -           | 0.00%  | -          | -      | 7.08       | 0.06%  | -          | -      |
| 合同负债      | 11,363.32   | 35.28% | 5,858.66   | 23.10% | 4,278.19   | 33.96% | 6,717.25   | 37.45% |
| 应付职工薪酬    | 1,766.36    | 5.48%  | 2,053.65   | 8.10%  | 1,162.19   | 9.23%  | 639.78     | 3.57%  |
| 应交税费      | 202.02      | 0.63%  | 545.12     | 2.15%  | 23.68      | 0.19%  | 49.53      | 0.28%  |
| 其他应付款     | 296.33      | 0.92%  | 207.50     | 0.82%  | 80.23      | 0.64%  | 1,742.76   | 9.72%  |
| 一年内到期的非流动 | 6,437.92    | 19.99% | 4,305.16   | 16.98% | 1,221.18   | 9.69%  | 244.80     | 1.36%  |

| 项目     | 2025.9.30 |         | 2024.12.31 |         | 2023.12.31 |         | 2022.12.31 |         |
|--------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|        | 金额        | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      |
| 负债     |           |         |            |         |            |         |            |         |
| 其他流动负债 | 2,319.60  | 7.20%   | 2,380.92   | 9.39%   | 1,261.93   | 10.02%  | 704.74     | 3.93%   |
| 流动负债合计 | 32,205.16 | 100.00% | 25,360.35  | 100.00% | 12,597.96  | 100.00% | 17,937.60  | 100.00% |

报告期各期末，公司流动负债总额分别为 17,937.60 万元、12,597.96 万元、25,360.35 万元和 **32,205.16 万元**，主要由短期借款、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债等构成。

## 1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款构成情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---------|-----------|------------|------------|------------|
| 质押借款    | -         | 50.00      | 1,000.00   | 2,500.00   |
| 保证借款    | 1,000.00  | 1,050.00   | 2,000.00   | 3,000.00   |
| 信用借款    | -         | -          | 100.00     | -          |
| 未到期应付利息 | 0.76      | 2.37       | 3.33       | 6.81       |
| 合计      | 1,000.76  | 1,102.37   | 3,103.33   | 5,506.81   |

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 5,506.81 万元、3,103.33 万元、1,102.37 万元和 **1,000.76 万元**，占流动负债比例分别为 30.70%、24.63%、4.35% 和 **3.11%**。短期借款主要用于公司日常经营和流动性补充。报告期内，短期借款到期偿还导致公司短期借款金额下降。

## 2、应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2025.9.30 |         | 2024.12.31 |         | 2023.12.31 |         | 2022.12.31 |         |
|--------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|        | 金额        | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      |
| 材料、劳务款 | 4,186.16  | 47.47%  | 2,123.86   | 23.84%  | 1,460.14   | 100.00% | 2,287.22   | 98.08%  |
| 工程、设备款 | 4,632.69  | 52.53%  | 6,783.12   | 76.16%  | -          | -       | 44.69      | 1.92%   |
| 合计     | 8,818.84  | 100.00% | 8,906.98   | 100.00% | 1,460.14   | 100.00% | 2,331.92   | 100.00% |

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 2,331.92 万元、1,460.14 万元、



8,906.98 万元和 **8,818.84 万元**，占各期末流动负债的比例分别为 13.00%、11.59%、35.12%和 **27.38%**。

报告期各期末，公司应付材料及劳务款金额分别为 2,287.22 万元、1,460.14 万元、2,123.86 万元和 **4,186.16 万元**，占应付账款总额比例分别为 98.08%、100.00%、23.84%和 **47.47%**。

2024 年末及 **2025 年 9 月 30 日**，公司应付工程、设备款金额较高，主要是因为公司“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房建设、装修相关应付款项大幅增加。

### 3、合同负债

报告期各期末，公司合同负债金额分别为 6,717.25 万元、4,278.19 万元、5,858.66 万元和 **11,363.32 万元**，占各期末流动负债的比例分别为 37.45%、33.96%、23.10%和 **35.28%**，是流动负债的重要组成部分。

公司的合同负债均为预收客户的货款。公司设备在获得客户验收后确认收入，公司将确认收入前收到客户支付的款项均作为合同负债核算。

### 4、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 639.78 万元、1,162.19 万元、2,053.65 万元和 **1,766.36 万元**，占各期末流动负债的比例分别为 3.57%、9.23%、8.10%和 **5.48%**。公司应付职工薪酬主要为应付职工的工资、奖金、津贴和补贴等。报告期内公司应付职工薪酬逐年增加，主要系员工人数以及人均薪酬均有所提升所致。

### 5、应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 49.53 万元、23.68 万元、545.12 万元和 **202.02 万元**，占各期末流动负债的比例分别为 0.28%、0.19%、2.15%和 **0.63%**，整体占比较小。报告期各期末，公司应交税费具体情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 增值税   | 12.29     | 11.87      | 12.19      | 8.44       |
| 企业所得税 | -         | 487.53     | -          | -          |

| 项目      | 2025. 9. 30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|
| 土地使用税   | 3.97        | -          | -          | -          |
| 房产税     | 178.09      | -          | -          | -          |
| 城市维护建设税 | 0.03        | 0.02       | 0.11       | 19.88      |
| 教育费附加   | 0.01        | 0.01       | 0.05       | 8.52       |
| 地方教育费附加 | 0.01        | 0.01       | 0.03       | 5.68       |
| 个人所得税   | 7.62        | 45.69      | 4.74       | 7.00       |
| 印花税     | -           | -          | 6.56       | -          |
| 合计      | 202.02      | 545.12     | 23.68      | 49.53      |

## 6、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款的构成情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2025. 9. 30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|
| 关联方往来款   | 6.87        | 1.61       | 7.38       | 1,707.60   |
| 应付报销款及其他 | 289.46      | 205.89     | 72.85      | 35.16      |
| 合计       | 296.33      | 207.50     | 80.23      | 1,742.76   |

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 1,742.76 万元、80.23 万元、207.50 万元和 **296.33 万元**，占各期末流动负债的比例分别为 9.72%、0.64%、0.82%和 **0.92%**。公司其他应付款主要包括关联方往来款和应付报销款等。

关联方往来款具体情况请参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方与关联交易情况”。

## 7、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债金额分别为 244.80 万元、1,221.18 万元、4,305.16 万元和 **6,437.92 万元**，占各期末流动负债的比例分别为 1.36%、9.69%、16.98%和 **19.99%**。报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元

| 项目         | 2025. 9. 30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 一年内到期的长期借款 | 6,219.23    | 4,019.41   | 1,005.52   | -          |
| 一年内到期的租赁负债 | 218.70      | 285.75     | 215.66     | 244.80     |

| 项目 | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|----|-----------|------------|------------|------------|
| 合计 | 6,437.92  | 4,305.16   | 1,221.18   | 244.80     |

2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月 30 日，公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款，具体情况请参见本节之“八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（三）非流动负债构成及其变化分析”之“1、长期借款”。

8、其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 704.74 万元、1,261.93 万元、2,380.92 万元和 2,319.60 万元，占各期末流动负债的比例分别为 3.93%、10.02%、9.39%和 7.20%。报告期各期末，公司其他流动负债的具体情况如下：

单位：万元

| 项目                  | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 产品质量保证              | 2,099.46  | 1,897.74   | 924.18     | 292.46     |
| 未终止确认的已背书未到期的银行承兑汇票 | 132.11    | 361.16     | 250.57     | 140.82     |
| 待转销项税额              | 88.03     | 122.01     | 87.18      | 72.89      |
| 应付退货款               | -         | -          | -          | 198.58     |
| 合计                  | 2,319.60  | 2,380.92   | 1,261.93   | 704.74     |

报告期各期末，公司其他流动负债中的产品质量保证计提金额分别为 292.46 万元、924.18 万元、1,897.74 万元和 2,099.46 万元。公司将不能合理预计一年以内清偿的保证类质保形成的预计负债列示为其他流动负债。公司报告期内产品质量保证相关负债的计提情况请参见本节“六、经营成果分析”之“（三）营业成本分析”之“3、主营业务成本分类别分析”的相关内容。

（三）非流动负债构成及其变化分析

报告期各期末，公司非流动负债情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2025.9.30 |        | 2024.12.31 |        | 2023.12.31 |        | 2022.12.31 |         |
|------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|      | 金额        | 占比     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比     | 金额         | 占比      |
| 长期借款 | 20,461.16 | 74.15% | 16,969.32  | 70.46% | 4,000.00   | 60.05% | -          | -       |
| 租赁负债 | 163.55    | 0.59%  | 146.59     | 0.61%  | 274.47     | 4.12%  | 471.78     | 100.00% |

| 项目      | 2025.9.30 |         | 2024.12.31 |         | 2023.12.31 |         | 2022.12.31 |         |
|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|         | 金额        | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      | 金额         | 占比      |
| 递延收益    | 6,968.00  | 25.25%  | 6,968.00   | 28.93%  | 2,387.00   | 35.83%  | -          | -       |
| 非流动负债合计 | 27,592.71 | 100.00% | 24,083.91  | 100.00% | 6,661.47   | 100.00% | 471.78     | 100.00% |

报告期各期末，公司非流动负债分别为 471.78 万元、6,661.47 万元、24,083.91 万元和 27,592.71 万元，占各期末负债总额的比例分别为 2.56%、34.59%、48.71% 和 46.14%，由长期借款、租赁负债、递延收益和递延所得税负债构成。

1、长期借款

报告期各期末，公司长期借款构成情况如下：

单位：万元

| 项目           | 2025.9.30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 质押借款         | 4,950.00  | 4,950.00   | 4,000.00   | -          |
| 抵押借款         | 20,659.71 | 15,009.32  | -          | -          |
| 保证借款         | 950.00    | 950.00     | 1,000.00   | -          |
| 信用借款         | 100.00    | 60.00      | -          | -          |
| 应计利息         | 20.67     | 19.41      | 5.52       | -          |
| 减：一年内到期的长期借款 | 6,219.23  | 4,019.41   | 1,005.52   | -          |
| 合计           | 20,461.16 | 16,969.32  | 4,000.00   | -          |

2023 年末，公司长期借款项目主要包括：（1）自国家开发银行取得质押借款 4,000.00 万元，质押物为公司应收账款；（2）自成都农村商业银行股份有限公司取得保证借款 1,000.00 万元，保证人为东骏投资、毛冬、叶向明（该借款到期日为 2024 年 9 月 9 日，重分类为“一年内到期的非流动负债”）。

2024 年末，公司长期借款项目主要包括：（1）与交通银行签订授信贷款合同，总额度 34,600.00 万元，抵押物为公司土地使用权；截至 2024 年 12 月 31 日，公司已取得抵押借款 15,009.32 万元；（2）自国家开发银行取得质押借款 4,000.00 万元（该借款到期日为 2025 年 11 月 30 日，重分类为“一年内到期的非流动负债”），质押物为公司应收账款；（3）自成都农商银行取得质押借款 950.00 万元，质押物为公司专利；（4）自成都农商银行取得保证借款 950.00 万元，保证人为东骏投资、叶向明、毛冬。

2025 年 9 月 30 日，公司长期借款项目主要包括：（1）与交通银行签订授

信贷款合同，总额度 34,600.00 万元，抵押物为公司土地使用权；截至 2025 年 9 月 30 日，公司已取得抵押借款 20,659.71 万元（其中根据约定的还款进度，一年内应还款 298.56 万元，重分类为“一年内到期的非流动负债”）；（2）自国家开发银行取得质押借款 4,000.00 万元（该借款到期日为 2025 年 11 月 30 日，重分类为“一年内到期的非流动负债”），质押物为公司应收账款；（3）自成都农商银行取得质押借款 950.00 万元（该借款到期日为 2026 年 3 月 5 日，重分类为“一年内到期的非流动负债”），质押物为公司专利；（4）自成都农商银行取得保证借款 950.00 万元（该借款到期日为 2026 年 2 月 4 日，重分类为“一年内到期的非流动负债”），保证人为东骏投资、叶向明、毛冬。

2、租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债金额分别为 471.78 万元、274.47 万元、146.59 万元和 163.55 万元，占各期末非流动负债的比例分别为 100.00%、4.12%、0.61% 和 0.59%，主要为租赁厂房的租赁付款额。

3、递延收益

报告期各期末，公司递延收益金额分别为 0.00 万元、2,387.00 万元、6,968.00 万元和 6,968.00 万元，占各期末非流动负债总额的比例分别为 0.00%、35.83%、28.93%和 25.25%。

2023 年末，公司递延收益系收到的国家某部委应用专项相关政府补助款；2024 年末和 2025 年 9 月 30 日，公司递延收益包括收到的国家某部委应用专项相关政府补助款 5,968.00 万元及“面向芯片先进制程的激光退火技术与制造装备研制项目”相关政府补助款 1,000.00 万元。截至报告期末，前述政府补助项目尚未验收，收到的补助款均作为递延收益核算，待项目验收后转入其他收益。以上政府补助项目的具体情况如下：

单位：万元

| 科研项目的名称                  | 科研项目的类别                    | 实施周期                   | 总预算       | 财政预算金额   |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------|
| 国家某部委应用专项                |                            | 2023 年 1 月-2024 年 12 月 | 14,920.45 | 5,968.00 |
| 面向芯片先进制程的激光退火技术与制造装备研制项目 | 2023 年度四川省省级工业发展资金产业基础攻关任务 | 2022 年 1 月-2024 年 12 月 | 2,000.00  | 1,000.00 |

（四）偿债能力分析

1、主要偿债能力指标

报告期内，公司各期主要偿债能力指标如下：

| 项目            | 2025. 9. 30  | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍）       | 2. 25        | 2.54       | 4.36       | 1.21       |
| 速动比率（倍）       | 1. 39        | 1.81       | 3.30       | 0.70       |
| 资产负债率（合并口径）   | 52. 34%      | 48.17%     | 28.91%     | 74.81%     |
| 项目            | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度    | 2023 年度    | 2022 年度    |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 3, 695. 07   | 7,960.23   | 3,737.92   | -524.71    |
| 利息保障倍数（倍）     | 6. 45        | 16.81      | 21.10      | -5.51      |

报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.21 倍、4.36 倍、2.54 倍和 **2. 25 倍**，速动比率分别为 0.70 倍、3.30 倍、1.81 倍和 **1. 39 倍**，资产负债率分别为 74.81%、28.91%、48.17%和 **52. 34%**。2023 年，一方面，公司经营规模快速增长带来应收账款、存货、其他流动资产等流动性经营资产规模扩大；另一方面，外部融资带来货币资金金额增长，因此公司流动比率、速动比率较 2022 年大幅提高，资产负债率大幅下降。随着公司“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”建设的推进，与项目相关的应付账款、长期借款、一年内到期的非流动负债金额较大幅度提升，导致公司 2024 年末、2025 年 9 月 30 日流动比率、速动比率下降，同时资产负债率提高。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合同负债、长期借款金额较 2024 年末分别增加 5,504.66 万元、3,491.84 万元，导致公司流动比率、速动比率较 2024 年末有所下降，而资产负债率较 2024 年末有所提高。公司合同负债、长期借款的具体情况参见本节之“八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（二）流动负债构成及其变化分析”之“3、合同负债”及“（三）非流动负债构成及其变化分析”之“1、长期借款”。

2、可比公司对比分析

报告期内，公司与可比公司的流动比率、速动比率与资产负债率的比较情况如下：



| 项目          | 名称          | 2025. 9. 30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 流动比率<br>(倍) | 中微公司        | 2. 62       | 3.18       | 4.16       | 3.74       |
|             | 芯源微         | 1. 80       | 2.70       | 2.35       | 2.22       |
|             | 拓荆科技        | 1. 53       | 1.86       | 2.84       | 2.31       |
|             | 华海清科        | 2. 19       | 2.11       | 2.92       | 2.88       |
|             | 屹唐股份        | 4. 57       | 2.94       | 2.79       | 2.82       |
|             | 可比公司平<br>均值 | 2. 54       | 2.56       | 3.01       | 2.79       |
|             | 本公司         | 2. 25       | 2.54       | 4.36       | 1.21       |
| 速动比率<br>(倍) | 中微公司        | 1. 52       | 1.93       | 2.99       | 2.87       |
|             | 芯源微         | 0. 85       | 1.55       | 1.16       | 1.28       |
|             | 拓荆科技        | 0. 75       | 0.80       | 1.31       | 1.54       |
|             | 华海清科        | 1. 27       | 1.33       | 2.00       | 1.92       |
|             | 屹唐股份        | 2. 54       | 1.52       | 1.38       | 1.40       |
|             | 可比公司平<br>均值 | 1. 39       | 1.43       | 1.77       | 1.80       |
|             | 本公司         | 1. 39       | 1.81       | 3.30       | 0.70       |
| 资产负债<br>率   | 中微公司        | 28. 02%     | 24.72%     | 17.20%     | 22.72%     |
|             | 芯源微         | 54. 77%     | 49.62%     | 44.60%     | 39.75%     |
|             | 拓荆科技        | 67. 72%     | 65.40%     | 53.94%     | 49.30%     |
|             | 华海清科        | 42. 44%     | 44.85%     | 39.48%     | 38.79%     |
|             | 屹唐股份        | 24. 48%     | 40.57%     | 35.94%     | 34.46%     |
|             | 可比公司平<br>均值 | 43. 49%     | 45.03%     | 38.23%     | 37.00%     |
|             | 本公司         | 52. 34%     | 48.17%     | 28.91%     | 74.81%     |

数据来源：可比公司招股说明书、定期公告

2022 年末，公司经营规模较小，短期借款、合同负债及其他应付款等负债科目金额较大，导致流动比率、速动比率与同行业可比公司相比较低，而资产负债率较高。2023 年末，随着公司经营规模的扩大及外部融资的落地，公司流动比率、速动比率及资产负债率等偿债能力指标均有较大幅度优化。2024 年末、2025 年 9 月 30 日，“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”使得公司流动负债、长期负债增加，进而导致公司流动比率、速动比率整体有所下降，而资产负债率有所提高，但与可比公司同期相比不存在重大差异。

## （五）股利分配情况

根据四川中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《审计报告》（中汇蓉会审[2022]0072号），发行人2021年度实现净利润15,115,673.32元，可供股东分配利润为19,185,886.72元（含以前年度未分配利润6,993,457.53元）。

2022年6月8日，公司召开2021年年度股东大会并审议通过《成都莱普科技股份有限公司2021年度利润分配的议案》，同意以公司总股本3,000万股为基数，拟向全体股东每10股派3.75元人民币现金（含税），共计派送现金股利1,125.00万元。

根据发行人会计师出具的《审计报告》（致同审字（2025）第510A033855号），经审计调整后，截至报告期初（2022年1月1日）发行人未分配利润为-2,834.98万元，不再满足2021年度分红条件。公司股东东骏投资、东莞聚慧、东莞天戈、东莞莱普、东莞骏峰已于2023年12月28日退回所获全部分红款1,125.00万元。公司于2025年8月24日召开2025年第三次临时股东会审议通过《关于确认退回莱普科技2021年度超额分配的分红款的议案》，对上述2021年度分红退回事项作出追溯确认。

## （六）现金流情况分析

报告期内，公司现金流量总体情况如下：

单位：万元

| 项目               | 2025年<br>1-9月 | 2024年度     | 2023年度     | 2022年度    |
|------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 4,626.66      | 3,202.59   | -3,272.37  | -2,827.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -9,400.16     | -24,255.52 | -22,812.34 | 48.32     |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 4,974.72      | 13,226.93  | 39,765.05  | 7,381.76  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.16        | 2.47       | 5.19       | -2.33     |
| 现金及现金等价物净增加额     | 189.06        | -7,823.54  | 13,685.54  | 4,600.50  |
| 年初现金及现金等价物余额     | 11,257.59     | 19,081.12  | 5,395.58   | 795.08    |
| 年末现金及现金等价物余额     | 11,446.64     | 11,257.59  | 19,081.12  | 5,395.58  |

1、经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

| 项目              | 2025 年<br>1-9 月 | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度   |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 30,156.71       | 26,231.51 | 15,466.43 | 10,163.96 |
| 收到的税费返还         | 413.40          | 69.04     | 61.07     | 140.88    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 355.73          | 4,009.97  | 2,131.28  | 216.66    |
| 经营活动现金流入小计      | 30,925.84       | 30,310.53 | 17,658.78 | 10,521.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 16,813.93       | 16,659.41 | 14,880.76 | 8,652.05  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,579.95        | 5,228.58  | 3,500.27  | 1,991.77  |
| 支付的各项税费         | 1,039.24        | 538.56    | 548.06    | 1,353.52  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 2,866.06        | 4,681.38  | 2,002.06  | 1,351.43  |
| 经营活动现金流出小计      | 26,299.18       | 27,107.94 | 20,931.15 | 13,348.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 4,626.66        | 3,202.59  | -3,272.37 | -2,827.26 |

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,827.26 万元、-3,272.37 万元、3,202.59 万元和 **4,626.66 万元**。2022 年和 2023 年，公司处于快速扩张阶段，业务规模持续扩大，一方面，为适应客户需求日渐增长的趋势，公司提前投入较多资金用于生产与备货；另一方面，客户对于公司设备的验收及付款需要一定周期，公司整体收款时间普遍晚于原材料、人工薪酬等支出发生时间，导致营运资金占用增加，经营活动产生的现金流量净额为负。2024 年，公司整体业务及客户回款规模显著提升，同时因前期备货充足、供应链资金使用效率提高等原因，公司采购相关资金占用情况显著改善，经营活动产生的现金流量净额转为正数。2025 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额较 2024 年增加 1,424.07 万元，主要是因为当期销售回款金额较高而支付的期间费用等其他与经营活动有关的现金与 2024 年全年相比较少。

（1）销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的匹配性分析

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比较情况如下：

单位：万元

| 项目             | 2025 年<br>1-9 月 | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度   |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,156.71       | 26,231.51 | 15,466.43 | 10,163.96 |

| 项目                     | 2025 年<br>1-9 月 | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度  |
|------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 营业收入                   | 19,046.49       | 28,102.42 | 19,075.73 | 7,414.56 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例 | 158.33%         | 93.34%    | 81.08%    | 137.08%  |

报告期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 10,163.96 万元、15,466.43 万元、26,231.51 万元和 **30,156.71 万元**，占同期营业收入的比例分别为 137.08%、81.08%、93.34%和 **158.33%**。与 2022 年相比，公司 2023 年、2024 年销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例降低，主要是因为 2022 年发货但未验收的激光诱导结晶设备（LIC）预收款金额相对较高（相关设备为复购设备，销售合同约定的信用条款为“设备到货后 60 天内支付合同金额的 90%，验收后支付 10%”）。公司 2025 年 1-9 月期间收到的部分货款来自于前期销售所得，因此当期销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例较高。

（2）净利润与经营活动现金流量净额的差异分析

报告期内，公司净利润与经营活动现金流量净额的调整过程情况如下：

单位：万元

| 项目                              | 2025 年<br>1-9 月 | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度   |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 净利润                             | 988.73          | 5,491.16  | 2,279.87  | -938.22   |
| 加：信用减值损失                        | -72.63          | 335.95    | 31.86     | 50.81     |
| 资产减值准备                          | 1,493.25        | 336.76    | 289.73    | 100.85    |
| 固定资产折旧                          | 2,095.61        | 1,458.47  | 613.65    | 253.29    |
| 使用权资产折旧                         | 214.18          | 268.32    | 238.87    | 166.60    |
| 无形资产摊销                          | 81.43           | 84.41     | 32.17     | 0.98      |
| 长期待摊费用摊销                        | 135.40          | 187.08    | 175.43    | 146.91    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（收益以“-”号填列） | -37.38          | -0.45     | -         | 2.20      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）             | 1.27            | 15.66     | -1.27     | 0.17      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）             | -               | -         | -8.49     | -         |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                 | 585.00          | 308.73    | 298.28    | 292.09    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                 | -264.75         | -307.41   | -71.42    | -5.52     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）            | -392.75         | -1,062.59 | -176.46   | -249.57   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                | -11,056.45      | -5,744.29 | -4,678.93 | -4,213.76 |

| 项目                    | 2025 年<br>1-9 月 | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度   |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 3, 233. 83      | -6,764.79 | -2,764.02 | -3,265.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 7, 621. 92      | 8,595.59  | 468.36    | 4,830.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 4, 626. 66      | 3,202.59  | -3,272.37 | -2,827.26 |

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,827.26 万元、-3,272.37 万元、3,202.59 万元和 4, 626. 66 万元。报告期内，公司业务规模持续增长，而客户对于公司设备的验收及付款需要一定周期，导致报告期内 2022 年度、2023 年度、2024 年度公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润。受到公司“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房及装修转固后固定资产折旧金额上升、发出商品等存货跌价准备计提金额增加及前期应收账款回款等因素的影响，公司 2025 年 1-9 月净利润显著低于经营活动产生的现金流量净额。

2、投资活动产生的现金流量分析

单位：万元

| 项目                        | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度    | 2023 年度    | 2022 年度  |
|---------------------------|--------------|------------|------------|----------|
| 收回投资收到的现金                 | 17, 000. 00  | 30,000.00  | 9,000.00   | 1,650.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 292. 60      | 136.10     | 69.59      | 7.79     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0. 75        | 0.24       | 0.10       | 0.30     |
| 收到与其他投资活动相关的现金            | 0. 00        | 21.76      | -          | -        |
| 投资活动现金流入小计                | 17, 293. 36  | 30,158.10  | 9,069.69   | 1,658.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7, 693. 52   | 18,413.62  | 9,882.02   | 609.77   |
| 投资支付的现金                   | 19, 000. 00  | 36,000.00  | 22,000.00  | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 26, 693. 52  | 54,413.62  | 31,882.02  | 1,609.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9, 400. 16  | -24,255.52 | -22,812.34 | 48.32    |

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 48.32 万元、-22,812.34 万元、-24,255.52 万元和-9. 400. 16 万元。为了提高资金使用效率，公司将部分闲置资金用于申购理财产品。报告期内，公司收回投资收到的现金系赎回的理财产品投资款；投资支付的现金主要系公司购买的理财产品支付的投资款。2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月，公司“全国总部暨集成电路装备研发制造基

地项目”建设及研发、生产用固定资产购置导致公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加。

### 3、筹资活动产生的现金流量分析

单位：万元

| 项目                | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度   | 2023 年度   | 2022 年度   |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 吸收投资收到的现金         | 9.95         | 7.50      | 38,188.47 | 4,462.50  |
| 取得借款收到的现金         | 5,690.39     | 18,169.32 | 8,100.00  | 5,500.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金    | 93.47        | 173.00    | 1,125.00  | 1,400.00  |
| 筹资活动现金流入小计        | 5,793.81     | 18,349.82 | 47,413.47 | 11,362.50 |
| 偿还债务支付的现金         | 100.00       | 4,200.00  | 5,500.00  | 800.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 569.93       | 460.55    | 175.15    | 89.64     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 149.16       | 462.34    | 1,973.27  | 3,091.10  |
| 筹资活动现金流出小计        | 819.09       | 5,122.89  | 7,648.41  | 3,980.74  |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 4,974.72     | 13,226.93 | 39,765.05 | 7,381.76  |

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 7,381.76 万元、39,765.05 万元、13,226.93 万元和 **4,974.72 万元**。公司收到的其他与筹资活动有关的现金主要包括关联方借款及股东分红款退回，相关情况请参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方与关联交易情况”之“（二）报告期内关联交易情况”之“4、重大偶发性关联交易”之“（1）关联方资金拆借”，及本节之“八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（五）股利分配情况”。

#### （七）重大资本性支出计划

截至招股说明书签署日，除本次发行募集资金投资项目外，公司无可预见的重大资本性支出计划。本次发行募集资金投资计划请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件六、募集资金具体运用情况”。

#### （八）流动性风险及应对措施

报告期内，公司不存在重大或有负债，不存在影响现金流量的重要事件或承诺事项。公司财务状况稳健，偿债能力指标良好，公司流动性不存在重大变化或风险。



为应对行业市场不利变化以及偶发事件所可能带来的流动性风险，公司将积极加强财务及资金管理能力，加强对客户信用的管理，加大应收款项催收力度，为公司持续发展提供有效的资金保障。

### （九）持续经营能力分析

报告期各期，公司营业收入分别为 7,414.56 万元、19,075.73 万元、28,102.42 万元和 **19,046.49 万元**，净利润分别为-938.22 万元、2,279.87 万元、5,491.16 万元和 **988.73 万元**，公司业绩持续快速增长，盈利能力稳步增强。

近年来，中国大陆半导体产能（尤其是集成电路产能）的高速增长带来大量设备增量需求及一定的存量替换需求。公司现有的激光热处理设备与专用激光加工设备两大产品序列高度匹配半导体当前迈向更高精度、更高效能以及更先进技术水平的发展趋势，因此在半导体产业投资增加及产业升级过程中有望迎来规模化增长和结构化增长的双重发展机遇。

基于上述分析，公司管理层认为，公司具备持续经营能力，未来发展前景广阔，报告期及可预见的未来，不存在对公司持续经营有重大不利影响的事项，但公司未来的经营业绩和盈利能力可能会受到一些风险因素的影响，具体情况请参见本招股说明书“第三节 风险因素”。

## 九、重大投资、资本性支出及重大资产业务重组或股权收购合并事项

### （一）重大投资或资本性支出情况

报告期内，公司重大资本性支出主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产。报告期各期，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为 609.77 万元、9,882.02 万元、18,413.62 万元和 **7,693.52 万元**。

### （二）重大资产业务重组或股权收购合并事项

报告期内，公司不存在重大资产业务重组或股权收购合并事项。

## 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

截至招股说明书签署日，公司不存在重要的资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至招股说明书签署日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

（三）重大担保、诉讼事项

截至招股说明书签署日，公司不存在需要披露的重大对外担保、诉讼及其他重要事项。

（四）其他重大事项

截至招股说明书签署日，公司不存在需要披露的承诺事项等其他重大事项。

十一、审计截止日后的主要经营情况

（一）财务报告审计截止日后主要经营状况

公司财务报告审计截止日为 2025 年 9 月 30 日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司总体经营情况良好，公司所面临的产业政策、税收政策等未发生重大变化，公司业务经营模式、主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。

（二）2025 年经营业绩情况

致同会计师对公司 2025 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2025 年度的合并利润表、合并现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（致同审字（2026）第 510A002706 号）。

根据经审阅的财务数据，公司主要财务情况如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目          | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 变动比例   |
|-------------|------------------|------------------|--------|
| 资产总额        | 111,875.30       | 102,640.75       | 9.00%  |
| 负债总额        | 51,149.58        | 49,444.26        | 3.45%  |
| 所有者权益       | 60,725.72        | 53,196.49        | 14.15% |
| 归属于母公司所有者权益 | 60,848.04        | 53,269.51        | 14.23% |

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额较上年末增长 9.00%，主要系公司

整体业务规模扩大；公司负债总额较上年末增长 3.45%，变动幅度不大；公司归属于母公司所有者权益较上年末增长 14.23%，与归属于母公司所有者净利润的变动趋势一致。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目                     | 2025 年度        | 2024 年度        | 变动比例    |
|------------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                   | 35,045.78      | 28,102.42      | 24.71%  |
| 净利润                    | 7,171.13       | 5,491.16       | 30.59%  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 7,230.39       | 5,564.28       | 29.94%  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 4,085.47       | 4,834.56       | -15.49% |
| 项目                     | 2025 年 10-12 月 | 2024 年 10-12 月 | 变动比例    |
| 营业收入                   | 15,999.29      | 18,932.51      | -15.49% |
| 净利润                    | 6,182.41       | 6,659.87       | -7.17%  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 6,196.14       | 6,676.35       | -7.19%  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 3,366.64       | 6,217.90       | -45.86% |

2025 年度公司实现营业收入 35,045.78 万元，同比增长 24.71%，收入增长主要受益于下游行业景气度提升、客户资本性支出上升以及公司持续研发推出新产品、市场开拓情况良好等因素；2025 年 10-12 月公司实现营业收入 15,999.29 万元，同比下降-15.49%，主要系公司首台 USJLA、LIEG 设备经过较长时间的验证周期后在 2024 年第四季度得到了下游客户最终验证通过，2024 年 10-12 月的营业收入较高。

2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 7,230.39 万元，同比增长 29.94%，一方面系公司经营规模扩大、营业收入增长；另一方面，公司国家某部委应用专项与“面向芯片先进制程的激光退火技术与制造装备研制项目”于 2025 年第四季度验收通过，相关政府补助款按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》由递延收益转入其他收益，公司的非经常性损益金额上升。

2025 年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,085.47 万元，同比下降 15.49%，2025 年 10-12 月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,366.64 万元，同比下降-45.86%，主要系

当年“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房转固，折旧摊销费大幅上升。

3、合并现金流量表主要数据

(1) 2025 年度现金流情况

单位：万元

| 项目            | 2025 年度        | 2024 年度        | 变动比例     |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,603.46       | 3,202.59       | 74.97%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,352.20     | -24,255.52     | 53.20%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,538.78       | 13,226.93      | -65.69%  |
| 项目            | 2025 年 10-12 月 | 2024 年 10-12 月 | 变动比例     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 976.80         | -144.88        | 774.22%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,952.04      | -3,495.15      | 44.15%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -435.95        | 2,829.40       | -115.41% |

2025 年度公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 74.97%，主要系当年销售回款金额较高；2025 年 10-12 月公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 774.22%，主要系当期收到的政府补助款增加。

2025 年度公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 53.20%，主要系公司“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”已于当年竣工，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年减少；2025 年 10-12 月公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 44.15%，主要系当期存在大额银行理财赎回。

2025 年度公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降-65.69%，主要系公司当年取得借款收到的现金减少；2025 年 10-12 月公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 115.41%，主要系当期存在大额银行借款归还。

4、非经常性损益明细表

(1) 2025 年度非经常性损益明细表

单位：万元

| 项目                                                                   | 2025 年度        | 2024 年度        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -38.92         | 0.45           |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 3,484.23       | 591.58         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 333.94         | 307.41         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 2.60           | -              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -73.72         | -37.51         |
| 非经常性损益总额                                                             | 3,708.12       | 861.93         |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                                      | 556.22         | 132.14         |
| 非经常性损益净额                                                             | 3,151.91       | 729.79         |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数                                                 | 6.99           | 0.08           |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益                                                    | 3,144.92       | 729.72         |
| 项目                                                                   | 2025 年 10-12 月 | 2024 年 10-12 月 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -76.30         | 0.17           |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 3,350.63       | 490.00         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 69.19          | 82.25          |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | -              | -              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -14.31         | -33.04         |
| 非经常性损益总额                                                             | 3,329.21       | 539.38         |
| 减：非经常性损益的所得税影响数                                                      | 499.38         | 80.91          |
| 非经常性损益净额                                                             | 2,829.82       | 458.48         |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数                                                 | 0.32           | 0.03           |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益                                                    | 2,829.50       | 458.45         |

2025 年 10-12 月，公司的非经常性损益金额较高，主要系公司国家某部委应用专项与“面向芯片先进制程的激光退火技术与制造装备研制项目”于 2025 年第四季度验收通过，相关政府补助款按照《企业会计准则第 16 号——政府补

助》由递延收益转入其他收益。

综上，公司 2025 年度的财务状况稳定，与公司实际经营活动相匹配。

（三）2026 年 1-3 月业绩预计

基于目前的经营状况和市场环境，公司预计 2026 年 1-3 月主要财务数据如下：

| 单位：万元                  |                     |              |                  |
|------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 项目                     | 2026 年 1-3 月        | 2025 年 1-3 月 | 变动比例             |
| 营业收入                   | 5,000.00 至 5,500.00 | 3,662.77     | 36.51%至 50.16%   |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 220.00 至 650.00     | 79.96        | 175.15%至 712.96% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | -500.00 至-70.00     | -53.32       | -837.70%至-31.28% |

2026 年 1-3 月，发行人预计实现营业收入较上年同期增加 36.51%至 50.16%，主要受益于下游行业景气度提升、客户资本性支出上升、市场开拓情况良好等因素；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 175.15%至 712.96%，与营业收入的变动趋势一致；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少-837.70%至-31.28%，主要系“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房转固后，折旧摊销费大幅上升。

十二、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。



## 第七节 募集资金运用与未来发展规划

### 一、募集资金运用概况

#### （一）本次募集资金计划和投资方向

经发行人股东会审批通过，公司本次拟公开发行人民币普通股 1,606.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），实际募集资金扣除发行相关费用后的净额，拟按照轻重缓急投资以下项目：

单位：万元

| 项目名称             | 投资总额      | 利用募集资金投资额 |
|------------------|-----------|-----------|
| 晶圆制造设备开发与制造中心项目  | 30,588.35 | 30,588.35 |
| 先进封装设备开发与制造中心项目  | 13,970.46 | 13,970.46 |
| 研发中心及信息化建设项目     | 15,240.43 | 15,240.43 |
| 研发、技术支持与营销网络建设项目 | 16,209.32 | 16,209.32 |
| 补充流动资金           | 8,991.44  | 8,991.44  |
| 合计               | 85,000.00 | 85,000.00 |

本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

本次募集资金将按照募投项目的进度等实际情况，依次合理有序地投入实际项目的使用中。若本次募集资金净额不能满足上述募投项目的实际资金使用需求，不足部分由公司自筹资金解决。若募集资金超过上述募投项目的实际资金使用需求，公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定对超募资金进行使用。

#### （二）募集资金使用管理制度

公司已经建立《募集资金管理制度》，本次募集资金到位后，将存放于专项账户中进行集中管理，且募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途，做到专款专用。公司将在募集资金到账后与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用管理的各项规定执行。

### （三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

本次募集资金投资项目依托公司已经建立成形的产品供应体系与研发体系，契合国家有关产业政策导向和公司发展战略规划。项目与公司主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和长远发展目标相匹配。

本次募集资金到位及投资项目的实施，将进一步扩大公司激光热处理设备、专用激光加工设备高端产品品类及其产能，增强公司服务下游先进制造需求的能力，提高公司在高端半导体专用激光设备领域的市场地位和核心竞争力，同时助力实现公司的持续发展目标以及国家关于增强半导体供应链稳健性的战略愿景。

### （四）募集资金投资项目的确定依据

本次募集资金投资项目与公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和发展目标等相适应，具体分析如下：

#### 1、募集资金投资项目与公司主营业务、经营规模及发展目标、资本支出规划相适应的依据

公司长期致力于以更具前瞻性、更高效的激光技术解决方案满足半导体等下游行业日益增长的高端制造需求。

报告期内，公司经营业绩良好，且伴随着国家半导体等产业快速发展，公司承接的设备订单量逐年提升。但受制于场地规模、人员数量等因素限制，公司交付能力难以完全满足下游需求，公司业务推广和长远发展受到严重制约，公司亟需实施较大规模资本支出以全方位增强业务发展能力。

本次募投项目晶圆制造设备开发与制造中心项目、先进封装设备开发与制造中心项目的实施有助于公司在现有产品序列的基础上进一步扩大经营规模；同时研发中心及信息化建设项目，研发、技术支持与营销网络建设项目的实施也有助于提升公司新品开发质量和效率，优化对客户需求响应的时效性，从而强化公司对下游制造业的支撑作用。

综上，相关募投项目符合公司整体发展战略及资本支出规划，与公司现有主营业务、经营规模和未来发展目标相适应。

## 2、募集资金投资项目与公司财务状况相适应的依据

公司已建立成熟的商业运行模式，具备持续经营和盈利能力。报告期内，公司财务状况良好，可为本次募集资金投资项目的实施及后续运营提供良好的财务支撑。同时，本次募集资金到位后也将大幅增强公司资金实力，公司资产负债结构将进一步优化，运营资源及抵御风险能力也将随之提升，因此公司募集资金投资项目与公司财务状况相适应。

## 3、募集资金投资项目与公司技术条件相适应的依据

基于长期以来持续的研发投入与积累，公司已构建完善的核心技术与工艺体系。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已取得 94 项授权专利，其中 16 项系发明专利，公司是国家高新技术企业和国家级“专精特新”重点小巨人企业，2024 年四川省重点“小巨人”企业，入选“2024 年成都市集成电路产业链链主企业”。自成立以来，公司已承担国家某部委应用专项攻关任务，建成了四川省企业技术中心、四川省全固态先进激光工程技术研究中心，与中国科学院半导体所联合成立了半导体材料先进激光加工技术联合实验室，并荣获集成电路创新联盟第六届和第七届“IC 创新奖”、中国通信工业协会“2020 年度半导体装备卓越创新奖”、客户 A“2024 年度优秀技术支持团队”、客户 A“协同创新奖”、客户 C“新锐突破奖”、客户 C“研发合作奖”、晶合集成“在地化突破奖”等奖项。

本次募集资金投资项目既包含公司当前成熟技术工艺的产业化应用，也包含对相关技术的进一步优化迭代，相关项目的实施有良好的技术基础支撑，也将进一步增强公司技术研发水平，因此与公司技术条件相适应。

## 4、募集资金投资项目与公司管理能力相适应的依据

公司建立健全了法人治理结构，建立了符合公司生产经营需要的内部控制制度，并促使各项制度得到有效执行。公司管理团队均拥有丰富的行业经验，能够对公司经营过程的研发、采购、生产、销售等各项业务环节进行有效管理。本次募投项目的实施，与公司现有管理能力相适应。

### （五）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目，实施主体为公司，项目实施后不会产生同业竞争，不会对公司的独立性产生不利影响。

## （六）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

本次计划实施的募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，主要目标是扩大产能规模、增强研发实力，提升公司核心竞争力，并通过优化营销渠道方式巩固现有市场基础，同时逐步拓展海外业务。本次募集资金重点投向科技创新领域的具体安排请参见本招股说明书“附件六：募集资金具体运用情况”。

## 二、募投项目可行性及与发行人主要业务、核心技术的关系

### （一）募投项目可行性分析

#### 1、国家政策支持行业健康快速发展

半导体专用设备所处的专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造行业，位于半导体产业链上游的核心环节，对于实现我国半导体产业稳定发展、缓解供应链风险等国家经济发展战略具有重要意义，是国家产业政策重点支持鼓励的对象。

“十三五”以来，国家密集出台了一系列规划与政策，确立了优化半导体设备供货能力的系统性目标，其中《集成电路产业“十三五”发展规划建议》和《“十四五”国家信息化规划》进一步明确了促进半导体设备行业发展的方向和措施。这些规划和政策旨在推动关键设备国产供应，加强集成电路等关键前沿领域的战略研究和技术融通创新。

除了中央政策的支持，地方政府也推出了具体的补贴政策以促进半导体设备产业的发展。以四川省成都市为例，政府从投资扩产、研发、销售、投融资等多个维度给予半导体设备企业支持，2023年3月印发的《成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策的通知》中指出：“对总投资5亿元（含）以上的集成电路装备的重大项目，根据其技术产品、工艺水平和市场前景等，按固定资产投资额10%给予企业最高不超过5亿元综合支持”、“本政策重点支持芯片级、晶圆级、系统级、三维封装等先进封装测试产业化项目，以及配套关键设备和材料产业化项目”等。

这些政策措施不仅涵盖了财政补贴和税收优惠，还包括了技术创新、市场拓展和人才培养等多方面的扶持，共同推动了国内半导体设备行业的健康发展和技术进步。

## 2、广阔的市场前景

### （1）激光热处理设备市场

热处理与光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积、清洗/抛光、金属化并列为半导体制造前道七大工艺步骤。IC Insights 数据显示，以常规热处理应用场景测算，在半导体设备市场中，热处理设备价值规模占比也已达到 3%，整体与离子注入设备（3%）、清洗设备（4%）、CMP 设备（4%）和涂胶显影（3%）相近。结合 SEMI 数据测算，2024 年度中国大陆热处理半导体设备市场规模已达 14.87 亿美元。

对于公司聚焦的激光热处理领域，该技术主要面向集成电路先进制程与各类新兴工艺架构和新兴材料，如三维堆叠、异构集成、第三代化合物半导体材料等。随着中国大陆半导体制造产业规模增长，叠加先进制程渗透率提升，激光热处理设备市场发展回归上行周期，QY Research 等机构数据显示，中国大陆是全球主要的激光热处理设备消费市场之一，2024 年市场规模为 16.95 亿元，预计 2030 年将达到 32.96 亿元，年复合增长率（CAGR）为 11.72%。

### （2）专用激光加工设备市场

先进精密激光技术凭借较强的灵活性和较高的工作效率，对于半导体领域的降本增效具有重要意义；且其高精度特征匹配半导体精细化发展趋势，因此无论是，激光加工在半导体领域均具备广阔的应用场景。此外，消费电子等终端市场的需求牵引也成为精密电子、MLED 等领域产能扩充的重要推动力。

欧洲领先的光学技术贸易杂志，暨德国光子学会和德国应用光学学会官方出版物《Photonics Views》数据显示，中国工业激光设备市场占激光设备市场的比例为 62%，工业激光设备中有 12%用于半导体/显示领域（不含切割）；另结合中国科学院武汉文献情报中心发布的《2024 中国激光产业发展报告》《2025 中国激光产业发展报告》中全国激光设备市场规模保守测算，2024 年我国半导体领域激光加工设备市场规模将达 65.38 亿元，2019 年至 2024 年期间年复合增长率达 5.96%。

## 3、技术储备充足，专业稳定的人员团队

公司围绕先进精密激光技术在半导体领域的应用需求开发了全流程覆盖光、



机、电、算等各个环节的核心技术体系，已掌握多波长固态激光技术、多波长光路整形技术、高精度能量密度控制技术、复杂多变量协同监测检测技术、半导体领域多用途激光加工技术、半导体领域激光设备整机设计技术等多项核心技术，具备紧跟行业趋势和下游工艺需求升级而不断迭代设备产品的研发实力。截至**2025年12月31日**，公司及其子公司拥有**43项**已授权软件著作权，**94项**已授权境内专利，其中**16项**为发明专利。

公司核心团队成员均拥有多年半导体、激光技术领域的研发、生产、销售和管理经验，同时建立技术带头人制度，引进行业内技术专家作为专业技术带头人，通过具体的项目实践，快速培养激光半导体设备专业技术人才，建立起一支研发经验和产线调试经验丰富的研发团队。为了充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀专业人才，公司建立了长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和技术研发人员个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，公司团队核心人员未发生重大不利变动，核心技术团队人员稳定。

综上，公司充足的技术储备、专业稳定的人员团队，为项目顺利实施提供保障。

#### **4、丰富的客户资源**

经过多年的经营发展，公司在业内树立了良好的品牌形象，积累了丰富的客户资源。报告期内，公司在存储芯片、数字逻辑芯片领域的主要客户包括客户A、客户B、客户C以及其他领先晶圆代工厂等知名企业；在功率器件领域的主要客户包括中车时代、客户E3、华润微、士兰微、三安半导体等龙头企业；在封装测试领域的主要客户包括华天科技、达迩科技、佰维存储等龙头企业。

公司丰富的客户资源将为项目顺利实施提供保障。

#### **（二）与发行人主要业务、核心技术的关系**

公司本次募集资金运用围绕主营业务，扩大现有产能，开展新品研发，并建立优化技术支持与市场营销体系贴合公司经营战略的发展方向，是对公司现有主要业务和核心技术的高效利用与积极延伸，也是公司实现股东回报、助力国家半导体产业稳定发展的重要组成部分，与公司现有业务、核心技术以及发展愿景紧密相关。



## 三、未来发展与规划

### （一）整体发展战略规划

公司长期致力于以科技创新助力国家半导体产业发展，已确立了“激光热处理设备和专用激光加工设备”双引擎可持续发展的战略。未来，公司将继续以先进精密激光技术为核心，通过高强度研发投入持续夯实公司技术实力，推进产品矩阵多元化发展和深度优化；同时积极扩大服务对象群体，丰富下游应用领域并提高市场占有率，以自主研发的先进精密激光技术助力维护国家半导体等关键产业链的安全与稳定。

### （二）报告期内已采取的措施及实施效果

#### 1、建立健全高层次研发人才体系，扩大研发投入支出

报告期内，公司持续引进光、机、电、算及半导体工艺等各领域的高专业水准研发人才，并通过内部人才培育机制自主培养技术骨干，建立健全高层次人才体系。截至报告期末，公司研发人员 **79 人**，占员工总数的 **23.10%**。

公司保持较高强度研发水平，报告期各期，公司研发费用分别为 1,528.13 万元、2,395.18 万元、5,873.72 万元和 **3,784.97 万元**，占营业收入的比例分别为 20.61%、12.56%、20.90%和 **19.87%**。公司参与了国家某部委应用专项攻关任务，并积极与合作单位 A、合作单位 B 等产业链上下游企业开展联合研发，促进先进精密激光技术与半导体等产业融合发展。

#### 2、扩充产品序列，推进多领域市场布局

报告期内，面向市场持续升级的工艺需求，公司研发并量产了多款半导体领域激光热处理设备与专用激光加工设备，不断扩充产品序列以满足各类高端制程工艺需求。

目前，公司设备产品已应用于客户 A、客户 B、客户 C、华润微、士兰微、三安半导体、中车时代、客户 D、华天科技、达迩科技等主流半导体厂商，应用于包括先进制程 3D NAND Flash 存储芯片、先进制程 DRAM 存储芯片、28nm 及以下先进制程逻辑芯片、SiC 功率芯片、沟槽栅型 IGBT 功率芯片、先进电源管理芯片、BSI-CCD 芯片量产，以及国产 HBM 芯片工艺研发等前沿应用场景。

### 3、优化治理结构，完善基础设施建设

报告期内，公司持续优化内部治理结构、提高管理水平以适应高速发展需求。公司参照上市公司要求不断完善法人治理结构，规范股东会、董事会及其下设专门委员的运作，建立独立董事、董事会秘书、内部审计等相关制度，形成了科学有效的公司运营决策机制，为公司平稳高速发展提供治理结构基础。

为满足持续快速增长的半导体设备科研、生产任务需求，以及人员办公需求，公司持续完善基础设施。报告期内，公司开工建设“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”，包含激光工程研发中心、半导体材料先进激光技术联合实验室等。

#### （三）未来规划采取的措施

##### 1、推进创新常态化，布局前沿技术

公司将以市场需求为导向大力推进创新常态化。公司计划持续引入高层次研发人才，保持高强度研发投入，巩固创新的底层支撑；同时深度接触市场，确保技术创新方向与产业界实际需求保持一致。

基于常态化创新机制，公司将紧密跟随行业前沿动态，布局前沿产业技术，针对激光和半导体制造领域的前沿理论持续开展技术研究及产品开发，加快推动产业转型升级。

##### 2、强化品牌效应，扩大市场覆盖

基于成熟的自主创新能力和领先的产品力，公司已在半导体领域激光热处理及激光加工市场建立良好口碑并初步形成品牌效应，实现多数客户重复采购。未来，公司将巩固现有客户关系，并借助已有的设备产品的成功应用案例进一步强化品牌效应，推广自身品牌并加快市场开发，开拓更多不同应用领域的领先客户。

此外，公司积极践行“走出去”战略，公司将通过积极兴建海外技术支持与营销网点的方式开拓海外市场。扩大海外市场覆盖，不仅有助于公司提高全球影响力，挖掘新的业绩增长点，也有助于公司强化研发实力，通过直接服务国际领先晶圆厂并与国际领先设备厂商直接展开竞争，进一步深化公司对先进半导体制造工艺的理解。

### 3、充分发挥资本平台优势，加大资源整合力度

公司将充分利用本次 IPO 融资机会，合理、高效利用资本市场资金支持。公司已结合业务发展目标与市场需求等因素对募集资金运用做了充分论证，上市后公司将审慎推进募集资金使用。

未来，公司还将充分利用上市后的融资平台，为公司发展提供长期资金和产业资源支持，增强自身竞争力，提高国产半导体供稳定性水平，并同步实现股东利益最大化。

## 第八节 公司治理与独立性

### 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

自股份公司设立以来，发行人逐步建立健全了股东（大）会、董事会、监事会/审计委员会、独立董事及董事会秘书等制度，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定。同时，公司制定了《公司章程》及相关议事规则，明确了股东（大）会、董事会、监事会/审计委员会的权责，形成了股东（大）会、董事会、监事会/审计委员会和管理层之间有效制衡的法人治理结构，股东（大）会、董事会、监事会/审计委员会和管理层能够按照《公司章程》和相关法律法规的规定履行职权、规范运作，不存在董事会、管理层等违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为；公司制定了《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等相关制度，在独立董事产生办法、董事会秘书主要职责等方面进行了具体规定，独立董事和董事会秘书能够严格按照相关法规的规定出席相关会议并积极履行职责。

此外，发行人董事会内部设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的工作细则，有效地保证了公司的规范运作和可持续发展，形成了科学和规范的治理制度。2025年6月，根据证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，发行人调整内部监督机构，由董事会下设的审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，不设监事会或者监事。

综上所述，发行人参照相关法律、法规及规范性文件的要求开展公司治理，公司治理规范，不存在重大缺陷。

### 二、内部控制情况

#### （一）发行人管理层对内部控制的自我评估意见

2026年3月6日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司内部控制评价报告及<内部控制审计报告>的议案》，董事会认为：于内部控制评价报告基准日（2025年9月30日），公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制体系运行良好，未

发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

（二）注册会计师对发行人内部控制的审计意见

致同会计师对公司的内部控制情况进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（致同专字（2026）第 510A001449 号），其审计结论为：公司于 2025 年 9 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）财务内控不规范情形及整改情况

报告期内，发行人曾存在使用员工个人账户进行款项收付、在无真实业务支持情况下通过关联方取得银行贷款及为关联方提供银行贷款资金走账通道、票据使用不规范、与关联方直接进行资金拆借及通过第三方代收货款等《监管规则适用指引——发行类第 5 号》所列示的财务内控不规范情形，具体情况如下：

1、财务内控不规范情形及其影响和整改情况

（1）使用员工个人账户进行款项收付

报告期内，发行人存在使用出纳个人账户收付款项的情形，相关个人账户的使用集中于 2022 年，账户资金来源主要包括呆滞库存处理所得、部分员工备用金与薪酬返还，而账户款项主要用于支付员工日常报销与备用金支取、员工薪酬与福利发放及无票费用支出。前述出纳个人账户报告期内使用情况如下：

| 单位：万元      |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| 收款明细       | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| 呆滞库存处理所得   | -       | -       | 75.22   |
| 员工备用金与薪酬返还 | -       | -       | 48.28   |
| 账户结息等零星收款  | 0.00    | 0.00    | 0.03    |
| 合计         | 0.00    | 0.00    | 123.53  |
| 付款明细       | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| 员工报销与备用金支取 | -       | 1.00    | 35.50   |
| 员工薪酬与福利发放  | -       | -       | 20.28   |
| 无票费用支出     | -       | -       | 73.93   |
| 手续费等零星付款   | 0.18    | 0.01    | 0.03    |

|    |      |      |        |
|----|------|------|--------|
| 合计 | 0.18 | 1.01 | 129.73 |
|----|------|------|--------|

注：用于发行人款项收付的出纳个人账户已于 2024 年 12 月注销。

如上表所示，报告期内发行人使用出纳个人账户进行款项收付的行为不涉及关联方或第三方代垫资金、发行人利益受到损害等情形；使用出纳个人账户收付款项的行为已于 2023 年开始基本停止，报告期内相关账户的资金收付均已并入发行人账户，用于发行人款项收付的出纳个人账户已于 2024 年 12 月完成注销。

（2）在无真实业务支持情况下通过关联方取得银行贷款及为关联方提供银行贷款资金走账通道

2022 年 6 月，发行人为关联方东骏激光向成都农村商业银行股份蒲江西来古镇支行获取的银行贷款提供 500 万元的资金走账通道；2022 年 9 月，为满足日常经营中产生的流动资金需求，发行人在无真实业务背景的情况下通过关联供应商得旭智能向成都农村商业银行股份有限公司蒲江西来古镇支行获取贷款 1,000 万元。前述银行借款已分别于 2023 年 5 月、2023 年 7 月提前偿清。根据成都农村商业银行股份有限公司蒲江西来古镇支行出具的确认文件，相关借款未发生逾期还款或其他违约情形，不存在危害银行权益的情形，发行人或东骏激光不涉及面临罚息或其他惩罚性措施的情况。

（3）票据使用不规范

2022 年，为缓解经营资金紧张问题，发行人曾将到期期限较长的票据背书于关联方东骏激光以获取银行存款，相关票据背书转让不具有真实交易背景，发行人与东骏激光之间无商业背景的票据拆借金额共计 456.23 万元。票据背书转入主体东骏激光收票后向东骏激光供应商背书转出或到期兑付，票据的最终使用具有真实交易背景，发行人不存在通过票据背书转让进行体外资金循环的情形。

此外，2023 年，发行人存在客户以较大面额票据支付货款（支付的票据面额超过应结算金额），发行人收到票据后以现金形式进行差额找回的情况，发行人向客户支付票据找零金额共计 26.87 万元。发行人与客户发生的票据找零情形均基于真实的业务背景，找零原因系交易金额与票面金额不完全匹配，发行人从客户背书转入的票据均用于日常经营周转或到期承兑，金额较小，发行



人不存在通过相关客户票据找零进行体外资金循环的情形。

2024 年以来，发行人未再发生无真实交易背景的票据业务。发行人报告期内的票据使用不规范行为具有商业合理性，不属于故意或恶意套取银行票据融资或骗取财务的票据欺诈或诈骗行为，不存在侵害银行等金融机构权益的情形，不属于按相关法律法规应当追究刑事责任或应当给予行政处罚的情形，发行人报告期内未因相关票据使用不规范行为受到中国人民银行的行政处罚。发行人控股股东、实际控制人出具了《承诺函》，承诺如因票据使用不规范导致发行人受到有关政府主管部门的处罚、追究责任或遭受任何实际损失，将补偿发行人因此遭受的损失。

#### （4）与关联方直接进行资金拆借

报告期内，发行人与关联方的资金拆借情况具体参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方与关联交易情况”之“（二）报告期内关联交易情况”之“4、重大偶发性关联交易”之“（1）关联方资金拆借”。

#### （5）通过第三方代收货款

报告期各期，发行人第三方回款金额分别为 0.20 万元、21.79 万元、321.04 万元和 183.70 万元，占当期营业收入的比例分别为 0.00%、0.11%、1.14%和 0.96%，占比较低，具体情况如下：

单位：万元

| 项目                      | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 融资租赁公司代客户付款             | 178.20       | 284.80  | -       | -       |
| 客户的法定代表人、实际控制人或其配偶代客户付款 | 5.50         | 27.20   | 16.90   | -       |
| 发行人员工收到客户款项后上交发行人       | -            | 6.54    | 4.89    | 0.20    |
| 同一集团下关联公司代客户付款          | -            | 2.50    | -       | -       |
| 合计                      | 183.70       | 321.04  | 21.79   | 0.20    |

发行人报告期内的第三方回款存在商业合理性，相关交易真实，不存在虚构交易或调节账龄的情形，发行人及其实际控制人、董监高或其他关联方与第三方回款的支付方不存在关联关系或其他利益安排，报告期内发行人不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷。报告期最后一期，发行人已不存在由员工代

收客户款项的情形。

发行人上述财务内控不规范情形主要发生在报告期初，且所涉金额较小，不属于主观故意或恶意行为，不构成重大违法违规；相关行为不涉及通过体外资金循环粉饰业绩或发行人利益受到损害的情形。报告期内，发行人已通过注销用于资金收付的员工个人账户、提前偿还贷款等方式对不规范行为进行了纠正，截至报告期末，发行人与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。

## 2、发行人内控制度建立及运行情况

为进一步规范财务内控，发行人制定了《资金管理制度》《商业汇票管理办法》《应收账款管理制度》《筹资管理制度》《关联交易管理制度》等内控制度，对货币资金及票据使用、筹资行为、客户收款及关联交易等方面做出了明确的内部控制规定。此外，发行人在报告期内持续加强对实际控制人、董事、监事（取消监事会前）、高级管理人员及主要财务人员关于上市相关法律法规、上市公司治理规范要求的培训，发行人整体内部控制水平与规范意识得到显著提升。截至报告期末，发行人已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证发行人的运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，不影响本次发行条件及信息披露质量。

## 三、发行人报告期内违法违规行及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况

报告期内，发行人及子公司不存在违法违规情况，也不存在受到行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情形。

## 四、报告期内资金被实际控制人及其控制企业占用或者为实际控制人及其控制企业担保的情况

报告期内，发行人不存在资金被实际控制人及其控制企业占用的情况，亦不存在为实际控制人及其控制企业进行担保的情况。

## 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力情况

发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，具体如下：

## （一）资产完整

发行人具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施。截至本招股说明书签署日，发行人合法拥有或使用与生产经营有关的主要厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。截至本招股说明书签署日，发行人不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，不存在资产、资金被控股股东或其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况，也未为公司其他股东提供资产抵押和担保。

## （二）人员独立

发行人的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## （三）财务独立

自报告期初至 2023 年 9 月，发行人与实际控制人控制的其他企业东骏激光曾共同使用同一套用友财务软件，但发行人与东骏激光在上述财务软件中分别设置账套，并拥有独立的账套查阅与操作权限。自 2023 年 9 月起，发行人与东骏激光未再使用同一套财务软件。截至本招股说明书签署日，发行人和东骏激光不存在共用财务软件的情形。

报告期内，发行人和东骏激光各自设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够各自独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并各自分别开立了银行账户，不存在共用银行账户的情形。发行人与东骏激光之间财务独立。

截至本招股说明书签署日，发行人已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策；具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

## （四）机构独立

发行人设有股东会、董事会、审计委员会等决策、执行、监督机构，各机构

均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，并依照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会会议事规则》等规定规范运行。

发行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

## （五）业务独立

发行人的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

## （六）经营稳定性

发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均未发生重大不利变化；截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人持有的发行人股份权属清晰，不存在可能导致控制权变更的重大权属纠纷；最近两年，发行人实际控制人未发生变化。

## （七）影响持续经营的重大事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，亦不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

# 六、发行人同业竞争情况

## （一）发行人与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业不存在构成重大不利影响的同业竞争

报告期内，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的除发行人及子公司外的其他企业主营业务情况如下：

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系                               | 主营业务及差异分析                            |
|----|-------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 东骏投资  | 发行人控股股东                            | 主要从事股权投资；与发行人不属于相同或相似业务。             |
| 2  | 东骏激光  | 东骏投资直接持股 63.44%，实际控制人叶向明、毛冬间接控制的企业 | 东骏激光为发行人控股股东东骏投资控制的企业，主要从事激光晶体材料、功能陶 |

| 序号 | 关联方名称          | 关联关系                                                              | 主营业务及差异分析                                                                                                                                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                                                                   | 瓷及激光器模组研发、生产和销售，主要产品包括激光晶体材料、功能陶瓷、激光模组、特殊光学窗口、压电晶体等；<br>与发行人不属于相同或相似业务。                                                                    |
| 3  | 骏铭佳创           | 东骏激光持股 100.00%，实际控制人叶向明、毛冬间接控制的企业                                 | 骏铭佳创作为东骏激光的全资子公司，依托其母公司激光晶体材料方面的优势，主要从事各种固体激光器及衍生设备的研发、生产与销售，已有/在研产品包括人眼安全激光器、脉冲激光器、医疗应用激光模组、基于飞秒激光器应用的牙科 3D 激光自动磨削设备等；<br>与发行人不属于相同或相似业务。 |
| 4  | 东莞普英           | 发行人股东，东骏投资担任执行事务合伙人，实际控制人叶向明、毛冬间接控制的企业；控股股东东骏投资的一致行动人             | 主要从事股权投资；<br>与发行人不属于相同或相似业务。                                                                                                               |
| 5  | 东莞市圆盈健康管理有限公司  | 实际控制人叶向明、毛冬实际控制的企业，该企业已于 2025 年 4 月注销                             | 报告期内未经营实际业务，仅对外出租房产；<br>与发行人不属于相同或相似业务。                                                                                                    |
| 6  | 东莞智勤企业管理服务有限公司 | 实际控制人叶向明、毛冬实际控制的企业，该企业已于 2025 年 5 月注销                             | 报告期内未经营实际业务；<br>与发行人不属于相同或相似业务。                                                                                                            |
| 7  | 东莞市衍德贸易有限公司    | 实际控制人毛冬的儿子及其配偶控制的企业，该企业已于 2025 年 5 月注销                            | 报告期内未经营实际业务；<br>与发行人不属于相同或相似业务。                                                                                                            |
| 8  | 东莞市昊圆设备维修有限公司  | 实际控制人毛冬的儿子控制的企业，该企业已于 2025 年 5 月注销                                | 报告期内未经营实际业务；<br>与发行人不属于相同或相似业务。                                                                                                            |
| 9  | 东莞市聚宝餐饮管理有限公司  | 实际控制人毛冬的儿子控制的企业                                                   | 报告期内未经营实际业务；<br>与发行人不属于相同或相似业务。                                                                                                            |
| 10 | 东莞市东城雨果花店      | 实际控制人毛冬的儿子的配偶控制的企业                                                | 主要经营花卉销售、租赁等业务；<br>与发行人不属于相同或相似业务。                                                                                                         |
| 11 | 东莞聚慧           | 发行人持股 5%以上股东；发行人控股股东东骏投资的一致行动人；发行人实际控制人叶向明的弟弟叶向忠担任执行事务合伙人并形成控制的企业 | 主要从事股权投资；<br>与发行人不属于相同或相似业务。                                                                                                               |

上述关联企业中，东骏投资、东莞普英、东莞聚慧为股权投资平台，东骏激光、骏铭佳创、东莞市聚宝餐饮管理有限公司、东莞市东城雨果花店亦与发行人主营业务、产品不同；截至本招股说明书签署日，东莞市圆盈健康管理有限公司、东莞智勤企业管理服务有限公司、东莞市衍德贸易有限公司、东莞市昊圆设备维修有限公司已注销；上述关联企业与发行人不构成同业竞争。

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其近亲属未直接或间接以任何形式从事、经营或为他人经营与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务，公司不存在与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。

报告期内，发行人与东骏激光存在关联交易情形，具体请参见本节之“七、关联方与关联交易情况”之“（二）报告期内关联交易情况”。东骏激光基本情况如下：

|          |                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 成都东骏激光股份有限公司                                                                                                                                                                                       |
| 成立时间     | 2001 年 4 月 27 日                                                                                                                                                                                    |
| 注册资本     | 6,000.00 万元人民币                                                                                                                                                                                     |
| 主要生产经营地  | 四川成都蒲江县鹤山镇工业开发区                                                                                                                                                                                    |
| 主营业务     | 主要从事激光晶体材料、功能陶瓷及激光器模组研发、生产和销售                                                                                                                                                                      |
| 与发行人业务关系 | 无直接业务关系，亦不构成同业竞争                                                                                                                                                                                   |
| 经营范围     | 开发、制造、加工、销售光电子器件及其它光学电子通讯器材和设备（以上核准项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |

东骏激光最近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

| 期间                           | 总资产       | 净资产       | 营业收入     | 净利润      |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 | 24,582.73 | 19,024.02 | 6,153.81 | 843.14   |
| 2024 年 12 月 31 日/2024 年度     | 24,005.44 | 18,181.15 | 9,099.49 | 1,340.40 |

注：以上为东骏激光单体报表数据；2024 年财务数据已经北京睿瑛会计师事务所（普通合



伙）审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免与发行人产生同业竞争，发行人实际控制人、控股股东及其一致行动人出具了《避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件三、与投资者保护相关的承诺”。

七、关联方与关联交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，发行人关联方和关联关系如下：

1、控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东东骏投资以及实际控制人叶向明、毛冬为发行人的关联方。

此外，与发行人控股股东东骏投资构成《上市公司收购管理办法(2025 修正)》第八十三条第二款第（五）项所述的一致行动的王晓峰、潘岭峰、唐昊，为发行人的关联方。

发行人控股股东、实际控制人情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）发行人控股股东基本情况”、“（二）发行人实际控制人基本情况”。

2、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人、法人或其他组织

截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人之外，发行人其他直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人股东、法人或其他组织情况如下：

| 序号 | 关联方  | 关联关系             | 备注                                         |
|----|------|------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 东莞莱普 | 直接持有发行人 12.02%股份 | 东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈和东莞普英为发行人控股股东东骏投资的一致行动人 |
| 2  | 东莞聚慧 | 直接持有发行人 9.96%股份  |                                            |
| 3  | 东莞骏峰 | 直接持有发行人 7.47%股份  |                                            |
| 4  | 东莞天戈 | 直接持有发行人 6.43%股份  |                                            |

| 序号 | 关联方        | 关联关系            | 备注 |
|----|------------|-----------------|----|
| 5  | 东莞普英       | 直接持有发行人 4.28%股份 |    |
| 6  | 国家集成电路基金二期 | 直接持有公司 7.66%股份  | -  |
| 7  | 傅建伟        | 间接持有发行人 5.21%股份 | -  |

注：直接持有发行人 5%以上股份的股东的一致行动人为发行人关联方。

### 3、发行人的子公司

发行人的子公司情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人子公司及参股公司的情况”。

### 4、发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人控制的除发行人及其子公司之外的其他企业情况请参见本节“六、发行人同业竞争情况”之“（一）发行人与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业不存在构成重大不利影响的同业竞争”。

### 5、发行人关联自然人

发行人实际控制人、直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及上述人员关系密切的家庭成员和发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员为发行人的关联自然人。关系密切的家庭成员包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员详细情况请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”。

### 6、发行人其他关联方

发行人的其他关联方包括：由直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或间接控制的企业；发行人的关联自然人控制的，或者由其担任董事、高级管理人员的企业；根据实质重于形式原则认定的关联方。截至本招股说明书签署日，除与取消监事会前在任监事相关的关联方于本小节“7、曾经存在关联关系关联方及关联方变化情况”中披露外，发行人主要其他关联方和关联关系如下：

| 序号 | 关联方                      | 关联关系                                                                                |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 东骏激光                     | 实际控制人叶向明、毛冬实际控制的企业；控股股东东骏投资持股 63.44%；实际控制人、董事长叶向明担任董事；实际控制人、董事毛冬担任董事长；董事傅建伟担任董事、总经理 |
| 2  | 骏铭佳创                     | 实际控制人叶向明、毛冬实际控制的企业；东骏激光持股 100.00%；发行人董事傅建伟担任执行董事、经理                                 |
| 3  | 厦门元新兰产业投资有限公司            | 持股 5%以上股东国家集成电路基金二期持股 100.00%                                                       |
| 4  | 北京鸿丰投资股份有限公司             | 实际控制人、董事叶向明担任监事会主席；实际控制人、董事毛冬担任董事                                                   |
| 5  | 北京润和微光科技有限公司             | 董事、副总经理王晓峰担任董事长；副总经理潘岭峰担任董事                                                         |
| 6  | 成都芬得利建筑材料有限公司            | 独立董事曹昱持股 55.00%，曹昱的配偶担任总经理                                                          |
| 7  | 东莞市聚宝餐饮管理有限公司            | 实际控制人、董事毛冬的儿子担任执行董事、经理，并持股 100.00%                                                  |
| 8  | 东莞市东城雨果花店                | 实际控制人、董事毛冬的儿子的配偶为该个体工商户的经营者                                                         |
| 9  | 江苏华医大健康服务股份有限公司          | 董事傅建伟的女儿的配偶担任董事                                                                     |
| 10 | 国寿（南京）健康管理有限公司           | 董事傅建伟的女儿的配偶担任董事、经理                                                                  |
| 11 | 成都西煜百年商贸有限公司             | 独立董事曹昱的配偶担任经理并持股 60.00%；曹昱的配偶的哥哥担任执行董事                                              |
| 12 | 上海高等教育建筑设计研究院有限公司        | 副总经理潘岭峰的配偶的哥哥担任董事、经理                                                                |
| 13 | 深圳市佳时特模具材料有限公司           | 副总经理杨博的弟弟担任执行董事、总经理，并持股 100.00%                                                     |
| 14 | 共青城博源凯乐创业投资合伙企业（有限合伙）    | 控股股东东骏投资、实际控制人叶向明的弟弟叶向忠分别持有 24.60%、5.40%合伙份额                                        |
| 15 | 共青城博源联丰创业投资合伙企业（有限合伙）    | 控股股东东骏投资、实际控制人叶向明的弟弟叶向忠分别持有 11.83%、3.40%合伙份额                                        |
| 16 | 东莞市博源朗月机器人股权投资合伙企业（有限合伙） | 控股股东东骏投资、实际控制人叶向明的弟弟叶向忠分别持有 15.63%、15.63%合伙份额                                       |
| 17 | 苏州莱普企业管理合伙企业（有限合伙）       | 持有发行人控股子公司江苏莱普 30.00%的股权的企业                                                         |
| 18 | 邵西河                      | 持有苏州莱普企业管理合伙企业（有限合伙）70.00%合伙份额，间接持有发行人控股子公司江苏莱普 21.00%股权                            |
| 19 | 苏州捷兴激光设备有限公司             | 间接持有发行人控股子公司江苏莱普 21.00%股权的自然人邵西河持股 100.00%并担任执行董事；该企业已于 2025 年 5 月注销                |
| 20 | 叶玉冰                      | 与发行人实际控制人构成《上市公司收购管理办法（2025 修正）》第八十三条第二款第（五）项所述的一致行动                                |
| 21 | 刘钧伟                      | 与发行人实际控制人构成《上市公司收购管理办法（2025 修正）》第八十三条第二款第（五）项所述的一致行动                                |

| 序号 | 关联方 | 关联关系                                                 |
|----|-----|------------------------------------------------------|
|    |     | 致行动                                                  |
| 22 | 刘嘉桦 | 与发行人实际控制人构成《上市公司收购管理办法(2025 修正)》第八十三条第二款第(五)项所述的一致行动 |

## 7、发行人曾经存在关联关系关联方及关联方变化情况

发行人曾经存在关联关系的关联方包括：曾经直接或间接控制发行人的法人及其控制的除发行人外的其他企业；曾经直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人以及该等主体控制的企业，一致行动人为自然人的，相关自然人担任董事、高级管理人员的企业亦为发行人曾经的关联方；曾经间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；曾经直接或间接控制发行人的自然人及与其关系密切的家庭成员以及该等自然人控制的企业、担任董事和高级管理人员的企业；曾经直接或间接持有上市公司 5%以上股份的自然人及与其关系密切的家庭成员以及该等自然人控制的企业、担任董事和高级管理人员的企业；曾经直接或间接控制发行人的法人的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人以及该等自然人控制的企业、担任董事和高级管理人员的企业；发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员曾经控制的企业、担任董事和高级管理人员的企业等亦为发行人曾经的关联方。

自报告期初前十二个月至本招股说明书签署日，与发行人曾经存在关联关系的主要关联方和关联关系如下：

| 序号 | 关联方名称       | 关联关系                                                                            |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 曾滔勇         | 2021 年 1 月至 2021 年 2 月，曾为发行人实际控制人                                               |
| 2  | 何剑雄         | 2021 年 1 月至 2021 年 2 月，曾通过东骏集团间接持有发行人 5%以上股份                                    |
| 3  | 陈小钧         | 2021 年 1 月至 2021 年 2 月，曾通过东骏激光间接持有发行人 5%以上股份                                    |
| 4  | 东骏集团        | 2021 年 1 月至 2021 年 2 月，曾通过原控股股东东骏激光间接控制发行人；原实际控制人曾滔勇、原间接持股 5%以上股东何剑雄分别持股 50.00% |
| 5  | 北方激光研究院有限公司 | 曾通过原控股股东东骏激光间接持有发行人 5%以上股份                                                      |
| 6  | 东莞市篁城开发有限公司 | 实际控制人叶向明、毛冬曾分别担任董事长、董事，已于 2021 年 9 月卸任；原实际控制人曾滔勇担任执行董事、经理                       |
| 7  | 德雄發展有限公司    | 原实际控制人曾滔勇持股 51.00%                                                              |

| 序号 | 关联方名称           | 关联关系                                                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 8  | 东莞市东骏物业管理有限公司   | 原实际控制人曾滔勇担任执行董事                                                  |
| 9  | 东莞市骏博置业投资有限公司   | 原实际控制人曾滔勇担任执行董事                                                  |
| 10 | 成都东骏房地产开发有限公司   | 原实际控制人曾滔勇担任董事长                                                   |
| 11 | 东莞市东骏房地产投资有限公司  | 原实际控制人曾滔勇担任董事长、经理                                                |
| 12 | 东莞市汉邦房地产有限公司    | 原实际控制人曾滔勇担任执行董事、经理                                               |
| 13 | 东莞市汉邦穗丰房地产有限公司  | 原实际控制人曾滔勇担任执行董事、经理                                               |
| 14 | 东莞市弘大贸易有限公司     | 原实际控制人曾滔勇担任执行董事、经理                                               |
| 15 | 东莞市汉邦投资有限公司     | 原实际控制人曾滔勇担任执行董事、经理                                               |
| 16 | 东莞市汉邦东方实业投资有限公司 | 原实际控制人曾滔勇任执行董事、经理                                                |
| 17 | 东莞市珠江虎门综合开发有限公司 | 原实际控制人曾滔勇担任董事                                                    |
| 18 | 汉邦能源            | 原实际控制人曾滔勇担任董事                                                    |
| 19 | 东骏电器            | 原实际控制人曾滔勇担任执行董事、总经理                                              |
| 20 | 成都湖景湾物业服务集团有限公司 | 东骏集团间接控制的企业                                                      |
| 21 | 东莞市东盈典当有限公司     | 东骏集团间接控制的企业                                                      |
| 22 | 汉邦投资集团有限公司      | 东骏集团直接持股 30.00%的企业                                               |
| 23 | 东莞市汉邦置业管理有限公司   | 汉邦投资集团有限公司持股 100.00%的企业                                          |
| 24 | 东莞市汉邦物业管理有限公司   | 汉邦投资集团有限公司持股 90.00%的企业                                           |
| 25 | 东莞市虎门南湾物业管理有限公司 | 汉邦投资集团有限公司间接控制的企业                                                |
| 26 | 广东云景旅游文化产业有限公司  | 汉邦投资集团有限公司直接持股 35.00%的企业                                         |
| 27 | 东莞市乾利机电安装工程有限公  | 原间接持股 5%以上股东陈小钧的儿子担任经理、执行董事                                      |
| 28 | 东莞市圆盈健康管理有限公司   | 实际控制人叶向明、毛冬曾实际控制的企业；该企业已于 2025 年 4 月注销                           |
| 29 | 东莞智勤企业管理服务有限公司  | 实际控制人叶向明、毛冬曾实际控制的企业；该企业已于 2025 年 5 月注销                           |
| 30 | 东莞市衍德贸易有限公司     | 实际控制人、董事毛冬的儿子曾担任执行董事；毛冬的儿子的配偶曾担任监事，并持股 55.00%；该企业已于 2025 年 5 月注销 |
| 31 | 东莞市昊圆设备维修有限公司   | 实际控制人、董事毛冬的儿子合计持股 100.00%的企业；该企业已于 2025 年 5 月注销                  |



| 序号 | 关联方名称                                         | 关联关系                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 东莞市宏昌贸易有限公司                                   | 实际控制人叶向明及其弟弟叶向忠曾分别持股 50.00%的企业；该企业已于 2023 年 4 月注销                                           |
| 33 | 共青城原始玖号创业投资合伙企业（有限合伙）                         | 实际控制人叶向明的弟弟叶向忠曾持有 62.50%的合伙份额，2021 年 1 月已退出；该企业已于 2025 年 5 月注销                              |
| 34 | 东莞冀农投资管理中心（有限合伙）                              | 实际控制人叶向明的弟弟叶向忠曾持有 28.57%合伙份额；曾通过原控股股东东骏激光间接控制发行人的东骏集团曾持有 70.43%合伙份额；该企业已于 2022 年 4 月 22 日注销 |
| 35 | 东莞市京鸿贸易有限公司                                   | 实际控制人毛冬的儿子曾持股 50.50%的企业；该企业已于 2023 年 9 月注销                                                  |
| 36 | 成都东骏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                          | 董事傅建伟持有 60.00%的合伙份额，担任执行事务合伙人；该企业已于 2022 年 5 月注销                                            |
| 37 | 成都莱普企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                          | 董事、总经理黄永忠曾担任执行事务合伙人；该企业已于 2022 年 5 月注销                                                      |
| 38 | 中山莱普激光技术有限公司                                  | 董事、总经理黄永忠曾担任执行董事、经理；该企业已于 2024 年 2 月注销                                                      |
| 39 | 成都骏峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                          | 董事、副总经理王晓峰曾担任执行事务合伙人；该企业已于 2022 年 5 月注销                                                     |
| 40 | 德州润和光电科技有限公司                                  | 董事、副总经理王晓峰曾持股 40.00%，为其第一大股东；该企业已于 2023 年 7 月注销                                             |
| 41 | 北京隆宇腾飞科技有限公司                                  | 董事、副总经理王晓峰的配偶曾担任执行董事、经理；发行人董事、副总经理王晓峰的配偶以及王晓峰的岳母曾分别持股 50.00%；该企业已于 2025 年 8 月注销             |
| 42 | 广东佛智芯微电子有限公司                                  | 取消监事会前在任职工监事刘辉涛担任董事                                                                         |
| 43 | 中科光纳科技（深圳）有限公司（以下简称“中科光纳”）                    | 取消监事会前在任职工监事刘辉涛的配偶直接持股 70.00%                                                               |
| 44 | 得旭智能科技（深圳）有限公司（曾用名为名光智能科技（佛山）有限公司，以下简称“得旭智能”） | 取消监事会前在任职工监事刘辉涛的配偶直接持股 70.00%的企业中科光纳曾经持股 100.00%，2024 年 7 月已退出持股                            |
| 45 | 蚌埠齐心共创机电设备制造合伙企业（有限合伙）                        | 取消监事会前在任职工监事刘辉涛曾持有 47.37%的合伙份额并担任执行事务合伙人；该企业已于 2023 年 2 月注销                                 |
| 46 | 捷科光纳科技（深圳）有限公司                                | 取消监事会前在任职工监事刘辉涛的配偶直接持股 70.00%的企业中科光纳持股 100.00%                                              |
| 47 | 中科一号激光智能（深圳）合伙企业（有限合伙）                        | 取消监事会前在任职工监事刘辉涛的配偶担任执行事务合伙人，并持有 76.67%合伙份额                                                  |
| 48 | 迈科半导体（深圳）合伙企业（有限合伙）                           | 取消监事会前在任职工监事刘辉涛的配偶直接持股 70.00%的企业中科光纳为该企业的执行事务合伙人，并持有 79.59%合伙份额                             |



| 序号 | 关联方名称                 | 关联关系                                                                                                                   |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 中科海特半导体（深圳）合伙企业（有限合伙） | 取消监事会前在任职工监事刘辉涛的配偶直接持股 70.00%的企业中科光纳曾担任执行事务合伙人并持有部分合伙份额；2025 年 5 月，中科光纳已退出                                             |
| 50 | 迈科半导体技术（广州）有限公司       | 取消监事会前在任职工监事刘辉涛的配偶直接持股 70.00%的企业中科光纳曾担任执行事务合伙人的迈科半导体（深圳）合伙企业（有限合伙）持股 55.00%的企业；2025 年 5 月，中科光纳已退出中科海特半导体（深圳）合伙企业（有限合伙） |

## （二）报告期内关联交易情况

### 1、重大关联交易判断标准

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》对关联交易信息披露的规定，结合发行人实际经营情况，发行人将交易金额超过 300.00 万元的关联交易或金额虽未达到上述标准但发行人认为较为重要的相关事项认定为重大关联交易，从而区分重大关联交易和一般关联交易。

### 2、一般关联交易

报告期内，发行人一般关联交易的汇总情况如下：

单位：万元

| 交易类型            | 关联方  | 交易内容         | 2025 年<br>1-9 月 | 2024<br>年度 | 2023<br>年度 | 2022<br>年度 |
|-----------------|------|--------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 经常性<br>关联交<br>易 | 关联销售 | 得旭智能         | -               | -          | -          | 193.81     |
|                 |      | 中科光纳         | -               | -          | 13.27      | -          |
|                 | 关联采购 | 得旭智能         | -               | -          | 9.84       | 65.32      |
|                 |      | 中科光纳         | -               | -          | 9.20       | 5.16       |
|                 |      | 王晓峰          | -               | -          | -          | 95.20      |
|                 |      | 潘岭峰          | -               | -          | -          | 96.20      |
|                 | 关联租赁 | 苏州捷兴激光设备有限公司 | -               | -          | -          | 14.17      |

报告期内，发行人先后通过深圳办事处、深圳分公司经营华南地区相关业务。得旭智能作为广东企业，在华南地区有一定的销售和采购渠道优势。2022 年，发行人向得旭智能销售激光打标机、激光切割机等激光设备，金额为 193.81 万元，得旭智能作为经销商，向发行人采购上述产品后销售给其自行开发的客户。2022 年、2023 年发行人向得旭智能采购原材料主要系利用其渠道优势，降低成

本。发行人向得旭智能销售、采购产品，由双方参考市场价格协商定价，定价公允、合理。

王晓峰、潘岭峰于 2023 年 1 月正式入职公司。2022 年，两人为公司提供关于半导体工艺方面的技术咨询等劳务服务。发行人根据提供劳务服务的内容，与两人协商确定相关费用，定价公允、合理。

3、重大经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

单位：万元

| 关联方  | 关联交易内容 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------|--------|--------------|---------|---------|---------|
| 东骏激光 | 采购原材料  | -            | 2.41    | 13.07   | 257.09  |
|      | 采购软件   | -            | -       | 34.50   | -       |
| 合计   |        | -            | 2.41    | 47.57   | 257.09  |

东骏激光为发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业。

在 2023 年 3 月首次完成市场化融资之前，公司经营资金较为紧张。2022 年至 2023 年，东骏激光根据公司需求代公司采购原材料并垫付采购资金，以缓解公司资金压力。经双方协商，公司与东骏激光的代采原材料结算价格相较东骏激光向供应商采购价格的加价幅度为 2.00%；除加价 2.00%之外，发行人对 2022 年、2023 年因东骏激光代采原材料导致的占用东骏激光资金按照 2.35%利率另行计提利息并支付给东骏激光。2022 年、2023 年，发行人参照 2.35%的利率按月对占用的东骏激光采购原材料资金计提利息金额分别为 56.73 万元、53.83 万元。

2022 年 12 月、2023 年 12 月中国人民银行发布的金融机构人民币贷款加权平均利率（季度）分别为 4.14%、3.83%。报告期内，发行人向东骏激光代采原材料支付的整体价格为东骏激光向供应商采购价格的 4.35%（加价幅度 2.00%以及按 2.35%利率另行计提利息），与同时期市场贷款利率较为接近，公允、合理。

自 2024 年起，发行人不再由东骏激光代采原材料，不存在占用东骏激光资金情形。2024 年，发行人向东骏激光零星采购少量原材料，主要为发行人因生产需要向东骏激光购买其自产的加工件。

报告期初至 2023 年 9 月，发行人存在与关联方东骏激光共用财务软件情形，

共用财务软件的权属方原为东骏激光。发行人出于实现财务软件独立性的考虑，于 2023 年向东骏激光买断财务软件使用许可，价格为 34.50 万元，由双方参考市场价格协商定价，定价公允、合理。

（2）关键管理人员及其亲属报酬

单位：万元

| 项目             | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度  | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----------------|--------------|----------|---------|---------|
| 关键管理人员薪酬       | 563.13       | 1,097.33 | 804.85  | 442.44  |
| 关键管理人员股份支付费用   | 96.63        | 128.85   | 445.11  | 402.16  |
| 关键管理人员亲属薪酬     | 66.57        | 145.81   | 81.27   | 48.44   |
| 关键管理人员亲属股份支付费用 | -            | -        | 31.54   | 31.54   |

注：含子公司关键管理人员；报告期内，发行人 3 名关键管理人员的配偶在公司任职，产生薪酬及股份支付费用。

报告期内，关键管理人员及其亲属薪酬变动主要系报告期内发行人关键管理人员数量变化以及发行人每年根据市场和公司发展情况对员工薪酬进行调整所致。

4、重大偶发性关联交易

（1）关联方资金拆借

单位：万元

| 序号 | 资金拆借主体 | 提供借款的关联方           | 拆入借款金额   | 起始日       | 到期日        | 利率情况            |
|----|--------|--------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| 1  | 莱普科技   | 东骏激光               | 1,000.00 | 2022/1/1  | 2023/2/3   | 年利率 4.35%、3.80% |
| 2  | 莱普科技   | 东骏激光               | 420.00   | 2022/1/1  | 2023/2/1   | 年利率 3.80%       |
| 3  | 莱普科技   | 东骏激光               | 300.00   | 2022/1/1  | 2022/6/28  | 年利率 3.80%       |
| 4  | 莱普科技   | 东骏激光               | 700.00   | 2022/8/6  | 2022/8/30  | 年利率 6.00%       |
| 5  | 莱普科技   | 东骏投资               | 700.00   | 2022/8/29 | 2022/10/28 | 年利率 6.00%       |
| 6  | 江苏莱普   | 苏州莱普企业管理合伙企业（有限合伙） | 173.00   | 2024/7/11 | 2024/12/12 | 年利率 3.45%       |
| 7  | 江苏莱普   | 苏州莱普企业管理合伙企业（有限合伙） | 40.00    | 2025/6/16 | 2025/11/14 | 年利率 3.10%       |

注：本表中第一项发行人向东骏激光的 1,000.00 万元借款，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月

5日，执行的借款利率为4.35%；2022年2月6日至2023年2月3日执行的借款利率为3.80%，系双方经协商参考市场利率进行调整。

报告期内，发行人因经营需要分别向东骏激光、东骏投资借入资金 2,420.00 万元、700.00 万元；苏州莱普企业管理合伙企业（有限合伙）持有发行人子公司江苏莱普 30.00%股权，江苏莱普因经营需要向苏州莱普企业管理合伙企业（有限合伙）借入资金 **213.00 万元**。2022 年 12 月、2023 年 12 月、2024 年 12 月中国人民银行发布的金融机构人民币贷款加权平均利率（季度）分别为 4.14%、3.83%、3.28%；报告期内，发行人及子公司与东骏激光、东骏投资及苏州莱普企业管理合伙企业（有限合伙）之间资金拆借的利率与前述市场贷款利率相对接近，具备合理性。

截至报告期末，发行人与东骏激光、东骏投资之间不存在资金拆借情形；**江苏莱普 2025 年 6 月向苏州莱普企业管理合伙企业(有限合伙)借款 40.00 万元，已于 2025 年 11 月到期并已全部偿还。**

（2）关联方票据往来

2022 年，为缓解经营资金紧张问题，发行人将到期期限较长的票据向关联方东骏激光进行背书转让以获取银行存款。报告期内，发行人与东骏激光票据往来仅发生在 2022 年度，金额共计 456.23 万元。

（3）关联方担保或共同借款

报告期内，发行人存在关联方为公司、子公司提供担保、反担保或共同借款情形，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 担保方/共同借款人   | 被担保方/主债务人 | 性质     | 担保/共同借款金额 | 主债务起始日     | 主债务终止日     | 是否已经履行完毕 |
|----|-------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|----------|
| 1  | 黄永忠、刘屹      | 莱普科技      | 担保、反担保 | 800.00    | 2021/5/10  | 2022/5/9   | 是        |
| 2  | 叶向明、刘淑贞     | 莱普科技      | 担保     | 1,000.00  | 2022/3/30  | 2023/3/29  | 是        |
| 3  | 叶向明、毛冬、黄永忠  | 莱普科技      | 担保、反担保 | 1,000.00  | 2022/5/10  | 2023/5/9   | 是        |
| 4  | 东骏投资、叶向明、毛冬 | 莱普科技      | 担保、反担保 | 1,000.00  | 2022/9/21  | 2023/9/20  | 是        |
| 5  | 东骏投资、叶向明、毛冬 | 莱普科技      | 担保     | 2,500.00  | 2022/10/21 | 2023/10/20 | 是        |
| 6  | 东骏投资、叶      | 莱普科技      | 担保     | 1,000.00  | 2023/8/10  | 2024/9/9   | 是        |

| 序号 | 担保方/共同借款人       | 被担保方/主债务人 | 性质     | 担保/共同借款金额 | 主债务起始日     | 主债务终止日     | 是否已经履行完毕 |
|----|-----------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|----------|
|    | 向明、毛冬           |           |        |           |            |            |          |
| 7  | 叶向明、毛冬          | 莱普科技      | 担保、反担保 | 1,000.00  | 2023/9/12  | 2024/9/11  | 是        |
| 8  | 叶向明、刘淑贞、毛冬      | 莱普科技      | 担保、反担保 | 1,000.00  | 2023/9/21  | 2024/9/20  | 是        |
| 9  | 东骏投资、叶向明、刘淑贞、毛冬 | 莱普科技      | 担保     | 34,600.00 | 2024/3/14  | 2035/3/12  | 否        |
| 10 | 东骏投资、叶向明、毛冬     | 莱普科技      | 担保     | 1,000.00  | 2024/7/22  | 2026/1/21  | 否        |
| 11 | 东骏投资、叶向明、毛冬     | 莱普科技      | 担保     | 1,000.00  | 2024/7/22  | 2026/1/21  | 否        |
| 12 | 叶向明、毛冬          | 莱普科技      | 担保     | 1,000.00  | 2024/9/11  | 2024/11/29 | 是        |
| 13 | 叶向明、毛冬          | 莱普科技      | 担保     | 1,000.00  | 2024/11/27 | 2025/11/26 | 否        |
| 14 | 邵西河             | 江苏莱普      | 共同借款   | 100.00    | 2023/8/7   | 2024/8/7   | 是        |
| 15 | 邵西河             | 江苏莱普      | 共同借款   | 100.00    | 2024/11/29 | 2027/11/29 | 否        |

注：1、本表中第 1 项，黄永忠、刘屹为发行人借款提供连带责任保证；成都中小企业融资担保有限责任公司为发行人借款提供担保，黄永忠、刘屹为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。2、本表中第 3 项，叶向明、毛冬为发行人借款提供连带责任保证；成都中小企业融资担保有限责任公司为发行人借款提供担保，叶向明、毛冬、黄永忠为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。3、本表中第 4 项，叶向明、毛冬为发行人借款提供连带责任保证；成都中小企业融资担保有限责任公司为发行人借款提供担保，叶向明、毛冬为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。4、本表中第 7 项，叶向明、毛冬为发行人借款提供连带责任保证；成都中小企业融资担保有限责任公司为发行人借款提供担保，叶向明、毛冬为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。5、本表中第 8 项，叶向明、刘淑贞为发行人借款提供连带责任保证；成都中小企业融资担保有限责任公司为发行人借款提供担保，发行人实际控制人叶向明、毛冬为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。6、本表中第 12 项，银行综合授信额度 1,000.00 万元，叶向明、毛冬最高担保金额 1,000.00 万元，发行人实际借款 100.00 万元。7、本表中第 14 项和第 15 项，邵西河作为共同借款人与江苏莱普承担连带债务责任，债权人可以向江苏莱普或邵西河任何一方主张全部债权。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收款项

单位：万元

| 项目名称 | 关联方  | 2025.9.30 |      | 2024.12.31 |      | 2023.12.31 |      | 2022.12.31 |       |
|------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|------------|-------|
|      |      | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备  |
| 预付款项 | 得旭智能 | -         | -    | -          | -    | 0.35       | -    | -          | -     |
| 应收账款 | 中科光纳 | -         | -    | -          | -    | -          | -    | 60.93      | 27.47 |
| 其他应  | 东骏投资 | -         | -    | -          | -    | -          | -    | 483.75     | 4.84  |

| 项目名称  | 关联方          | 2025. 9. 30 |      | 2024.12.31 |      | 2023.12.31 |      | 2022.12.31 |       |
|-------|--------------|-------------|------|------------|------|------------|------|------------|-------|
|       |              | 账面余额        | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备  |
| 收款    |              |             |      |            |      |            |      |            |       |
| 其他应收款 | 东莞莱普         | -           | -    | -          | -    | -          | -    | 202.29     | 10.11 |
| 其他应收款 | 东莞聚慧         | -           | -    | -          | -    | -          | -    | 180.00     | 1.80  |
| 其他应收款 | 东莞骏峰         | -           | -    | -          | -    | -          | -    | 135.00     | 1.35  |
| 其他应收款 | 东莞天戈         | -           | -    | -          | -    | -          | -    | 123.84     | 1.24  |
| 其他应收款 | 苏州捷兴激光设备有限公司 | -           | -    | -          | -    | -          | -    | 5.15       | 0.77  |

2022 年末、2023 年末，发行人与中科光纳、得旭智能之间的应收账款、预付款项主要系关联销售、采购所致。

2022 年末，发行人与股东东骏投资、东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈之间的其他应付款，主要系该等股东应向发行人退回的 2021 年度分红款。相关分红退回事项详见“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（五）股利分配情况”。

## （2）应付款项

单位：万元

| 项目名称  | 关联方                | 2025. 9. 30 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 2022.12.31 |
|-------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 应付账款  | 东骏激光               | -           | 1.10       | 19.51      | 1,428.89   |
| 应付账款  | 中科光纳               | -           | 3.72       | 26.69      | 42.80      |
| 应付账款  | 得旭智能               | -           | -          | -          | 119.30     |
| 其他应付款 | 东骏激光               | -           | -          | 7.38       | 1,707.60   |
| 其他应付款 | 苏州莱普企业管理合伙企业（有限合伙） | 6.87        | 1.61       | -          | -          |

报告期各期末，发行人与东骏激光、中科光纳、得旭智能之间的应付账款系关联采购所致。发行人与东骏激光间的关联采购情况详见本小节之“3、重大经常性关联交易”之“（1）采购商品/接受劳务”。



2022 年末、2023 年末，发行人与东骏激光之间的其他应付款主要为发行人应付的拆借资金本金及利息，资金拆借事项详见本小节之“4、重大偶发性关联交易”之“（1）关联方资金拆借”；此外，2022 年末亦存在发行人因报告期前向东骏激光租赁房屋导致的应付款项，相关款项已于 2023 年结清。

报告期各期末，发行人与苏州莱普企业管理合伙企业（有限合伙）之间的其他应付款，系发行人控股子公司江苏莱普应向苏州莱普企业管理合伙企业（有限合伙）支付的借款利息，借款事项详见本小节之“4、重大偶发性关联交易”之“（1）关联方资金拆借”。

## 6、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期各期，发行人向关联方采购占营业成本比例、向关联方销售占营业收入比例均较小，对发行人财务状况及经营成果的影响较小。

发行人具有独立的研发、采购、生产与销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不存在依赖主要股东及其控制的其他企业的情况。报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循公平、公开、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

### （三）报告期内关联交易履行程序情况

#### 1、董事会和股东大会对报告期内关联交易的确认情况

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第二届董事会第八次会议，于 2025 年 8 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于确认 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月关联交易的议案》，对发行人 **2022 年度、2023 年度、2024 年度**应提交董事会或股东会审议的关联交易进行了确认，关联董事、关联股东已回避表决。

公司于 2026 年 3 月 6 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年 1-9 月关联交易的议案》，对发行人 2025 年 1-9 月关联交易进行了确认，关联董事已回避表决。

## 2、独立董事关于公司报告期内关联交易执行情况的意见

发行人独立董事对上述关联交易议案发表了肯定意见，认为上述关联交易是在自愿和诚信的原则下进行的，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合公司价值最大化的基本原则。交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。上述关联交易的表决是在公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，对于发行人报告期内根据《公司章程》应提交董事会或股东会审议的关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格合法公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况；发行人独立董事在审议相关关联交易事项时发表了肯定意见。

### （四）规范和减少关联交易的措施

发行人已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等制度中，规定了与关联交易相关的回避表决制度、决策权限、决策程序等，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

### （五）关于规范关联交易的承诺

公司持股 5%以上股东东骏投资、东莞莱普、东莞聚慧、国家集成电路基金二期、东莞骏峰、东莞天戈以及东骏投资的一致行动人东莞普英分别作出关于规范关联交易的承诺，详情请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“附件三、与投资者保护相关的承诺”之“（八）关于规范关联交易的承诺”。

## 八、比照关联交易披露的其他交易

客户 A 为公司报告期内主要客户并且客户 A 的关联方股东 A 持有发行人 5% 以下股份，客户 A 不属于相关法律法规规定的公司关联方，出于审慎考虑，公司将与客户 A 及其关联方相关的交易比照关联交易进行披露。

### （一）相关交易情况

1、销售交易

单位：万元

| 企业名称 | 交易内容 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度   | 2023 年度  | 2022 年度  |
|------|------|--------------|-----------|----------|----------|
| 客户 A | 销售商品 | 11,294.94    | 14,928.95 | 8,177.49 | 1,398.23 |
| 客户 B | 销售商品 | -            | 4,140.00  | -        | -        |
| 合计   |      | 11,294.94    | 19,068.95 | 8,177.49 | 1,398.23 |

注：客户 A、客户 B 为同控下关联企业。

报告期内，公司主要向客户 A、客户 B 销售激光热处理设备。公司激光热处理设备产品主要面向集成电路先进制程、三维异构集成等前沿高端应用领域，客户 A、客户 B 作为国内主流晶圆厂商因生产经营需要向发行人采购相关设备，交易价格由各方协商确定，定价公允。

2、采购交易

单位：万元

| 企业名称        | 交易内容     | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度  | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------|----------|--------------|----------|---------|---------|
| 客户 A        | 验证费      | -            | 1,559.13 | 129.93  | -       |
| 客户 A        | 采购商品     | 1.16         | 0.42     | 0.50    | -       |
| 客户 A        | 员工住宿     | -            | -        | 0.12    | -       |
| 客户 A 的关联方 A | 房屋租赁及物业费 | 3.35         | -        | -       | -       |
| 合计          |          | 4.51         | 1,559.55 | 130.55  | -       |

注：客户 A、客户 A 的关联方 A 为同控下关联企业。

报告期内，发行人向客户 A 支付验证费，系因公司承担的国家某部委应用专项研发项目任务书明确规定，公司需委托国家某部委指定的用户单位客户 A 对设备进行工艺验证。验证费价格为双方基于业务内容协商确定，发行人相关费用支出情况已报国家某部委审批，研发项目已经国家某部委验收通过。

报告期内，发行人员工在客户 A 长期驻场、提供设备安装及售后服务。上述发行人向客户 A 及其关联方采购商品及支付住宿费用、房屋租赁费、物业费系员工驻场服务期间购买洁净服等日常工作用品及住宿产生。相关费用由双方参考市场价格协商确定，定价公允。

（二）应收应付款项情况

## 1、应收款项

单位：万元

| 项目名称 | 企业名称        | 2025. 9. 30 |      | 2024. 12. 31 |       | 2023. 12. 31 |      | 2022. 12. 31 |       |
|------|-------------|-------------|------|--------------|-------|--------------|------|--------------|-------|
|      |             | 账面余额        | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备  | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备  |
| 应收账款 | 客户 A        | 596.26      | 5.96 | 5,057.69     | 50.58 | 185.25       | 1.85 | 1,580.00     | 15.80 |
| 预付款项 | 客户 A        | 0.20        | -    | -            | -     | -            | -    | -            | -     |
| 预付款项 | 客户 A 的关联方 A | 0.98        | -    | 0.98         | -     | -            | -    | -            | -     |

报告期各期末，发行人应收账款主要为销售设备的应收款项；预付款项主要为员工在客户处驻场服务期间产生的房屋租赁费等。

## 2、应付款项

单位：万元

| 项目名称 | 企业名称 | 2025. 9. 30 | 2024. 12. 31 | 2023. 12. 31 | 2022. 12. 31 |
|------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 客户 A | -           | -            | 129.93       | -            |
| 合同负债 | 客户 A | 6,394.82    | 3,917.13     | 2,762.12     | 4,308.16     |

2023 年末，发行人应付账款主要为应向客户 A 支付的验证费，具体情况请参见本节之“八、比照关联交易披露的其他交易”之“（一）相关交易情况之“2、采购交易”；报告期各期末，合同负债主要为发行人预收客户 A 的货款。

## 第九节 投资者保护

### 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序

2025年8月24日，发行人2025年第三次临时股东会决议，本次发行并上市完成前实现的滚存的未分配利润由新股东及原股东按照发行后的持股比例共享。

### 二、本次股利分配政策

为充分考虑全体股东的利益，根据《成都莱普科技股份有限公司章程（草案）》的相关规定，本次发行后公司将实施的主要股利分配政策和相关决策程序如下：

公司现金股利政策目标为：以可持续发展和维护股东权益为宗旨，综合考虑公司盈利状况、经营发展需要和对投资者的合理回报等因素，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，以现金分红为主。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红。公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流满足公司正常经营和长期发展；
- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在满足前述现金分红条件时，原则上公司应当进行一次现金分红。公司年度内现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年度实现的可供分配利润的10.00%。可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80.00%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40.00%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20.00%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。

当公司存在以下任一情形的，可不进行利润分配：

1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

2、当年经审计的资产负债率高于百分之六十五；

3、当年经营性现金流净额为负值；

4、公司认为不适宜进行利润分配的其他情况。

公司对利润分配政策进行决策时，以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策时，首先应经公司二分之一以上的独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会、股东会审议批准。如果调整分红政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交董事会审议。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

### 三、发行人上市后三年内分红回报规划

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，有利于股东投资收益最大化的实现，发行人根据《公司法》等法律法规并结合《公司章程（草案）》的相关规定，制定了公司上市后未来三年分红回报规划（以下简称“股东分红回报规划”）。



### （一）股东分红回报规划制定考虑因素

公司着眼于实际经营情况和长远可持续发展，在综合分析企业发展战略、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东的要求和意愿、资金成本、公司发展所处阶段、盈利规模、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性、公司利润分配不得影响公司的持续经营。

### （二）股东分红回报规划制定原则

公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者合理投资回报，结合公司的盈利情况和公司业务的可持续发展，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司制定利润分配规划应依据《公司章程》等的规定，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。公司股东大会和董事会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事和股东（特别是公众投资者）的意见。

### （三）上市后未来三年股东分红回报计划

1、利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，以现金分红为主。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红。公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流满足公司正常经营和长期发展；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在满足前述现金分红条件时，原则上公司应当进行一次现金分红。公司年度内现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年度实现的可分配利润的 10.00%。可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈

利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80.00%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40.00%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20.00%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以参照前项规定处理。

3、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司在实施上述现金方式分配利润的同时，可以采取股票方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### **（四）股东分红回报规划的决策机制**

1、公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并提交公司股东会通过网络投票的形式进行表决。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占的比例不低于 10.00%。

2、公司对利润分配政策进行决策时，以及因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策时，首先应经公司二分之一以上的独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会、股东会审议批准。如果调整分红政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交董事会审议。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

### （五）其他

公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配方案及其执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。公司对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

## 四、长期回报规划的内容及制定考虑因素

发行人长期回报规划的内容及制定考虑因素详见本节之“三、发行人上市后三年内分红回报规划”。

发行人利润分配的决策机制符合规定，发行人利润分配政策和未来分红规划注重了给予投资者合理回报、有利于保护投资者合法权益。

## 五、本次发行前后股利分配政策的差异情况

发行人根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规的相关规定进一步明确了公司利润分配的原则、形式、优先顺序、分配条件、决策程序以及利润分配政策调整等相关事项，加强了对中小投资者的利益保护。本次发行完成后，公司股利分配政策更重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

## **六、发行人存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的保护投资者合法权益措施**

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排；截至报告期末，发行人已盈利且不存在累计未弥补亏损。

第十节 其他重要事项

一、重大合同情况

报告期内，公司正在履行、已履行完毕和将要履行的合同中，对公司的生产经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况如下：

（一）销售合同

公司将报告期内签署或履行的 1,000.00 万元或 150 万美元以上的销售合同及框架协议（按年度订单金额合并计算）认定为重大合同，具体情况如下：

| 序号 | 签订日期        | 客户名称            | 合同类型 | 主要销售内容  | 合同金额           | 履行情况 |
|----|-------------|-----------------|------|---------|----------------|------|
| 1  | 2021 年 7 月  | 客户 A            | 框架协议 | 激光热处理设备 | 以订单为准          | 履行中  |
| 2  | 2024 年 9 月  | 客户 C1           | 框架协议 | 激光热处理设备 | 以订单为准          | 履行中  |
| 3  | 2023 年 11 月 | 客户 B            | 销售合同 | 激光热处理设备 | 含税 4,678.20 万元 | 履行完毕 |
| 4  | 2023 年 11 月 | 宜兴中车时代半导体有限公司   | 销售合同 | 激光热处理设备 | 含税 1,494.00 万元 | 履行中  |
| 5  | 2021 年 3 月  | 湖南三安半导体有限责任公司   | 销售合同 | 激光热处理设备 | 含税 1,176.00 万元 | 履行完毕 |
| 6  | 2025 年 4 月  | 株洲中车时代半导体股份有限公司 | 销售合同 | 激光热处理设备 | 含税 1,472.00 万元 | 履行中  |
| 7  | 2025 年 5 月  | 达迩科技（成都）有限公司    | 销售合同 | 激光加工设备  | 172.50 万美元     | 履行中  |

注：履行情况为截至报告期末时点的状态。

（二）采购合同

公司将报告期内签署或履行的 500.00 万元以上的采购合同及框架协议（按年度订单金额合并计算）认定为重大合同，具体情况如下：

| 序号 | 签订日期       | 供应商名称           | 合同类型 | 主要采购内容 | 合同金额           | 履行情况 |
|----|------------|-----------------|------|--------|----------------|------|
| 1  | 2023 年 4 月 | 富通尼激光科技（东莞）有限公司 | 采购合同 | 激光器    | 含税 3,864.00 万元 | 履行完毕 |
| 2  | 2024 年 2 月 | 富通尼激光科技（东莞）有限公司 | 采购合同 | 激光器    | 含税 3,833.13 万元 | 履行中  |
| 3  | 2024 年 1 月 | 供应商 A           | 采购合同 | 激光器    | 含税 1,868.96 万元 | 履行完毕 |
| 4  | 2023 年 1 月 | 供应商 A           | 采购合同 | 激光器    | 含税 1,558.90 万元 | 履行完毕 |

| 序号 | 签订日期    | 供应商名称           | 合同类型 | 主要采购内容 | 合同金额           | 履行情况 |
|----|---------|-----------------|------|--------|----------------|------|
| 5  | 2024年5月 | 炬光（海宁）光电有限公司    | 采购合同 | 激光器    | 含税 872.00 万元   | 履行完毕 |
| 6  | 2024年5月 | 安徽华创鸿度光电科技有限公司  | 采购合同 | 激光器    | 含税 768.00 万元   | 履行完毕 |
| 7  | 2024年1月 | 北京锐洁机器人科技有限公司   | 采购合同 | 机械手    | 含税 689.80 万元   | 履行中  |
| 8  | 2022年9月 | 富通尼激光科技（东莞）有限公司 | 采购合同 | 激光器    | 含税 686.00 万元   | 履行完毕 |
| 9  | 2022年2月 | 北京凤启科技有限公司      | 采购合同 | 激光器    | 含税 656.00 万元   | 履行完毕 |
| 10 | 2023年4月 | 安徽华创鸿度光电科技有限公司  | 采购合同 | 激光器    | 含税 576.00 万元   | 履行完毕 |
| 11 | 2022年7月 | 富通尼激光科技（东莞）有限公司 | 采购合同 | 激光器    | 含税 564.00 万元   | 履行完毕 |
| 12 | 2022年1月 | 苏州权日智能科技有限公司    | 采购合同 | 机械手    | 含税 552.31 万元   | 履行完毕 |
| 13 | 2023年1月 | 东莞市卡特金属制品有限公司   | 框架协议 | 钣金件等   | 以订单为准          | 履行完毕 |
| 14 | 2024年1月 | 东莞市卡特金属制品有限公司   | 框架协议 | 钣金件等   | 以订单为准          | 履行中  |
| 15 | 2025年4月 | 富通尼激光科技（东莞）有限公司 | 采购合同 | 激光器    | 含税 2,328.74 万元 | 履行中  |
| 16 | 2025年4月 | 安徽华创鸿度光电科技有限公司  | 采购合同 | 激光器    | 含税 1,152.00 万元 | 履行中  |

注：履行情况为截至报告期末时点的状态。

（三）借款合同

截至报告期末，公司正在履行的金额在 1,000 万元及以上的借款合同如下：

单位：万元

| 序号 | 借款主体 | 贷款银行        | 合同金额      | 抵押、担保情况                           | 期限起始日      | 期限到期日      | 履行情况 |
|----|------|-------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|------|
| 1  | 莱普科技 | 交通银行成都高新区支行 | 34,600.00 | 担保方：东骏投资、叶向明、刘淑贞、毛冬；抵押物：莱普科技土地使用权 | 2024/3/14  | 2035/3/12  | 履行中  |
| 2  | 莱普科技 | 国家开发银行四川省分行 | 5,000.00  | 抵押物：莱普科技应收账款                      | 2023/11/30 | 2025/11/30 | 履行中  |
| 3  | 莱普科技 | 成都银行德盛支行    | 1,000.00  | 担保方：叶向明、毛冬                        | 2024/11/27 | 2025/11/26 | 履行中  |
| 4  | 莱普科技 | 成都农商银行蒲江支行  | 1,000.00  | 担保方：东骏投资、叶向明、毛冬                   | 2024/7/22  | 2026/1/21  | 履行中  |



| 序号 | 借款主体 | 贷款银行       | 合同金额     | 抵押、担保情况                        | 期限起始日     | 期限到期日     | 履行情况 |
|----|------|------------|----------|--------------------------------|-----------|-----------|------|
| 5  | 莱普科技 | 成都农商银行蒲江支行 | 1,000.00 | 担保方：东骏投资、叶向明、毛冬；<br>抵押物：莱普科技专利 | 2024/7/22 | 2026/1/21 | 履行中  |

**（四）建设工程合同**

公司与成都建工第八建筑工程有限公司于 2023 年、2024 年分别签订了《建设工程施工合同》及《补充协议》，由成都建工第八建筑工程有限公司作为承包人负责建设莱普科技“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”，签约合同价（含税、暂定价）为 28,292.29 万元。**截至 2025 年末，上述合同尚处于审价结算阶段。**

上述重要销售合同、采购合同、借款合同及建设工程合同均按照合同约定执行，不存在对公司生产经营及本次发行上市产生重大影响的潜在风险。

**二、对外担保情况**

截至本招股说明书签署日，公司不存在任何对外担保事项。

**三、重大诉讼或仲裁事项**

**（一）对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项**

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司不存在对公司产生较大影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁事项。

**（二）发行人控股股东或实际控制人、子公司，发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项**

报告期内，不存在发行人控股股东、实际控制人、子公司、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

## 第十一节 声明

### 一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

  
叶向明

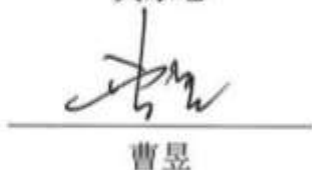
  
毛冬

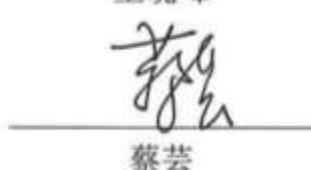
  
傅建伟

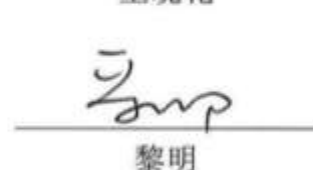
  
黄永忠

  
王晓峰

  
王晓礼

  
曹昱

  
蔡芸

  
黎明



## 一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签名：

  
曹显

  
蔡芸

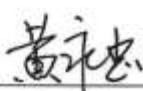
  
傅建伟



## 一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

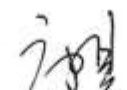
全体高级管理人员签名：

  
黄永忠

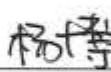
  
王晓峰

  
潘岭峰

  
何刘

  
唐昊

  
郭红

  
杨博



## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东法定代表人签字：



毛冬



## 发行人实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人：



叶向明



毛冬

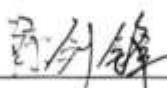
2016 年 3 月 18 日



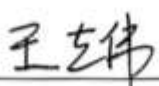
### 三、保荐人（主承销商）声明

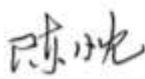
本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人签名：

  
陈剑锋

保荐代表人签名：

  
王志伟

  
陈 忱

法定代表人/董事长签名：

  
刘 成



## 声明

本人已认真阅读成都莱普科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理签名：

  
金剑华

法定代表人/董事长签名：

  
刘 成



#### 四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



乔佳平

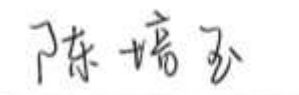
经办律师：



苗 丁



冯 兰



陈培玉



## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、审阅报告（如有）、盈利预测审核报告（如有）、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、审阅报告（如有）、盈利预测审核报告（如有）、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：中国注册会计师 陈平 500300020629 陈平  
中国注册会计师 钟阳 110001570401 钟阳

会计师事务所负责人：李惠琦 中国注册会计师 李惠琦 110000150172  
李惠琦

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



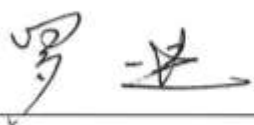
## 六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

评估机构法定代表人：

  
肖 力

签字资产评估师：

  
罗 进

（已离职）

  
罗 松



## 关于签字资产评估师离职的说明

罗松（身份证号码：513401199508176114）曾经作为本单位的签字资产评估师为成都莱普科技股份有限公司出具《成都莱普科技股份有限公司拟进行股改涉及成都莱普科技有限公司审计后净资产市场价值评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2021]第 030058 号），现已离职。

特此说明。

评估机构法定代表人：



肖 力

中水致远资产评估有限公司





## 六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告（中威正信评报字[2024]第 6068 号）无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

评估机构负责人：

赵霖

赵霖

见习执业会员

资产评估师

赵霖

11230484

签字资产评估师：

正式执业会员

资产评估师

刘震

51190019

正式执业会员

资产评估师

王丰

51100011

王丰

中威正信（北京）资产评估有限公司

2026年3月18日

## 验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

陈平 钟阳

中国注册会计师 陈平 500300020629

中国注册会计师 钟阳 110001570401

会计师事务所负责人：

李惠琦

中国注册会计师 李惠琦 110000150172

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年3月18日



## 第十二节 附件

### 一、备查文件

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- （七）与投资者保护相关的承诺；
- （八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- （九）发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报告及审阅报告；（如有）
- （十）盈利预测报告及审核报告；（如有）
- （十一）内部控制审计报告；
- （十二）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （十三）股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；
- （十四）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- （十五）募集资金具体运用情况；
- （十六）子公司简要情况；
- （十七）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅时间和地点

投资者可于本次发行期间到公司及保荐人（主承销商）办公地查阅，该等文

件也在指定网站披露。查阅时间：工作日上午 9:30-11:30；下午 13:30-15:30。

（一）发行人：成都莱普科技股份有限公司

办公地址：成都高新区康强三路 179 号

电话：028-88556028

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

电话：010-56052384

附件一、发行人已获授权专利情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及控股子公司无境外授权专利，境内授权专利列示如下：

| 序号 | 专利名称                       | 专利权人      | 类型   | 取得方式 | 专利号              | 申请日        | 授权公告日      | 他项权利 |
|----|----------------------------|-----------|------|------|------------------|------------|------------|------|
| 1  | 一种硅基 MEMS 晶圆多焦点激光切割系统及切割方法 | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL201710721276.2 | 2017.08.21 | 2019.10.25 | 无    |
| 2  | 一种带激光切割功能的 IC 芯片光学抽检机      | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL201810585880.1 | 2018.06.08 | 2020.10.16 | 无    |
| 3  | 一种 SIC 晶圆隐形加工方法            | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202110570113.5 | 2021.05.25 | 2022.12.16 | 无    |
| 4  | 基于衍射光学元件的斜向多焦点产生系统及方法      | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202210515792.0 | 2022.05.12 | 2024.09.13 | 无    |
| 5  | 一种半导体器件退火工艺效果的测试方法         | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202210844559.7 | 2022.07.18 | 2023.08.04 | 无    |
| 6  | 基于达曼光栅的线性平顶光斑的发生系统、方法及设备   | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202211030700.6 | 2022.08.26 | 2022.12.30 | 无    |
| 7  | 矩形平顶光斑的发生系统、方法及设备          | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202211346429.7 | 2022.10.31 | 2023.04.25 | 无    |
| 8  | 一种用于晶圆激光退火的挡光环及其制备方法       | 莱普科技、长江存储 | 发明专利 | 原始取得 | ZL202310127876.1 | 2023.02.17 | 2023.04.28 | 无    |
| 9  | 二氧化碳激光的光束整形设备以及光束整形方法      | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202310468102.5 | 2023.04.27 | 2023.08.04 | 无    |
| 10 | 应用于激光退火系统的温度控制方法和激光退火系统    | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202310997052.X | 2023.08.08 | 2024.09.13 | 无    |
| 11 | 一种光束整形模组、方法及装置             | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202311188945.6 | 2023.09.15 | 2023.11.24 | 无    |
| 12 | 一种具有 SiO2 薄膜的碲化镉发电玻璃及其制备方法 | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202311791502.6 | 2023.12.25 | 2025.3.18  | 无    |
| 13 | 连续绿光激光退火设备及退火方法            | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202410624743.X | 2024.05.20 | 2025.3.14  | 无    |
| 14 | 激光透过功率的测量方法、装置、电子设备及存储介质   | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202411092920.0 | 2024.08.09 | 2024.11.05 | 无    |
| 15 | 一种枪械瞄准器的激光打标系统             | 莱普科技      | 发明专利 | 原始取得 | ZL202510762436.2 | 2025.06.09 | 2025.9.16  | 无    |

| 序号 | 专利名称                        | 专利权人 | 类型   | 取得方式 | 专利号              | 申请日        | 授权公告日      | 他项权利 |
|----|-----------------------------|------|------|------|------------------|------------|------------|------|
| 16 | 激光合束能量损耗的抑制方法、系统及存储介质       | 莱普科技 | 发明专利 | 原始取得 | ZL202511198455.3 | 2025.08.26 | 2025.12.16 | 无    |
| 17 | 一种用于芯片抽检机的芯片条带取送装置          | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201820884325.4 | 2018.06.08 | 2018.12.21 | 无    |
| 18 | 一种能 360 度观察的显微镜机构           | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201820884324.X | 2018.06.08 | 2018.12.21 | 无    |
| 19 | 一种带激光切割功能的芯片抽检机的控制系统        | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201820884700.5 | 2018.06.08 | 2019.03.01 | 无    |
| 20 | 一种激光器波形控制卡                  | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201822060452.5 | 2018.12.10 | 2019.08.02 | 无    |
| 21 | 一种超精细激光钻孔机                  | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201822061147.8 | 2018.12.10 | 2019.10.18 | 无    |
| 22 | 一种新型激光开封机                   | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL201920223568.8 | 2019.02.22 | 2020.01.21 | 无    |
| 23 | 一种 SIC 晶圆表面加工划片机            | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202121135980.8 | 2021.05.25 | 2021.10.26 | 无    |
| 24 | 一种用于子弹打标的全自动激光打标机           | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202121138605.9 | 2021.05.25 | 2021.11.16 | 无    |
| 25 | 一种激光加工设备的光源截取装置             | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202220590092.3 | 2022.03.16 | 2022.10.14 | 无    |
| 26 | 一种 IC 芯片光学三光机               | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202220680682.5 | 2022.03.25 | 2022.10.18 | 无    |
| 27 | 一种效果和产能可调的激光退火装置            | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202221557485.0 | 2022.06.21 | 2022.10.21 | 无    |
| 28 | 一种芯片封装后条带的上料装置及芯片生产线        | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202221565232.8 | 2022.06.21 | 2022.12.30 | 无    |
| 29 | 一种工件装夹装置                    | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202221812947.9 | 2022.07.13 | 2022.10.21 | 无    |
| 30 | 一种用于打印二维码的全自动设备             | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202221908718.7 | 2022.07.22 | 2022.10.21 | 无    |
| 31 | 一种工件装夹装置                    | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202222394014.9 | 2022.09.06 | 2022.12.23 | 无    |
| 32 | 一种芯片观察装置及设备                 | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202222356609.5 | 2022.09.06 | 2022.12.30 | 无    |
| 33 | 一种 6 寸和 8 寸料盒兼容机械人取放晶圆用料盒工装 | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202222859263.0 | 2022.10.28 | 2023.04.18 | 无    |
| 34 | 一种晶圆固定组件和晶圆制标设备             | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202222868802.7 | 2022.10.28 | 2023.04.25 | 无    |
| 35 | 一种氮气吹扫装置及晶圆激光处理系统           | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202222871768.9 | 2022.10.28 | 2023.04.28 | 无    |



| 序号 | 专利名称                | 专利权人      | 类型   | 取得方式 | 专利号              | 申请日        | 授权公告日      | 他项权利 |
|----|---------------------|-----------|------|------|------------------|------------|------------|------|
| 36 | 一种双轨道标签制作机构置        | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202223038425.0 | 2022.11.14 | 2023.04.28 | 无    |
| 37 | 一种激光光斑整形装置          | 莱普科技、长江存储 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202223469369.6 | 2022.12.23 | 2023.04.25 | 无    |
| 38 | 一种激光用光闸结构           | 莱普科技、长江存储 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202223468618.X | 2022.12.23 | 2023.05.05 | 无    |
| 39 | 一种晶圆吸附装置和晶圆加工设备     | 莱普科技、长江存储 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202223466302.7 | 2022.12.23 | 2023.07.25 | 无    |
| 40 | 用于激光退火的挡光装置以及激光退火设备 | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202223527516.0 | 2022.12.28 | 2023.07.25 | 无    |
| 41 | 一种晶圆激光处理用加工装置       | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202320162929.9 | 2023.01.30 | 2023.08.04 | 无    |
| 42 | 一种挡光环的夹具            | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202320087986.5 | 2023.01.30 | 2023.08.22 | 无    |
| 43 | 一种多光路合束装置           | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202320087985.0 | 2023.01.30 | 2023.08.25 | 无    |
| 44 | 一种晶圆加热冷却装置          | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202320201828.8 | 2023.02.07 | 2023.08.04 | 无    |
| 45 | 一种双光路激光发射装置和激光切割设备  | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202222597607.5 | 2023.02.08 | 2023.04.28 | 无    |
| 46 | 气浮平台式晶圆加热装置         | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202320211440.6 | 2023.02.14 | 2023.08.04 | 无    |
| 47 | 打标装置及自动打标机          | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202321911607.6 | 2023.07.18 | 2024.01.16 | 无    |
| 48 | 承载装置                | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202322733284.2 | 2023.10.11 | 2024.06.07 | 无    |
| 49 | 夹取装置                | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202323372259.2 | 2023.12.08 | 2024.08.09 | 无    |
| 50 | 晶圆激光处理用密封氮气环境腔室     | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202323372128.4 | 2023.12.08 | 2024.09.13 | 无    |
| 51 | 晶圆激光处理用密封晶圆加工室      | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202323345010.2 | 2023.12.08 | 2024.12.17 | 无    |
| 52 | 加工系统                | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202323372303.X | 2023.12.08 | 2025.01.21 | 无    |
| 53 | 卡门涡流流量计总成           | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421077895.4 | 2024.05.16 | 2024.12.20 | 无    |
| 54 | 薄片质检设备及薄片生产线        | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421070430.6 | 2024.05.16 | 2025.06.06 | 无    |
| 55 | 一种激光扩束装置及二氧化碳激光加    | 莱普科技      | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421446530.4 | 2024.06.24 | 2025.03.14 | 无    |

| 序号 | 专利名称                  | 专利权人 | 类型   | 取得方式 | 专利号              | 申请日        | 授权公告日      | 他项权利 |
|----|-----------------------|------|------|------|------------------|------------|------------|------|
|    | 工设备                   |      |      |      |                  |            |            |      |
| 56 | 一种激光能量调节装置及二氧化碳激光加工设备 | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421446531.9 | 2024.06.24 | 2025.03.14 | 无    |
| 57 | 一种激光加工装置及系统           | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421446529.1 | 2024.06.24 | 2025.04.18 | 无    |
| 58 | 键合晶圆解键合装置及解键合机        | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421446524.9 | 2024.06.24 | 2025.04.18 | 无    |
| 59 | 晶圆清洗装置                | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421446527.2 | 2024.06.24 | 2025.04.18 | 无    |
| 60 | 一种能够补料的打标机            | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421780747.9 | 2024.07.25 | 2025.06.06 | 无    |
| 61 | 一种便于芯片打标的打标机          | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421779660.X | 2024.07.25 | 2025.06.06 | 无    |
| 62 | 真空吸附治具及芯片加工机          | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421782083.X | 2024.07.25 | 2025.06.06 | 无    |
| 63 | 翻转机构及打标机              | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421782132.X | 2024.07.25 | 2025.06.06 | 无    |
| 64 | 分离式料盒及打标机             | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421778088.5 | 2024.07.25 | 2025.06.10 | 无    |
| 65 | 可翻转的打标机构及打标机          | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421778085.1 | 2024.07.25 | 2025.06.10 | 无    |
| 66 | 一种便于芯片定位的打标机          | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421780729.0 | 2024.07.25 | 2025.06.10 | 无    |
| 67 | 一种用于芯片两面打标的打标机        | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421782163.5 | 2024.07.25 | 2025.06.10 | 无    |
| 68 | 带压紧机构的治具及条带加工机        | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421778087.0 | 2024.07.25 | 2025.06.10 | 无    |
| 69 | 晶圆加工限位装置及二氧化碳激光加工设备   | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202422844916.7 | 2024.11.21 | 2025.11.28 | 无    |
| 70 | 光纤激光器                 | 莱普科技 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202423155251.5 | 2024.12.20 | 2025.12.02 | 无    |
| 71 | 激光诱导击穿光谱仪             | 莱普科技 | 外观设计 | 原始取得 | ZL202430295169.9 | 2024.05.17 | 2024.12.13 | 无    |
| 72 | 晶圆表面加工机               | 莱普科技 | 外观设计 | 原始取得 | ZL202430295179.2 | 2024.05.17 | 2024.12.17 | 无    |
| 73 | 连续光纤激光器               | 莱普科技 | 外观设计 | 原始取得 | ZL202430295171.6 | 2024.05.17 | 2025.01.14 | 无    |
| 74 | 激光退火器                 | 莱普科技 | 外观设计 | 原始取得 | ZL202430295170.1 | 2024.05.17 | 2025.01.14 | 无    |
| 75 | 切割机                   | 莱普科技 | 外观设计 | 原始取得 | ZL202430295178.8 | 2024.05.17 | 2025.01.14 | 无    |
| 76 | 晶圆打标机                 | 莱普科技 | 外观设计 | 原始取得 | ZL202430295168.4 | 2024.05.17 | 2025.01.14 | 质押   |
| 77 | 激光标刻机                 | 莱普科技 | 外观设计 | 原始取得 | ZL202430295173.5 | 2024.05.17 | 2025.01.14 | 无    |

| 序号 | 专利名称                         | 专利权人 | 类型   | 取得方式 | 专利号              | 申请日        | 授权公告日               | 他项权利 |
|----|------------------------------|------|------|------|------------------|------------|---------------------|------|
| 78 | 晶圆表面退火机                      | 莱普科技 | 外观设计 | 原始取得 | ZL202430295175.4 | 2024.05.17 | 2025.01.14          | 无    |
| 79 | 激光退火器                        | 莱普科技 | 外观设计 | 原始取得 | ZL202430295177.3 | 2024.05.17 | 2025.01.14          | 无    |
| 80 | 激光打标机(双头)                    | 莱普科技 | 外观设计 | 原始取得 | ZL202430295176.9 | 2024.05.17 | 2025.01.14          | 无    |
| 81 | 一种用于 LOW-K 晶圆开槽的全自动上下料装置     | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202320282755.X | 2023.02.22 | 2023.06.23          | 无    |
| 82 | 一种用于 MINI-LED 晶圆划片的全自动激光加工装置 | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202320282925.4 | 2023.02.22 | 2023.06.30          | 无    |
| 83 | 一种用于半导体晶圆的激光开槽装置             | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202320952334.3 | 2023.04.25 | 2023.10.20          | 无    |
| 84 | 一种用于偏光镜的实时功率监测装置             | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202321069750.5 | 2023.05.06 | 2023.09.12          | 无    |
| 85 | 一种用于半导体晶圆的真空吸附装置             | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202321175020.3 | 2023.05.16 | 2023.10.13          | 无    |
| 86 | 一种用于偏光镜划片的光路整形装置             | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202321618902.2 | 2023.06.25 | 2023.12.08          | 无    |
| 87 | 一种晶圆清洗设备                     | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202321683064.7 | 2023.06.29 | 2023.11.24          | 无    |
| 88 | 一种用于偏光镜划片的三轴精密大理石平台          | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202321842584.8 | 2023.07.13 | 2024.04.26          | 无    |
| 89 | 一种用于 LOW-K 晶圆的片厚测量装置         | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202322211219.3 | 2023.08.17 | 2024.02.23          | 无    |
| 90 | 一种用于硅晶圆划片的光路整形装置             | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202322944580.7 | 2023.11.01 | 2024.06.21          | 无    |
| 91 | 一种用于半导体晶圆的裂片装置               | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202420017777.8 | 2024.01.04 | 2024.08.06          | 无    |
| 92 | 一种用于半导体晶圆的涂胶装置               | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421044396.5 | 2024.05.14 | 2025.01.03          | 无    |
| 93 | 一种用于硅晶圆划片的上下料装置              | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202421152924.9 | 2024.05.24 | 2025.01.07          | 无    |
| 94 | 一种用于偏光镜的复杂曲线切割装置             | 江苏莱普 | 实用新型 | 原始取得 | ZL202422955246.6 | 2024.12.02 | <b>2025. 10. 17</b> | 无    |

注：1、2024 年 7 月，莱普科技与成都农村商业银行股份有限公司蒲江支行签订《权利质押合同》（编号：成农商蒲公权质 20240002），以上表第 48 项专利（ZL202322733284.2）为公司签订的《流动资金借款合同》（编号：成农商蒲公流借 20240010）项下的全部债务提供质押担保；2024 年 8 月 6 日，国家知识产权局对该项专利权进行了质押登记（登记号：Y2024980032084）；截至本招股说明书签署日，发行人上述专利质押所对应的银行借款已经偿还完毕，专利质押已实际失效，上述专利解除质押登记手续尚未办理完成。2、2026 年 2 月 9 日，发行人与成都农村商业银行股份有限公司蒲江支行签署《小企业流动资金贷款续借款合同》（成农商蒲公续借 20260001）以及《权利质押合同》（成农商蒲公权质 20260001），约定发行人以本表第 76 项专利（ZL202430295168.4）为上述银行借款提供质押担保；截至

本招股说明书签署日，上述专利质押登记手续尚未办理完成。3、上表中第 8、37、38、39 项专利系发行人与长江存储共有，双方未约定收益分配条款。4、发明专利权利期限为自申请日起 20 年，实用新型专利权利期限为自申请日起 10 年，外观设计专利权利期限为自申请日起 15 年。

## 附件二、发行人软件著作权情况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人拥有的软件著作权列示如下：

| 序号 | 著作权人 | 软件名称               | 登记号           | 登记日期       | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|--------------------|---------------|------------|------|------|
| 1  | 莱普科技 | 莱普风冷端泵 dpl 激光器控制软件 | 2010SR067107  | 2010.12.10 | 原始取得 | 无    |
| 2  | 莱普科技 | 莱普激光标刻软件           | 2011SR008731  | 2011.02.23 | 原始取得 | 无    |
| 3  | 莱普科技 | 莱普消光比测量系统软件        | 2011SR019107  | 2011.04.11 | 原始取得 | 无    |
| 4  | 莱普科技 | 莱普激光自动调阻软件         | 2011SR019193  | 2011.04.11 | 原始取得 | 无    |
| 5  | 莱普科技 | 莱普大幅面激光精密雕刻控制软件    | 2012SR026625  | 2012.04.09 | 原始取得 | 无    |
| 6  | 莱普科技 | 散射系数测量软件           | 2012SR117407  | 2012.12.01 | 原始取得 | 无    |
| 7  | 莱普科技 | 旋光仪损入损耗及旋光角系数测量软件  | 2013SR140420  | 2013.12.06 | 原始取得 | 无    |
| 8  | 莱普科技 | 标签机专用控制系统          | 2014SR029294  | 2014.03.11 | 原始取得 | 无    |
| 9  | 莱普科技 | 旋臂式激光标刻设备控制软件系统    | 2014SR179202  | 2014.11.22 | 原始取得 | 无    |
| 10 | 莱普科技 | 激光清洗设备控制软件系统       | 2014SR179396  | 2014.11.22 | 原始取得 | 无    |
| 11 | 莱普科技 | 激光退火控制系统           | 2017SR264811  | 2017.06.14 | 原始取得 | 无    |
| 12 | 莱普科技 | 薄片材料的精密激光划片钻孔控制系统  | 2017SR356384  | 2017.07.10 | 原始取得 | 无    |
| 13 | 莱普科技 | LC-05UV 激光开封机专用软件  | 2019SR0628208 | 2019.06.18 | 原始取得 | 无    |
| 14 | 莱普科技 | 晶圆激光划片软件控制系统       | 2019SR1344295 | 2019.12.11 | 原始取得 | 无    |

| 序号 | 著作权人 | 软件名称                          | 登记号           | 登记日期       | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|-------------------------------|---------------|------------|------|------|
| 15 | 莱普科技 | 镀膜层损伤<br>阈值激光测试系统             | 2019SR1344305 | 2019.12.11 | 原始取得 | 无    |
| 16 | 莱普科技 | CCD 自动定位的多工件<br>自动快速打标系统      | 2019SR1344678 | 2019.12.11 | 原始取得 | 无    |
| 17 | 莱普科技 | 激光抽检机系统                       | 2019SR1345188 | 2019.12.11 | 原始取得 | 无    |
| 18 | 莱普科技 | 滤光片皮秒切割系统                     | 2022SR0042482 | 2022.01.07 | 原始取得 | 无    |
| 19 | 莱普科技 | 晶圆高温处理全自动控制系统                 | 2022SR0712814 | 2022.06.07 | 原始取得 | 无    |
| 20 | 莱普科技 | 精准打标<br>CCD 定位软件              | 2022SR0717926 | 2022.06.08 | 原始取得 | 无    |
| 21 | 莱普科技 | 4 寸晶圆基板<br>紫外激光切割系统           | 2022SR0860560 | 2022.06.28 | 原始取得 | 无    |
| 22 | 莱普科技 | LMC-150S<br>汽车空气过滤器滤芯打<br>孔系统 | 2022SR0860561 | 2022.06.28 | 原始取得 | 无    |
| 23 | 莱普科技 | 12 寸晶圆快速激光处理<br>控制系统          | 2023SR0176157 | 2023.01.31 | 原始取得 | 无    |
| 24 | 莱普科技 | 激光脉冲触发控制软件                    | 2023SR0377331 | 2023.03.21 | 原始取得 | 无    |
| 25 | 莱普科技 | 铁氧体基板<br>双面钻孔机控制系统            | 2023SR0377320 | 2023.03.21 | 原始取得 | 无    |
| 26 | 莱普科技 | 12 寸晶圆激光多路复用<br>退火控制系统        | 2023SR0377322 | 2023.03.21 | 原始取得 | 无    |
| 27 | 莱普科技 | CSP 晶圆打标控制系统                  | 2023SR0377321 | 2023.03.21 | 原始取得 | 无    |
| 28 | 莱普科技 | 全自动打标系统                       | 2023SR1329489 | 2023.10.30 | 原始取得 | 无    |
| 29 | 莱普科技 | NG 打标系统                       | 2024SR0822815 | 2024.06.18 | 原始取得 | 无    |
| 30 | 莱普科技 | 全自动晶圆打标软件                     | 2024SR1253259 | 2024.08.27 | 原始取得 | 无    |
| 31 | 莱普科技 | 全自动激光半切划片系统                   | 2025SR1522808 | 2025.08.13 | 原始取得 | 无    |
| 32 | 莱普科技 | 晶圆定位                          | 2025SR1520888 | 2025.08.13 | 原始取得 | 无    |

| 序号 | 著作权人 | 软件名称            | 登记号           | 登记日期       | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|-----------------|---------------|------------|------|------|
|    |      | 打点机控制系统         |               |            |      |      |
| 33 | 莱普科技 | 全自动激光解键合机控制系统   | 2025SR1521815 | 2025.08.13 | 原始取得 | 无    |
| 34 | 莱普科技 | 全自动激光开槽系统       | 2025SR1525789 | 2025.08.13 | 原始取得 | 无    |
| 35 | 莱普科技 | 全自动晶圆打标软件       | 2025SR1754266 | 2025.09.11 | 原始取得 | 无    |
| 36 | 江苏莱普 | LED 裂片机设备软件     | 2023SR0188731 | 2023.02.01 | 原始取得 | 无    |
| 37 | 江苏莱普 | MINI LED 激光切割软件 | 2023SR0425130 | 2023.03.31 | 原始取得 | 无    |
| 38 | 江苏莱普 | 半导体设备通用软件框架软件   | 2023SR0464090 | 2023.04.12 | 受让取得 | 无    |
| 39 | 江苏莱普 | 激光开槽机半导体设备软件    | 2023SR0464089 | 2023.04.12 | 受让取得 | 无    |
| 40 | 江苏莱普 | 莱普激光偏光镜划片软件     | 2023SR0500400 | 2023.04.25 | 原始取得 | 无    |
| 41 | 江苏莱普 | 莱普激光半导体晶圆开槽软件   | 2023SR0500303 | 2023.04.25 | 原始取得 | 无    |
| 42 | 江苏莱普 | 莱普激光偏光镜异形划片软件   | 2024SR1363584 | 2024.09.12 | 原始取得 | 无    |
| 43 | 江苏莱普 | 莱普激光晶圆异形划片软件    | 2025SR0647155 | 2025.04.21 | 原始取得 | 无    |

注：上表中第 38、39 项江苏莱普软件著作权系自江苏莱普员工张文受让取得。



## 附件三、与投资者保护相关的承诺

发行人及相关主体与投资者保护相关的承诺如下：

### （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

#### 1、发行人实际控制人及其一致行动人承诺

发行人股东东莞聚慧合伙人叶玉冰、刘钧伟、刘嘉桦与发行人实际控制人叶向明、毛冬构成《上市公司收购管理办法(2025 修正)》第八十三条第二款第(五)项所述的一致行动。

发行人实际控制人叶向明、毛冬及其一致行动人叶玉冰、刘钧伟、刘嘉桦作出《关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》，主要内容如下：

“（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如遇派息、送股、转增股本等除权、除息事项，上述发行价相应调整。

（3）公司上市后存在破发（即减持计划公告前 20 个交易日中的任一日股票收盘价（向后复权）低于首次公开发行股票时的股票发行价格）、破净（即减持计划公告前 20 个交易日中的任一日股票收盘价（向后复权）低于最近一个会计年度或者最近一期财务会计报告期末每股净资产）情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的（但其中净利润为负的会计年度不纳入计算），本人不通过集中竞价交易、大宗交易方式减持发行人股份。

（4）公司若出现上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上情形的，按以下方式延长本人届时所持股份的锁定期限：①公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；②公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；③公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。

（5）在上述锁定期满后 2 年内减持的，本人减持价格不低于发行价。在减持发行人股票前，如遇派息、送股、转增股本等除权、除息事项，减持价格下限将相应进行调整。

（6）在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间（如适用），每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。

（7）在叶向明、毛冬被认定为公司实际控制人期间，将向公司申报本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。

（8）自本承诺函出具后，若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

（9）本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。

如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。”

发行人实际控制人叶向明、毛冬及其一致行动人叶玉冰、刘钧伟、刘嘉桦作出《关于持股及减持意向承诺函》，主要内容如下：

“（1）本人持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司的股份。

（2）对于公司首次公开发行股票并上市前本人持有的公司股份，本人将严格遵守已

做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。

（3）如在本人所持公司股份的锁定期届满后，本人减持股票的，将严格遵守中国证监会及上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，保证公司的稳定经营，并按照相关规定予以公告。

（4）本人在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股并上市时股票的发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）。在承诺的持股锁定期满后两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。

（5）本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（6）如因本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。”

## 2、发行人控股股东及其一致行动人承诺

**发行人股东东莞骏峰合伙人王晓峰、潘岭峰以及东莞莱普合伙人唐昊与发行人控股股东东骏投资构成《上市公司收购管理办法(2025 修正)》第八十三条第二款第(五)项所述的一致行动。**

发行人控股股东东骏投资及其一致行动人东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英、**王晓峰、潘岭峰、唐昊**作出《关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》，主要内容如下：

“（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业/**本人**直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本企业/**本人**直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本企业/**本人**不转让或者委托他人管理本企业/**本人**直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如遇派息、送股、转增股本等除权、除息事项，上述发行价相应调整。

（3）公司上市后存在破发（即减持计划公告前 20 个交易日中的任一日股票收盘价（向后复权）低于首次公开发行时的股票发行价格）、破净（即减持计划公告前 20 个交易日中的任一日股票收盘价（向后复权）低于最近一个会计年度或者最近一期财务会计报告期末每股净资产）情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的（但其中净利润为负的会计年度不纳入计算），不通过集中竞价交易、大宗交易方式减持发行人股份。

（4）公司若出现上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上情形的，按以下方式延长本企业/**本人**届时所持股份的锁定期限：①公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本企业/**本人**届时所持股份锁定期限 6 个月；②公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业/**本人**届时所持股份锁定期限 6 个月；③公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业/**本人**届时所持股份锁定期限 6 个月。

（5）在上述锁定期满后 2 年内减持的，本企业/**本人**减持价格不低于发行价。在减持发行人股票前，如遇派息、送股、转增股本等除权、除息事项，减持价格下限将相应进行调整。

（6）在东莞市东骏投资有限公司/东骏投资被认定为公司控股股东期间，将向公司申报本企业/**本人**直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。

（7）自本承诺函出具后，若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时，本企业/**本人**承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

（8）本企业/**本人**将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担

法律责任外，本企业/本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。

如本企业/本人违反上述承诺，本企业/本人愿承担因此而产生的一切法律责任。”

发行人控股股东东骏投资及其一致行动人东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英、**王晓峰、潘岭峰、唐昊**作出《关于持股及减持意向承诺函》，主要内容如下：

“（1）本企业/本人持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司的股份。

（2）对于公司首次公开发行股票并上市前本企业/本人持有的公司股份，本企业/本人将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。

（3）如在本企业/本人所持公司股份的锁定期届满后，本企业/本人减持股票的，将严格遵守中国证监会及上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，保证公司的稳定经营，并按照相关规定予以公告。

（4）本企业/本人在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股并上市时股票的发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）。在承诺的持股锁定期满后两年后减持的，减持价格在满足本企业/本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。

（5）本企业/本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（6）如因本企业/本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本企业/本人将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本企业/本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。”

### 3、发行人持股 5%以上股东国家集成电路基金二期承诺

发行人持股 5%以上股东国家集成电路基金二期作出《关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》，主要内容如下：

“（1）本企业首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本单位直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）自本承诺函出具后，若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时，本企业承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

（3）本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

如本企业违反上述承诺，本企业愿承担因此而产生的一切法律责任。”

发行人持股 5%以上股东国家集成电路基金二期作出《关于持股及减持意向承诺函》，主要内容如下：

“（1）对于公司首次公开发行股票并上市前本单位持有的公司股份，本单位将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。

（2）如在本单位所持公司股份的锁定期届满后，本单位减持股票的，将严格遵守中国证监会及上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，保证公司的稳定经营，并按照相关规定予以公告。

（3）本单位减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（4）如因本单位未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本单位将向公司或其投资者依法予以赔偿。”

### 4、发行人其他直接持股股东承诺

发行人股东长存产投、厦门石普、广州山立、青岛琮碧、全德学镭科芯、华西金智、成都高投、鼎创一号、余姚石溪、泰达恒鼎、青岛勤芯、全德学四专芯、上海浦宸、无锡国联、徐林仙、淄博君恒、西藏芯前沿、浦东海望、鼎创二号、蓉创投资、金智莱鑫，作出《关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》，主要内容如下：



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“（1）本人/本企业首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本单位直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>（2）自本承诺函出具后，若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。</p> <p>（3）本人/本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>如本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业愿承担因此而产生的一切法律责任。”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>5、发行人实际控制人的弟弟叶向忠承诺</p> <p>发行人实际控制人的弟弟叶向忠作出《关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》，主要内容如下</p> <p>“（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>（2）自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如遇派息、送股、转增股本等除权、除息事项，上述发行价相应调整。</p> <p>（3）公司上市后存在破发（即减持计划公告前 20 个交易日中的任一股票收盘价（向后复权）低于首次公开发行时的股票发行价格）、破净（即减持计划公告前 20 个交易日中的任一股票收盘价（向后复权）低于最近一个会计年度或者最近一期财务会计报告期末每股净资产）情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的（但其中净利润为负的会计年度不纳入计算），本人不通过集中竞价交易、大宗交易方式减持发行人股份。</p> <p>（4）公司若出现上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上情形的，按以下方式延长本人届时所持股份的锁定期限：①公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；②公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月；③公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 6 个月。</p> <p>（5）在上述锁定期满后 2 年内减持的，本人减持价格不低于发行价。在减持发行人股票前，如遇派息、送股、转增股本等除权、除息事项，减持价格下限将相应进行调整。</p> <p>（6）在叶向明、毛冬被认定为公司实际控制人期间，将向公司申报本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情况。</p> <p>（7）自本承诺函出具后，若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。</p> <p>（8）本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本人还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。</p> <p>如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。”</p> |
| <p>6、发行人持股董事、高级管理人员、核心技术人员黄永忠、王晓峰以及高级管理人员、核心技术人员潘岭峰、何刘承诺</p> <p>黄永忠、王晓峰、潘岭峰、何刘作出《关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>（2）自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

购该部分股份。如遇派息、送股、转增股本等除权、除息事项，上述发行价相应调整。

（3）在担任公司董事/高级管理人员、核心技术人员期间，本人将如实并及时向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况。

（4）本人担任公司董事/高级管理人员，在上述锁定期届满后，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。

（5）本人担任公司核心技术人员，所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

（6）公司有关员工股权激励制度对本人间接所持发行人股份的锁定期另有规定的，本人同时遵守相关规定及协议文件。

（7）自本承诺函出具后，若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

（8）本人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。”

#### 7、发行人持股董事傅建伟承诺

发行人持股董事傅建伟作出《关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》，主要内容如下：

“（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如遇派息、送股、转增股本等除权、除息事项，上述发行价相应调整。

（3）在担任公司董事期间，本人将如实并及时向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况；在上述锁定期届满后，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。

（4）自本承诺函出具后，若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。

（5）本人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。

如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。”

#### 8、发行人持股高级管理人员唐昊、郭红、杨博承诺

发行人持股高级管理人员唐昊、郭红、杨博作出《关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺函》，主要内容如下：

“（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如遇派息、送股、转增股本等除权、除息事项，上述发行价相应调整。

（3）在担任公司高级管理人员期间，本人将如实并及时向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况；在上述锁定期届满后，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内本人亦遵守本条承诺。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（4）公司有关员工股权激励制度对本人间接所持发行人股份的锁定期另有规定的，本人同时遵守相关规定及协议文件。</p> <p>（5）自本承诺函出具后，若中国证监会、上海证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所的该等规定时，本人承诺届时将按照该最新规定出具补充承诺。</p> <p>（6）本人在锁定期届满后减持首发前股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定，并履行相应的信息披露义务。</p> <p>如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>9、发行人持股董事、高级管理人员承诺</b></p> <p>发行人持股董事、高级管理人员作出《关于持股及减持意向承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“（1）本人持续看好公司及其所处行业的发展前景，愿意长期持有公司的股份。</p> <p>（2）对于公司首次公开发行股票并上市前本人持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。</p> <p>（3）如在本人所持公司股份的锁定期届满后，本人减持股票的，将严格遵守中国证监会及上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，保证公司的稳定经营，并按照相关规定予以公告。</p> <p>（4）本人在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股并上市时股票的发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）。在承诺的持股锁定期满后两年后减持的，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。</p> <p>（5）本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>（6）如因本人未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，本人将向公司或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。”</p>                                                                                                                                               |
| <p style="text-align: center;"><b>（二）稳定股价的措施和承诺</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>2025 年 8 月 24 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了《公司股票上市后三年内稳定股价的预案》，具体内容如下：</p> <p>“一、本预案有效期及启动条件</p> <p>（一）本预案自公司股票上市之日起三年内有效。</p> <p>（二）在本预案有效期内，如非因不可抗力因素所致，一旦公司股票出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产（公司最近一期审计基准日后，因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，则每股净资产相应进行调整，下同），则在符合相关法律法规、中国证监会、证券交易所相关规定及其他有约束力的规范性文件规定且公司股权分布符合上市条件的前提下，公司、控股股东及其一致行动人、在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。</p> <p>二、稳定股价的具体措施</p> <p>本预案具体包括三个阶段的稳定股价措施，依次为：（一）公司回购本公司股票；（二）公司控股股东及其一致行动人增持公司股票；（三）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员增持公司股票。公司将按照顺序采取如下全部或部分措施：</p> <p>（一）公司回购本公司股票</p> <p>1、公司董事会应在股价稳定措施的启动条件所述情形出现 10 个交易日内，参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，并对外公告；回购方案经股东会或董事会审议通过后，由公司按照相关规定通过公开的集中交易方式进行回购，回购的股份将按照《公司法》的规定予以处置。</p> <p>2、公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合：（1）回购股票的价格不高于公告日前最近一期公司经审计的每股净资产；（2）</p> |



公司用于回购股份的资金总额不超过上一会计年度归属于公司母公司股东净利润；（3）公司单次用于回购股票的金额不得低于人民币 1000 万元；（4）公司单次回购股票数量不超过公司总股本的 2.00%，若上述第（3）项与本项冲突的，按照本项执行。

3、在实施上述回购计划过程中，如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司经审计的最近一期末每股净资产，则公司可中止实施股份回购计划。

（二）公司控股股东及其一致行动人增持公司股票

1、公司回购股票达到承诺上限后仍触发股价稳定措施的启动条件的，控股股东及其一致行动人应在 10 个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持计划，明确增持的数量范围、价格区间、方式和期限及完成时间，并对外公告。

2、公司控股股东及其一致行动人增持公司股票应符合：（1）单次合计增持总金额不低于人民币 1,000.00 万元；（2）单次或连续 12 个月内合计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2.00%；若上述第（1）项与本项冲突的，按照本项执行；（3）增持股票的价格不高于公告日前最近一期公司经审计的每股净资产。

3、在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司经审计的最近一期末每股净资产，则可中止实施股份增持计划。增持行为严格遵守《证券法》《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票。

（三）在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员增持公司股票

1、公司回购股票达到承诺上限，且公司控股股东及其一致行动人增持公司股票达到承诺上限，或依照相关法律规定和增持方案，不再继续实施增持公司股票计划的，但仍触发股价稳定措施的启动条件的，在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员应在股价稳定措施的启动条件所述情形出现 10 个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持计划，明确增持的数量范围、价格区间、方式和期限及完成时间，对外公告。

2、公司非独立董事和高级管理人员增持公司股票应符合：（1）增持股票的价格不高于公告日前最近一期公司经审计的每股净资产；（2）用于增持公司股票的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和的 20.00%，但不超过该等董事、高级管理人员上一年度的税后薪酬总和。

3、在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司经审计的最近一期末每股净资产，则可中止实施股份增持计划。增持行为严格遵守《证券法》《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

三、未能履行本预案的约束措施

（一）如公司未履行稳定股价的具体措施，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 5 个交易日内公告相关情况，公司将在股东会及证券监督管理部门指定媒体上公开作出解释，及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因公司未履行承诺给投资者造成损失的，公司应按照法律、法规及相关监管机构的要求向投资者依法赔偿损失并承担相应的责任。

（二）如控股股东及其一致行动人未能履行稳定股价的具体措施，其自未能履行约定义务之日起，停止其在公司处获得股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的增持措施并实施完毕时为止。

（三）如在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员未能履行稳定股价的具体措施，该董事、高级管理人员将在公司股东会及证券监督管理部门指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司有权停止发放应付的薪酬，且有权停止对其分取红利（如有）；其直接或间接持有的公司股份（如有）不得转让；直至该等董事、高级管理人员采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

（四）本预案需提交公司股东会审议通过，且需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

（五）公司承诺并保证以同意本预案内容作为选任董事和高级管理人员的标准之一，要求新聘任的董事和高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求和本预案的相应要求。”

此外，发行人、控股股东及其一致行动人、非独立董事及高级管理人员就上述预案出具了《关于公司上市后三年内稳定股价的承诺函》，主要内容如下：1、本公司/本企业/本人将依照《公司股票上市后三年内稳定股价的预案》规定的条件、时间、期限、价格、方式等履行稳定发行人股价的义务。2、如本公司/本企业/本人未能依照上述承诺履行义务的，本公司/本企业/本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。3、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、要求以及违反相关措施而应承担的责任及后果有不同规定的，本公司/本企业/本人将自愿无条件地遵从该等规定。

### （三）对欺诈发行上市的股份回购和股份购回的承诺

#### 1、发行人承诺

发行人作出《关于对欺诈发行上市股份回购的承诺函》，主要内容如下：

“（1）公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在欺诈发行的情形。

（2）若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或有权机构认定公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情形，导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等有权部门作出前述认定后五个工作日内启动股份购回程序，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价，并根据相关法律、法规及公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。若公司在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对前述发行价进行除权除息调整。

（3）如公司因主观原因违反上述承诺，公司将依法承担相应法律责任。”

#### 2、发行人实际控制人及其一致行动人、控股股东及其一致行动人承诺

发行人实际控制人叶向明、毛冬及其一致行动人叶玉冰、刘钧伟、刘嘉桦以及控股股东东骏投资及其一致行动人东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英、王晓峰、潘岭峰、唐昊作出《关于对欺诈发行上市股份回购的承诺函》，主要内容如下：

“（1）本人/本企业保证公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在欺诈发行的情形。

（2）若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或有权机构认定公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或公司存在欺诈发行的情形，导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本企业将在该等有权部门作出前述认定后五个工作日内启动股份购回程序，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于公司股票发行价，并根据相关法律、法规及公司章程规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。若公司在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对前述发行价进行除权除息调整。

（3）若因公司首次公开发行股票并上市存在欺诈发行情形的，招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法赔偿投资者实际损失。在该等违法事实被中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本人/本企业将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的实际损失，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

（4）如本人/本企业因主观原因违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应法律责任。”

### （四）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

#### 1、发行人承诺

发行人作出《关于填补被摊薄即期回报的承诺函》，主要内容如下：

“（1）规范募集资金使用，强化募集资金管理，提高募集资金的收益率

首次公开发行股票募集资金到位后，本公司将在募集资金的使用、核算、风险防范等方面强化管理，确保募集资金依照本公司《招股说明书》披露的募集资金用途科学、合理地投入到相关的募投项目中。同时，本公司将严格按照募集资金管理制度的相关规定，执行严格的募集资金三方监管制度，保证募集资金合理、合法、规范的使用。同时，在符合上述要求的基础上，本公司将结合当时的市场状况、行业发展等多种因素，优化募集资金的使用，提高募集资金的收益率。

**（2）加快募集资金投资项目的建设进度**

在符合法律、法规、规范性文件以及本公司募集资金管理制度规定的前提下，将根据市场状况、行业发展的客观条件，在确保公司募集资金规范、科学、合理使用的基础上，尽快完成募集资金投资项目的开发、建设，加快实现募集资金投资项目的预期经济效益。

**（3）加快技术创新，加强品牌建设，提升核心竞争力**

将依托首次公开发行股票并上市以及募集资金投资项目建设契机，进一步加快技术创新，同时，借助技术创新、服务能力提升，加强自身品牌建设和管理，提升行业影响力和公司的品牌价值。

**（4）建立健全投资者回报机制，完善利润分配政策**

将依照本公司上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容，建立和健全利润分配政策，既符合公司发展战略、发展规划需要，又紧密结合公司发展阶段、经营状况、行业前景，并在充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，完善利润分配政策，持续优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理的预期回报。

**（5）本承诺函出具日后，若中国证监会/上海证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会/上海证券交易所该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会/上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”**

**2、发行人实际控制人及其一致行动人、控股股东及其一致行动人承诺**

发行人实际控制人叶向明、毛冬及其一致行动人叶玉冰、刘钧伟、刘嘉桦以及控股股东东骏投资及其一致行动人东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英、**王晓峰、潘岭峰、唐昊**作出《关于填补被摊薄即期回报的承诺函》，主要内容如下：

“（1）本人/本企业不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

（2）若违反承诺给公司或者其他股东造成损失的，本人/本企业将依法承担补偿责任。

（3）本承诺函出具日后，若中国证监会/上海证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会/上海证券交易所该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照中国证监会/上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”

**3、发行人非独立董事、高级管理人员承诺**

发行人非独立董事、高级管理人员作出《关于填补被摊薄即期回报的承诺函》，主要内容如下：

“（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）对本人的职务消费行为进行约束；

（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

（5）如果未来公司实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

（6）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

（7）本承诺函出具日后，若中国证监会/上海证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会/上海证券交易所该等规定时，承诺届时将按照中国证监会/上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。”



**（五）利润分配政策的承诺****1、发行人承诺**

发行人作出《关于利润分配政策的承诺》，主要内容如下：

“根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范文件的相关要求，成都莱普科技股份有限公司（以下简称“公司”）重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《上市后未来三年分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者的权益。

公司上市后，如果公司未履行或者未完全履行上述承诺，有权主体可自行依照法律、法规、规章及规范性文件对公司采取相应惩罚/约束措施，公司对此不持异议。”

**2、发行人实际控制人及其一致行动人、控股股东及其一致行动人承诺**

发行人实际控制人叶向明、毛冬及其一致行动人叶玉冰、刘钧伟、刘嘉桦以及控股股东东骏投资及其一致行动人东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英、王晓峰、潘岭峰、唐昊作出《关于利润分配政策的承诺》，主要内容如下：

“（1）根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；

（2）在审议公司利润分配预案的股东会上，本人/本企业将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配议案投赞成票；

（3）督促公司根据相关决议实施利润分配。”

**（六）依法承担赔偿责任的承诺****1、发行人承诺**

发行人作出《关于依法承担赔偿责任的承诺》，主要内容如下：

“（1）本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本公司将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。

（3）若本公司未及时履行上述承诺，本公司将在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉，并按上述承诺采取相应的赔偿措施直至履行完毕时为止。”

**2、发行人实际控制人及其一致行动人、控股股东及其一致行动人承诺**

发行人实际控制人叶向明、毛冬及其一致行动人叶玉冰、刘钧伟、刘嘉桦以及控股股东东骏投资及其一致行动人东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英、王晓峰、潘岭峰、唐昊作出《关于依法承担赔偿责任的承诺》，主要内容如下：

“（1）发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人/本企业对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（2）发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人/本企业将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。

（3）若本人/本企业未及时履行上述承诺，本人/本企业将在发行人股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉，并按上述承诺采取相应的赔偿措施直至履行完毕时为止。”

**3、发行人非独立董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺**

发行人非独立董事、审计委员会成员、高级管理人员作出《关于依法承担赔偿责任的承诺》，主要内容如下：

“（1）发行人首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>性陈述或者重大遗漏，本人对其所载内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。</p> <p>（2）如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。上述事项涉及的有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。”</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>4、保荐机构承诺</p> <p>中信建投证券作出《中信建投证券股份有限公司关于依法赔偿投资者损失的承诺》，主要内容如下：</p> <p>“本保荐机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。如因本保荐机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等事实被认定后，本保荐机构将依法赔偿投资者损失。”</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>5、发行人律师承诺</p> <p>北京市康达律师事务所作出《北京市康达律师事务所关于成都莱普科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的承诺》，主要内容如下：</p> <p>“如因本所在发行人首次公开发行股票并在科创板上市工作期间未勤勉尽责，导致本所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资者损失。”</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>6、审计机构、验资复核机构承诺</p> <p>致同会计师事务所（特殊普通合伙）作出《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都莱普科技股份有限公司首次公开发行股票并上市承担依法赔偿投资者损失的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法积极赔偿投资者损失。”</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>7、评估机构承诺</p> <p>中水致远资产评估有限公司作出《中水致远资产评估公司关于依法赔偿投资者损失的承诺》，主要内容如下：</p> <p>“本公司为成都莱普科技股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。如因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”</p> <p>中威正信（北京）资产评估有限公司作出《中威正信（北京）资产评估有限公司关于依法赔偿投资者损失的承诺》，主要内容如下：</p> <p>“本公司为成都莱普科技股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件（中威正信评报字[2024]第 6068 号评估报告）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。如因本公司为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”</p> |
| <p><b>（七）关于避免同业竞争的承诺</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>1、发行人实际控制人及其一致行动人承诺</p> <p>发行人实际控制人叶向明、毛冬及其一致行动人叶玉冰、刘钧伟、刘嘉桦作出《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“截至本承诺函出具之日，除莱普科技及其控股子公司外，本人及本人近亲属未投资任何与莱普科技具有相同或相似业务的公司、企业或其他经营实体；本人及本人近亲属未经营或为他人或企业经营与莱普科技相同或相似的业务。</p> <p>为避免对莱普科技的生产经营构成新的业务竞争，除莱普科技及其控股子公司外，本人将不会投资于任何与莱普科技的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；本人保证将促使本人控制的企业不直接或间接从事或参与与莱普科技的产品生产和业务经营相竞争的任何活动；本人所参股的企业，如从事与莱普科技构成竞争的产品生</p>                                                                                    |

产和业务经营，本人将避免获得该等企业的实际控制权。如莱普科技此后进一步拓展产品或业务范围，本人控制的企业将不与莱普科技拓展后的产品或业务相竞争，本人控制的企业与莱普科技拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争的，则本人将敦促控制的企业采取措施，以按照最大限度符合莱普科技利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：

（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到发行人来经营。”

## 2、发行人控股股东及其一致行动人承诺

发行人控股股东东骏投资及其一致行动人东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英、**王晓峰、潘岭峰、唐昊**作出《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

“截至本承诺函出具之日，除莱普科技及其控股子公司外，本企业/本人及本企业/本人控制的企业未以任何形式从事与莱普科技现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动。

为避免对莱普科技的生产经营构成新的业务竞争，除莱普科技及其控股子公司外，本企业/本人将不以任何形式从事与莱普科技相同或类似的产品生产和业务经营；本企业/本人将不会投资于任何与莱普科技的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；本企业/本人保证将促使本企业/本人控制的企业不直接或间接从事或参与与莱普科技的产品生产和业务经营相竞争的任何活动；本企业/本人所参股的企业，如从事与莱普科技构成竞争的产品生产和业务经营，本企业/本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权。如莱普科技此后进一步拓展产品或业务范围，本企业/本人及本企业/本人控制的企业将不与莱普科技拓展后的产品或业务相竞争，本企业/本人及本企业/本人控制的企业与莱普科技拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争的，则本企业/本人将亲自或敦促控制的企业采取措施，以按照最大限度符合莱普科技利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到发行人来经营。”

## （八）关于规范关联交易的承诺

### 1、发行人实际控制人及其一致行动人承诺

发行人实际控制人叶向明、毛冬及其一致行动人**叶玉冰、刘钧伟、刘嘉桦**作出《关于减少及规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：

“（1）本人已被告知、并知悉相关关联方的认定标准。

（2）除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人及本人关联方与发行人及其下属企业之间不存在其他任何应披露而未披露的关联交易。

（3）在本人作为发行人实际控制人/实际控制人的**一致行动人**期间，本人及本人关联方将尽量避免、减少与发行人及其下属企业发生关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

（4）严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

（5）本人保证不会利用关联交易转移发行人的利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益，避免一切非法占用发行人的资金、资产的行为。

若违反上述承诺，本人将及时采取必要措施予以纠正补救，对由此给发行人造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”

### 2、发行人控股股东及其一致行动人承诺

发行人控股股东东骏投资及其一致行动人东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英、**王晓峰、潘岭峰、唐昊**作出《关于减少及规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：

“（1）本企业/本人已被告知、并知悉相关关联方的认定标准。



（2）除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本企业/本人以及本企业/本人的关联方与发行人及其下属企业之间不存在其他任何应披露而未披露的关联交易。

（3）在东莞市东骏投资有限公司作为发行人控股股东期间，本企业/本人及本企业/本人关联方将尽量避免、减少与发行人及其下属企业发生关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

（4）严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

（5）本企业/本人保证不会利用关联交易转移发行人的利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益，避免一切非法占用发行人的资金、资产的行为。

若违反上述承诺，本企业/本人将及时采取必要措施予以纠正补救，对由此给发行人造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”

### 3、发行人持股 5%以上股东国家集成电路基金二期承诺

发行人持股 5%以上股东国家集成电路基金二期作出《关于减少及规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：

“（1）本企业已被告知、并知悉相关关联方的认定标准。

（2）除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本企业以及本企业的关联方与发行人及其下属企业之间不存在其他任何应披露而未披露的关联交易。

（3）在本企业作为发行人持股 5%以上股东期间，本企业及本企业关联方将尽量避免、减少与发行人及其下属企业发生关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

（4）严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

（5）本公司保证不会利用关联交易转移发行人的利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益，避免一切非法占用发行人的资金、资产的行为。

若违反上述承诺，本企业将及时采取必要措施予以纠正补救，对由此给发行人造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”

### 4、发行人董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺

发行人董事、审计委员会成员、高级管理人员作出《关于减少及规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：

“（1）本人已被告知、并知悉相关关联方的认定标准。

（2）除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人及本人关联方与发行人及其下属企业之间不存在其他任何应披露而未披露的关联交易。

（3）在本人担任发行人董事/审计委员会成员/高级管理人员期间，本人及本人关联方将尽量避免、减少与发行人及其下属企业发生关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

（4）严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

（5）本人保证不会利用关联交易转移发行人的利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益，避免一切非法占用发行人的资金、资产的行为。

若违反上述承诺，本人将及时采取必要措施予以纠正补救，对由此给发行人造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”

## （九）关于股东信息披露的专项承诺

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>发行人作出《关于股东信息披露的专项承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“（1）本公司股东均具备持有本公司股份的适当资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形。</p> <p>（2）本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形。</p> <p>（3）本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。</p> <p>（4）本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。</p> <p>上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>（十）关于在审期间不进行现金分红的承诺</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>发行人就在审期间不进行分红事项承诺如下：</p> <p>“（1）本公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有；</p> <p>（2）自本公司申请首次公开发行股票并在科创板上市至完成上市前即在审期间，本公司承诺不进行现金分红；</p> <p>（3）上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，如本公司违反承诺给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担责任。”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>（十一）未履行相关承诺的约束措施</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>1、发行人关于未履行相关承诺的约束措施</p> <p>发行人作出《关于未能履行承诺时的约束措施的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“如本公司未能履行所作承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露本公司未能履行承诺的具体原因；</p> <p>（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东会审议；</p> <p>（4）自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；</p> <p>（5）如因本公司未能履行承诺导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理；</p> <p>（6）其他根据届时规定可以采取的约束措施。</p> <p>如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司未能履行承诺的，本公司将采取以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露本公司未能履行承诺的具体原因；</p> <p>（2）向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。”</p> |
| <p>2、发行人实际控制人及其一致行动人、控股股东及其一致行动人关于未履行相关承诺的约束措施</p> <p>发行人实际控制人叶向明、毛冬及其一致行动人叶玉冰、刘钧伟、刘嘉桦以及控股股东东骏投资及其一致行动人东莞莱普、东莞聚慧、东莞骏峰、东莞天戈、东莞普英、王晓峰、潘岭峰、唐昊作出《关于未能履行承诺时的约束措施的承诺函》，主要内容如下：</p> <p>“如本人/本企业所作承诺未能履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人/本企业将采取以下措施：</p> <p>（1）通过发行人及时、充分披露本人/本企业未能履行承诺的具体原因；</p> <p>（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人/本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人/本企业将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东会审议；

（4）本人/本企业将停止在发行人领取股东分红，同时本人/本企业持有的发行人股份将不得转让，直至本人/本企业按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；

（5）因本人/本企业未履行相关承诺事项导致投资者损失的，由本人/本企业依法赔偿投资者的损失；本人/本企业因违反承诺所得收益归发行人所有；

（6）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人/本企业自身无法控制的客观原因，导致本人/本企业未能履行承诺的，本人/本企业将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露本人/本企业未能履行承诺的具体原因；

（2）向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。”

3、发行人持股 5%以上股东国家集成电路基金二期关于未履行相关承诺的约束措施  
发行人持股 5%以上股东国家集成电路基金二期作出《关于未能履行承诺时的约束措施的承诺函》，主要内容如下：

“如本企业所作承诺未能履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本企业将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露未能履行承诺的具体原因；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本企业将向投资者依法作出适当的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东会审议；

（4）因本企业未履行相关承诺事项导致投资者损失的，由本企业依法赔偿投资者的损失；

（5）如本企业未能依法承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本企业在公司应取得的股东分红，用于承担前述赔偿责任，直至本企业根据相关法律确定的补偿义务完全履行；

（6）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本企业自身无法控制的客观原因，导致本企业未能履行所作承诺的，本企业将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露本企业承诺未履行承诺的具体原因；

（2）向发行人及投资者依法作出适当的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。”

4、发行人董事、审计委员会成员、高级管理人员关于未履行相关承诺的约束措施  
发行人董事、审计委员会成员、高级管理人员作出《关于未能履行承诺时的约束措施的承诺函》，主要内容如下：

“如本人所作承诺未能履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露未能履行承诺的具体原因；

（2）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

（3）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东会审议；

（4）因本人未履行相关承诺事项导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴发行人所有；

（5）本人将停止在公司领取股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，不得以任何形式要求公司增加本人的薪资或津贴，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

（6）其他根据届时规定可以采取的约束措施。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本

人未能履行承诺的，本人将采取以下措施：

（1）通过发行人及时、充分披露未能履行承诺的具体原因；

（2）向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护发行人及投资者的权益。

本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。”



## 附件四、股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

自股份公司设立以来，发行人逐步建立健全了股东会、董事会、独立董事及董事会秘书等制度，并设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等各专门委员会，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定。同时，公司制定了《公司章程》及三会议事规则，明确了股东会、董事会、的权责，形成了股东会、董事会和管理层之间有效制衡的法人治理结构，股东会、董事会和管理层能够按照《公司章程》和相关法律法规的规定履行职权、规范运作，不存在董事会、管理层等违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为；公司制定了《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等相关制度，在独立董事产生办法、董事会秘书主要职责等方面进行了具体规定，独立董事和董事会秘书能够严格按照相关法律法规的规定出席相关会议并积极履行职责；公司董事会内部设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并实际发挥作用。公司治理情况良好，不存在重大缺陷。

### （一）股东会的运行及履职情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东会议事规则》，股东会依法规范运行。自股份公司设立以来，公司共召开了 21 次股东会，其中年度股东会 4 次、临时股东会 17 次，历次股东会均按照《公司章程》《股东大会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。

### （二）董事会的运行及履职情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。自股份公司设立以来，公司共召开了 27 次董事会会议，历次董事会均按照《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，相关决议内容合法、有效。

### （三）独立董事的履职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事会共设 9 名成员，其中 3 人为独立董事，占董事会人数三分之一以上，并有一名会计专业人士，符合相关规定。

报告期内，公司独立董事均能勤勉尽责，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责并出席有关董事会和股东大会，积极参与议案讨论，独立行使表决权，独立董事对公司有关事项未曾提出异议。

此外，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员，结合公司实际情况，在完善公司法人治理结构、提高公司决策水平等方面提出了积极的建议，发挥良好的作用，有效维护了公司及股东合法权益。

#### **（四）董事会秘书的履职情况**

2023年1月30日，公司召开第一届董事会第七次会议，同意聘任唐昊为公司副总经理、董事会秘书。

公司董事会秘书自聘任以来尽职尽责，依据《公司章程》《董事会秘书工作细则》以及其他相关法律法规的规定筹备董事会会议、股东大会会议并积极配合独立董事履行职责，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。



## 附件五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作细则。董事会各专门委员会组成如下：

| 董事会专门委员会 | 召集人、主任委员 | 委员          |
|----------|----------|-------------|
| 审计委员会    | 曹昱       | 曹昱、蔡芸、傅建伟   |
| 薪酬与考核委员会 | 蔡芸       | 蔡芸、黎明、毛冬    |
| 提名委员会    | 黎明       | 黎明、蔡芸、王晓峰   |
| 战略委员会    | 叶向明      | 叶向明、王晓礼、黄永忠 |

公司董事会专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及各专门委员会工作细则等相关规定开展工作，履行了相应职责，运作情况良好。

附件六、募集资金具体运用情况

（一）晶圆制造设备开发与制造中心项目

1、项目基本情况

本项目拟通过新建现代化的生产基地，购置先进的硬件设备，引入行业专业人才，对公司现有产品扩产，以满足日益增长的下游应用市场需求，扩大产品销售规模，巩固优势市场地位。

此外，在现有产品的基础上，公司将应用在存储器、逻辑芯片、功率器件（含第三代化合物半导体）的激光热处理设备进行持续迭代升级并形成量产。项目建设完成后，公司在行业的竞争力和盈利能力将得到显著提升。

本项目拟新增激光热处理设备产能 32 台，具体说明如下：

| 序号 | 具体扩产产品             | 新增产能（台/套） | 备注   |
|----|--------------------|-----------|------|
| 1  | 激光诱导结晶设备（LIC）      | 7         | 现有产品 |
| 2  | 激光诱导外延生长设备（LIEG）   |           | 现有产品 |
| 3  | 超浅结激光退火设备（USJLA）   | 3         | 现有产品 |
| 4  | 动态合金退火设备（DALA ）    |           | 新产品  |
| 5  | IGBT 晶圆激光退火设备      | 22        | 现有产品 |
| 6  | SiC 晶圆激光退火设备       |           | 现有产品 |
| 7  | SiC 晶圆激光退火设备（8 英寸） |           | 新产品  |

2、项目投资概算

本项目预计总投资 30,588.35 万元，各项具体投资金额及相应比例如下：

单位：万元

| 序号  | 项目名称     | 投资总额      | 募集资金投入总额  | 占比      |
|-----|----------|-----------|-----------|---------|
| 1   | 工程建设费用   | 20,701.00 | 20,701.00 | 67.68%  |
| 1.1 | 场地建造费    | 11,000.00 | 11,000.00 | 35.96%  |
| 1.2 | 硬件设备购置   | 9,701.00  | 9,701.00  | 31.71%  |
| 2   | 研发人员薪酬   | 4,062.19  | 4,062.19  | 13.28%  |
| 3   | 基本预备费 2% | 495.26    | 495.26    | 1.62%   |
| 4   | 铺底流动资金   | 5,329.90  | 5,329.90  | 17.42%  |
| 合计  |          | 30,588.35 | 30,588.35 | 100.00% |

3、项目投资进度安排

本项目预计建设期为 3 年，其中第一年投资金额为 11,220.00 万元，第二年投资金额为 8,484.10 万元，第三年投资金额为 10,884.25 万元。

4、项目实施规划

本项目建设期为 3 年，项目开展将按照场地土建及装修、设备购置安装及调试、人员招募及培训和投入生产进度来安排，具体如下表：

| 时间单位：月  | T+6 | T+12 | T+18 | T+24 | T+30 | T+36 |
|---------|-----|------|------|------|------|------|
| 场地土建    |     |      |      |      |      |      |
| 场地装修    |     |      |      |      |      |      |
| 设备购置及安装 |     |      |      |      |      |      |
| 人员招募及培训 |     |      |      |      |      |      |
| 生产      |     |      |      |      |      |      |

注：T 代表项目开始时点

5、项目涉及土地使用权情况

本项目场地选址于四川省成都高新区西园街道青龙村 3 社，项目拟使用建筑面积为 17,000.00 平方米。公司已取得编号为“川（2023）成都市不动产权第 0327410 号”的土地权属证明。

6、项目备案及环评情况

本项目已办理投资项目备案，取得成都市高新区发展改革局出具的编号为“川投资备【2306-510109-04-01-709214】FGQB-0341 号”的《四川省固定资产投资项目备案表》。

本项目不涉及向相关部门办理环境影响评价手续的情形。

（二）先进封装设备开发与制造中心项目

1、项目基本情况

本项目拟通过新建现代化的生产基地，购置先进的硬件设备，引入行业专业人才，对公司现有产品扩产，以满足日益增长的下游应用市场需求，扩大产品销售规模，巩固优势市场地位。

此外，在现有产品的基础上，公司将应用在先进封装环节的高精度激光加工

设备进行持续迭代升级并达成量产。项目建设完成后，公司在行业的竞争力和盈利能力将得到显著提升。

本项目拟新增专用激光加工设备产能 110 台，具体说明如下：

| 序号 | 具体扩产产品     | 新增产能（台/套） | 备注   |
|----|------------|-----------|------|
| 1  | 激光解临时键合设备  | 20        | 现有产品 |
| 2  | 激光切割划片设备   | 20        | 现有产品 |
| 3  | 晶圆激光隐切设备   | 5         | 新产品  |
| 4  | 晶圆激光开槽划片设备 | 5         | 新产品  |
| 5  | 激光去溢胶设备    | 60        | 现有产品 |

2、项目投资概算

本项目预计总投资 13,970.46 万元，各项具体投资金额及相应比例如下：

单位：万元

| 序号  | 项目名称     | 投资总额      | 募集资金投入总额  | 占比      |
|-----|----------|-----------|-----------|---------|
| 1   | 工程建设费用   | 7,622.12  | 7,622.12  | 54.56%  |
| 1.1 | 场地建造费    | 4,750.00  | 4,750.00  | 34.00%  |
| 1.2 | 硬件设备购置   | 2,872.12  | 2,872.12  | 20.56%  |
| 2   | 研发人员薪酬   | 2,979.38  | 2,979.38  | 21.33%  |
| 3   | 基本预备费 2% | 212.03    | 212.03    | 1.52%   |
| 4   | 铺底流动资金   | 3,156.94  | 3,156.94  | 22.60%  |
| 合计  |          | 13,970.46 | 13,970.46 | 100.00% |

3、项目投资进度安排

本项目预计建设期为 3 年，其中第一年投资金额为 4,845.00 万元，第二年投资金额为 4,497.41 万元，第三年投资金额为 4,628.05 万元。

4、项目实施规划

本项目建设期为 3 年，项目开展将按照场地土建及装修、设备购置安装及调试、人员招募及培训和投入生产进度来安排，具体如下表：

| 时间单位：月 | T+6 | T+12 | T+18 | T+24 | T+30 | T+36 |
|--------|-----|------|------|------|------|------|
| 场地土建   |     |      |      |      |      |      |
| 场地装修   |     |      |      |      |      |      |

|         |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 设备购置及安装 |  |  |  |  |  |  |
| 人员招募及培训 |  |  |  |  |  |  |
| 生产      |  |  |  |  |  |  |

注：T 代表项目开始时点

5、项目涉及土地使用权情况

本项目场地选址于四川省成都高新区西园街道青龙村 3 社，项目拟使用建筑面积为 8,000.00 平方米。公司已取得编号为“川（2023）成都市不动产权第 0327410 号”的土地权属证明。

6、项目备案及环评情况

本项目已办理投资项目备案，取得成都市高新区发展改革局出具的编号为“川投资备【2306-510109-04-01-709214】FGQB-0341 号”的《四川省固定资产投资项目备案表》。

本项目不涉及向相关部门办理环境影响评价手续的情形。

（三）研发中心及信息化建设项目

1、项目基本情况

本项目将基于对高端半导体专用设备终端应用市场发展的深刻理解，围绕公司现有产品及技术积累，通过新建研发中心场地、购置实验设备仪器及信息化软件系统，进行半导体激光隐形晶圆减薄技术及装备的研发，为公司未来扩充产品品类做前瞻性布局，同时，公司将往高端半导体装备产业链上游关键零部件延伸，新增半导体晶圆激光退火用激光器、半导体晶圆激光退火设备关键部件（铜反射镜、PBS 偏振片镀膜、水冷机等）的自主开发，提高产品附加值，从而提升公司的盈利水平。

具体研发内容如下：

| 拟研发技术/产品         | 研发方向                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 半导体激光隐形晶圆减薄技术及装备 | 依托公司已掌握的激光器、光学整形等技术，突破激光晶圆减薄关键技术，集成自主开发的软件控制系统形成样机。项目研发成功后，有助于打破国外技术垄断，提升公司的研发实力，待达成量产机台的成果转化并实现应用，有助于丰富公司产品种类，扩大企业影响力和营收规模。 |
| 半导体晶圆激光退火用激光器    | 通过与国内具备一流激光器技术的科研院所、高校以及上下游供应商联合开展研发半导体激光退火激光器。项目研发成功后，                                                                      |

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 有助于缓解公司激光退火设备对上游关键零部件的进口依赖，降低产品制造成本。                                                                                                                       |
| 半导体晶圆激光退火设备关键技术及部件 | 结合自身设备需求，与上游供应商联合研发半导体晶圆激光退火设备关键部件，包括高功率高精度高稳定铜反射镜、PBS 偏振片镀膜、水冷机等。项目研发成功后，将有效实现半导体晶圆激光退火设备关键技术及部件稳定供应，解决供应链风险，提升产品性能，降低产品成本，提高产品科技水平，助力企业扩大市场规模和提升产品市场占有率。 |

此外，本项目基于公司对信息化系统及软件的需求，采购市面上较为成熟的软件及系统，提升运营效率、优化决策流程，实现资源的高效配置。

2、项目投资概算

本项目预计总投资 15,240.43 万元，各项具体投资金额及相应比例如下：

单位：万元

| 序号  | 项目名称     | 投资总额      | 募集资金投入总额  | 占比      |
|-----|----------|-----------|-----------|---------|
| 1   | 工程建设项目投资 | 11,118.55 | 11,118.55 | 72.95%  |
| 1.1 | 场地建造费    | 5,550.00  | 5,550.00  | 36.42%  |
| 1.2 | 研发硬件设备   | 4,139.55  | 4,139.55  | 27.16%  |
| 1.3 | 信息化系统及软件 | 1,429.00  | 1,429.00  | 9.38%   |
| 2   | 研发人员薪酬   | 3,823.05  | 3,823.05  | 25.08%  |
| 3   | 基本预备费 2% | 298.83    | 298.83    | 1.96%   |
| 合计  |          | 15,240.43 | 15,240.43 | 100.00% |

3、项目投资进度安排

本项目预计建设期为 3 年，其中第一年投资金额为 5,661.00 万元，第二年投资金额为 5,415.74 万元，第三年投资金额为 4,163.69 万元。

4、项目实施规划

本项目建设期为 3 年，项目开展将按照场地土建及装修、软硬件设施购置及安装调试、人员招募及培训和产品技术研发进度来安排，具体如下表：

| 时间单位：月     | T+6 | T+12 | T+18 | T+24 | T+30 | T+36 |
|------------|-----|------|------|------|------|------|
| 项目立项与方案设计  |     |      |      |      |      |      |
| 场地土建及装修    |     |      |      |      |      |      |
| 软硬件设施购置及安装 |     |      |      |      |      |      |
| 人员招募及培训    |     |      |      |      |      |      |



| 时间单位：月 | T+6 | T+12 | T+18 | T+24 | T+30 | T+36 |
|--------|-----|------|------|------|------|------|
| 研发工作开展 |     |      |      |      |      |      |

注：T 代表项目开始时点

5、项目涉及土地使用权情况

本项目场地选址于四川省成都高新区西园街道青龙村 3 社，项目拟使用建筑面积为 7,500.00 平方米。公司已取得编号为“川（2023）成都市不动产权第 0327410 号”的土地权属证明。

6、项目备案及环评情况

本项目已办理投资项目备案，取得成都市高新区发展改革局出具的编号为“川投资备【2306-510109-04-01-709214】FGQB-0341 号”的《四川省固定资产投资项目备案表》。

本项目不涉及向相关部门办理环境影响评价手续的情形。

（四）研发、技术支持与营销网络建设项目

1、项目基本情况

本项目拟在北京、上海、武汉、新加坡和日本东京等五地，以租赁办公场地、仓库的方式设立多个技术支持与营销网点，进行产品展示与售后服务，同时引进专业销售服务人才拓展和深化销售渠道，提高公司对各地区客户的销售和服务能力，进一步提高品牌在全球市场的影响力。

2、项目投资概算

本项目预计总投资 16,209.32 万元，各项具体投资金额及相应比例如下：

单位：万元

| 序号  | 项目名称     | 投资总额      | 募集资金投入总额  | 占比      |
|-----|----------|-----------|-----------|---------|
| 1   | 工程建设费用   | 8,416.15  | 8,416.15  | 51.92%  |
| 1.1 | 场地装修费    | 2,310.35  | 2,310.35  | 14.25%  |
| 1.2 | 硬件购置     | 6,105.80  | 6,105.80  | 37.67%  |
| 2   | 营销费用     | 3,927.47  | 3,927.47  | 24.23%  |
| 3   | 研发人员薪酬   | 3,547.87  | 3,547.87  | 21.89%  |
| 4   | 基本预备费 2% | 317.83    | 317.83    | 1.96%   |
| 合计  |          | 16,209.32 | 16,209.32 | 100.00% |

### 3、项目投资进度安排

本项目预计建设期为3年，其中第一年投资金额为9,615.69万元，第二年投资金额为2,708.66万元，第三年投资金额为3,884.97万元。

### 4、项目实施规划

本项目建设期为3年，项目开展将按照场地租赁及装修、软硬件购置及安装调试、人员招募及培训来安排，具体如下表：

| 时间单位：月    | T+6 | T+12 | T+18 | T+24 | T+30 | T+36 |
|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| 项目立项与方案设计 |     |      |      |      |      |      |
| 场地租赁及装修   |     |      |      |      |      |      |
| 硬件购置及安装调试 |     |      |      |      |      |      |
| 人员招募及培训   |     |      |      |      |      |      |

注：T代表项目开始时点

### 5、项目涉及土地使用权情况

根据公司的发展规划和客观情况，本项目将于北京、上海、武汉、新加坡、东京等5个地点实施，公司拟租赁房屋面积约为2,850.00平方米。

| 序号            | 名称    | 面积（平方米）       |
|---------------|-------|---------------|
| <b>武汉场地规划</b> |       |               |
| 1             | 千级净化区 | 150.00        |
| 2             | 办公室   | 200.00        |
| 3             | 仓储区   | 250.00        |
| 合计            |       | <b>600.00</b> |
| <b>北京场地规划</b> |       |               |
| 1             | 展厅    | 50.00         |
| 2             | 千级净化区 | 200.00        |
| 3             | 办公室   | 150.00        |
| 4             | 仓储区   | 100.00        |
| 合计            |       | <b>500.00</b> |
| <b>上海场地规划</b> |       |               |
| 1             | 千级净化区 | 300.00        |
| 2             | 办公室   | 200.00        |
| 3             | 仓储区   | 200.00        |

| 序号      | 名称    | 面积（平方米） |
|---------|-------|---------|
| 合计      |       | 700.00  |
| 新加坡场地规划 |       |         |
| 1       | 展厅    | 50.00   |
| 2       | 千级净化区 | 300.00  |
| 3       | 办公室   | 200.00  |
| 4       | 仓储区   | 100.00  |
| 合计      |       | 650.00  |
| 东京场地规划  |       |         |
| 1       | 千级净化区 | 200.00  |
| 2       | 办公室   | 100.00  |
| 3       | 仓储区   | 100.00  |
| 合计      |       | 400.00  |

本项目不涉及新增土地使用权情形。

## 6、项目备案及环评情况

本项目不涉及向相关部门申请项目备案和环境影响评价手续的情况。